

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



合肥晶合集成电路股份有限公司

**Nexchip Semiconductor Corporation**

（住所：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书

保荐人（主承销商）



（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

## 声 明

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	501,533,789股（行使超额配售选择权之前） 576,763,789股（全额行使超额配售选择权之后）
每股面值	1.00元人民币
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	2023年4月20日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后已发行股份总数	2,006,135,157股（行使超额配售选择权之前） 2,081,365,157股（全额行使超额配售选择权之后）
保荐人（主承销商）	中国国际金融股份有限公司
招股意向书签署日期	2023年4月12日

## 目 录

声 明 .....	1
本次发行概况 .....	2
目 录 .....	3
第一节 释义 .....	8
第二节 概览 .....	13
一、重大事项提示.....	13
二、发行人及中介机构情况.....	22
三、本次发行概况.....	24
四、发行人主营业务经营情况.....	38
五、发行人符合科创板定位相关情况.....	40
六、发行人主要财务数据及财务指标.....	40
七、财务报告审计截止日后的主要经营状况.....	41
八、发行人选择的上市标准.....	42
九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项.....	42
十、发行人募集资金运用与未来发展规划.....	42
十一、其他对发行人有重大影响的事项.....	44
第三节 风险因素 .....	45
一、与发行人相关的风险.....	45
二、与行业相关的风险.....	53
三、其他风险.....	55
第四节 发行人基本情况 .....	57
一、发行人的基本信息.....	57
二、发行人设立及股本和股东变化情况.....	58
三、发行人股权结构.....	70
四、发行人控股、参股公司、分公司情况.....	70
五、持有发行人 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况 .....	74
六、特别表决权股份或类似安排的情况.....	85

七、协议控制架构安排的情况.....	85
八、控股股东报告期内重大违法行为.....	85
九、发行人股本有关情况.....	85
十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....	136
十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.....	150
十二、发行人员工及其社保情况.....	153
<b>第五节 业务与技术 .....</b>	<b>157</b>
一、公司的主营业务、主要产品及服务.....	157
二、行业基本情况.....	167
三、公司的行业地位及竞争优势.....	189
四、公司主营业务经营情况.....	203
五、与发行人业务相关的主要资产情况.....	209
六、公司的技术与研发情况.....	212
七、环保情况.....	233
八、公司境外经营情况.....	234
<b>第六节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>235</b>
一、财务报表.....	235
二、财务报告编制基础.....	243
三、财务报表的合并范围及其变化.....	244
四、审计意见.....	245
五、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.....	245
六、重要会计政策和会计估计.....	247
七、财务报告事项.....	292
八、财务指标.....	294
九、经营成果分析.....	295
十、资产质量分析.....	323
十一、偿债能力与流动性分析.....	340
十二、持续经营能力分析.....	354
十三、资本性支出分析.....	357
十四、重大资产重组.....	357

十五、重要承诺及或有事项.....	357
十六、资产负债表日后事项.....	362
十七、盈利预测.....	362
十八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.....	362
<b>第七节 募集资金运用及未来发展规划 .....</b>	<b>364</b>
一、募集资金投资项目概况.....	364
二、募集资金投资项目对发行人主营业务的贡献、未来经营战略的影响.....	365
三、未来发展规划.....	368
<b>第八节 公司治理与独立性 .....</b>	<b>371</b>
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....	371
二、公司内部控制制度的情况.....	371
三、公司报告期内违法违规行及受到处罚的情况.....	372
四、公司报告期内资金占用与对外担保情况.....	372
五、公司独立性.....	372
六、同业竞争.....	374
七、关联方、关联关系及关联交易.....	376
<b>第九节 投资者保护 .....</b>	<b>404</b>
一、本次发行前滚存利润的分配安排.....	404
二、公司本次发行前后的股利分配政策差异情况.....	404
三、特别表决权股份、协议控制的特殊安排.....	404
<b>第十节 其他重要事项 .....</b>	<b>405</b>
一、重大合同.....	405
二、对外担保.....	412
三、重大诉讼或仲裁事项.....	413
<b>第十一节 声明 .....</b>	<b>414</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	414
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	433
三、保荐人（主承销商）声明.....	434
四、发行人律师声明.....	437
五、审计机构声明.....	438

六、验资机构声明.....	439
七、验资复核机构声明.....	441
八、评估机构声明.....	442
<b>第十二节 附件 .....</b>	<b>444</b>
一、备查文件.....	444
二、查阅时间及地点.....	444
三、查阅网址.....	445
<b>附件一 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 .....</b>	<b>446</b>
一、投资者关系主要安排.....	446
二、公司本次发行后的股利分配政策和决策程序.....	447
三、股东投票机制建立情况.....	450
<b>附件二 与投资者保护相关的承诺 .....</b>	<b>452</b>
一、股份锁定的承诺.....	452
二、持股意向和减持意向的承诺.....	459
三、股份回购和股份购回的措施和承诺.....	462
四、稳定股价的措施和承诺.....	463
五、对欺诈发行上市的股份购回承诺.....	468
六、填补被摊薄即期回报的措施与承诺.....	469
七、利润分配政策的安排及承诺.....	472
八、未能履行承诺的约束措施.....	475
九、证券服务机构出具的承诺事项.....	476
十、其他承诺事项.....	478
<b>附件三 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 .....</b>	<b>484</b>
一、股东大会、董事会、监事会的实际运行情况.....	484
二、独立董事制度运行情况.....	486
三、董事会秘书制度运行情况.....	486
<b>附件四 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 .....</b>	<b>487</b>
一、董事会战略委员会.....	487

二、董事会审计委员会.....	487
三、董事会提名委员会.....	488
四、董事会薪酬与考核委员会.....	489
<b>附件五 募集资金具体运用情况 .....</b>	<b>490</b>
一、合肥晶合集成电路先进工艺研发项目.....	490
二、收购制造基地厂房及厂务设施.....	495
三、补充流动资金及偿还贷款.....	496
<b>附件六 发行人主要无形资产 .....</b>	<b>497</b>
一、境内专利情况.....	497
二、境外专利情况.....	511
三、境内商标情况.....	515
四、境外商标情况.....	518
五、域名.....	523



## 第一节 释义

本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、一般词汇		
公司、本公司、股份公司、晶合集成、发行人	指	合肥晶合集成电路股份有限公司（根据文义需要，亦包括其前身合肥晶合集成电路有限公司和/或其控股子公司）
晶合有限、有限公司	指	合肥晶合集成电路有限公司，发行人前身
发起人	指	本公司整体变更设立时签署《发起人协议》之晶合有限的全体股东
合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司，发行人的控股股东
合肥市国资委	指	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会，发行人的实际控制人
合肥芯屏	指	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙），发行人股东
力晶科技	指	力晶创新投资控股股份有限公司，曾用名力晶科技股份有限公司（注册于中国台湾地区），发行人股东
美的创新	指	美的创新投资有限公司，发行人股东
中安智芯	指	合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
惠友豪创	指	深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥存鑫	指	合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
海通创新	指	海通创新证券投资有限公司，发行人股东
杭州承富	指	杭州承富投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
泸州隆信	指	泸州隆信投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
宁波华淳	指	宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
中小企业基金	指	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），发行人股东
安华创新	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司，发行人股东
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司，发行人股东
中金浦成	指	中金浦成投资有限公司，发行人股东
合肥晶焠	指	合肥晶焠企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶遂	指	合肥晶遂企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶炯	指	合肥晶炯企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶咖	指	合肥晶咖企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶珏	指	合肥晶珏企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶梢	指	合肥晶梢企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶柔	指	合肥晶柔企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东

合肥晶悬	指	合肥晶悬企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶本	指	合肥晶本企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶洛	指	合肥晶洛企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶辽	指	合肥晶辽企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶确	指	合肥晶确企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶铁	指	合肥晶铁企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶妥	指	合肥晶妥企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
合肥晶雄	指	合肥晶雄企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
员工持股平台	指	合肥晶煅、合肥晶遂、合肥晶炯、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶悬、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶辽、合肥晶确、合肥晶铁、合肥晶妥、合肥晶雄
合肥晶策	指	合肥晶策企业管理有限公司，发行人员工持股平台的管理机构
日本晶合	指	晶合日本株式会社，发行人子公司
北京晶芯成	指	晶芯成（北京）科技有限公司，发行人子公司
南京晶驱	指	南京晶驱集成电路有限公司，发行人子公司
新品集成	指	合肥新品集成电路有限公司，发行人子公司
上海晶合	指	合肥晶合集成电路股份有限公司上海分公司，发行人分公司
合肥蓝科	指	合肥蓝科投资有限公司，发行人主要生产经营用地及厂房的出租方
力积电	指	力晶积成电子制造股份有限公司，前身为钜晶电子股份有限公司
力积电子	指	力积电子股份有限公司（现为爱普科技股份有限公司子公司）
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
联华电子	指	联华电子股份有限公司
世界先进	指	世界先进积体电路股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
华虹半导体	指	华虹半导体有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司
中微半导体	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
本次发行	指	发行人首次公开发行人民币 A 股股票的行为
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币 A 股股票并在上交所科创板上市交易的行为
招股意向书、本招股意向书	指	本《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》
报告期、最近三年	指	2020 年度、2021 年度及 2022 年度

保荐人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
发行人律师、公司律师、金杜	指	北京市金杜律师事务所
审计机构、会计师、容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
《审计报告》	指	容诚于 2023 年 3 月 1 日出具的容诚审字[2023]230Z0133 号《审计报告》，包括后附的经审计的发行人的财务报表及其附注
《内控鉴证报告》	指	容诚于 2023 年 3 月 1 日出具的容诚专字[2023]230Z0277 号《内部控制鉴证报告》
《公司章程》	指	发行人现行有效的《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）》，公司本次发行上市后适用的章程
《合作框架协议》	指	《12 吋晶圆制造基地项目合作框架协议书》
《投资参股协议》	指	《合肥 12 吋晶圆制造基地项目投资参股协议书》
《技术移转协议》	指	《合肥 12 吋晶圆制造基地项目技术移转协议》
《委托经营管理合约》	指	《合肥 12 吋晶圆制造基地项目委托经营管理合约》
股东大会	指	合肥晶合集成电路股份有限公司股东大会
董事会	指	合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
监事会	指	合肥晶合集成电路股份有限公司监事会
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》	指	财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
《注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《暂行规定》	指	《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》
《交易规则》	指	《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》
《管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《业务实施细则》	指	《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》
《承销业务规则》	指	《首次公开发行证券承销业务规则》
<b>二、专业词汇</b>		
DDIC	指	Display Driver IC，面板显示驱动芯片
TDDI	指	Touch and Display Driver IC，触控与显示驱动集成芯片
MCU	指	Microcontroller Unit，微控制单元
CIS	指	CMOS Image Sensor，CMOS 图像传感器
PMIC	指	Power Management IC，电源管理芯片
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示屏
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管
Mini LED	指	Mini Light-Emitting Diode，次毫米发光二极管
SRAM	指	Static Random-Access Memory，静态随机存取存储器
PR	指	Purchase Request，采购申请单
PO	指	Purchase Order，采购订单
E-Tag	指	电子标签
CMOS	指	互补金属氧化物半导体
BCD	指	一种结合了双极型、CMOS 和 DMOS 的单片 IC 制造工艺。相对于传统的双极功率工艺，BCD 为一种单芯片功率集成电路技术
FSI	指	Front Side Illumination，即前照式入射，光线从光电二极管的电路面入射，经由光电二极管的上方金属开口达到光电二极管中
BSI	指	Back Side Illumination，即背照式入射，将感光二极管元件调转方向，光线从光电二极管的背面入射
MTP	指	Multiple Times Programmable，是可编程逻辑器件的一类，多次可编程
OTP	指	One Time Programmable，是可编程逻辑器件的一类，一次性可编程
FPS	指	Finger Print Sensor，指纹识别芯片
晶圆	指	晶圆指制造集成电路芯片的衬底（也叫基片）。由于是圆形晶体材料，所以称为晶圆。按照直径进行分类，主要包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格
光掩模板	指	制造半导体芯片时，将电路印制在硅晶圆上所使用的图形母版，是根据芯片设计公司设计的集成电路版图来生产制作的，又被称掩模、掩模版、光罩
封测	指	“封装、测试”的简称；“封装”指为芯片安装外壳，起到

		安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用；“测试”指检测封装后的芯片是否可正常运作
制程	指	集成电路制造过程中，以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺，尺寸越小，工艺水平越高，意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片，或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，指垂直整合制造工厂，是集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的整合元件制造商，属于半导体芯片行业的一种运作模式
Fabless	指	指没有制造业务、只专注于设计的一种运作模式。Fabless公司负责芯片的电路设计与销售，将生产、测试、封装等环节外包
Foundry	指	晶圆代工模式，专门负责生产、制造芯片，不负责芯片设计，可同时为多家设计公司提供服务
EDA	指	Electronic Design Automation，EDA 工具指电子设计自动化，是 IC 电子行业必备的设计工具软件
逻辑电路	指	传递和处理离散信号，以二进制为原理，实现数字信号逻辑运算和操作的电路
存储器	指	用于存放程序 and 数据的设备，可根据控制器指定的地址存入和读出信息
晶体管	指	半导体器件包括二极管、三极管、场效应管等的泛称
电阻	指	对电流产生阻碍作用的元件
电容	指	能够储存电量和电能的元件
电感	指	能够把电能转化为磁能而存储起来的元件
铝制程	指	集成电路内部器件之间互连使用铝线
铜制程	指	集成电路内部器件之间互连使用铜线
白色家电	指	白色家电是对家电的一种分类的具体类别名称，白色家电指可以替代人们家务劳动的电器产品，主要包括部分厨房电器、洗衣机、冰箱、空调等，早期这些家电大多是白色的外观，故称之为白色家电
IoT	指	Internet of Things，物联网
nm	指	纳米，长度的度量单位，1nm 等于 10 的负 9 次方米

注：本招股意向书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本招股意向书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

## 第二节 概览

本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

### 一、重大事项提示

#### （一）特别风险提示

公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股意向书“第三节 风险因素”中的全部内容。

##### 1、经营业绩下滑的风险

报告期各期，发行人营业收入分别为 151,237.05 万元、542,900.93 万元和 1,005,094.86 万元，归属于母公司普通股股东的净利润分别为-125,759.71 万元、172,883.20 万元和 304,543.08 万元。报告期内，随着发行人产销量的提高，发行人的营业收入已有所上升，盈利水平逐步改善，发行人整体经营业绩已有所提升。

2022 年第三季度以来，受消费性终端需求疲软的影响，晶圆代工行业景气度下行，发行人 2022 年下半年经营业绩承压，其中第三季度盈利水平环比出现下降，第四季度出现单季亏损；同时，发行人合理预计 2023 年第一季度仍将出现亏损，具体预计情况详见本招股意向书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后的主要经营状况”。

未来，不排除受市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，下游市场需求可能发生波动。如果发行人未能及时应对上述市场变化，将面临经营业绩下滑和亏损的风险。

**2、晶圆代工业务投资规模大，受下游景气度影响较大，发行人与行业领先企业相比，在技术水平、业务规模、盈利能力等方面还存在较大差距**

##### （1）晶圆代工业务投资规模大，受下游景气度影响较大的风险

发行人所处的晶圆代工行业技术更新迭代快、资金投入大、研发周期长，属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、设备购置成本高，而公司近年来不

断进行产能扩充，固定资产投资规模较大。截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定资产的账面价值为 2,143,736.82 万元，占公司总资产的比例为 55.30%；公司在建工程的账面价值为 138,504.36 万元，占公司总资产的比例为 3.57%。未来，公司将进一步扩充产能并提高研发投入以满足下游客户对发行人稳定性更高、平台更多元的晶圆代工服务需求，公司也将提高对固定资产的投入，资金筹措能力面临较大的考验。

同时，2020 年-2022 年间，发行人营业收入由 151,237.05 万元上升至 1,005,094.86 万元，年均复合增长率达到 157.79%。发行人营业收入快速增长与下游市场需求息息相关。2018 年-2020 年间，中国大陆晶圆代工行业市场规模由 107.3 亿美元上升至 148.9 亿美元，年均复合增长率为 17.8%；中国大陆 DDIC 出货量由 38.5 亿颗上升至 52.7 亿颗，年均复合增长率为 17%。晶圆代工行业受下游景气度影响较大，不排除未来市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，导致下游市场需求发生波动进而对发行人业绩造成不利影响。

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 47,282.88 万元、957,388.50 万元和 628,003.34 万元。如发行人无法维持充足的现金流，导致业务拓展困难、市场开拓无法达到预期；或未能及时应对下游市场变化，导致经营业绩下滑，将对公司稳定经营产生不利影响。

(2) 发行人与行业领先企业相比，在技术水平、业务规模、盈利能力等方面存在较大差距的风险

技术水平方面，自设立至今，发行人专注于 12 英寸晶圆代工业务，已实现 150nm-90nm 制程节点量产，正在进行 55nm 制程技术平台的风险量产。但台积电、联华电子、中芯国际等全球行业领先企业已达 5nm、14nm 等制程节点，发行人与之存在较大差距。

业务规模和盈利能力方面，报告期内，发行人主营业务收入分别为 151,186.11 万元、542,084.44 万元和 1,002,549.95 万元；2020 年至 2022 年，产能分别为 266,237 片/年、570,922 片/年和 1,262,110 片/年；综合毛利率分别为-8.57%、45.13%和 46.16%；净利润分别为-125,759.71 万元、172,883.20 万元和 315,619.62 万元，毛利率、业务规模和市场占有率低于台积电、联华电子等行业领先企业，发行人在业务规模和盈利能力等方面与行业领先企业存在较大差距。

如果发行人无法在未来持续推动技术进步，丰富产品结构、拓展客户、提高业务规模和市场占有率、增强盈利能力，将可能难以缩短与行业领先企业的差距，在激烈的市场竞争中受到不利影响。

### **3、晶圆代工服务的产品应用领域单一，后续研发投入大，业务拓展面临技术风险**

报告期内，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务，主要向客户提供 DDIC 及其他工艺平台的晶圆代工服务，上述晶圆代工服务的产品应用领域主要为面板显示驱动芯片领域。报告期内，发行人 DDIC 晶圆代工服务形成的收入合计分别为 148,394.24 万元、467,914.67 万元和 714,261.58 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.15%、86.32%和 71.24%，形成主营业务收入的晶圆代工服务的产品应用领域较为单一。

晶圆代工客户对发行人技术迭代和产品多元化的要求日益提高。报告期内，发行人研发费用分别为 24,467.56 万元、39,668.49 万元和 85,707.00 万元，呈逐年上升趋势，主要用于 55nm、40nm、28nm 等更先进制程研发，以及 CIS、MCU、PMIC 等其他产品技术平台拓展；未来，发行人将投入 49 亿元募集资金用于合肥晶合集成电路先进工艺研发项目，其中包括 55nm 后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台、40nm MCU 工艺平台、40nm 逻辑芯片工艺平台、28nm 逻辑及 OLED 芯片工艺平台等项目研发。随着制程节点进一步提升及技术平台种类增加，预计发行人研发投入将持续增长。

如发行人在面板显示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降，且未能及时完成 CIS、MCU 的扩产和 PMIC 等其他技术平台的研发及量产工作，无法在短时间内形成多元化的产品应用领域结构，或先进制程节点研发进度滞后，则可能对发行人的经营业绩造成不利影响。

### **4、客户集中度较高的风险**

报告期内，发行人前五大客户的销售收入合计分别为 135,804.49 万元、380,807.45 万元和 608,959.01 万元，占营业收入的比例分别为 89.80%、70.14%和 60.59%，客户集中度较高。发行人目前已经与主要客户建立了长期业务往来关系并与部分客户签署了长期框架协议，如果发行人的主要客户生产经营出现问题，导致其向发行人下达的订单数量下降，则可能对发行人的业绩稳定性产生影响。未来，若发行人无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，



将可能对发行人经营业绩产生不利影响。

## 5、国际贸易摩擦的风险

发行人使用的主要生产设备，硅片、设备零配件等主要原材料均主要通过向境外企业采购取得。发行人的部分主要客户亦为境外企业，报告期各期，公司向境外客户销售产品实现主营业务收入分别为 126,253.69 万元、317,382.24 万元和 453,647.82 万元，占公司主营业务收入比例为 83.51%、58.55%和 45.25%。

未来，可能因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素造成公司设备、原材料进口成本增加，产品境外销售利润率下降。此外，基于目前国际政治环境、多边合作关系变动、各大经济体贸易政策存在不确定性的考量，发行人的境外采购及销售可能因此受到影响。倘若未来国际贸易环境发生重大不利变化，一方面，发行人直接向境外采购可能会受到不利影响，另一方面，发行人的中国大陆供应商可能会受到不利影响进而使发行人的采购受到不利影响，该等不利影响可能导致发行人无法采购相关生产设备或生产设备的零配件，进而可能导致发行人面临关键设备采购不到位影响生产的风险。

### （二）发行人的第二大股东力晶科技对发行人技术研发、业务经营等方面的影响

2015 年，合肥市政府根据集成电路产业发展规划及“芯屏器合”的产业发展战略，拟引进国际知名企业合作设立晶圆代工厂，利用合肥市新型显示产业的协同效应，以显示驱动芯片为切入点，通过面板显示等终端应用带动芯片产业发展。2015 年 4 月 27 日，合肥市人民政府与力晶科技签署《合作框架协议》。2015 年 10 月，合肥建投与力晶科技签署了《投资参股协议》、公司与力晶科技签署了《委托经营管理合约》，公司与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》。截至 2018 年 10 月，力晶科技持有发行人出资比例为 41.28%；2020 年 9 月，发行人进行了一次减资和两次增资，并于 2020 年 11 月整体变更设立股份公司，截至本招股意向书签署之日，力晶科技持股比例为 27.44%。

2019 年 5 月，力晶科技将位于中国台湾的 3 座 12 英寸晶圆厂相关净资产、业务分割让与力积电，由力积电主导晶圆代工服务的生产与销售，力晶科技不再从事晶圆代工业务。截至本招股意向书签署之日，发行人与力晶科技关联企业力积电均从事晶圆

代工业务，力晶科技已不具备晶圆代工产能。

力晶科技对发行人在技术、人员、业务等方面的具体影响如下：

## 1、技术方面

发行人 150nm-90nm LCD 显示驱动芯片技术为在力晶科技的技转技术基础上进行改良优化、创新升级后形成。2015 年，力晶科技依据《技术移转协议》，将 LCD 显示驱动芯片代工相关的 90 纳米、110 纳米、150 纳米工艺制程的基础技术文件及规格文件提供给发行人，并于 2018 年 3 月 31 日完成技转。2018 年，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》，导入 90nm M+ 技术平台。在取得力晶科技转让的相关技术后，为更好地满足客户需求，提升自身的市场竞争力，发行人针对市场需求，由发行人自身的研发团队采取了一系列技术研发措施，对工艺结构和工艺流程进行了自主设计和创新升级，形成了发行人的核心技术平台，并将部分技术成果申请并获得了专利。

除此之外，发行人 LED 显示驱动、CIS、E-tag、MCU、PMIC 以及 55nm 逻辑及显示驱动芯片等领域的核心技术平台均为自主研发。未来，发行人将利用上市募集资金投入至 40nm、28nm 等更先进制程平台的自主研发，进一步增强先进制程服务能力，拓宽产品结构。

## 2、人员方面

根据《合作框架协议》《委托经营管理合约》，2016 年，力晶科技在入股发行人后，部分员工考虑到更好的职业发展空间，从力晶科技离职并加入发行人，该等员工自力晶科技离职后与力晶科技及关联公司不再存在劳动关系、雇佣关系或其他受力晶科技管控的关系。同时，发行人也通过在中国台湾地区相关招聘网站上刊登招聘信息等方式，自行招聘中国台湾员工。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人拥有在职中国台湾员工 352 名，其中 85 名中国台湾员工加入公司前曾在力晶科技、力积电或力积电子工作。截至本招股意向书签署之日，发行人员工均与发行人签署了劳动合同，并解除了与前任雇主的劳动合同。

2018 年 5 月前，力晶科技根据《委托经营管理合约》在短期内向发行人委派部分管理人员，协助发行人结合晶圆制造行业经验及中国大陆特点，完成财务、内部控制及稽核等制度的落地，完成任务后即返回力晶科技；2020 年 3 月前，力晶科技根据《合资合同》《投资参股协议》向公司委派审计师等管理人员，主要作用为通过参与公

司财务事项审批及内部审计流程，对公司财务状况实施监督，防止控股股东滥用控股地位。上述人员在帮助发行人落地、改善相关制度的运作，提高公司内部控制和稽核能力，传授财务核算经验等方面提供了帮助。截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任，不涉及股东委派的情形。

截至本招股意向书签署之日，发行人董事会包括九名成员（含独立董事），其中蔡国智、郑素芬、陈绍亨等三名董事由力晶科技提名；发行人监事会由三名监事组成，其中胡竞英由力晶科技提名；发行人高级管理人员共九名，其中蔡辉嘉（总经理）、邱显寰（副总经理）、李庆民（协理）、李洳谕（协理）等四名高级管理人员曾在力晶科技任职。

### 3、业务方面

（1）在客户开拓方面，力晶科技参与情况如下：

发行人建设初期（2016年），根据发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》，力晶科技向发行人引荐了奇景光电和奕力科技两家客户，以进行技术平台验证、满足技转完成条件；发行人于2017年9月、11月分别和奕力科技及奇景光电确认了技术转让平台的适用性后，与奇景光电、奕力科技独立沟通、谈判签署相关合同订单，并完成后续试产、风险量产、量产以及客户关系维护等工作。2016年11月，发行人独立与联咏科技建立了合作意向，2017年3月，发行人选定联咏科技作为150nm工艺平台首个客户，由于当时发行人的工厂尚未竣工，尚不具备生产能力，因此力晶科技应发行人要求在其工厂内配合对150nm平台进行了验证。此外，由于发行人在2018年6月前不具备光罩设计能力，发行人曾委托力晶科技在2018年6月前协助发行人针对奇景光电、奕力科技、联咏科技、集创北方、敦泰电子等主要客户进行光罩设计；2018年7月后发行人具备光罩设计能力，力晶科技不再参与该环节。

除上述情况外，发行人全部客户均由发行人独立开发、谈判及维护，无力晶科技及力积电参与；报告期初至本招股意向书签署日，发行人新开拓的客户均由发行人独立开发、谈判及维护，无力晶科技及力积电参与。

（2）在供应商开拓方面，力晶科技参与情况如下：

发行人建设初期，根据发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》，发行人自力晶科技处取得了相关技术文件，其中的《合格供应商名单》载明了技转平台涉及的所需

主要设备、原材料的供应商名称，由于集成电路行业上游设备及原材料行业集中度较高，该名单中供应商主要为行业知名企业。在发行人生产经营初期，为确保技转成功、品质稳定，发行人结合过往行业经验及生产经营的实际需要，主要向《合格供应商名单》中载明的供应商进行采购；该采购过程均为发行人独立谈判、议价，并由发行人与供应商独立签署协议或订单，无力晶科技及力积电参与。

#### **4、报告期内发行人与力晶科技及力积电均从事晶圆代工业务不会对发行人造成重大不利影响**

报告期内，发行人与力晶科技及力积电均从事晶圆代工业务。2019年5月，力晶科技将晶圆代工资产业务转移给力积电，停止从事晶圆代工业务。发行人与力晶科技及力积电均从事晶圆代工业务不会对发行人造成重大不利影响，具体如下：

在产品方面，发行人与力积电从事的晶圆代工业务在晶圆尺寸、制程节点、工艺平台、未来发展方向各方面均存在一定差异。在晶圆尺寸方面，发行人从事12英寸半导体晶圆代工，力积电从事12英寸及8英寸半导体晶圆代工；在制程节点方面，发行人以150nm、110nm、90nm半导体晶圆代工为主，55nm制程节点的12英寸晶圆代工平台已开始风险量产，力积电可以提供350nm至25nm制程节点的半导体晶圆代工服务；在工艺平台方面，报告期内，发行人以显示驱动芯片晶圆代工为主，力积电以内存产品晶圆代工、逻辑及特殊应用产品（例如：显示驱动芯片、电源管理芯片等）晶圆代工为主；在未来发展方向上，发行人将进行40nm、28nm制程研发，并将积极从事MCU、CIS、PMIC、Mini LED等晶圆代工工艺平台的研发工作；力积电未来计划开发的下一代新产品及服务主要涉及逻辑及特殊应用产品晶圆代工平台和内存产品晶圆代工平台。发行人与力晶科技及力积电晶圆代工业务情况比较详见招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“2、力晶科技”。

在公司治理方面，报告期内，力晶科技作为发行人股东，通过委派董事正常参与公司治理，不存在通过股东地位及委派董事导致双方非公平竞争、利益输送、相互或单方让渡商业机会的情形。为防范非公平竞争、利益输送或相互或者单方让渡商业机会，发行人制定了一系列公司治理制度，对公司重大投资、交易、资金往来的审议和决策程序等进行了规定，并制定了研发、采购、生产、销售、人力资源管理、财务管

理等业务及财务相关的管理制度，对公司各类业务审批、执行、管理等事项进行了规定。

综上，报告期内发行人与力晶科技及力积电均从事晶圆代工业务，不会对发行人造成重大不利影响。

### 5、力晶科技未来退出影响发行人后续经营的风险

在公司治理方面，晶圆代工行业具有较高的专业性，力晶科技系半导体行业国际知名企业，在晶圆代工领域具有多年的行业经验，力晶科技及其提名的董事在参与公司董事会、股东大会时，对于公司治理方面起到积极促进作用，公司的经营及重大决策在目前的治理结构下运行稳定。未来，如力晶科技退出发行人，公司现有股东大会、董事会的结构将发生变化，若发行人未能及时找到合适的董事人选，或新进股东、新任董事不认同公司目前的管理层及经营策略，可能会对公司治理造成不利影响。

### （三）《委托经营管理合约》的签订与解除情况

2015年10月19日，公司与力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理，以协助公司执行于合肥新站区建成12英寸晶圆制造厂项目。2020年1月2日，公司与力晶科技签订了《委托经营管理合约之终止协议》，双方同意自2019年12月25日起即终止《委托经营管理合约》，《委托经营管理合约》终止未影响发行人与客户、供应商之间的业务合作，对于发行人客户、供应商稳定性与业务持续性方面没有影响。《委托经营管理合约》解除前后的具体影响请见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）报告期内的关联交易”之“3、一般关联交易”之“（2）一般偶发性关联交易”。

《委托经营管理合约》终止前后发行人客户和供应商情况如下：

#### 1、发行人客户

力晶科技参与发行人客户开拓情况详见招股意向书本节之“一、重大事项提示”之“（二）发行人的第二大股东力晶科技对发行人技术研发、业务经营等方面的影响”。

除上述情况外，发行人全部客户均由发行人独立开发、谈判及维护，无力晶科技

及力积电参与；报告期初至本招股意向书签署日，发行人新开拓的客户均由发行人独立开发、谈判及维护，无力晶科技及力积电参与。主要包括：发行人与客户对接的销售人员均为发行人员工，与发行人签署独立劳动关系合同，与力晶科技不存在劳动关系；发行人销售人员与客户通过邮件、电话、现场拜访等方式取得联系，沟通确认需求，正式订单由客户主要通过邮件等方式直接向发行人下达，发行人与客户的销售合同均由发行人与客户直接签署，前述过程无力晶科技及力积电参与。

《委托经营管理合约》终止后，发行人独立开拓的新客户及在手订单情况请见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）报告期内的关联交易”之“3、一般关联交易”之“（2）一般偶发性关联交易”。

## 2、发行人供应商

力晶科技参与发行人供应商开拓情况详见招股意向书本节之“一、重大事项提示”之“（二）发行人的第二大股东力晶科技对发行人技术研发、业务经营等方面的影响”。

技转完成后，为加强成本控制、保证晶圆代工服务质量、提高生产效率和存货周转效率，公司已建立严格的采购流程和供应商管理体系。截至本招股意向书签署之日，发行人已通过独立开拓的方式，与中微半导体、北方华创、液化空气及其关联企业、重庆超硅半导体有限公司等《合格供应商名单》外的知名供应商建立了良好的采购合作关系，扩大供应商范围，降低供应链风险。

报告期内，发行人与供应商独立联系并建立合作，主要包括：发行人与供应商对接的采购人员均为发行人员工，与发行人签署独立劳动关系合同，与力晶科技不存在劳动关系；发行人采购人员与供应商通过邮件、电话、现场拜访等方式取得联系，沟通确认发行人需求，正式订单由发行人直接向供应商下达，发行人与供应商的采购合同均由发行人与供应商直接签署，前述过程无力晶科技及力积电参与。

### （四）本次发行前滚存利润的分配安排

2021年3月16日，发行人召开股东大会，审议通过了《关于<合肥晶合集成电路股份有限公司滚存未分配利润分配方案>的议案》，决议本次发行前公司的滚存未分配

利润（累计未弥补亏损）将由公司本次发行上市完成后的全体股东按照各自持股比例共同享有（承担）。

#### （五）本次发行相关责任主体作出的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况，具体承诺事项请参见本招股意向书“附件二与投资者保护相关的承诺”。

#### （六）2022年度所得税优惠事项说明

根据国发〔2020〕8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》规定，国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据发改高技〔2022〕390号《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》规定，清单印发前，企业可依据税务有关管理规定，先行按照企业条件和项目标准享受相关国内税收优惠政策；清单印发后，如企业未被列入清单，应按规定补缴已享受优惠的企业所得税款。

发行人结合实际情况对税收优惠政策中所列的要求逐项对比分析，判断预计很可能享受五免五减半的税收优惠政策，公司已提出申请，2022年度作为五免五减半的第一年依据上述税收优惠政策享受所得税减免。

发行人已依据上述税收优惠政策，于2022年度财务报表中相应调减所得税费用，对2022年度所得税费用、净利润的影响金额为17,977.85万元。

## 二、发行人及中介机构情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	合肥晶合集成电路股份有限公司	成立日期	2015年5月19日

(一) 发行人基本情况			
注册资本	150,460.1368 万元人民币	法定代表人	蔡国智
注册地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号	主要生产经营地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
控股股东	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	实际控制人	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	中国国际金融股份有限公司	主承销商	中国国际金融股份有限公司
发行人律师	北京市金杜律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	评估机构	中水致远资产评估有限公司
保荐人(主承销商)律师	北京市海问律师事务所	-	-
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		<p>截至本招股意向书签署之日,发行人本次发行的保荐人(主承销商)中金公司通过全资子公司中金浦成持有发行人 0.12% 的股份。除此之外,中金公司自身及其下属子公司不存在持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况。</p> <p>根据国家企业信用信息公示系统公开信息显示,中金公司通过其以自有或投资的已经基金业协会备案的相关金融产品等形式间接持有发行人股东集创北方、宁波华淳的股权/财产份额(穿透后持有发行人股份的比例不超过 0.01%),该等投资行为并非中金公司主动针对发行人进行投资,具体持股情况详见本招股意向书“附件二 与投资者保护相关的承诺”之“十、其他承诺事项”之“(六) 股东信息披露的相关承诺”。</p> <p>根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律、法规的规定,发行人的保荐人依法设立的相关子公司将参与本次发行战略配售,并对获配股份设定限售期,具体认购数量、金额等内容在发行前确定并公告。</p> <p>除上述情况外,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。</p>	
(三) 本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	中国建设银行北京市分行国贸支行
其他与本次发行有关的机构		验资机构	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



### 三、本次发行概况

#### (一) 本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	501,533,789 股（行使超额配售选择权之前） 576,763,789 股（全额行使超额配售选择权之后）	占发行后总股本比例	25%（行使超额配售选择权之前） 27.71%（全额行使超额配售选择权之后）
其中：发行新股数量	501,533,789 股（行使超额配售选择权之前） 576,763,789 股（全额行使超额配售选择权之后）	占发行后总股本比例	25%（行使超额配售选择权之前） 27.71%（全额行使超额配售选择权之后）
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	2,006,135,157 股（行使超额配售选择权之前） 2,081,365,157 股（全额行使超额配售选择权之后）		
每股发行价格	人民币【】元		
发行市盈率	【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	8.72 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份总数计算）	发行前每股收益	1.91 元（以 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前已发行股份总数计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后已发行股份总数计算）	发行后每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后已发行股份总数计算）
发行市净率	【】倍（按发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元，根据发行价格乘以发行股数确定		
募集资金净额	【】万元，由募集资金总额扣除发行费用后确定		
募集资金投资项目	1、合肥晶合集成电路先进工艺研发项目 2、收购制造基地厂房及厂务设施 3、补充流动资金及偿还贷款		
发行费用概算	本次发行费用构成如下： (1) 承销费及保荐费：本次发行最终实际募集资金总额（含超额配售选择		

	<p>权)*2.1% (含增值税)</p> <p>(2) 审计、验资费: 2,259.00 万元</p> <p>(3) 律师费: 965.00 万元</p> <p>(4) 用于本次发行的信息披露费用: 不超过 465.00 万元</p> <p>(5) 上市相关的手续费等其他费用: 不超过 75.00 万元</p> <p>注 1: 发行手续费中暂未包含本次发行的印花税, 税基为扣除印花税前的募集资金净额 (超额配售选择权后发行股份对应的募集资金), 税率为 0.025%; 将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费</p> <p>注 2: 各项费用根据发行结果可能会有调整, 除保荐承销费为含增值税以外, 其他费用均不含增值税</p> <p>注 3: 保荐承销费用所指最终实际募集款项总额 (含超额配售选择权), 是超额配售选择权行使期届满后最终发行股数对应的募集资金</p>
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	<p>发行人高级管理人员及核心员工通过“中金丰众 42 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”“中金丰众 43 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”“中金丰众 44 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”“中金丰众 45 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次公开发行的战略配售。前述资管计划合计认购金额不超过 40,292.8926 万元, 且配售数量不超过首次公开发行股票数量的 10%。具体比例和金额将在确定发行价格后确定。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月</p>
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	<p>保荐人子公司中国中金财富证券有限公司将参与本次发行战略配售, 跟投的初始股份数量为本次公开发行股份数量的 2.00%, 即 10,030,676 股。因保荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关, 保荐人 (主承销商) 将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月</p>
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用

## (二) 本次发行上市的重要日期

刊登初步询价公告日期	2023 年 4 月 12 日
初步询价日期	2023 年 4 月 17 日
刊登发行公告日期	2023 年 4 月 19 日
申购日期	2023 年 4 月 20 日
缴款日期	2023 年 4 月 24 日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申请股票上市

## (三) 本次战略配售情况

### 1、配售数量

本次初始公开发行股票数量为 501,533,789 股, 发行股份占公司发行后总股本的比

例为 25.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 576,763,789 股，占公司发行后总股本的比例约为 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行后公司总股本为 2,006,135,157 股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 2,081,365,157 股（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为 150,460,136 股，占初始发行数量的 30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

## 2、配售对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下四类：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（3）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中金财富”）；

（4）中金丰众 42 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 42 号”）、中金丰众 43 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 43 号”）、中金丰众 44 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 44 号”）、中金丰众 45 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 45 号”）（以下合称为“专项资产管理计划”）。

## 3、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况

本次保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份数量的 2.00%，即 10,030,676 股。因保荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，

保荐人（主承销商）将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。

#### 4、发行人高管、员工拟参与战略配售情况

2022年6月10日，发行人召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案的议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心员工以设立专项资产管理计划的方式参与本次战略配售。资产管理计划认购的股票数量不超过本次公开发行股票数量的10.00%，即50,153,378股，并承诺参与本次配售获得的股票持有期限不少于12个月。

##### （1）投资主体

发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中金丰众42号、中金丰众43号、中金丰众44号、中金丰众45号，管理人均为中金公司。

##### （2）参与规模

中金丰众42号的认购上限为9,931.8470万元，中金丰众43号的认购上限为10,249.6891万元，中金丰众44号的认购上限为16,311.3909万元，中金丰众45号的认购上限为3,799.9656万元，合计40,292.8926万元。专项资产管理计划获配股票数量按照本次发行最终确定的发行价格及其分别承诺认购的金额进行确定。

##### （3）参与人姓名、职级与比例

###### ①中金丰众42号参与人员名单

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1.	詹奕鹏	副总经理	1,584	15.95%	发行人	高级管理人员
2.	蔡辉嘉	总经理	840	8.46%	发行人	高级管理人员
3.	邱显寰	副总经理	666	6.71%	发行人	高级管理人员
4.	谢承璋	分立器件技术中心技术经理	210	2.11%	发行人	核心员工
5.	赵家保	关务课副理	200	2.01%	发行人	核心员工
6.	黄晋德	分立器件技术中心资深处长	180	1.81%	发行人	核心员工
7.	杨国栋	黄光工程部技术经理	162	1.63%	发行人	核心员工
8.	束乐	员工发展课副理	160	1.61%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
9.	曾国祯	厂务二部部经理	150	1.51%	发行人	核心员工
10.	杜雷	光罩服务组部经理	150	1.51%	发行人	核心员工
11.	李庆民	助理	150	1.51%	发行人	高级管理人员
12.	张兴才	厂务课副理	150	1.51%	发行人	核心员工
13.	卓俊麒	电脑辅助设计部部经理	150	1.51%	发行人	核心员工
14.	蔡杰良	制程二课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
15.	陈俊宏	设备三课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
16.	范振富	扩散生产课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
17.	方建智	薄膜工程部副理	120	1.21%	发行人	核心员工
18.	郭宣婷	制程三课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
19.	黄彦昌	安全管理课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
20.	林宗晔	设备信息课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
21.	缪凤玲	代工业务三部技术副理	120	1.21%	发行人	核心员工
22.	潘坡	业务支援组专案副理	120	1.21%	发行人	核心员工
23.	彭泽昌	制程一课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
24.	孙浩晏	生产管理课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
25.	汪高生	网络系统课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
26.	吴德刚	工业工程三课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
27.	杨安立	设备一课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
28.	杨俊杰	设备三课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
29.	杨昆	平台服务课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
30.	喻加云	税务课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
31.	张静	总账课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
32.	官建宏	洗净工程部技术经理	115	1.16%	发行人	核心员工
33.	杨宗凯	核心技术一部部经理	105	1.06%	发行人	核心员工
34.	白康茜	材料二课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
35.	陈春安	设备三课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
36.	陈家宏	设备三课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
37.	何倩倩	事务部副理	100	1.01%	发行人	核心员工
38.	洪启恭	电脑整合制造部部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
39.	胡六四	事务部副理	100	1.01%	发行人	核心员工
40.	黄国助	流程整合组部经理	100	1.01%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
41.	黄皓皓	储运部代部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
42.	黄南翔	生管物管部部长	100	1.01%	发行人	核心员工
43.	廖宥宏	蚀刻生产课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
44.	林皓庭	制程一课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
45.	林育兴	洗磨生产课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
46.	林智伟	前瞻技术发展一组技术副理	100	1.01%	发行人	核心员工
47.	刘波	洁净及化学分析课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
48.	卢俊玮	制程三课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
49.	罗国基	制造部副理	100	1.01%	发行人	核心员工
50.	蒲甜松	核心技术二部代部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
51.	施介文	N1A1 厂长室副厂长	100	1.01%	发行人	核心员工
52.	汪小小	元件开发部部长	100	1.01%	发行人	核心员工
53.	王嘉祥	蚀刻工程部副理	100	1.01%	发行人	核心员工
54.	吴文达	信息服务处副处长	100	1.01%	发行人	核心员工
55.	许春龙	核心技术三部代部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
56.	许信忠	黄光生产课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
57.	叶峻玮	微影开发部技术经理	100	1.01%	发行人	核心员工
58.	余义祥	制程三课技术副理	100	1.01%	发行人	核心员工
59.	张凯帆	营运系统课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
60.	赵丽云	出货品质保证课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
61.	朱哲仪	设备课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
<b>总计</b>			<b>9,931.8470</b>	<b>100%</b>		-

注 1：中金丰众 42 号为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售。

注 2：认购金额为以万元为单元进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 3：以上比例待确定发行价格后确认。

## ②中金丰众 43 号参与人员名单

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1.	朱才伟	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理	1,800	17.56%	发行人	高级管理人员
2.	朱晓娟	董事、副总经理	1,120	10.93%	发行人	高级管理人员
3.	周义亮	副总经理	800	7.80%	发行人	高级管理人员
4.	方华	对外事务室处长	675	6.59%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
5.	吴佳特	先进整合处处长	510	4.98%	发行人	核心员工
6.	王兴亚	财会处处长	500	4.88%	发行人	核心员工
7.	刘桂云	总务部部长	375	3.66%	发行人	核心员工
8.	张庆勇	IP 服务二组部经理	375	3.66%	发行人上海分公司	核心员工
9.	谢长峯	制程整合技术处副处长	360	3.51%	发行人	核心员工
10.	方圣昌	N1A1 厂长室副厂长	350	3.41%	发行人	核心员工
11.	江英和	人力资源处代副处长	350	3.41%	发行人	核心员工
12.	李宁	薪资福利部代部经理	310	3.02%	发行人	核心员工
13.	曹宗野	证券事务部部经理	300	2.93%	发行人	核心员工
14.	李德龙	采购一部部经理	300	2.93%	发行人	核心员工
15.	王云直	会计部部经理	300	2.93%	发行人	核心员工
16.	谢文智	营运企划处副处长	300	2.93%	发行人	核心员工
17.	陈景	客户工程处代副处长	295	2.88%	发行人	核心员工
18.	李迦谕	助理	230	2.24%	发行人	高级管理人员
19.	王逸蓉	关务部部经理	230	2.24%	发行人	核心员工
20.	周儒领	先进整合前端组部经理	220	2.15%	发行人	核心员工
21.	张英杰	代工业务一部部经理	200	1.95%	发行人	核心员工
22.	郑晓	产品工程二部部经理	200	1.95%	发行人	核心员工
23.	张存兴	经营管理组部经理	150	1.46%	发行人	核心员工
总计			10,249.6891	100%		-

注 1：中金丰众 43 号为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售。

注 2：认购金额为以万元为单元进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 3：以上比例待确定发行价格后确认。

### ③中金丰众 44 号参与人员名单

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1.	郑志成	前瞻技术发展中心资深处长	724	4.44%	发行人	核心员工
2.	简瑞荣	助理	520	3.19%	发行人	高级管理人员
3.	陈维邦	前瞻技术发展中心部经理	500	3.07%	发行人	核心员工
4.	吴启明	前瞻技术发展中心部经理	500	3.07%	发行人	核心员工
5.	吴志楠	前瞻技术发展中心处长	480	2.94%	发行人	核心员工
6.	蔡国智	董事长	460	2.82%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
7.	李建政	前瞻技术发展一组技术经理	400	2.45%	发行人	核心员工
8.	王建智	先进整合后端部部长	375	2.30%	发行人	核心员工
9.	崔助凤	器件架构部部长	346	2.12%	发行人	核心员工
10.	金起準	模型器件处技术副处长	334	2.05%	发行人	核心员工
11.	郭廷晃	前瞻技术发展一组技术经理	325	1.99%	发行人	核心员工
12.	许宗能	先进整合处代副处长	320	1.96%	发行人	核心员工
13.	陈嘉勇	前瞻技术发展二组技术经理	300	1.84%	发行人	核心员工
14.	黎翠綾	企业规划室资深处长	300	1.84%	发行人	核心员工
15.	李旭昇	行政与网络系统部部长	300	1.84%	发行人	核心员工
16.	刘棋彬	风险管理处处长	300	1.84%	发行人	核心员工
17.	杨子亿	洗净开发部部长	300	1.84%	发行人	核心员工
18.	蔡清彦	研发良率部部长	275	1.69%	发行人	核心员工
19.	王志良	风险控制部部长	275	1.69%	发行人	核心员工
20.	吴建兴	先进整合处技术副处长	270	1.66%	发行人	核心员工
21.	林豫立	前瞻技术发展一组技术经理	260	1.59%	发行人	核心员工
22.	刘哲儒	前瞻技术发展一组技术经理	260	1.59%	发行人	核心员工
23.	罗钦贤	前瞻技术发展二组技术经理	252	1.54%	发行人	核心员工
24.	高志杰	前瞻技术发展一组技术经理	250	1.53%	发行人	核心员工
25.	林士程	总经理室特助	250	1.53%	发行人	核心员工
26.	林士然	深圳办公室处长	250	1.53%	发行人	核心员工
27.	魏郁忠	全面品质管理部部长	250	1.53%	发行人	核心员工
28.	杨清晓	前瞻技术发展中心技术副处长	250	1.53%	发行人	核心员工
29.	张正杰	前瞻技术发展二组技术经理	250	1.53%	发行人	核心员工
30.	罗招龙	模组开发处副处长	220	1.35%	发行人	核心员工
31.	蔡栋煌	N1A1 厂长室副厂长	199	1.22%	发行人	核心员工
32.	黄凯全	策略规划组部长	200	1.23%	发行人	核心员工
33.	黄世豪	安全管理二组部长	200	1.23%	发行人	核心员工
34.	柯家宇	品质工程部部长	200	1.23%	发行人	核心员工
35.	李天定	经营与营运系统部部长	200	1.23%	发行人	核心员工
36.	苏财宝	前瞻技术发展二组技术经理	200	1.23%	发行人	核心员工
37.	曲厚任	制程整合二部部长	195	1.20%	发行人	核心员工
38.	陈有德	前瞻技术发展二组技术经理	183	1.12%	发行人	核心员工



序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
39.	蔡俊郎	良率提升部部长	173	1.06%	发行人	核心员工
40.	林东亿	模组开发处代副处长	170	1.04%	发行人	核心员工
41.	刘文彬	化学机械研磨开发部部长	165	1.01%	发行人	核心员工
42.	吕绍维	前瞻技术发展一组技术副理	165	1.01%	发行人	核心员工
43.	蔡佳勋	采购处处长	160	0.98%	发行人	核心员工
44.	洪春田	黄光工程部部长	160	0.98%	发行人	核心员工
45.	林成芝	前瞻技术发展二组技术经理	160	0.98%	发行人	核心员工
46.	徐柏谦	招募任用部代部长	157	0.96%	发行人	核心员工
47.	陈世昌	整合支援组部长	150	0.92%	发行人	核心员工
48.	陈信全	技术开发一处副处长	150	0.92%	发行人	核心员工
49.	柯孟志	制造部部长	150	0.92%	发行人	核心员工
50.	梁君丽	元件技术部部长	150	0.92%	发行人	核心员工
51.	吴则贤	技术开发二处技术副处长	150	0.92%	发行人	核心员工
52.	沈侑达	厂务一部部长	145	0.89%	发行人	核心员工
53.	陈文璟	制程整合一部部长	139	0.85%	发行人	核心员工
54.	柯天麒	模型器件处副处长	130	0.80%	发行人	核心员工
55.	罗丁硕	模组技术研发一组代部长	130	0.80%	发行人	核心员工
56.	许嘉哲	分析技术部部长	130	0.80%	发行人	核心员工
57.	郑荣杰	模组技术研发三组部长	130	0.80%	发行人	核心员工
58.	洪国利	安全管理一部部长	125	0.77%	发行人	核心员工
59.	蔡承佑	制程整合三部部长	121	0.74%	发行人	核心员工
60.	林滔天	逻辑一部部长	110	0.67%	发行人	核心员工
61.	刘荣文	市场调研组副理	110	0.67%	发行人	核心员工
62.	杨智强	蚀刻开发部部长	110	0.67%	发行人	核心员工
63.	陈冠中	前瞻技术发展一组技术副理	100	0.61%	发行人	核心员工
64.	雷澔仁	稽核室部长	100	0.61%	发行人	核心员工
65.	林群证	洗净工程部部长	100	0.61%	发行人	核心员工
66.	吕正良	前瞻技术发展一组技术经理	100	0.61%	发行人	核心员工
67.	秦典昇	黄光工程部副理	100	0.61%	发行人	核心员工
68.	苏深池	资安室部长	100	0.61%	发行人	核心员工
69.	王忠诚	前瞻技术发展二组技术经理	100	0.61%	发行人	核心员工
70.	吴启熙	分析及可靠性工程部部长	100	0.61%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
71.	吴照文	企业规划室技术经理	100	0.61%	发行人	核心员工
72.	谢荣源	技术开发二处副处长	100	0.61%	发行人	核心员工
73.	游咏晞	前瞻技术发展二组技术副理	100	0.61%	发行人	核心员工
74.	张伟瑾	N1厂厂长	100	0.61%	发行人	核心员工
总计			<b>16,311.3909</b>	<b>100%</b>		-

注 1：中金丰众 44 号为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售。

注 2：认购金额为以万元为单元进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 3：以上比例待确定发行价格后确认。

#### ④中金丰众 45 号参与人员名单

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1.	陈思皓	缺陷改善课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
2.	古哲安	制程一课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
3.	黄普嵩	器件架构二课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
4.	林胜雄	水处理课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
5.	林政纬	制程二课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
6.	田俊鹏	生管二课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
7.	王新贵	制程二课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
8.	陈伟华	制程三课技术副理	80	1.68%	发行人	核心员工
9.	邓元吉	设备一课技术副理	75	1.58%	发行人	核心员工
10.	郝利兰	制程二课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
11.	洪佐旻	设备四课技术副理	75	1.58%	发行人	核心员工
12.	黄志贤	专案课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
13.	彭科津	设备一课技术副理	75	1.58%	发行人	核心员工
14.	彭萍	制程一课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
15.	邵迎亚	整合一课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
16.	苏圣哲	制程一课技术副理	75	1.58%	发行人	核心员工
17.	唐昌玉	工业工程一课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
18.	王梦曦	政府事务组代部经理	75	1.58%	发行人	核心员工
19.	徐东东	大数据分析课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
20.	张润生	专案课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
21.	钟胤	工会事务组专案副理	75	1.58%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
22.	周宗典	制程一课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
23.	冯文辉	专案课技术副理	60	1.26%	发行人	核心员工
24.	顾炜	业务一课副理	60	1.26%	发行人	核心员工
25.	何瑞凤	基准情报一课副理	60	1.26%	发行人	核心员工
26.	柯孟志	制造部部长	60	1.26%	发行人	核心员工
27.	毛泽民	业务一课副理	60	1.26%	发行人	核心员工
28.	沈俊明	制程一课技术副理	60	1.26%	发行人	核心员工
29.	吴颖麒	设备一课技术副理	60	1.26%	发行人	核心员工
30.	詹益明	制程一课技术副理	60	1.26%	发行人	核心员工
31.	冯维	物管课副理	55	1.16%	发行人	核心员工
32.	黄铭仁	系统整合课副理	50	1.05%	发行人	核心员工
33.	蔡明洋	制程二课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
34.	陈欣蕙	元件一课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
35.	丁璇璇	行政与网络系统部技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
36.	黄君杰	设备三课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
37.	季能	经营系统课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
38.	李强	水处理课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
39.	李青	生产资源课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
40.	林祐丞	制程一课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
41.	凌军	制造信息课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
42.	刘凯文	制程二课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
43.	潘雨	水处理课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
44.	索圣涛	制程二课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
45.	檀翠琴	经营系统课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
46.	唐世桦	消防管理课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
47.	万少强	住宿管理课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
48.	王厚有	制程一课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
49.	王丽平	税务课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
50.	夏海峰	应急管理课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
51.	许玉媛	法务室专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
52.	杨大桂	空调课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
53.	杨丽	薪资课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
54.	游舜宏	水处理课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
55.	袁修云	进出口课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
56.	钟尚仁	气体化学课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
57.	朱连枝	设备课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
58.	蔡君正	整合二课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
59.	陈庆鸿	物管课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
60.	董允文	厂务二部技术经理	40	0.84%	发行人	核心员工
61.	方思哲	整合一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
62.	郭千琦	模型器件一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
63.	洪素真	采购处技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
64.	黄家洋	空调课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
65.	黄志平	设备二课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
66.	黄重育	研发良率一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
67.	金良民	行政系统课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
68.	赖正训	设备一课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
69.	李雪娇	经营管理组技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
70.	林宏展	设备三课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
71.	林明志	气体化学课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
72.	罗贤福	设备一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
73.	苗洁	制程一课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
74.	穆慧慧	企业规划室技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
75.	汪雪春	整合二课代副理	40	0.84%	发行人	核心员工
76.	王振择	制程二课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
77.	魏家信	结构分析课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
78.	吴冠毅	制程三课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
79.	谢明勋	气体化学课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
80.	谢琦山	扩散工程部技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
81.	熊健	生管一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
82.	许凯迪	自动化系统课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
83.	詹益轩	制程一课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
84.	张建烜	空调课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
85.	张世琛	设备二课副理	40	0.84%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系 所属公司	员工类别
86.	张晓亮	制程二课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
87.	张照和	空调课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
88.	章淑媛	工程信息课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
89.	周成	制程一课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
总计			<b>4,749.9570</b>	<b>100%</b>		-

注 1：中金丰众 45 号为混合类资管计划，其募集资金的 80%用于参与本次战略配售。

注 2：认购金额为以万元为单元进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 3：以上比例待确定发行价格后确认。

#### （四）超额配售选择权实施方案

##### 1、超额配售选择权整体情况

本次初始公开发行股票数量为 501,533,789 股，发行股份占公司发行后总股本的比例为 25.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 576,763,789 股，占公司发行后总股本的比例约为 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

公司本次发行前总股本为 1,504,601,368 股，本次发行后公司总股本为 2,006,135,157 股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 2,081,365,157 股（超额配售选择权全额行使后）。

##### 2、实施方式

自发行人股票在上交所上市之日起 30 个自然日内，发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格时，获授权主承销商中金公司有权使用超额配售股票募集的资金，以《交易规则》规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价格；获授权主承销商以竞价交易方式申报买入还应当符合下列规定：

（1）在开盘集合竞价阶段申报的，申报买入价格不得超过本次发行的发行价，且不得超过即时行情显示的前收盘价；

（2）发行人证券的市场交易价格低于或者等于发行价格的，可以在连续竞价阶段

申报，申报买入价格不得超过本次发行的发行价；

(3) 在收盘集合竞价阶段申报的，申报买入价格不得超过本次发行的发行价，且不得超过最近成交价。

获授权主承销商未购买发行人股票或者购买发行人股票数量未达到全额行使超额配售选择权拟发行股票数量的，可以要求发行人按照发行价格增发股票。另外，获授权主承销商以竞价交易方式买入的股票不得卖出。获授权主承销商以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

获授权主承销商应当将超额配售股票募集的资金存入其在商业银行开设的独立账户。获授权主承销商在发行人股票上市之日起 30 个自然日内，不得使用该账户资金外的其他资金或者他人账户交易发行人股票。

### 3、操作策略

中金公司已根据《管理办法》《业务实施细则》及《承销业务规则》等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件制定了《中国国际金融股份有限公司境内超额配售选择权实施办法》。中金公司已根据该实施办法制定具体操作策略行使超额配售选择权。

### 4、预期效果

因行使超额配售选择权超额发行的股数=发行时超额配售股数-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况。

(1) 超额配售选择权不行使。分两种情况：①未进行超额配售；②获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票，累计购回的股票数量达到全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

(2) 超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15%，且获授权主承销商未使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票。获授权主承销商将要求发行人超额发行本次发行初始发行规模 15%的股票。

(3) 超额配售选择权部分行使。①超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15%，获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票，且累计购

回的股票数量未达到全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。获授权主承销商将要求发行人按照发行价格增发证券。以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过发行公告中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的 15%；②超额配售股数小于本次发行初始发行规模的 15%，未使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票或获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票，且累计购回的股票数量未达到超额配售股数，因此获授权主承销商将要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的 15%的股票。

中金公司在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 5 个工作日内，将超额配售选择权专门账户上所有股份向同意延期交付股票的投资者交付。中金公司在符合相关法律法规规定的条件下，可在发行人股票上市后 30 个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证防止股价下跌。中金公司在发行人股票上市后 30 个自然日之后或行使超额配售选择权后，将不再采取上述措施支持股价。

## 四、发行人主营业务经营情况

### （一）发行人主营业务概况

晶合集成主要从事 12 英寸晶圆代工业务，致力于研发并应用行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。公司目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的风险量产。公司所代工的产品被广泛应用于液晶面板、手机、消费电子等领域，获得了众多境内外知名半导体设计公司的认可。2020 年度，公司 12 英寸晶圆代工年产能达约 26.62 万片；2022 年度，公司 12 英寸晶圆代工产能为 126.21 万片。根据 Frost & Sullivan 的统计，截至 2020 年底，晶合集成已成为收入第三大、12 英寸晶圆代工产能第三大的中国大陆纯晶圆代工企业（不含外资控股企业）<sup>1</sup>，有效提高了中国大陆晶圆代工行业的自主水平。根据市场研究机构 TrendForce 的统计，2022 年第二季度，在全球晶圆代工企业中，公司营业收入排名全球第九。

<sup>1</sup>排名不包括采用 IDM 模式的半导体企业；数据来源：Frost & Sullivan

报告期内，发行人向客户提供晶圆代工服务的制程节点主要为 150nm 至 90nm。发行人按照制程节点分类的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
55nm	3,912.65	0.39%	4.99	0.00%	-	-
90nm	521,240.66	51.99%	303,310.46	55.95%	80,268.82	53.09%
110nm	316,507.96	31.57%	132,328.41	24.41%	40,725.48	26.94%
150nm	160,888.68	16.05%	106,440.58	19.64%	30,191.80	19.97%
<b>合计</b>	<b>1,002,549.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,084.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,186.11</b>	<b>100.00%</b>

注：发行人 55nm 技术平台正在风险量产阶段

报告期内，发行人向客户提供 DDIC 及其他工艺平台的晶圆代工服务。发行人按照工艺平台分类的主营业务收入构成如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDIC 工艺平台晶圆代工	714,261.58	71.24%	467,914.67	86.32%	148,394.24	98.15%
其他工艺平台晶圆代工	288,288.37	28.76%	74,169.78	13.68%	2,791.87	1.85%
<b>合计</b>	<b>1,002,549.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,084.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,186.11</b>	<b>100.00%</b>

## （二）发行人的主要经营模式

### 1、主要生产模式

报告期内，发行人主要的生产模式为晶圆代工模式，发行人接到客户需求后，首先进行小规模试产；在良率及工艺条件稳定后，进入风险量产阶段；在各项交付指标达标后，与客户签订正式的销售合同或接受批量订单，按照客户需求分配产能、制定生产计划、进行大批量生产。

### 2、主要原材料及重要供应商

报告期内，发行人生产经营所需的原材料主要包括硅片、化学品、气体、靶材、零配件以及光阻等，重要供应商包括：GlobalWafers、Applied Materials、中环领先半导体等。



### 3、销售方式和渠道及重要客户

报告期内，发行人主要的销售方式为直销，面向客户直接进行销售，重要客户包括：联咏科技、集创北方、思特威、奕力科技等。

## 五、发行人符合科创板定位相关情况

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。发行人所属行业领域属于《暂行规定》第四条规定的领域之“（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”。

公司最近三年研发投入占营业收入比例为 8.82%、最近三年研发投入累计为 149,843.05 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 1,388 人，占当年员工总数的 32.86%。公司报告期各期末研发人员占当年员工总数的比例平均为 22.44%；截至 2022 年 12 月 31 日，发行人应用于公司主营业务的发明专利共 316 项；发行人最近三年营业收入复合增长率为 157.79%，2022 年度实现营业收入 1,005,094.86 万元。发行人符合《暂行规定》对于科创属性的要求。

## 六、发行人主要财务数据及财务指标

项目	2022年12月31日/ 2022年度	2021年12月31日/ 2021年度	2020年12月31日/ 2020年度
资产总额（万元）	3,876,457.45	3,127,227.47	1,564,233.24
归属于母公司所有者权益（万元）	1,312,415.66	922,265.35	715,793.43
资产负债率（合并）	53.44%	68.38%	54.24%
资产负债率（母公司）	61.78%	70.60%	54.19%
营业收入（万元）	1,005,094.86	542,900.93	151,237.05
净利润（万元）	315,619.62	172,883.20	-125,759.71
归属于母公司所有者的净利润（万元）	304,543.08	172,883.20	-125,759.71
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	287,834.64	153,364.72	-123,333.42
基本每股收益（元）	2.02	1.15	-0.27
稀释每股收益（元）	2.02	1.15	-0.27

项目	2022年12月31日/ 2022年度	2021年12月31日/ 2021年度	2020年12月31日/ 2020年度
加权平均净资产收益率	26.91%	21.55%	-28.93%
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	628,003.34	957,388.50	47,282.88
现金分红(万元)	-	-	-
研发费用占营业收入比例	8.53%	7.31%	16.18%

## 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况

财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大变化；公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，不存在重大不利变化；公司所处晶圆代工行业长期发展前景良好，2022年第三季度以来晶圆代工行业市场的需求及价格变动属于行业周期性波动，行业的产业政策、税收政策均未发生重大变化。

公司合理预计2023年1-3月的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动率
营业收入	105,357.84至110,861.09	281,828.26	-62.62%至-60.66%
归属于母公司所有者的净利润	-35,497.62至-27,313.03	130,743.00	-127.15%至-120.89%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-40,037.27至-31,852.68	129,529.16	-130.91%至-124.59%

根据行业发展态势、市场供需情况以及公司自身经营情况预测等，公司预计2023年1-3月可实现营业收入的区间为105,357.84万元至110,861.09万元，同比下降62.62%至60.66%；预计2023年1-3月可实现归属于母公司所有者的净利润区间为-35,497.62万元至-27,313.03万元，同比下降127.15%至120.89%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为-40,037.27万元至-31,852.68万元，同比下降130.91%至124.59%。2023年1-3月，公司预计经营业绩同比下降且可能出现亏损，主要系在2022年，智能手机、消费电子需求下行，受到消费性终端需求疲软的影响，整体而言，2022年第三季度起产能缺口情况有所缓解，使得晶圆代工产能利用率面临挑战。发行人作为半导体晶圆代工企业，生产经营受到行业整体需求变化及周期性波动

的影响，因产能利用率不足等原因导致经营业绩同比下滑。

基于上述 2023 年 1-3 月业绩预测数据，并结合 2022 年第三季度以来晶圆代工行业市场需求及价格变动趋势，公司提示投资者关注业绩下滑风险。

前述财务数据系公司初步预测的结果，不构成公司所做的盈利预测或业绩承诺。

## 八、发行人选择的上市标准

晶合集成选择的具体上市标准为《科创板上市规则》第 2.1.2 条的第四套标准，即，“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。发行人 2022 年度实现营业收入 1,005,094.86 万元，结合最近一次外部股权融资情况，可比公司在境内外市场的估值情况，发行人预计将满足《科创板上市规则》第 2.1.2 条的第四套标准。

## 九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项

截至本招股意向书签署之日，发行人不存在公司治理的特殊安排。

## 十、发行人募集资金运用与未来发展规划

### （一）募集资金运用

公司本次拟公开发行 A 股普通股股票，实际募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

为积极开发多元化产品、向更先进制程节点顺利发展，晶合集成选择 40 纳米、28 纳米和后照式 CMOS 图像传感器芯片制造工艺技术、微控制器芯片工艺平台作为先进工艺研发项目。此外，为加强公司资产完整性、独立性，公司拟向合肥蓝科收购制造基地厂房及厂务设施，收购完成后，公司将拥有主要生产经营厂房、现有土建建成部分对应的土地及配套厂务设施的完整所有权。同时，为补充公司资本金实力，增强公司市场竞争力，拟定 15 亿元用于补充流动资金及偿还贷款。具体明细见下表：

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金额 (亿元)
----	------	------	------------------

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金金额 (亿元)
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	晶合集成	49.0
1.1	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目 (包含 90 纳米及 55 纳米)	晶合集成	6.0
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目 (包含 55 纳米及 40 纳米)	晶合集成	3.5
1.3	40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	晶合集成	15.0
1.4	28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	晶合集成	24.5
2	收购制造基地厂房及厂务设施	晶合集成	31.0
3	补充流动资金及偿还贷款	晶合集成	15.0
<b>合计</b>			<b>95.0</b>

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司通过自有资金以及银行贷款等自筹资金方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述拟投入募集资金总额，则公司根据发展规划及实际生产经营需求，将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据上述投资项目实际进度的需要，以自有资金以及银行贷款等自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金。

## （二）未来发展规划

集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业，集成电路制造又是集成电路产业的核心环节。在当前的国内行业上下游仍高度依赖进口的背景下，发行人将抓住 5G、AI、物联网等市场机遇，提升晶圆制造环节的本土企业市场影响力，实现国内显示驱动芯片、微处理器、CMOS 图像传感器等集成电路产品的自主可控供应，进一步提高集成电路行业的国产化水平。

未来，公司将不断依托核心优势、提升专业技术水平，整合行业及客户资源，发挥管理团队和技术团队能动性，进一步向兼顾晶圆代工产品和设计服务能力的综合性晶圆制造企业发展，逐步形成显示驱动、图像传感、微控制器、电源管理四大集成电路特色工艺应用产品线。

## 十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股意向书签署日，发行人不存在其他重大影响的事项。

## 第三节 风险因素

投资者在评价判断本公司股票价值时，除仔细阅读本招股意向书提供的其他资料外，应该特别关注下述各项风险因素。

### 一、与发行人相关的风险

#### （一）经营业绩下滑的风险

报告期各期，发行人营业收入分别为 151,237.05 万元、542,900.93 万元和 1,005,094.86 万元，归属于母公司普通股股东的净利润分别为-125,759.71 万元、172,883.20 万元和 304,543.08 万元。报告期内，随着发行人产销量的提高，发行人的营业收入已有所上升，盈利水平逐步改善，发行人整体经营业绩已有所提升。

2022 年第三季度以来，受消费性终端需求疲软的影响，晶圆代工行业景气度下行，发行人 2022 年下半年经营业绩承压，其中第三季度盈利水平环比出现下降，第四季度出现单季亏损；同时，发行人合理预计 2023 年第一季度仍将出现亏损，具体预计情况详见本招股意向书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后的主要经营状况”。

未来，不排除受市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，下游市场需求可能发生波动。如果发行人未能及时应对上述市场变化，将面临经营业绩下滑和亏损的风险。

#### （二）制程节点技术研发滞后的风险

发行人所处的晶圆代工行业技术更新迭代快，研发周期长。自设立至今，发行人专注于 12 英寸晶圆代工业务，已实现 150nm-90nm 制程节点量产，正在进行 55nm 制程技术平台的风险量产，但台积电、联华电子、中芯国际等行业领先企业已达 5nm、14nm 等制程节点，发行人与之存在差距。根据发行人规划，发行人拟进一步研发更先进制程，技术研发难度不断增加，对工艺、设备、原材料、研发人员的要求将进一步提升。如无法及时完成相关技术平台的研发以响应市场需求，将对发行人的市场竞争力及市场份额造成不利影响。

### （三）工艺平台技术研发无法满足市场需求的风险

发行人报告期内形成主营业务收入的工艺平台应用领域主要为 DDIC，正在研发中的工艺平台应用领域主要为 CIS、MCU 及 PMIC。以上工艺平台的终端市场应用主要为液晶面板、手机、车用、消费电子等，具有技术革新速度快、产品需求多元化等特点。如发行人工艺平台技术研发方向、进度、成果等无法满足市场需求，将可能导致发行人前期研发投入难以收回、发行人代工服务应用领域难以拓展，对发行人经营造成不利影响。

### （四）技术研发投入不足的风险

发行人所处的晶圆代工行业研发投入大，随着制程不断缩小，研发投入将进一步增长。报告期内，发行人研发费用分别为 24,467.56 万元、39,668.49 万元和 85,707.00 万元，占营业收入比重分别为 16.18%、7.31%和 8.53%。如发行人后续研发投入不足，亦可能造成研发进度滞后，导致发行人失去技术优势并存在产品被竞争对手替代的风险，从而对公司稳定经营产生不利影响。

### （五）研发人员不足或流失的风险

发行人所处的晶圆代工行业属于技术密集型行业，技术研发涉及多学科交叉，生产工艺流程复杂，对研发人员专业程度、经验水平均有较高要求。不断吸纳技术人才、持续扩充研发团队是集成电路企业增加竞争力的重要因素。近年来，我国集成电路行业发展迅速，但相关人才储备仍有缺口，人员专业程度存在不足。目前集成电路行业人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人研发人员 1,388 人，占发行人员工比例 32.86%。发行人正在进行 55nm 低功耗逻辑及触控与显示驱动整合技术等技术平台的研发、风险量产工作，人才需求较大。如发行人无法持续吸引人才并扩充研发团队，或发行人无法留住研发人员并保持研发团队的稳定性，将对发行人的技术研发及生产经营造成不利影响。

### （六）发行人与行业领先企业相比，在技术水平、业务规模、盈利能力等方面存在较大差距的风险

技术水平方面，自设立至今，发行人专注于 12 英寸晶圆代工业务，已实现 150nm-90nm 制程节点量产，正在进行 55nm 制程技术平台的风险量产。但台积电、联

华电子、中芯国际等全球行业领先企业已达 5nm、14nm 等制程节点，发行人与之存在较大差距。

业务规模和盈利能力方面，报告期内，发行人主营业务收入分别为 151,186.11 万元、542,084.44 万元和 1,002,549.95 万元；2020 年至 2022 年，产能分别为 266,237 片/年、570,922 片/年和 1,262,110 片/年；综合毛利率分别为-8.57%、45.13%和 46.16%；净利润分别为-125,759.71 万元、172,883.20 万元和 315,619.62 万元，毛利率、业务规模和市场占有率低于台积电、联华电子等行业领先企业，发行人在业务规模和盈利能力等方面与行业领先企业存在较大差距。

如果发行人无法在未来持续推动技术进步，丰富产品结构、拓展客户、提高业务规模和市场占有率、增强盈利能力，将可能难以缩短与行业领先企业的差距，在激烈的市场竞争中受到不利影响。

#### **（七）晶圆代工服务的产品应用领域单一，后续研发投入大，业务拓展面临技术风险**

报告期内，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务，主要向客户提供 DDIC 及其他工艺平台的晶圆代工服务，上述晶圆代工服务的产品应用领域主要为面板显示驱动芯片领域。报告期内，发行人 DDIC 晶圆代工服务形成的收入合计分别为 148,394.24 万元、467,914.67 万元和 714,261.58 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.15%、86.32%和 71.24%，形成主营业务收入的晶圆代工服务的产品应用领域较为单一。

晶圆代工客户对发行人技术迭代和产品多元化的要求日益提高。报告期内，发行人研发费用分别为 24,467.56 万元、39,668.49 万元和 85,707.00 万元，呈逐年上升趋势，主要用于 55nm、40nm、28nm 等更先进制程研发，以及 CIS、MCU、PMIC 等其他产品技术平台拓展；未来，发行人将投入 49 亿元募集资金用于合肥晶合集成电路先进工艺研发项目，其中包括 55nm 后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台、40nm MCU 工艺平台、40nm 逻辑芯片工艺平台、28nm 逻辑及 OLED 芯片工艺平台等项目研发。随着制程节点进一步提升及技术平台种类增加，预计发行人研发投入将持续增长。

如发行人在面板显示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降，且未能及时完成 CIS、MCU 的扩产和 PMIC 等其他技术平台的研发及量产工作，无法在短时间内形成多元化的产品应用领域结构，或先进制程节点研发进度滞后，则可能对发行人的经营业绩造成不利影响。



### （八）客户集中度较高的风险

报告期内，发行人前五大客户的销售收入合计分别为 135,804.49 万元、380,807.45 万元和 608,959.01 万元，占营业收入的比例分别为 89.80%、70.14%和 60.59%，客户集中度较高。发行人目前与主要客户维持了长期业务往来关系并与部分客户签署了长期框架协议，如果发行人的主要客户生产经营出现问题，导致其向发行人下达的订单数量下降，则可能对发行人的业绩稳定性产生影响。未来，若发行人无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，将可能对发行人经营业绩产生不利影响。

### （九）供应商集中度较高的风险

报告期内，发行人向前五大原材料供应商采购额合计分别为 33,895.37 万元、59,363.58 万元和 93,108.26 万元，占原材料采购总额比例分别为 53.58%、47.35%和 45.65%，供应商集中度较高。

报告期内，发行人向境外供应商采购主要设备占比分别为 94.26%、95.31%和 94.77%，虽然在报告期内呈现出一定的下降趋势，但是发行人向境外供应商采购主要设备占比仍然较高，存在依赖境外供应商的情形；硅片采购方面，发行人硅片采购主要集中于 Global Wafers Co., Ltd.，2022 年度的采购占比达 55.61%，存在单一供应商依赖及境外供应商依赖的情形。

如未来由于贸易摩擦、关税制度或其他不可抗力因素导致原材料或设备供应商延迟交货、限制供应或提高价格，致使发行人原材料或生产设备无法顺利取得或取得成本大幅增加，而发行人未能及时找到替代供应商，则发行人持续生产经营能力将受到不利影响。

### （十）IP 授权商终止对公司授权的风险

根据集成电路行业垂直分工模式，主要可分为芯片设计企业、芯片制造企业、芯片封测企业，此外还有设备制造商、IP 授权商等。其中 IP 授权商设计特定功能的集成电路模块并提供给其他集成电路公司使用，通过收取技术授权费用的方式营利。

报告期内，公司与 IP 授权商签订了技术授权协议，通过支付设计服务费及权利金的方式取得相关第三方 IP 授权，该等技术授权具体情况详见招股意向书“第五节 业务与技术”之“五、与发行人业务相关的主要资产情况”之“（三）主要无形资产”

之“5、被授权使用的知识产权”。报告期内，发行人使用了上述第三方 IP 授权的产品所形成的主营业务收入占发行人主营业务收入的比重分别为 77.58%、69.38%和 79.81%。

以上授权 IP 为公司相应技术平台的重要组成部分，如公司在技术授权协议到期后，因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素，无法与其中部分 IP 授权商继续签订授权协议或取得 IP 授权成本大幅增加，且公司无法在合理期限内自行开发或找到其他 IP 授权商，则会对公司正常生产经营产生不利影响。

#### **（十一）报告期内，发行人与力晶科技及力积电从事同类型业务的风险**

报告期内，发行人与力晶科技及力积电均从事晶圆代工业务。力晶科技与发行人独立开展经营活动，力晶科技作为发行人股东，通过委派董事正常参与发行人具体生产经营管理，不存在通过股东地位及委派董事导致双方非公平竞争、利益输送、相互或单方让渡商业机会的情形。倘若未来公司治理和内部控制体系不能有效运行，内部管理不能适应发展需要，将影响公司持续、稳定、健康的发展。

#### **（十二）力晶科技未来退出影响发行人后续经营的风险**

在公司治理方面，晶圆代工行业具有较高的专业性，力晶科技系半导体行业国际知名企业，在晶圆代工领域具有多年的行业经验，力晶科技及其提名的董事在参与公司董事会、股东大会时，对于公司治理方面起到积极促进作用，公司的经营及重大决策在目前的治理结构下运行稳定。未来，如力晶科技退出发行人，公司现有股东大会、董事会的结构将发生变化，若发行人未能及时找到合适的董事人选，或新进股东、新任董事不认同公司目前的管理层及经营策略，可能会对公司治理造成不利影响。

#### **（十三）控股股东控制的风险**

截至本招股意向书签署日，公司控股股东合肥建投及其一致行动人合肥芯屏合计控制公司本次发行前 52.99%的股份。本次发行完成后，公司控股股东仍为合肥建投。虽然公司已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理机构和公司制度，但不能排除在本次发行后控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、人事决策等进行控制进而影响其他股东利益的可能性。

#### （十四）公司规模扩张带来的管理风险

报告期内，公司进行新厂建设，资产规模、业务规模和员工数量均持续增长。截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司总资产分别为 1,564,233.24 万元、3,127,227.47 万元和 3,876,457.45 万元，公司员工总数分别为 1,666 人、2,720 人和 4,224 人。公司规模快速扩张会使得公司的组织结构和经营管理趋于复杂化，对公司的管理水平将提出更高的要求。此外，公司成功上市后，也将面对资本市场的考验和更高的管理要求，公司可能存在一定的管理风险。

#### （十五）政府补助政策变化风险

报告期各期，公司获得的计入当期损益的政府补助金额分别为 8,706.06 万元、18,975.01 万元和 15,895.57 万元，均属于非经常性损益。未来，若政府部门对公司的支持政策发生变化，公司能否继续获得政府补助以及获得政府补助的金额等存在不确定性，进而对公司盈利水平产生一定的影响。

#### （十六）应收账款坏账风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 26,522.01 万元、94,885.30 万元和 50,874.52 万元，应收账款账面余额占当期营业收入的比例分别为 17.54%、17.48%和 5.06%。公司应收账款集中度较高，报告期内前五大应收账款账面余额占比分别为 97.26%、76.09%和 70.17%。若出现宏观经济环境不佳、行业周期景气度差、重要客户经营状况出现恶化等不利情形，公司可能存在应收账款发生坏账的风险。

#### （十七）存货跌价风险

报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 38,579.42 万元、78,700.55 万元和 102,165.32 万元，占总资产比例分别为 2.47%、2.52%和 2.64%，呈现不断增长态势。

报告期各期末，公司的存货跌价准备金额分别为 3,559.33 万元、2,315.43 万元和 32,705.17 万元，对应期末余额的计提比例分别为 8.45%、2.86%和 24.25%，2022 年末，公司存货跌价准备计提比例增长，主要系受公司产能利用率下降等原因影响，导致存货可变现净值降低所致。公司存货跌价准备的计提主要系公司尚处于产能、产量爬坡阶段，同时由于设备等生产性长期资产投入大，单位产品承担较大的折旧、摊销导致单位产品生产成本高于可变现净值，进而计提较多存货跌价准备。如果未来公司产能、产量爬坡未达预期，可能持续存在存货跌价风险。

### （十八）固定资产投资风险

晶圆代工行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、设备购置成本高，而公司近年为紧抓行业发展机遇积极进行产能扩充，固定资产投资规模较大。截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定资产的账面价值为 2,143,736.82 万元，占公司总资产的比例为 55.30%；公司在建工程的账面价值为 138,504.36 万元，占公司总资产的比例为 3.57%。公司持续的产能扩充对后续资金投入提出了较高要求，公司的资金筹措能力面临较大的考验。同时，若公司未来收入规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，公司将面临盈利能力下降的风险。

### （十九）无形资产减值风险

报告期各期末，发行人的无形资产账面价值分别为 129,948.64 万元、125,422.67 万元和 143,392.28 万元，占非流动资产的比例分别为 12.43%、5.24%和 5.13%。发行人的无形资产主要由专利构成。

报告期内，公司每年均对无形资产进行减值测试。2020 年度，公司受外部环境、产品结构规划调整等因素影响，当期计提无形资产减值准备 29,573.92 万元；2021 年度及 2022 年度公司无形资产因未有减值迹象而未计提减值准备。如果未来出现市场环境变化、产业变革、技术更新迭代等导致发行人产品市场需求下降的情形，则可能有继续产生无形资产减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

### （二十）偿债能力下降的风险

为满足较大资本开支需求，公司资产负债率维持在较高水平。报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 54.24%、68.38%和 53.44%。目前公司尚处于产能持续扩充阶段，后续资金投入需求较高，若未来公司不能保持较好的盈利能力并有效拓宽融资渠道，将面临一定偿债能力下降的风险。

### （二十一）核心技术失密风险

发行人拥有若干具有自主知识产权的核心技术，是发行人保持行业竞争优势的关键和核心竞争力的体现，公司核心技术人员的稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。若公司未来不能有效保护知识产权、核心技术及商业秘密，则可能削弱公司核心竞争优势，进而对发行人的生产经营产生不利影响。

## （二十二）知识产权风险

发行人所处的半导体行业属于典型的技术密集型行业。发行人一方面重视自身研发体系的自主性与合规性，竭力避免自身技术和产品落入竞争对手专利的保护范围；另一方面发行人也重视对自主知识产权的保护，建立了知识产权保护体系。若发行人被第三方提出知识产权侵权指控，或者发行人自身的知识产权被第三方侵犯，将导致公司发生知识产权纠纷或诉讼，对发行人的生产经营造成不利影响。

## （二十三）向控股股东子公司租赁主要生产经营用地及厂房的风险

截至本招股意向书签署之日，发行人及其子公司均无自购或自建房产，公司所有生产经营场所均为租赁。公司主要生产经营用地、厂房位于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，其土地使用权及房屋所有权系控股股东子公司合肥蓝科拥有。

2017 年 6 月 28 日，合肥蓝科与晶合有限已签订《电子器件厂房设施租赁合同》，约定晶合有限租赁电子器件厂房，租赁期限自 2017 年 6 月 28 日（交付日）至 2037 年 6 月 27 日（终止日），且如发行人无重大营运问题，将自动按原条件续约。2021 年 4 月 8 日，合肥蓝科同发行人已签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》，约定租赁范围为晶合二厂洁净室与厂务设施及配套设施，租赁期限为 10 年，具体起租时间以实际交付日为准，租赁期满后，发行人有优先承租权，续租协议由双方另行协商确定。

但若租赁合同到期后，新租赁合同商务条款发生重大不利变化或产权人不愿与公司续签新租赁合同，或公司未来收购制造基地厂房或者厂务设施存在障碍等，公司将面临续租成本增加甚至无法续租的风险。若公司此时未拥有能够替代的土地、房产，将会对公司的生产经营产生不利影响。

2021 年 8 月 12 日，公司召开 2021 年第一届第六次董事会审议通过了《关于变更上市募投项目的议案》。2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。募投项目变更后，拟使用 31 亿募集资金用于收购制造基地厂房及厂务设施，以保证发行人的独立性及资产的完整性。

## （二十四）安全生产风险

发行人高度重视安全生产，制定了完备的安全生产管理规范，建立了完善的安全生产管理体系。但由于发行人的生产工艺复杂，在生产中会使用操作难度高的大型设

备、腐蚀性化学品等，存在一定危险性且对操作人员的技术要求较高。如果员工在日常生产过程中出现操作不当、设备使用失误等意外事故，发行人将面临安全生产事故、人员伤亡及财产损失等风险。

### （二十五）环境保护风险

发行人的生产过程会产生废水、废气、固体废弃物和噪声，需遵守环境保护方面的相关法律法规。发行人在日常生产经营过程中，积极配合当地环境保护部门履行环保义务，投入大量人力、财力、物力完善环保设施、提高环保能力，并制定了严格的环保制度。但随着国家对环境保护的日益重视，民众环保意识的不断提高，有关国家政策、法律法规的出台可能对发行人的生产经营提出更为严格的要求。若发行人不能及时对生产设施进行升级改造以提高对废水、废气和固体废弃物的处理能力，满足更为严格的环保标准和环保要求，甚至发生环境污染事件，将给发行人生产经营带来不利影响。

## 二、与行业相关的风险

### （一）晶圆代工业务投资规模大，受下游景气度影响较大的风险

发行人所处的晶圆代工行业技术更新迭代快、资金投入大、研发周期长，属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、设备购置成本高，而公司近年来不断进行产能扩充，固定资产投资规模较大。截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定资产的账面价值为 2,143,736.82 万元，占公司总资产的比例为 55.30%；公司在建工程的账面价值为 138,504.36 万元，占公司总资产的比例为 3.57%。未来，公司将进一步扩充产能并提高研发投入以满足下游客户对发行人稳定性更高、平台更多元的晶圆代工服务需求，公司也将提高对固定资产的投入，资金筹措能力面临较大的考验。

同时，2020 年-2022 年间，发行人营业收入由 151,237.05 万元上升至 1,005,094.86 万元，年均复合增长率达到 157.79%。发行人营业收入快速增长与下游市场需求息息相关。2018 年-2020 年间，中国大陆晶圆代工行业市场规模由 107.3 亿美元上升至 148.9 亿美元，年均复合增长率为 17.8%；中国大陆 DDIC 出货量由 38.5 亿颗上升至 52.7 亿颗，年均复合增长率为 17%。晶圆代工行业受下游景气度影响较大，不排除未来市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，导致下游市场需求

发生波动进而对发行人业绩造成不利影响。

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 47,282.88 万元、957,388.50 万元和 628,003.34 万元。如发行人无法维持充足的现金流，导致业务拓展困难、市场开拓无法达到预期；或未能及时应对下游市场变化，导致经营业绩下滑，将对公司稳定经营产生不利影响。

## （二）国际贸易摩擦的风险

发行人使用的主要生产设备，硅片、设备零配件等主要原材料均主要通过向境外企业采购取得。发行人的部分主要客户亦为境外企业，报告期各期，公司向境外客户销售产品实现主营业务收入分别为 126,253.69 万元、317,382.24 万元和 453,647.82 万元，占公司主营业务收入比例为 83.51%、58.55% 和 45.25%。

未来，如果因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素造成公司设备、原材料进口成本增加，产品境外销售利润率下降。基于目前国际政治环境、多边合作关系变动、各大经济体贸易政策存在不确定性，发行人的境外采购及销售可能因此受到影响。倘若未来国际贸易环境发生重大不利变化，一方面，发行人直接向境外采购可能会受到不利影响，另一方面，发行人的中国大陆供应商可能会受到不利影响进而使发行人的采购受到不利影响，该等不利影响可能将导致发行人无法采购相关生产设备或生产设备的零配件，进而可能导致发行人面临关键设备采购不到位影响生产的风险。

## （三）产业政策变化的风险

近年来，国务院推出了《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等多项产业政策，促进集成电路行业发展；我国各级政府亦为集成电路企业提供了相关政策支持，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予一系列优惠措施，进一步加强信息产业的创新能力和国际竞争力。如未来上述产业政策出现不利变化，将对发行人的业务布局、人才引进、生产经营产生一定不利影响。

## （四）行业波动导致的产能利用率降低的风险

根据 TrendForce 的统计与分析，2021 年，5G 及新能源汽车兴起带动半导体需求增加，晶圆厂产能又无法快速投产，产能缺口不断扩大。但是在 2022 年，智能手机、

消费电子需求下行，受到消费性终端需求疲软的影响，整体而言，2022年第三季度起产能缺口情况有所缓解，使得晶圆代工产能利用率面临挑战。发行人作为半导体晶圆代工企业，生产经营会受到行业整体需求变化及周期性波动的影响，倘若发行人不能在行业波动中调整经营策略、挖掘客户需求、维护客户关系，则存在产能利用率降低的风险。

### （五）汇率波动风险

公司的记账本位币为人民币，而部分交易采用美元、日元等外币计价。报告期内，公司汇兑收益分别为-3,246.73万元、14,346.43万元和27,458.14万元。公司在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，合理控制外汇风险敞口。但未来若境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，公司仍将面临汇兑损失的风险。

## 三、其他风险

### （一）本次发行失败的风险

发行人本次申请首次公开发行股票并上市，发行结果将受到发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、公司经营业绩及发展前景、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内外部因素的影响，发行人存在因发行认购不足等未能达到上市条件的情形而导致的发行失败风险。

### （二）与募集资金相关的风险

发行人本次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金额 (亿元)
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	晶合集成	49.0
1.1	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目 (包含 90 纳米及 55 纳米)	晶合集成	6.0
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目 (包含 55 纳米及 40 纳米)	晶合集成	3.5
1.3	40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	晶合集成	15.0
1.4	28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	晶合集成	24.5
2	收购制造基地厂房及厂务设施	晶合集成	31.0



序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金额 (亿元)
3	补充流动资金及偿还贷款	晶合集成	15.0
	合计		95.0

本次募集资金投资项目金额较大，新增研发工艺平台种类及数量较多，募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关。如果未来 DDIC、CIS、MCU、OLED 芯片等产品的市场需求或该等产品的终端应用的市场需求不及预期，行业竞争加剧或集成电路市场环境发生重大变化，或如果未来后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台、微控制器芯片工艺平台、40 纳米逻辑芯片工艺平台和 28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台的研发失败或研发成果不达预期，募集资金投资项目未能按照计划顺利实施，发行人则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。

### （三）公司触发退市条件的风险

未来公司上市后，若生产经营环境发生重大不利变化，或者公司经营决策出现重大失误，公司将可能持续亏损，营业收入、净资产大幅下降，导致营业收入低于 1 亿元，或者净资产为负，触发退市风险警示标准，甚至出现明显丧失经营能力情形，从而触发退市标准，出现退市风险。

同时，未来公司上市后，若生产经营环境发生重大不利变化，或者公司经营决策出现重大失误，发行人股票投资价值将大幅下降，将可能出现交易不活跃情形，股票市值及交易价格、股票交易量、股东数量可能因公司投资价值大幅降低而触发退市标准，出现退市风险。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人的基本信息

中文名称：合肥晶合集成电路股份有限公司

英文名称：Nexchip Semiconductor Corporation

注册资本：150,460.1368 万元人民币

法定代表人：蔡国智

有限公司成立日期：2015 年 5 月 19 日

股份公司成立日期：2020 年 11 月 25 日

住所：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号

邮政编码：230011

联系电话：0551-62637000

互联网网址：[www.nexchip.com.cn](http://www.nexchip.com.cn)

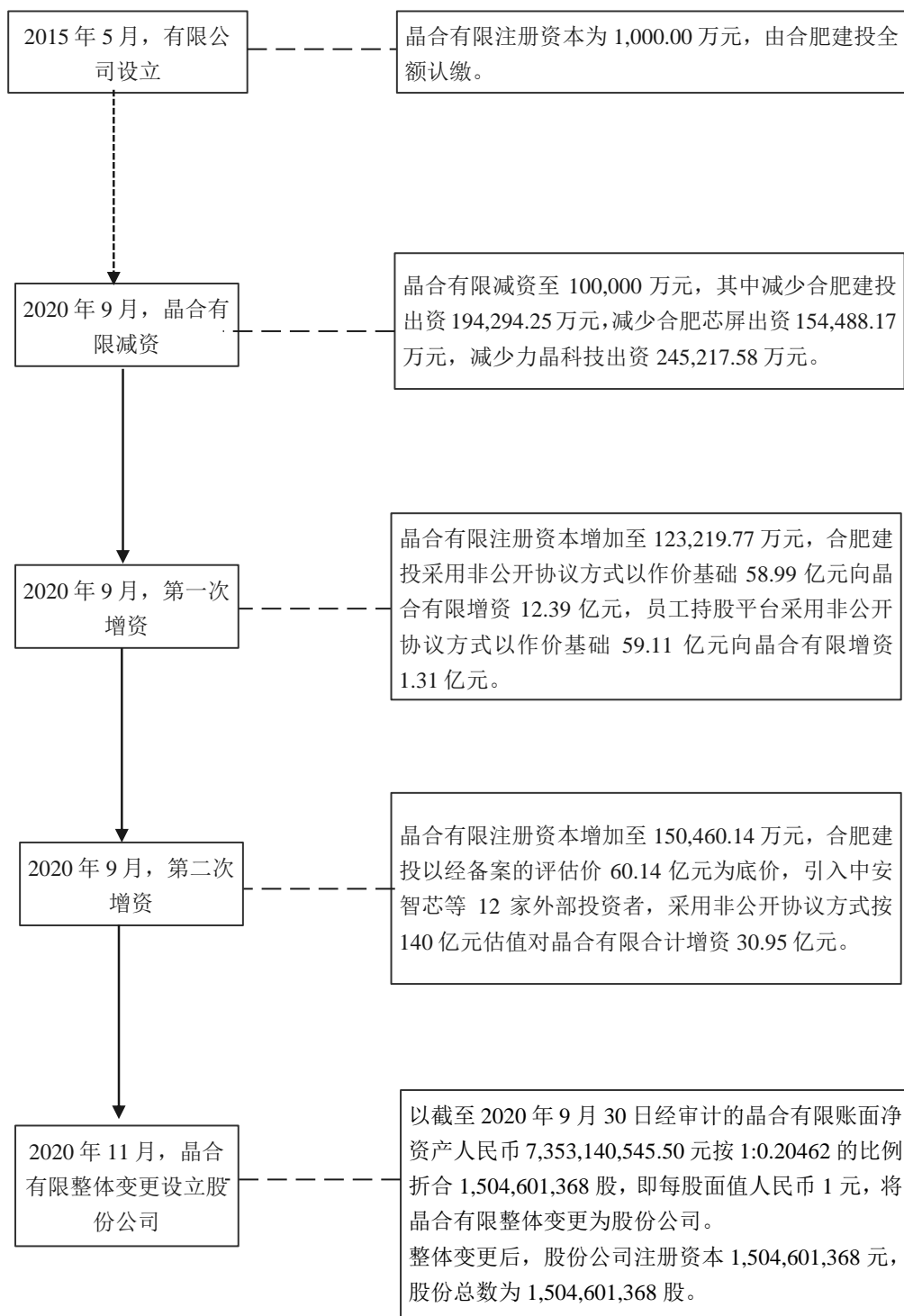
电子信箱：[stock@nexchip.com.cn](mailto:stock@nexchip.com.cn)

信息披露和投资者关系负责部门：证券事务部

信息披露和投资者关系负责部门负责人：朱才伟

信息披露和投资者关系负责部门联系电话：0551-62637000

## 二、发行人设立及股本和股东变化情况



## （一）有限责任公司设立情况

2015年4月27日，合肥市人民政府与力晶科技签署《12吋晶圆制造基地项目合作框架协议书》，约定双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区12吋晶圆制造基地项目。

2015年5月12日，合肥市国资委下发《关于同意组建合肥晶合集成电路股份有限公司的批复》（合国资产权[2015]60号），同意合肥建投组建全资子公司合肥晶合集成电路股份有限公司（以工商登记为准），注册资本为1,000.00万元。

2015年5月19日，合肥建投签署《合肥晶合集成电路有限公司章程》，晶合有限注册资本为1,000.00万元，由合肥建投全额认缴。

2015年5月19日，合肥市工商行政管理局向晶合有限核发了《营业执照》（注册号：340108000130981）。

2021年3月12日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0049号），经复核，截至2015年5月29日，晶合有限已收到合肥建投缴纳的实收资本合计1,000.00万元。

晶合有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

## （二）股份有限公司设立情况

### 1、股份有限公司的设立

2020年10月19日，容诚出具以2020年9月30日为基准日的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3994号），截至2020年9月30日，晶合有限账面净资产为7,353,140,545.50元。

2020年10月21日，中水致远出具了《合肥晶合集成电路有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020502号），以2020年9月30日为基准日对晶合有限的净资产进行评估，评估值为918,198.75万元。2020

年 11 月 9 日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2020 年 10 月 21 日，晶合有限董事会作出决议，同意以 2020 年 9 月 30 日为股改基准日将晶合有限整体变更为股份公司，原公司章程自股份公司完成设立登记之日起自动终止。

2020 年 11 月 5 日，晶合有限全体股东签署《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》，一致同意以晶合有限净资产折股整体变更的方式共同发起设立股份公司。

2020 年 11 月 12 日，合肥市国资委出具《关于同意合肥晶合集成电路有限公司变更为合肥晶合集成电路股份有限公司的批复》（合国资产权[2020]105 号），同意按照《公司法》的规定，以截至 2020 年 9 月 30 日经审计的晶合有限账面净资产人民币 7,353,140,545.50 元按 1:0.20462 的比例折合 1,504,601,368 股，即每股面值人民币 1 元，将晶合有限变更为晶合集成。

2020 年 11 月 20 日，发行人召开创立大会，以截至 2020 年 9 月 30 日股改基准日经容诚审计的晶合有限账面净资产 7,353,140,545.50 元为基础，按 1: 0.204620 的比例折合 1,504,601,368 股，每股面值为人民币 1 元，将晶合有限整体变更为股份公司。整体变更后，股份公司注册资本 1,504,601,368 元，股份总数为 1,504,601,368 股，整体变更后股份公司的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

2020 年 11 月 20 日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号），经审计，截至 2020 年 11 月 20 日，发行人之全体发起人已按发起人协议和公司章程的规定，以其拥有的晶合有限截至 2020 年 9 月 30 日止经审计的净资产人民币 7,353,140,545.50 元，按照 1:0.204620 比例折合股份 1,504,601,368 股，完成缴纳注册资本人民币 1,504,601,368 元，整体变更后的股本与整体变更前的注册资本保持一致。

2020 年 11 月 25 日，合肥市市场监督管理局向发行人核发《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

发行人整体变更设立后的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	合肥建投	468,474,592	31.14

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
2	合肥芯屏	328,736,799	21.85
3	力晶科技	412,824,208	27.44
4	美的创新	88,014,118	5.85
5	中安智芯	39,606,354	2.63
6	惠友豪创	26,404,236	1.75
7	合肥存鑫	26,404,236	1.75
8	海通创新	17,602,824	1.17
9	杭州承富	15,402,471	1.02
10	泸州隆信	13,202,118	0.88
11	宁波华淳	13,202,118	0.88
12	中小企业基金	13,202,118	0.88
13	安华创新	8,801,412	0.58
14	集创北方	8,801,412	0.58
15	中金浦成	1,760,282	0.12
16	合肥晶煨	5,195,398	0.35
17	合肥晶遂	4,197,429	0.28
18	合肥晶炯	3,813,060	0.25
19	合肥晶咖	1,456,606	0.10
20	合肥晶珏	1,262,054	0.08
21	合肥晶梢	1,174,082	0.08
22	合肥晶柔	862,798	0.06
23	合肥晶悬	852,648	0.06
24	合肥晶本	779,902	0.05
25	合肥晶洛	581,966	0.04
26	合肥晶辽	497,378	0.03
27	合肥晶确	414,481	0.03
28	合肥晶铁	414,481	0.03
29	合肥晶妥	406,023	0.03
30	合肥晶雄	253,764	0.02
	<b>合计</b>	<b>1,504,601,368</b>	<b>100.00</b>

## 2、有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为负的情况

### (1) 有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为负的形成原因

2020年10月19日，容诚出具以2020年9月30日为基准日的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3994号），截至2020年9月30日，晶合有限账面净资产为7,353,140,545.50元，其中，未分配利润为-4,172,660,675.85元。

公司整体变更基准日未分配利润为负的原因为：晶圆代工行业系技术密集型和资本密集型行业，对研发能力和资本实力等要求较高。公司成立以来至2020年度，为满足产能扩充需求，持续追加生产设备等资本性投入，固定成本规模较高，同时从项目建设到落地达产，再到实现规划产能需要一定周期，因此在产能爬坡初期、产销规模相对有限的情况下公司处于亏损状态，符合行业特点。

### (2) 该情形是否已消除，整体变更后的变化情况及未来发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响

截至2022年12月31日，公司未分配利润为负的情形已消除，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日
股本	150,460.14
资本公积	1,120,907.35
盈余公积	2,657.60
未分配利润	37,910.23
其他综合收益	480.35
归属于母公司所有者权益合计	1,312,415.66
少数股东权益	492,580.58
所有者权益合计	1,804,996.24

截至2022年12月31日，公司未分配利润为负的情形已消除，与公司报告期内盈利水平变动情况相匹配。报告期内，公司曾存在未分配利润为负的情形，主要是由于晶圆代工行业系技术密集型和资本密集型行业，公司于2015年成立，成立时间较短，目前仍处于产能扩张、技术升级阶段，固定资产投资、研发投入金额较大，前期产生的固定成本分摊较大，单位成本较高，从而自成立至2020年度期间产生亏损。报告期

内，公司营业收入、毛利率、净利率、研发投入、主营业务成本中制造费用情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	1,005,094.86	542,900.93	151,237.05
毛利率	46.16%	45.13%	-8.57%
制造费用	464,523.69	264,042.06	146,963.68
制造费用占营业收入的比例	46.22%	48.64%	97.17%
研发投入	85,707.00	39,668.49	24,467.56
研发投入占营业收入的比例	8.53%	7.31%	16.18%
净利润	315,619.62	172,883.20	-125,759.71
净利率	31.40%	31.84%	-83.15%

由上表可知，报告期内，随着晶圆代工行业市场需求的增长以及公司产能的逐步释放，公司营业收入实现大幅增长，规模效应逐渐显现，毛利率、净利率指标于2021年度由负转正，公司经营状况持续改善。同时，公司高研发投入、高制造费用等因素对业绩的影响明显减弱。长期来看，未来随着公司产能的进一步释放，以及产品市场认可度的提升，公司规模效应将进一步显现，从而提升公司盈利能力。

### (3) 整体变更的具体方案及相应的会计处理

截至2020年9月30日，晶合有限经容诚审计的实收资本为1,504,601,368.00元，资本公积为10,021,199,853.35元，未分配利润为-4,172,660,675.85元，所有者权益为7,353,140,545.50元。

2020年11月20日，发行人召开创立大会，以截至2020年9月30日股改基准日经容诚审计的晶合有限账面净资产7,353,140,545.50元为基础，按1: 0.204620的比例折合1,504,601,368股，每股面值为人民币1元，将晶合有限整体变更为股份公司。整体变更后，股份公司注册资本1,504,601,368元，股份总数为1,504,601,368股，整体变更后股份公司的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前保持不变。



### （三）报告期内的股本和股东变化情况

2020年初，晶合有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	227,003.72	32.71
2	合肥芯屏	180,496.28	26.01
3	力晶科技	286,500.00	41.28
合计		<b>694,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 1、2020年9月，晶合有限减资

截至2020年7月31日，晶合有限实收资本694,000.00万元，净资产规模低于实收资本，即每一元实收资本对应的净资产金额低于一元。

2020年7月24日，合肥市国资委出具《关于合肥晶合集成电路有限公司减少注册资本的意见》，晶合有限应按照《公司法》等有关规定，依法合规进行晶合有限减少注册资本工作。

2020年7月29日，晶合有限董事会通过决议，同意公司注册资本核减594,000.00万元，核减的注册资本金额将等额计入资本公积，晶合有限净资产及各股东对晶合有限的持股比例保持不变。

2020年8月1日，晶合有限在安徽日报上刊登了减资公告，履行了债权人通知义务。

2020年9月10日，晶合有限董事会通过决议，由于债权人对公司核减注册资本无异议，拟于减资公告发布45日期满后，向主管政府机关申请减资。

2020年9月15日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0190号），经审验，截至2020年9月15日，公司已减少实收资本594,000.00万元，其中减少合肥建投出资194,294.25万元，减少合肥芯屏出资154,488.17万元，减少力晶科技出资245,217.58万元；变更后公司的累计注册资本为100,000.00万元，实收资本100,000.00万元。

2020年9月15日，合肥市市场监督管理局向晶合有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

本次减资完成后，晶合有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	32,709.47	32.71
2	合肥芯屏	26,008.11	26.01
3	力晶科技	41,282.42	41.28
合计		<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、2020年9月，晶合有限第一次增资

为进一步建立、健全公司的激励机制，形成对核心员工的有效激励与约束，增强公司凝聚力，保持公司在市场、技术及管理方面的竞争力，晶合有限拟引入员工持股平台增资。

2020年7月1日，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟向其他投资者推介所涉及的合肥晶合集成电路有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2020]第080号），以2019年12月31日为基准日对晶合有限全部股东权益进行评估，评估值为591,071.91万元。2020年9月16日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2020年9月7日，合肥市国资委出具《关于同意对合肥晶合集成电路有限公司增资的批复》（合国资产权[2020]84号），同意合肥建投采用非公开协议方式以作价基础58.99亿元向晶合有限增资12.39亿元，同意员工持股平台采用非公开协议方式以作价基础59.11亿元向晶合有限增资1.31亿元。

2020年9月10日，晶合有限董事会通过决议，同意公司注册资本增加23,219.7669万元，其中合肥建投以货币出资83,400.00万元认缴14,137.99万元新增注册资本，合肥芯屏以货币出资40,500.00万元认缴6,865.57万元新增注册资本，合肥晶煨以货币出资3,071.00万元认缴519.54万元新增注册资本，合肥晶遂以货币出资2,481.10万元认缴419.74万元新增注册资本，合肥晶炯以货币出资2,253.90万元认缴381.31万元新增注册资本，合肥晶咖以货币出资861.00万元认缴145.66万元新增注册资本，合肥晶珏以货币出资746.00万元认缴126.21万元新增注册资本，合肥晶梢以货币出资694.00万元认缴117.41万元新增注册资本，合肥晶柔以货币出资510.00万元认

缴 86.28 万元新增注册资本，合肥晶悬以货币出资 504.00 万元认缴 85.26 万元新增注册资本，合肥晶本以货币出资 461.00 万元认缴 77.99 万元新增注册资本，合肥晶洛以货币出资 344.00 万元认缴 58.20 万元新增注册资本，合肥晶辽以货币出资 294.00 万元认缴 49.74 万元新增注册资本，合肥晶确以货币出资 245.00 万元认缴 41.45 万元新增注册资本，合肥晶铁以货币出资 245.00 万元认缴 41.45 万元新增注册资本，合肥晶妥以货币出资 240.00 万元认缴 40.60 万元新增注册资本，合肥晶雄以货币出资 150.00 万元认缴 25.38 万元新增注册资本。

2020 年 9 月 17 日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0191 号），经审验，截至 2020 年 9 月 17 日，公司已收到新增注册资本 23,219.77 万元，变更后公司的累计注册资本为 123,219.77 万元，实收资本 123,219.77 万元。

2020 年 9 月 16 日，合肥市市场监督管理局向晶合有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

本次增资完成后，晶合有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	46,847.46	38.03
2	合肥芯屏	32,873.68	26.68
3	力晶科技	41,282.42	33.50
4	合肥晶燧	519.54	0.42
5	合肥晶遂	419.74	0.34
6	合肥晶炯	381.31	0.31
7	合肥晶咖	145.66	0.12
8	合肥晶珏	126.21	0.10
9	合肥晶梢	117.41	0.10
10	合肥晶柔	86.28	0.07
11	合肥晶悬	85.26	0.07
12	合肥晶本	77.99	0.06
13	合肥晶洛	58.20	0.05
14	合肥晶辽	49.74	0.04
15	合肥晶确	41.45	0.03
16	合肥晶铁	41.45	0.03
17	合肥晶妥	40.60	0.03

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
18	合肥晶雄	25.38	0.02
	合计	123,219.77	100.00

### 3、2020年9月，晶合有限第二次增资

因公司产能扩充方面的需求，公司与外部投资者进行了接洽，拟引入外部投资者对公司增资。

2020年9月7日，中水致远出具了《合肥晶合集成电路有限公司拟进行增资扩股涉及的合肥晶合集成电路有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020443号），以2020年7月31日为基准日对晶合有限全部股东权益进行评估，评估值为601,400.00万元。2020年9月16日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2020年9月23日，合肥市国资委出具《关于同意引入战略投资者对合肥晶合集成电路有限公司增资扩股的批复》（合国资产权[2020]89号），同意合肥建投以经备案的评估价60.14亿元为底价，引入中安智芯等12家外部投资者，采用非公开协议方式按140亿元估值对晶合有限合计增资30.95亿元。

2020年9月25日，晶合有限董事会通过决议，同意引入中安智芯等12家外部投资者向公司增资，公司注册资本增加27,240.37万元，其中美的创新以货币出资100,000.00万元认缴8,801.41万元新增注册资本，中安智芯以货币出资45,000.00万元认缴3,960.64万元新增注册资本，惠友豪创以货币出资30,000.00万元认缴2,640.42万元新增注册资本，合肥存鑫以货币出资30,000.00万元认缴2,640.42万元新增注册资本，海通创新以货币出资20,000.00万元认缴1,760.28万元新增注册资本，杭州承富以货币出资17,500.00万元认缴1,540.25万元新增注册资本，泸州隆信以货币出资15,000.00万元认缴1,320.21万元新增注册资本，宁波华淳以货币出资15,000.00万元认缴1,320.21万元新增注册资本，中小企业基金以货币出资15,000.00万元认缴1,320.21万元新增注册资本，安华创新以货币出资10,000.00万元认缴880.14万元新增注册资本，集创北方以货币出资10,000.00万元认缴880.14万元新增注册资本，中金浦成以货币出资2,000.00万元认缴176.03万元新增注册资本。

2020年9月27日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0205号），经审验，截至2020年9月27日，公司已收到各股东以货币出资缴纳的新增注册资本27,240.37万元，变更后公司的累计注册资本为150,460.14万元，实收资本为150,460.14万元。

2020年9月28日，合肥市市场监督管理局向晶合有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

本次增资完成后，晶合有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	46,847.46	31.14
2	合肥芯屏	32,873.68	21.85
3	力晶科技	41,282.42	27.44
4	美的创新	8,801.41	5.85
5	中安智芯	3,960.64	2.63
6	惠友豪创	2,640.42	1.75
7	合肥存鑫	2,640.42	1.75
8	海通创新	1,760.28	1.17
9	杭州承富	1,540.25	1.02
10	泸州隆信	1,320.21	0.88
11	宁波华淳	1,320.21	0.88
12	中小企业基金	1,320.21	0.88
13	安华创新	880.14	0.58
14	集创北方	880.14	0.58
15	中金浦成	176.03	0.12
16	合肥晶焮	519.54	0.35
17	合肥晶遂	419.74	0.28
18	合肥晶炯	381.31	0.25
19	合肥晶咖	145.66	0.10
20	合肥晶珏	126.21	0.08
21	合肥晶梢	117.41	0.08
22	合肥晶柔	86.28	0.06
23	合肥晶悬	85.26	0.06
24	合肥晶本	77.99	0.05

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
25	合肥晶洛	58.20	0.04
26	合肥晶辽	49.74	0.03
27	合肥晶确	41.45	0.03
28	合肥晶铁	41.45	0.03
29	合肥晶妥	40.60	0.03
30	合肥晶雄	25.38	0.02
	合计	<b>150,460.14</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2020年11月，整体变更设立股份公司

晶合有限整体变更为股份公司的具体情况请参见本节之“二、发行人设立及股本和股东变化情况”之“（二）股份有限公司设立情况”。

2021年4月12日，合肥市国资委出具《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司历史沿革中涉及国有股权变动事项合规性的函》，确认“晶合集成的设立、历次股权变动、股改等事项均履行了审批程序，符合国资监管的有关规定，不存在损害国有股东权益及造成国有资产流失的情形。”

发行人自整体变更设立股份公司至本招股意向书签署之日，股本和各股东持股股数未发生变化。

#### （四）发行人成立以来重要事件情况

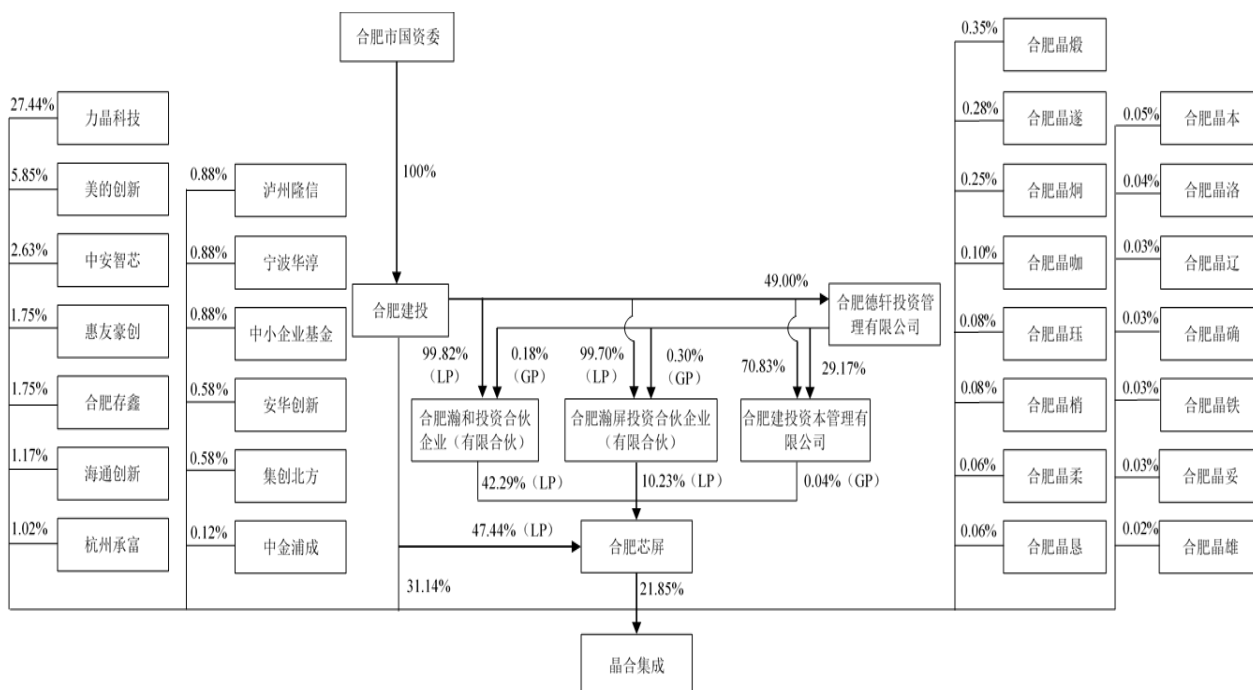
报告期内，发行人不存在重大资产重组等重要事件。

#### （五）公司在其他证券市场的上市、挂牌情况

截至本招股意向书签署之日，发行人未在其他证券市场上市或挂牌。

### 三、发行人股权结构

截至本招股意向书签署之日，发行人股权结构如下图所示：



### 四、发行人控股、参股公司、分公司情况

截至本招股意向书签署之日，发行人共有 4 家控股子公司，1 家分公司，不存在参股公司。

#### (一) 日本晶合

##### 1、基本情况

公司名称	晶合日本株式会社
成立时间	2017年8月18日
注册资本	3.5亿日元
实收资本	3.5亿日元
注册地址	東京都立川市曙町一丁目13番11号立川クレストビル2階
主要生产经营地	東京都立川市曙町一丁目13番11号立川クレストビル2階
股东构成	晶合集成持股 100%
主营业务	为集成电路设计支持服务及技术开发支持
在发行人业务板块中定位	系发行人主营业务的组成部分

## 2、简要财务数据

最近一年，日本晶合的主要财务数据（已经容诚审计）如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	592.04
净资产	463.27
营业收入	1,601.88
净利润	-4.62

## （二）北京晶芯成

### 1、基本情况

公司名称	晶芯成（北京）科技有限公司
成立时间	2020年9月7日
法定代表人	朱才伟
注册资本	20万元人民币
实收资本	20万元人民币
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街29号院一区2号楼13层1302-C54
主要生产经营地	未实际经营
股东构成	晶合集成持股100%
主营业务	未实际经营
在发行人业务板块中定位	未实际经营

### 2、简要财务数据

最近一年，北京晶芯成的主要财务数据（已经容诚审计）如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	8.40
净资产	8.40
营业收入	0
净利润	-0.06



### （三）南京晶驱

#### 1、基本情况

公司名称	南京晶驱集成电路有限公司
成立时间	2020年8月24日
法定代表人	朱才伟
注册资本	20万元人民币
实收资本	20万元人民币
注册地址	南京市秦淮区江宁路5号D栋409-32号
主要生产经营地	未实际经营
股东构成	晶合集成持股100%
主营业务	未实际经营
在发行人业务板块中定位	未实际经营

#### 2、简要财务数据

最近一年，南京晶驱的主要财务数据（已经容诚审计）如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	17.51
净资产	17.51
营业收入	0
净利润	-0.0018

### （四）新晶集成

#### 1、基本情况

公司名称	合肥新晶集成电路有限公司
成立时间	2021年8月24日
法定代表人	周义亮
注册资本	76.889026亿元人民币
实收资本	76.889026亿元人民币

注册地址	合肥市新站区综合保税区内西淝河路 88 号
主要生产经营地	合肥市新站区综合保税区内西淝河路 88 号
股东构成	晶合集成认缴 400,000 万元注册资本，持股 52.02% 建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）认缴 92,222.57 万元注册资本，持股 11.99% 建航晶合二期股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）认缴 30,802.34 万元注册资本，持股 4.01% 建航晶合三期股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）认缴 6,086.69 万元注册资本，持股 0.79% 上海景焯投资管理有限公司认缴 18,444.51 万元注册资本，持股 2.40% 北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）认缴 122,963.42 万元注册资本，持股 15.99% 农银金融资产投资有限公司认缴 61,481.71 万元注册资本，持股 8.00% 农银国际投资（苏州）有限公司认缴 12,296.34 万元注册资本，持股 1.60% 中国东方资产管理股份有限公司认缴 24,592.68 万元注册资本，持股 3.20%
主营业务	集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
在发行人业务板块中定位	系发行人主营业务的组成部分

## 2、简要财务数据

最近一年，新晶集成的主要财务数据（已经容诚审计）如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	1,409,734.54
净资产	1,026,634.96
营业收入	168,422.05
净利润	26,607.59

### （五）上海晶合

公司名称	合肥晶合集成电路股份有限公司上海分公司
成立时间	2019 年 12 月 19 日
负责人	蔡辉嘉
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 3 幢 502 室
主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 3 幢 502 室
主营业务	集成电路相关产品、配套产品的研发及销售
在发行人业务板块中定位	系发行人主营业务的组成部分

## 五、持有发行人 5% 以上的主要股东及实际控制人的基本情况

### （一）控股股东、实际控制人的基本情况

#### 1、控股股东的基本情况

截至本招股意向书签署之日，合肥建投直接持有发行人 31.14% 的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85% 的股份，合计控制发行人 52.99% 的股份，系发行人的控股股东。

合肥建投的基本情况如下：

公司名称	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
成立时间	2006 年 6 月 16 日
法定代表人	李宏卓
注册资本	1,329,800 万元人民币
实收资本	1,329,800 万元人民币
注册地址	合肥市滨湖新区武汉路 229 号
主要生产经营地	合肥市滨湖新区武汉路 229 号
股东构成	合肥市国资委持股 100%
主营业务	承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁
上述主营业务与发行人主营业务的关系	无

最近一年及一期，合肥建投的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (未经审计) <sup>1</sup>	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (已经容诚审计)
总资产	60,027,325.91	55,028,697.43
净资产	20,773,108.90	20,406,958.51
营业收入	2,702,729.96	2,743,753.54
净利润	-210,153.30	808,590.90

<sup>1</sup> 合肥建投因 2022 年度财务报表尚未编制完成，故补充 2022 年 1-9 月的财务数据。

## 2、实际控制人的基本情况

截至本招股意向书签署之日，合肥市国资委持有合肥建投 100%的股权，系发行人的实际控制人。

### (二) 控股股东控制的其他企业

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股股东合肥建投控制的除发行人及其子公司以外的主要企业基本情况如下：

序号	企业名称	注册地址	成立时间	经营范围
1	合肥芯屏	合肥市包河区武汉路 229 号	2016/01/18	投资管理、资产管理；投资咨询。
2	合肥蓝科	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内	2008/11/05	项目投资；基础设施建设；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；房产租赁；仓储（除危险品）物流；房地产开发及经营；科技工业园开发及管理；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会议服务。
3	合肥燃气集团有限公司	合肥市蜀山区合作化南路 466 号	1995/11/13	燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；燃气设备及智能安全家居产品生产销售与安装维修；商务信息咨询；教育信息咨询；保险信息咨询；能源项目建设、开发利用、运营管理；汽车货物运输；自有房产及设备租赁。
4	合肥供水集团有限公司	安徽省合肥市屯溪路 70 号	1994/07/21	许可项目：自来水生产与供应建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水质污染物监测及检测仪器仪表销售业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）建筑材料销售非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5	合肥蜀山百大	安徽省合肥市蜀山区望	2012/06/27	预包装食品批发兼零售（在许可证

序号	企业名称	注册地址	成立时间	经营范围
	购物中心有限公司	江西路 218 号		有效期内经营); 保健食品销售 (李宝赢堂牌参茸酒) (在许可证有效期内经营); 日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、五金交电、化工产品 (除危险品)、文体用品、办公用品、金银珠宝玉器、家具、皮革制品、钟表眼镜、照相器材、工艺品、儿童游乐设施、通讯设备、家电、电子产品、计算机软硬件及配件、劳保用品、建材、装饰材料、儿童用品销售; 卷烟零售; 合肥通卡代收代付 (在协议范围内经营); 物业服务; 企业管理咨询; 房屋租赁。
6	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	安徽省合肥市沿河路 118 号	2000/06/15	预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售、散装食品 (含冷藏冷冻食品、含散装熟食) 销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售; 酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务 (现场制售: 面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐); 农产品收购; 日用百货、针纺织品、家用电器及电子产品、通讯器材销售; 家具、文体用品、五金车件、化工产品 (除危险品)、建筑材料、劳保用品、汽车 (除小轿车) 及配件、摩托车及配件、花卉、玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售; 自营和代理各类商品的进出口业务 (国家限定和禁止企业经营商品除外); 医疗器械销售 (除国家限制项目)、音像制品、图书; 儿童娱乐服务; 彩扩服务; 房屋租赁、场地出租 (涉及许可在许可证有效期内经营); 停车场服务项目; 特殊医学用途配方食品销售; 网络表演; 为本超市销售产品提供配送服务。
7	合肥市建设投资有限公司	合肥市滨湖新区武汉路 229 号	1992/04/15	项目投资、股权投资、资产重组及并购 (未经金融监管部门批准, 不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务); 房屋租赁。
8	合肥交通投资控股有限公司	安徽省合肥市梅山路 77 号	2004/02/11	公路项目建设、营运、收费、咨询及服务; 城乡交通基础设施及相关产业的投资与运营; 营运授权范围

序号	企业名称	注册地址	成立时间	经营范围
				内的国有资产；按照法定程序处置、租赁所属企业土地和房屋资产；国内广告制作、代理、发布；公路服务区经营、策划及住宿、餐饮服务；车辆救援服务及汽车维修；交通工程物资销售；道路普通货运；仓储服务；实业投资；旅游项目的投资开发。
9	合肥城建投资控股有限公司	合肥市滨湖区武汉路229号	2001/12/06	城市建设项目开发和经营，房地产综合开发，对项目和企业进行投资，参股和收购，物资贸易，房屋租赁。
10	合肥百货大楼集团股份有限公司	安徽省合肥市长江中路150号	1996/07/29	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；美发饰品销售；茶具销售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；劳动保护用品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；货物进出口；食品进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；服装制造；服饰制造；鞋制造；塑料制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；停车场服务；化妆品批发；化妆品零售；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除

序号	企业名称	注册地址	成立时间	经营范围
				许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 食品生产; 食品销售; 酒类经营; 烟草制品零售; 药品零售; 城市配送运输服务(不含危险货物); 餐饮服务; 出版物批发; 出版物零售; 出版物互联网销售; 基础电信业务; 游艺娱乐活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11	合肥丰乐种业股份有限公司	中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区长江西路6500号	1997/04/16	主要农作物种子生产; 农作物种子经营; 农药生产; 农药批发; 农药零售; 肥料生产; 食品生产; 食品销售; 茶叶制品生产; 道路货物运输(不含危险货物); 农作物种子进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 非主要农作物种子生产; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 谷物种植; 谷物销售; 花卉种植; 香料作物种植; 蔬菜种植; 棉花种植; 油料种植; 豆类种植; 食用农产品初加工; 粮食收购; 粮油仓储服务; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 肥料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 化肥销售; 日用化学产品制造; 日用化学产品销售; 农副产品销售; 包装材料及制品销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售; 农林牧渔机械配件销售; 农用薄膜销售; 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务; 农作物栽培服务; 货物进出口; 技术进出口。
12	合肥科融高科技产业投资有限公司	安徽省合肥市滨湖新区武汉路229号	2009/11/10	高科技产业风险投资, 企业参股、并购及重组, 项目投资及运营, 股权管理。
13	合肥市轨道交通集团有限公司	安徽省合肥市阜阳路17号	2009/06/02	城市轨道交通系统项目策划、投资、建设、运营、管理及资源开发; 系统设备租赁、销售; 轨道交

序号	企业名称	注册地址	成立时间	经营范围
				通沿线及相关地区、地下空间资源开发及管理；物业管理；酒店管理；城市基础设计及咨询；代理设计、制作、发布国内广告。
14	合肥金太阳能源科技股份有限公司	安徽省合肥市高新区黄山路 630 号	2010/12/30	大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理；系统集成；技术咨询。
15	合肥文旅博览集团有限公司	安徽省合肥市政务文化新区习友路 988 号	2002/04/30	高端现代服务业投融资平台研发；文化体育产业策划、投资、运营管理；旅游产业策划、投资、运营管理；会展场馆运营、展会开发、广告搭建及展会综合配套服务；酒店投资运营及受托管理；餐饮管理；物业管理；教育投资及咨询；大健康产业、休闲养老产业投资建设运营管理；公益设施、基本建设项目开发、经营、融资管理；资产管理；投资管理；房地产综合开发、销售；供应链管理；电子商务、农业支撑服务；中介服务；房屋、停车场租赁、管理；企业管理咨询；信息技术咨询。
16	合肥市水务环境建设投资有限公司	安徽省合肥市包河区包河大道 398 号 A 座 1-7 楼	2000/08/08	水务和环境项目的投资、建设、运营、管理；承担政府性项目的投资、融资、委托代建、运营和管理任务；受政府委托从事土地一级开发，土地收储、拆迁、整理、基础配套等熟化工作；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；房屋租赁；承担市政府授权的其他工作。
17	合肥建投资本管理有限公司	合肥市包河区武汉路 229 号	2016/01/11	投资管理、资产管理。
18	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	安徽省合肥市包河区包河大道 398 号建投综合办公区 A 座 8-9 楼	2013/01/09	农业、文化旅游产业项目投资及运营管理；农村基础设施建设及人居环境建设；乡村旅游开发；特色小镇开发及田园综合体开发；农产品生产种植与销售；城市基础设施建设；土地整治；土地储备业务。
19	合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司	合肥市蜀山区合作化南路 466 号燃气大厦 22-24 层	2015/02/15	各类工程建设活动；电气安装服务；供电业务；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试。以自有资金从事投资活动；电动汽车充电基础设施运营；集中式



序号	企业名称	注册地址	成立时间	经营范围
				快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；汽车租赁；信息系统集成服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；软件开发；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；充电桩销售；电气设备修理；专用设备修理；停车场服务。
20	合肥市综合管廊投资运营有限公司	合肥市包河区武汉路229号建投大厦	2016/12/23	各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务。市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程技术服务；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。
21	合肥融科项目投资有限公司	合肥市新站区大禹路与东方大道交口西北角合肥综合保税区进口商品展示中心大楼12-14层	2010/11/11	项目投资。
22	合肥市引江济淮投资有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区九龙路118号	2017/08/30	引江济淮主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态旅游综合开发和经营；产业投资、项目建设、项目管理与运营；股权投资；文化旅游、休闲、养老、健康产业的物业投资、管理。
23	合肥市建庐建设投资有限公司	合肥市庐江县庐城镇晨光路17号东方水岸写字楼15层	2017/12/21	县域基础设施项目投资、建设、运营和管理。
24	安徽中安智通科技股份有限公司	合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路555号	2015/12/16	城市智能交通系统设计施工、产品研发、技术服务和销售；城市交通项目投资；交通设施和器材的研发、设计、制作、安装及维护维修；机械式立体停车设备、智能车位引导等自动化控制系统及系统集成的研发设计、生产制造销售、技术服务；停车场相关设计施工、技术服务、管理服务；软件开发；广告发布、传媒灯箱、信息咨询服务；住房及商用房屋租赁；物业管理。
25	合肥市住房租赁发展股份有限公司	安徽省合肥市蜀山区长江西路460号合房租赁办公区	2020/05/18	住房租赁，商业房产运营 房地产开发、咨询、代理、经纪，房屋建筑工程施工，室内外装饰工程施工，酒店管理，物业管理，停车场

序号	企业名称	注册地址	成立时间	经营范围
				(库)运营,户外广告、道路绿化及工程施工咨询,家具及家用电器用品出租服务,计算机和网络技术服务,互联网信息服务。
26	合肥建新投资有限公司	合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢604、605室	2020/02/20	项目投资。
27	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业(有限合伙)	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园G区1楼101	2020/05/28	投资管理;资产管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### (三) 控股股东直接或间接持有的公司股份质押或其他有争议的情况

截至本招股意向书签署之日,发行人控股股东直接或间接持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。

### (四) 其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况

截至本招股意向书签署之日,合肥芯屏持有发行人21.85%的股份,力晶科技持有发行人27.44%的股份,美的创新持有发行人5.85%的股份,基本情况如下:

#### 1、合肥芯屏

企业名称	合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)
成立时间	2016年1月18日
执行事务合伙人	合肥建投资本管理有限公司
出资总额	2,443,125万元人民币
注册地址	合肥市包河区武汉路229号
主营业务	投资管理、资产管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述主营业务与发行人主营业务的关系	无
基金管理人登记	基金管理人合肥建投资本管理有限公司于2016年9月19日进行了基金管理人登记,登记编号P1033786
私募基金备案	已于2016年12月8日备案,基金编号为SM7232

截至本招股意向书签署之日,合肥芯屏的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	合肥建投资本管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	0.04

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
2	合肥建投	有限合伙人	1,159,000.00	47.44
3	合肥瀚和投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,033,125.00	42.29
4	合肥瀚屏投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	250,000.00	10.23
合计			<b>2,443,125.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、力晶科技

公司名称	力晶创新投资控股股份有限公司
成立时间	1994年12月20日
法定代表人	黄崇仁
注册资本	150,000,000,000 元新台币
实收资本	13,663,071,300 元新台币
注册地址	台北市南京东路三段 70 号 15 楼
主要生产经营地	台北市南京东路三段 70 号 15 楼
主营业务	一般投资业务
上述主营业务与发行人主营业务的关系	无

力晶科技为一家注册在中国台湾地区的公开发行公司，经过业务重组，力晶科技于 2019 年将其晶圆代工业务转让至力积电。前述重组完成后，力晶科技成为控股型公司。根据力晶科技 2021 年度报告，截至 2022 年 3 月，力晶科技的前十大股东及其持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	黄崇仁	64,884,798	4.75
2	陈嘉益	32,103,674	2.35
3	瑞圣股份有限公司	17,118,874	1.25
4	智丰科技股份有限公司	16,644,641	1.22
5	陈敏惠	12,607,796	0.92
6	世成科技股份有限公司	10,200,590	0.75
7	仁典投资股份有限公司	9,942,719	0.73
8	智翔投资股份有限公司	9,388,460	0.69
9	吴亦猛	9,142,309	0.67

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
10	元隆投资有限公司	8,663,226	0.63
	合计	190,697,087	13.96

报告期内，发行人与力晶科技及力积电均从事晶圆代工业务。2019年5月，力晶科技将位于中国台湾地区的3座12英寸晶圆厂相关净资产、业务分割让与力积电，由力积电主导晶圆代工服务的生产与销售，力晶科技不再拥有晶圆代工产能，不再从事晶圆代工业务。根据力晶科技的确认，截至2021年12月31日，力晶科技持有力积电24.54%股份。

发行人与力积电从事的晶圆代工业务存在一定差异。在晶圆尺寸方面，发行人从事12英寸半导体晶圆代工，力积电从事12英寸及8英寸半导体晶圆代工；在制程节点方面，发行人以150nm、110nm、90nm半导体晶圆代工为主，55nm制程节点的12英寸晶圆代工平台已开始风险量产，力积电可以提供350nm至25nm制程节点的半导体晶圆代工服务；在工艺平台方面，报告期内，发行人以显示驱动芯片晶圆代工为主，力积电以内存产品晶圆代工、逻辑及特殊应用产品（例如：显示驱动芯片、电源管理芯片等）晶圆代工为主。在未来发展方向方面，发行人将进行40nm、28nm制程研发，并将积极从事MCU、CIS、PMIC、Mini LED等晶圆代工工艺平台的研发工作；力积电未来计划开发的下一代新产品及服务主要涉及逻辑及特殊应用产品晶圆代工平台和内存产品晶圆代工平台。

报告期内，发行人与力晶科技和力积电在晶圆代工业务方面的对比情况如下：

项目	发行人	力晶科技和力积电
代工模式	纯晶圆代工	纯晶圆代工
代工晶圆尺寸	12英寸	12英寸、8英寸
代工制程节点	150nm、110nm、90nm，55nm已开始风险量产	350nm、180nm、150nm、110nm、80nm、65nm、55nm、40nm、30nm、28nm、25nm等
代工工艺平台	报告期内以显示驱动芯片为主	以内存产品晶圆代工、逻辑及特殊应用产品（例如：显示驱动芯片、电源管理芯片等）晶圆代工为主
2020年度晶圆代工收入	151,186.11万人民币	约合1,057,275.75万人民币
2021年度晶圆代工收入	542,084.44万人民币	约合1,509,900.95万人民币

项目	发行人	力晶科技和力积电
未来发展方向	发行人将进行 40nm、28nm 制程研发，并将积极从事 MCU、CIS、PMIC、Mini LED 等晶圆代工工艺平台的研发工作	1、逻辑及特殊应用产品晶圆代工平台：BSI CMOS 影像感测平台、25nm 逻辑平台、40nm 内存整合芯片平台、3D 整合芯片技术平台、第三代半导体功率组件平台等晶圆代工平台等 2、内存产品晶圆代工平台：提供 30/25nm 及其以下制程的 DRAM 代工平台及 28nm NAND Flash 代工产品，并开发 48nm NOR Flash 代工产品等

在公司治理方面，力晶科技与发行人独立开展经营，力晶科技作为发行人股东，通过委派董事正常参与发行人具体生产经营管理，不存在通过股东地位及委派董事影响导致双方非公平竞争、利益输送、相互或单方让渡商业机会的情形。为防范非公平竞争、利益输送或相互或者单方让渡商业机会，发行人制定了《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等，在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度中对公司重大投资、交易、资金往来的审议和决策程序等进行了规定，并制定了研发、采购、生产、销售、人力资源管理、财务管理等业务及财务相关的管理制度，对公司各类业务审批、执行、管理等事项进行了规定，从而避免利益输送及利益冲突，保持公司独立性，保障公司及股东的利益。

综上，发行人与力晶科技及力积电从事同类型业务不会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争和利益输送，亦不存在对发行人利益造成重大损害的情形及风险。

### 3、美的创新

公司名称	美的创新投资有限公司
成立时间	2015年3月19日
法定代表人	刘啸
注册资本	10,000万元人民币
实收资本	10,000万元人民币
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
主要生产经营地	佛山市顺德区北滘镇美的大道6号
主营业务	投资管理及咨询；企业资产管理、投资顾问服务。

上述主营业务与发行人主营业务的关系	无
-------------------	---

截至本招股意向书签署之日，美的创新的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	美的集团股份有限公司	8,500.00	85.00
2	佛山市美的空调工业投资有限公司	1,500.00	15.00
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 六、特别表决权股份或类似安排的情况

截至本招股意向书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

## 七、协议控制架构安排的情况

截至本招股意向书签署日，发行人不存在协议控制架构安排的情况。

## 八、控股股东报告期内重大违法行为

公司控股股东报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

## 九、发行人股本有关情况

### （一）本次发行前后发行人股本情况

本次发行前，公司已发行股份总数为 1,504,601,368 股，本次发行的股票数量占公司发行后总股本的比例不超过 25%（行使超额配售选择权之前），不涉及股东公开发售股份。本次发行可以行使超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。若公司本次发行股份数量为 501,533,789 股，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 576,763,789 股，本次发行前后公司的股本

结构如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后 (超额配售选择权 行使前)		本次发行后 (超额配售选择权 全额行使后)	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	合肥建投	468,474,592	31.14	468,474,592	23.35	468,474,592	22.51
2	合肥芯屏	328,736,799	21.85	328,736,799	16.39	328,736,799	15.79
3	力晶科技	412,824,208	27.44	412,824,208	20.58	412,824,208	19.83
4	美的创新	88,014,118	5.85	88,014,118	4.39	88,014,118	4.23
5	中安智芯	39,606,354	2.63	39,606,354	1.97	39,606,354	1.90
6	惠友豪创	26,404,236	1.75	26,404,236	1.32	26,404,236	1.27
7	合肥存鑫	26,404,236	1.75	26,404,236	1.32	26,404,236	1.27
8	海通创新	17,602,824	1.17	17,602,824	0.88	17,602,824	0.85
9	杭州承富	15,402,471	1.02	15,402,471	0.77	15,402,471	0.74
10	泸州隆信	13,202,118	0.88	13,202,118	0.66	13,202,118	0.63
11	宁波华淳	13,202,118	0.88	13,202,118	0.66	13,202,118	0.63
12	中小企业基金	13,202,118	0.88	13,202,118	0.66	13,202,118	0.63
13	安华创新	8,801,412	0.58	8,801,412	0.44	8,801,412	0.42
14	集创北方	8,801,412	0.58	8,801,412	0.44	8,801,412	0.42
15	中金浦成	1,760,282	0.12	1,760,282	0.09	1,760,282	0.08
16	合肥晶焠	5,195,398	0.35	5,195,398	0.26	5,195,398	0.25
17	合肥晶遂	4,197,429	0.28	4,197,429	0.21	4,197,429	0.20
18	合肥晶炯	3,813,060	0.25	3,813,060	0.19	3,813,060	0.18
19	合肥晶咖	1,456,606	0.10	1,456,606	0.07	1,456,606	0.07
20	合肥晶珏	1,262,054	0.08	1,262,054	0.06	1,262,054	0.06
21	合肥晶梢	1,174,082	0.08	1,174,082	0.06	1,174,082	0.06
22	合肥晶柔	862,798	0.06	862,798	0.04	862,798	0.04
23	合肥晶悬	852,648	0.06	852,648	0.04	852,648	0.04
24	合肥晶本	779,902	0.05	779,902	0.04	779,902	0.04
25	合肥晶洛	581,966	0.04	581,966	0.03	581,966	0.03
26	合肥晶辽	497,378	0.03	497,378	0.02	497,378	0.02
27	合肥晶确	414,481	0.03	414,481	0.02	414,481	0.02
28	合肥晶铁	414,481	0.03	414,481	0.02	414,481	0.02
29	合肥晶妥	406,023	0.03	406,023	0.02	406,023	0.02

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后 (超额配售选择权 行使前)		本次发行后 (超额配售选择权 全额行使后)	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
30	合肥晶雄	253,764	0.02	253,764	0.01	253,764	0.01
本次发行流通股		-	-	<b>501,533,789</b>	<b>25.00</b>	<b>576,763,789</b>	<b>27.71</b>
合计		<b>1,504,601,368</b>	<b>100.00</b>	<b>2,006,135,157</b>	<b>100.00</b>	<b>2,081,365,157</b>	<b>100.00</b>

## (二) 发行人前十名股东持股情况

截至本招股意向书签署之日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合肥建投	468,474,592	31.14
2	力晶科技	328,736,799	27.44
3	合肥芯屏	412,824,208	21.85
4	美的创新	88,014,118	5.85
5	中安智芯	39,606,354	2.63
6	惠友豪创	26,404,236	1.75
7	合肥存鑫	26,404,236	1.75
8	海通创新	17,602,824	1.17
9	杭州承富	15,402,471	1.02
10	泸州隆信	13,202,118	0.88
11	宁波华淳	13,202,118	0.88
12	中小企业基金	13,202,118	0.88
合计		<b>1,463,076,192</b>	<b>97.24</b>

## (三) 发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任职务的情况

截至本招股意向书签署之日，发行人无自然人股东。

## (四) 发行人股本中的国有股份及外资股份情况

### 1、国有股份情况

2021年3月19日，合肥市国资委出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（合国资产权[2021]27号）。根据该批复，截止2020年12



月 31 日，晶合集成总股本 150,460.1368 万股，其中：合肥建投持有发行人股份 468,474,592 股，占总股本的 31.14%，为国有法人股，证券账户应标识为“SS”。

2021 年 7 月 28 日，合肥市国资委出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（合国资产权[2021]59 号）。根据该批复，截止 2020 年 12 月 31 日，晶合集成总股本 150,460.1368 万股，其中：合肥建投持有 46,847.4592 万股，持股比例为 31.14%；中金浦成持有 176.0282 万股，持股比例为 0.12%。合肥市国资委同意将合肥建投、中金浦成的股份界定为国有法人股，其证券账户应分别标识为“SS”、“CS”。

## 2、外资股份情况

截至本招股意向书签署之日，发行人的外资股东为力晶科技，持有发行人 27.44% 的股份。

### （五）申报前一年发行人新增股东情况

#### 1、申报前一年新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格及定价依据

发行人申报前一年新增股东包括：（1）员工持股平台，其增资情况详见本招股意向书本节之“二、发行人设立及股本和股东变化情况”之“（三）报告期内的股本和股东变化情况”之“2、2020 年 9 月，晶合有限第一次增资”；（2）对公司进行增资的 12 家外部投资者：美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成，其增资情况详见本招股意向书本节之“二、发行人设立及股本和股东变化情况”之“（三）报告期内的股本和股东变化情况”之“3、2020 年 9 月，晶合有限第二次增资”。

发行人申报前一年新增股东中，员工持股平台的作价依据为参考深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（鹏信资评报字[2020]第 080 号），并经各方友好协商，确定入股价格为 5.91 元/注册资本；该入股价格经 2020 年 9 月 7 日合肥市国资委出具《关于同意对合肥晶合集成电路有限公司增资的批复》（合国资产权[2020]84 号）确认。12 家外部投资者的作价依据系经各方友好协商，确定入股价格为 11.36 元/注册资本；该入股价格经 2020 年 9 月 23 日合肥市国资委出具《关于同意引入战略投资者对合肥晶合集成电路有限公司增资扩股的批复》（合国资产权

[2020]89号) 确认。

## 2、申报前一年新增股东的基本情况

截至本招股意向书签署之日，发行人申报前一年新增股东基本情况如下：

### (1) 美的创新

美的创新的基本情况详见本招股意向书本节之“五、持有发行人 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(四) 其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“3、美的创新”。

截至 2022 年 12 月 31 日，美的创新的实际控制人为何享健。

### (2) 中安智芯

截至 2022 年 12 月 31 日，中安智芯的基本情况如下：

企业名称	合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 9 月 1 日
执行事务合伙人	安徽创谷股权投资基金管理有限公司
出资总额	45,450 万元人民币
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路 860 号创新大厦 B 座 11 楼
经营范围	股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等相关金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金管理人登记	基金管理人安徽创谷股权投资基金管理有限公司已于 2018 年 7 月 25 日进行了基金管理人登记，登记编号 P1068748
私募基金备案	已于 2020 年 9 月 24 日备案，基金编号为 SLY251

截至 2022 年 12 月 31 日，中安智芯的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	安徽创谷股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	450.00	0.99
2	安徽省量子科学产业发展基金有限公司	有限合伙人	20,000.00	44.00
3	安徽省铁路发展基金股份有限公司	有限合伙人	20,000.00	44.00
4	安徽省中安金融资产管理股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	11.00
合计			45,450.00	100.00

截至 2022 年 12 月 31 日，中安智芯的普通合伙人为安徽创谷股权投资基金管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	安徽创谷股权投资基金管理有限公司
成立时间	2017 年 12 月 29 日
法定代表人	钱进
注册资本	10,000 万元人民币
注册地址	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 幢基金大厦 801 室
经营范围	股权投资、投资管理、投资咨询；创业企业管理服务；参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽创谷股权投资基金管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥鼎旭信息科技合伙企业（有限合伙）	5,500.00	55.00
2	安徽省高新技术产业投资有限公司	4,500.00	45.00
合计		10,000.00	100.00

截至 2022 年 12 月 31 日，中安智芯无实际控制人。

### （3）惠友豪创

截至 2022 年 12 月 31 日，惠友豪创的基本情况如下：

企业名称	深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 5 月 28 日
执行事务合伙人	深圳市惠友创盈投资管理有限公司
出资总额	120,000.01 万元人民币
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8 号楼 606A-15
经营范围	一般经营项目是：科技项目投资（不含限制类项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；科技信息咨询。
基金管理人登记	基金管理人深圳市惠友创盈投资管理有限公司已于 2015 年 9 月 29 日进行了基金管理人登记，登记编号 P1023992
私募基金备案	已于 2020 年 6 月 24 日备案，基金编号为 SLE922

截至 2022 年 12 月 31 日，惠友豪创的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	普通合伙人	0.01	0.00001
2	杨庆	有限合伙人	49,000.00	40.83
3	周祥书	有限合伙人	12,000.00	10.00
4	杨林	有限合伙人	10,000.00	8.33
5	深圳市创荟投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,800.00	7.33
6	共青城坤翎豪创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,200.00	6.00
7	刘晨露	有限合伙人	5,000.00	4.17
8	孙义强	有限合伙人	5,000.00	4.17
9	王赫	有限合伙人	5,000.00	4.17
10	深圳市瑞成永泽投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.17
11	深圳市君爵投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.17
12	深圳市创欣诚创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.17
13	苏州锦天前程投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	0.83
14	深圳市新思哲投资管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.83
15	刘军	有限合伙人	1,000.00	0.83
合计			<b>120,000.01</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，惠友豪创的普通合伙人为深圳市惠友创盈投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	深圳市惠友创盈投资管理有限公司
成立时间	2015 年 6 月 17 日
法定代表人	杨龙忠
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围	一般经营项目是：投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市惠友创盈投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨龙忠	9,500.00	95.00
2	黄卫钢	500.00	5.00
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，惠友豪创实际控制人为杨龙忠。

#### （4）合肥存鑫

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥存鑫的基本情况如下：

企业名称	合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 7 月 2 日
执行事务合伙人	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）
出资总额	30,100 万元人民币
注册地址	安徽省合肥市高新区创新产业园二期 G4 幢 C 座 401 室
经营范围	股权投资；创业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金管理人登记	基金管理人苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）已于 2018 年 2 月 11 日进行了基金管理人登记，登记编号 P1067353
私募基金备案	已于 2020 年 9 月 24 日备案，基金编号为 SLX942

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥存鑫的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）	普通合伙人	100.00	0.33
2	甘肃上峰水泥股份有限公司	有限合伙人	25,000.00	83.06
3	王强	有限合伙人	5,000.00	16.61
合计			<b>30,100.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥存鑫的普通合伙人为苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙），其基本情况如下：

企业名称	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）
成立时间	2016 年 4 月 8 日
执行事务合伙人	李海涛

出资总额	1,500 万元人民币
注册地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号 9 幢 301 室
经营范围	创业投资管理；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	朱克学	普通合伙人	250.00	16.67
2	闫海峰	普通合伙人	135.00	9.00
3	李海涛	普通合伙人	890.00	59.33
4	南京摩尔物联网科技有限公司	普通合伙人	225.00	15.00
合计			<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥存鑫实际控制人为李海涛。

#### （5）海通创新

截至 2022 年 12 月 31 日，海通创新的基本情况如下：

公司名称	海通创新证券投资有限公司
成立时间	2012 年 4 月 24 日
法定代表人	时建龙
注册资本	1,150,000 万元人民币
注册地址	上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室
经营范围	证券投资，金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2022 年 12 月 31 日，海通创新的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	海通证券股份有限公司	1,150,000	100.00
合计		<b>1,150,000</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，海通创新无实际控制人。

**(6) 杭州承富**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州承富的基本情况如下：

企业名称	杭州承富投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017 年 7 月 28 日
执行事务合伙人	杭州东方嘉富资产管理有限公司
出资总额	20,000 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢 301-306-05 室
经营范围	资产管理、股权投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金管理人登记	基金管理人杭州东方嘉富资产管理有限公司已于 2016 年 9 月 8 日进行了基金管理人登记，登记编号 P1033503
私募基金备案	已于 2020 年 8 月 17 日备案，基金编号为 SLR006

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州承富的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州东方嘉富资产管理有限公司	普通合伙人	200.00	1.00
2	西藏新华长江投资有限公司	有限合伙人	6,000.00	30.00
3	杭州戎富投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,800.00	19.00
4	深圳久悦投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,350.00	16.75
5	安徽长安开元投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	10.00
6	杭州驰富投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	10.00
7	曾乐民	有限合伙人	1,000.00	5.00
8	安徽华柏利华投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	5.00
9	上海元仁企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	650.00	3.25
合计			<b>20,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州承富的普通合伙人为杭州东方嘉富资产管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	杭州东方嘉富资产管理有限公司
成立时间	2016 年 5 月 17 日

法定代表人	徐晓
注册资本	10,000 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路 1 号
经营范围	资产管理、股权投资、投资咨询（除证券、期货）服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州东方嘉富资产管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	浙江东方集团产融投资有限公司	4,900.00	49.00
2	杭州小苍兰投资管理合伙企业（有限合伙）	4,800.00	48.00
3	陈万翔	300.00	3.00
	合计	10,000.00	100.00

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州承富实际控制人为陈万翔。

#### （7）泸州隆信

截至 2022 年 12 月 31 日，泸州隆信的基本情况如下：

企业名称	泸州隆信投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 5 月 19 日
执行事务合伙人	泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司
出资总额	16,100 万元人民币
注册地址	四川自贸区川南临港片区临港大道 1 段一带一路国家馆 603 号
经营范围	股权投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金管理人登记	基金管理人泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司已于 2018 年 7 月 12 日进行了基金管理人登记，登记编号 P1068660
私募基金备案	已于 2020 年 9 月 21 日备案，基金编号为 SLV278

截至 2022 年 12 月 31 日，泸州隆信的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.62
2	青岛启泰一号创业投资中心（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.62



序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
3	王士明	有限合伙人	3,000.00	18.63
4	上海众乙达企业管理有限公司	有限合伙人	3,000.00	18.63
5	四川璞信产融投资有限责任公司	有限合伙人	2,900.00	18.01
6	黄海翔	有限合伙人	2,200.00	13.66
7	陈越强	有限合伙人	1,950.00	12.11
8	君汇（日照）股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	6.21
9	陕西西电高科中低压开关有限公司	有限合伙人	500.00	3.11
10	沈雄杰	有限合伙人	300.00	1.86
11	上海亮轩企业管理咨询有限公司	有限合伙人	300.00	1.86
12	慈溪怡海企业管理咨询有限公司	有限合伙人	200.00	1.24
13	宁波东盈环境建设发展有限公司	有限合伙人	200.00	1.24
14	李梦迪	有限合伙人	150.00	0.93
15	曹雪丽	有限合伙人	100.00	0.62
16	陈葵	有限合伙人	100.00	0.62
合计			<b>16,100.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，泸州隆信的执行事务合伙人、普通合伙人为泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司
成立时间	2017 年 11 月 30 日
法定代表人	付宗要
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	四川自贸区川南临港片区云台路一段 68 号西南商贸城 16 区 B-JY-873 号（集群注册）
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）、股权投资、受托管理股权投资基金（1、不得从事证券投资活动；2、未经有关部门批准不得以公开方式募集开展投资活动；3、不得从事公开募集基金管理业务；4、不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	四川璞信产融投资有限责任公司	1,000.00	100.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，泸州隆信的普通合伙人为青岛启泰一号创业投资中心（有限合伙），其基本情况如下：

公司名称	青岛启泰一号创业投资中心（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 25 日
执行事务合伙人	张景丽
出资总额	300 万元人民币
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区红柳河路 651 号 121 室
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；社会经济咨询服务；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，青岛启泰一号创业投资中心（有限合伙）的出资构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张景丽	普通合伙人	100.00	33.33
2	张玉芝	有限合伙人	100.00	33.33
3	吕验其	有限合伙人	100.00	33.33
合计			<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，泸州隆信实际控制人为泸州市国有资产监督管理委员会。

#### （8）宁波华淳

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波华淳的基本情况如下：

企业名称	宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017 年 9 月 29 日
执行事务合伙人	华泰宝利投资管理有限公司
出资总额	90,437.41 万元人民币
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0604

经营范围	投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金管理人登记	基金管理人华泰宝利投资管理有限公司已于 2017 年 7 月 27 日进行了基金管理人登记，登记编号 P1063983
私募基金备案	已于 2017 年 12 月 6 日备案，基金编号为 SY3246

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波华淳的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	华泰宝利投资管理有限公司	普通合伙人	324.57	0.36
2	华泰人寿保险股份有限公司	有限合伙人	40,000.00	44.23
3	华泰财产保险有限公司	有限合伙人	25,000.00	27.64
4	华泰资产管理有限公司	有限合伙人	14,880.00	16.45
5	华泰保险集团股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	5.53
6	中荷人寿保险有限公司	有限合伙人	4,000.00	2.26
7	宁波扬泰企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	632.85	0.70
8	蔷薇资本有限公司	有限合伙人	600.00	0.67
合计			90,437.41	100.00

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波华淳的普通合伙人为华泰宝利投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	华泰宝利投资管理有限公司
成立时间	2017 年 4 月 24 日
法定代表人	李胜
注册资本	10,000 万元人民币
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0602
经营范围	投资管理、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，华泰宝利投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	华泰资产管理有限公司	8,000.00	80.00

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
2	宁波梅山保税港区泰洋投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	20.00
	合计	10,000.00	100.00

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波华淳无实际控制人。

### （9）中小企业基金

截至 2022 年 12 月 31 日，中小企业基金的基本情况如下：

企业名称	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）
成立时间	2016 年 12 月 21 日
执行事务合伙人	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司
出资总额	450,000 万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 508
经营范围	一般经营项目是：对中小企业发展创业投资业务，股权投资及相关业务（不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）
基金管理人登记	基金管理人深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司已于 2016 年 6 月 8 日进行了基金管理人登记，登记编号 P1031644
私募基金备案	已于 2017 年 3 月 16 日备案，基金编号为 SR5570

截至 2022 年 12 月 31 日，中小企业基金的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司	普通合伙人	4,500.00	1.00
2	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	110,000.00	24.44
3	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	109,500.00	24.33
4	安信证券股份有限公司	有限合伙人	25,000.00	5.56
5	深圳市汇通金控基金投资有限公司	有限合伙人	45,000.00	10.00
6	新余市华邦投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	56,000.00	12.44
7	万科企业股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.67
8	山证创新投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.67
9	山西交通产业基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	2.22

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
10	舟山保泰盈股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	2.22
11	深圳市创东方富盛投资企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	4.44
合计			<b>450,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，中小企业基金的普通合伙人为深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司
成立时间	2015 年 7 月 16 日
法定代表人	陈玮
注册资本	10,000 万元人民币
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理（不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金管理的管理业务）。

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	5,100.00	51.00
2	深圳市晋承鼎盛投资有限公司	2,084.21	20.84
3	深圳市创东方投资有限公司	1,389.47	13.89
4	深圳江合财富六期产学研基金合伙企业（有限合伙）	926.32	9.26
5	山东龙力生物科技股份有限公司	500.00	5.00
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，中小企业基金实际控制人为陈玮、程厚博。

#### （10）安华创新

截至 2022 年 12 月 31 日，安华创新的基本情况如下：

公司名称	安徽安华创新风险投资基金有限公司
成立时间	2017年11月30日
法定代表人	方立彬
注册资本	350,000 万元人民币
注册地址	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 866 室
经营范围	股权投资；债权投资；投资顾问、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金管理人登记	基金管理人华安嘉业投资管理有限公司已于 2015 年 7 月 16 日进行了基金管理人登记，登记编号 P1018000
私募基金备案	已于 2018 年 3 月 15 日备案，基金编号为 SCJ944

截至 2022 年 12 月 31 日，安华创新的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国元创新投资有限公司	70,000.00	20.00
2	华安嘉业投资管理有限公司	70,000.00	20.00
3	安徽省盐业投资控股集团有限公司	40,000.00	11.43
4	安徽交控资本投资管理有限公司	40,000.00	11.43
5	合肥市产业投资引导基金有限公司	36,000.00	10.29
6	安徽华文创业投资管理有限公司	22,000.00	6.29
7	时代出版传媒股份有限公司	22,000.00	6.29
8	合肥高新建设投资集团公司	20,000.00	5.71
9	阜阳市颍科创新投资有限公司	20,000.00	5.71
10	安徽国控投资有限公司	10,000.00	2.86
合计		<b>350,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，安华创新的基金管理人为华安嘉业投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	华安嘉业投资管理有限公司
成立时间	2012 年 10 月 29 日
法定代表人	方威
注册资本	150,000 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 528 号 S1904 室 A1
经营范围	为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投资基金，筹集并管理客户资金进行股权投资；有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，

	将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
--	---

截至 2022 年 12 月 31 日，华安嘉业投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	华安证券股份有限公司	200,000.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，安华创新无实际控制人。

### （11）集创北方

截至 2022 年 12 月 31 日，集创北方的基本情况如下：

公司名称	北京集创北方科技股份有限公司
成立时间	2008 年 9 月 3 日
法定代表人	张晋芳
注册资本	43,106.52 万元人民币
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢 8 层 801（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、灯具、五金交电、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，集创北方的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）
1	张晋芳	7,668.75	17.79
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	4,115.25	9.55
3	北京永昌寰宇投资有限公司	2,833.26	6.57
4	北京集智非凡科技中心（有限合伙）	1,788.85	4.15
5	北京永昌环宇投资中心（有限合伙）	1,715.90	3.98
6	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	1,609.89	3.73

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）
7	天津海松股权投资合伙企业（有限合伙）	1,480.99	3.44
8	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	1,304.81	3.03
9	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	1,282.38	2.97
10	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	1,078.06	2.50
11	珠海科技创业投资有限公司	1,008.99	2.34
12	珠海大横琴创新发展有限公司	1,008.99	2.34
13	厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	746.42	1.73
14	北京集创寰宇科技中心（有限合伙）	739.45	1.72
15	维沃移动通信有限公司	685.65	1.59
16	深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）	650.90	1.51
17	集创芯恒（珠海）科技中心（有限合伙）	530.53	1.23
18	苏州哲思灵行投资合伙企业（有限合伙）	512.08	1.19
19	上海聚源载兴投资中心（有限合伙）	499.79	1.16
20	厦门南圃秋风投资合伙企业（有限合伙）	484.72	1.12
21	北京京国创优势产业基金（有限合伙）	449.19	1.04
22	天津海松飞跃股权投资合伙企业（有限合伙）	438.81	1.02
23	北京欧镭德芯科技中心（有限合伙）	408.00	0.95
24	哈勃科技创业投资有限公司	403.60	0.94
25	苏州芯动能显示科技创业投资合伙企业（有限合伙）	342.82	0.80
26	厦门源峰磐松股权投资合伙企业（有限合伙）	342.82	0.80
27	思凯（珠海横琴）科技有限公司	329.11	0.76
28	北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）	283.29	0.66
29	苏州元禾厚望睿芯创业投资合伙企业（有限合伙）	274.26	0.64
30	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	274.26	0.64
31	井冈山晨睿股权投资合伙企业（有限合伙）	274.26	0.64
32	天津海河集睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	274.26	0.64
33	集创芯通（珠海）科技中心（有限合伙）	261.58	0.61
34	北京芯动能投资基金（有限合伙）	253.05	0.59
35	集创芯弘（珠海）科技中心（有限合伙）	248.02	0.58
36	北京晋睿博远科技有限公司	240.00	0.56
37	欧镭德弘（珠海）科技中心（有限合伙）	223.11	0.52



序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）
38	湖南湘江祥鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	221.62	0.51
39	北京丝路华创贰号股权投资中心（有限合伙）	212.55	0.49
40	青岛新鼎哨哥玖号股瑞捌私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200.00	0.46
41	无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	179.68	0.42
42	集创芯领（珠海）科技中心（有限合伙）	166.54	0.39
43	嘉兴鼎峰佳创创业投资合伙企业（有限合伙）	146.45	0.34
44	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	141.66	0.33
45	北京欧徕德芯诚科技中心（有限合伙）	138.31	0.32
46	辽宁和生中富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
47	嘉兴创领隆顺股权投资合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
48	苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
49	三亚星睿壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
50	广德远润创芯股权投资合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
51	中国互联网投资基金（有限合伙）	137.13	0.32
52	深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
53	中青芯鑫鼎橡（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
54	深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）	133.20	0.31
55	欧徕德鑫（珠海）科技中心（有限合伙）	125.28	0.29
56	北京丝路云和投资中心（有限合伙）	122.71	0.28
57	集芯领睿（珠海）科技中心（有限合伙）	120.10	0.28
58	湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）	119.28	0.28
59	集创芯盛（珠海）科技中心（有限合伙）	118.42	0.27
60	共青城哲灵丰升投资管理合伙企业（有限合伙）	116.79	0.27
61	SK海力士（无锡）投资有限公司	109.70	0.25
62	江苏隼泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）	109.70	0.25
63	集创芯美（珠海）科技中心（有限合伙）	101.21	0.23
64	集创芯兴（珠海）科技中心（有限合伙）	97.34	0.23
65	陕西葆晟控股有限公司	93.50	0.22
66	新疆 TCL 股权投资有限公司	89.84	0.21
67	集创芯卓（珠海）科技中心（有限合伙）	85.28	0.20
68	芜湖纪源灿辉创业投资合伙企业（有限合伙）	82.28	0.19

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）
69	珠海景祥恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	82.28	0.19
70	德芯非凡（珠海）科技中心（有限合伙）	81.45	0.19
71	珠海景祥宏利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80.72	0.19
72	集芯卓宇（珠海）科技中心（有限合伙）	70.98	0.16
73	苏州纪源皓月创业投资合伙企业（有限合伙）	70.87	0.16
74	欧镭德盛（珠海）科技中心（有限合伙）	69.18	0.16
75	北京汇智合盛电子科技有限公司	68.56	0.16
76	平潭宝盛股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
77	北京屹唐中艺投资中心（有限合伙）	68.56	0.16
78	嘉兴智徽股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
79	南京又东华兴创业投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
80	北京兴投优选创业投资基金（有限合伙）	68.56	0.16
81	珠海华金尚盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
82	共青城合盛犇犇股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
83	无锡芯创智享股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
84	北京中璟三号股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
85	曲水泉禾企业管理有限责任公司	68.56	0.16
86	银河芯动能壹号股权投资基金（烟台）合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
87	苏州工业园区中鑫致远投资中心（有限合伙）	68.56	0.16
88	珠海鲸芯一号集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
89	北京芯创科技一期创业投资中心（有限合伙）	65.09	0.15
90	宁波瀚澜企业管理合伙企业（有限合伙）	65.09	0.15
91	湖南湘江盛世光保股权投资合伙企业（有限合伙）	61.71	0.14
92	烟台德泰新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	57.59	0.13
93	芜湖金牛荣元股权投资中心（有限合伙）	54.85	0.13
94	苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙）	52.55	0.12
95	刘宏辉	48.41	0.11
96	珠海金镒铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42.57	0.10
97	天铭京福（台州）创业投资合伙企业（有限合伙）	27.43	0.06
98	北京国泰嘉泽创业投资中心（有限合伙）	21.28	0.05
	<b>合计</b>	<b>43,106.52</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，集创北方的实际控制人为张晋芳。

### (12) 中金浦成

截至 2022 年 12 月 31 日，中金浦成的基本情况如下：

公司名称	中金浦成投资有限公司
成立时间	2012 年 4 月 10 日
法定代表人	刘健
注册资本	600,000 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 29 层 2904A 单元
经营范围	投资管理，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理服务，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2022 年 12 月 31 日，中金浦成的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中金公司	600,000.00	100.00
	合计	600,000.00	100.00

截至 2022 年 12 月 31 日，中金浦成为中金公司的全资子公司，中金公司的控股股东为中央汇金投资有限责任公司。

### (13) 合肥晶燧

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶燧的基本情况如下：

企业名称	合肥晶燧企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 19 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1109-2
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶燧的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	詹奕鹏	有限合伙人	450.00	14.65	副总经理
3	黎湘鄂	有限合伙人	300.00	9.77	董事长室顾问
4	简瑞荣	有限合伙人	241.00	7.85	协理
5	黎翠綾	有限合伙人	150.00	4.88	企业规划室资深处长
6	张伟瑾	有限合伙人	150.00	4.88	N1厂厂长
7	林柏青	有限合伙人	150.00	4.88	N1厂长室副厂长
8	吴佳特	有限合伙人	130.00	4.23	先进整合处处长
9	谢长峯	有限合伙人	105.00	3.42	制程整合技术处副处长
10	李庆民	有限合伙人	100.00	3.26	协理
11	官佳琦	有限合伙人	100.00	3.26	品质处处长
12	方圣昌	有限合伙人	100.00	3.26	N1A1厂长室副厂长
13	张志宏	有限合伙人	100.00	3.26	业务副总经理室技术副处长
14	柯天麒	有限合伙人	90.00	2.93	模型器件处副处长
15	刘棋彬	有限合伙人	85.00	2.77	风险管理处处长
16	陈信全	有限合伙人	80.00	2.60	技术开发一处副处长
17	江英和	有限合伙人	70.00	2.28	人力资源处代副处长
18	谢文智	有限合伙人	70.00	2.28	营运企划处副处长
19	蔡辉嘉	有限合伙人	65.00	2.12	总经理
20	罗招龙	有限合伙人	60.00	1.95	模组开发处副处长
21	吴启熙	有限合伙人	60.00	1.95	分析及可靠性工程部部经理
22	张永忠	有限合伙人	60.00	1.95	设计服务处副处长
23	施介文	有限合伙人	60.00	1.95	N1A1厂长室副厂长
24	李天定	有限合伙人	50.00	1.63	经营与营运系统部部经理
25	钟青源	有限合伙人	50.00	1.63	N1厂长室副厂长
26	蔡国智	有限合伙人	50.00	1.63	董事长
27	吴文达	有限合伙人	50.00	1.63	信息服务处副处长
28	黄国助	有限合伙人	50.00	1.63	流程整合组部经理
29	朱晓娟	有限合伙人	25.00	0.81	董事、副总经理
30	施雪峯	有限合伙人	20.00	0.65	法务室副处长
合计			3,071.20	100.00	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶焯的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况如下：

公司名称	合肥晶策企业管理有限公司
成立时间	2020 年 6 月 18 日
法定代表人	曹宗野
注册资本	10 万元人民币
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
经营范围	企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶策的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹宗野	5.10	51.00
2	王云直	2.80	28.00
3	张静	2.10	21.00
合计		10.00	100.00

注：合肥晶策股东均为发行人员工。

合肥晶焯为员工持股平台，无实际控制人。

#### （14）合肥晶遂

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶遂的基本情况如下：

企业名称	合肥晶遂企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 14 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1112-3
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶遂的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	朱才伟	有限合伙人	450.00	18.14	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
3	朱晓娟	有限合伙人	416.10	16.77	董事、副总经理
4	周义亮	有限合伙人	380.00	15.31	副总经理
5	王兴亚	有限合伙人	125.00	5.04	财会处处长
6	方华	有限合伙人	125.00	5.04	对外事务室处长
7	王逸蓉	有限合伙人	50.00	2.02	关务部部长
8	江英和	有限合伙人	40.00	1.61	人力资源处代副处长
9	张庆勇	有限合伙人	40.00	1.61	IP服务二组部经理
10	陈景	有限合伙人	40.00	1.61	客户工程处代副处长
11	王云直	有限合伙人	40.00	1.61	会计部部长
12	刘桂云	有限合伙人	40.00	1.61	总务部部长
13	周儒领	有限合伙人	40.00	1.61	先进整合前端组部经理
14	郑晓	有限合伙人	36.00	1.45	产品工程二部部长
15	李德龙	有限合伙人	36.00	1.45	采购一部部经理
16	曹宗野	有限合伙人	30.00	1.21	证券事务部部长
17	喻加云	有限合伙人	25.00	1.01	税务课副理
18	张静	有限合伙人	25.00	1.01	总账课副理
19	缪凤玲	有限合伙人	24.00	0.97	代工业务三部技术副理
20	李宁	有限合伙人	24.00	0.97	薪资福利部代部经理
21	张英杰	有限合伙人	24.00	0.97	代工业务一部部经理
22	付刚 <sup>1</sup>	有限合伙人	20.00	0.81	品质体系管理部部经理
23	赵家保	有限合伙人	20.00	0.81	关务课副理
24	肖丹	有限合伙人	20.00	0.81	业务系统组代部经理
25	杜雷	有限合伙人	20.00	0.81	光罩服务组部经理
26	简瑞荣	有限合伙人	20.00	0.81	协理
27	束乐	有限合伙人	20.00	0.81	员工发展课副理
28	何倩倩	有限合伙人	20.00	0.81	事务部副理
29	杨大桂	有限合伙人	17.00	0.69	空调课技术副理
30	杨昆	有限合伙人	16.00	0.64	平台服务课副理
31	潘坡	有限合伙人	16.00	0.64	业务支援组专案副理
32	李林	有限合伙人	16.00	0.64	设备一课技术副理
33	魏家信	有限合伙人	16.00	0.64	结构分析课副理

<sup>1</sup> 付刚已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 21 日办理完成工商变更。

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
34	程长青	有限合伙人	16.00	0.64	量测设备课副理
35	蒲甜松	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术二部代部经理
36	许春龙	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术三部代部经理
37	汪小小	有限合伙人	16.00	0.64	元件开发部部经理
38	赵敬国	有限合伙人	16.00	0.64	工务管理课专案副理
39	黄皓皓	有限合伙人	16.00	0.64	储运部代部经理
40	白康茜	有限合伙人	16.00	0.64	材料二课副理
41	赵丽云	有限合伙人	16.00	0.64	出货品质保证课副理
42	唐京华	有限合伙人	16.00	0.64	电力课副理
43	李江敏	有限合伙人	16.00	0.64	稽核室专案副理
44	张存兴	有限合伙人	16.00	0.64	经营管理组部经理
45	黄小迪	有限合伙人	13.00	0.52	整合三课技术副理
46	周俊	有限合伙人	13.00	0.52	设备二课主任工程师
47	季能	有限合伙人	12.00	0.48	经营系统课副理
48	钟胤	有限合伙人	12.00	0.48	工会事务组专案副理
49	谢文智	有限合伙人	12.00	0.48	营运企划处副处长
50	王梦曦	有限合伙人	12.00	0.48	政府事务组代部经理
合计			<b>2,481.30</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶遂的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶焯”。

合肥晶遂为员工持股平台，无实际控制人。

### （15）合肥晶焯

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶焯的基本情况如下：

企业名称	合肥晶焯企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 20 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1109-3

经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	--

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶炯的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	蔡国智	有限合伙人	587.00	26.04	董事长
3	蔡辉嘉	有限合伙人	510.00	22.63	总经理
4	邱显寰	有限合伙人	380.00	16.86	副总经理
5	李迦谕	有限合伙人	200.00	8.87	助理
6	黄晋德	有限合伙人	148.00	6.57	分立器件技术中心资深处长
7	林士然	有限合伙人	100.00	4.44	深圳办公室处长
8	王建智	有限合伙人	40.00	1.77	先进整合后端部部长
9	许嘉哲	有限合伙人	36.00	1.60	分析技术部部长
10	吴建宏	有限合伙人	30.00	1.33	微影开发部部长
11	古哲安	有限合伙人	20.00	0.89	制程一课副理
12	田俊鹏	有限合伙人	16.00	0.71	生管二课副理
13	黄浩玮 <sup>1</sup>	有限合伙人	16.00	0.71	先进整合一部代部长
14	林政纬	有限合伙人	16.00	0.71	制程二课副理
15	柯天麒	有限合伙人	16.00	0.71	模型器件处副处长
16	蔡汉郢	有限合伙人	12.00	0.53	设备自动化课技术副理
17	邱一峯	有限合伙人	12.00	0.53	空调课技术副理
18	郑子锋	有限合伙人	12.00	0.53	设备二课技术副理
19	毛泽民	有限合伙人	12.00	0.53	业务一课副理
20	沈俊明	有限合伙人	12.00	0.53	制程一课技术副理
21	柯孟志	有限合伙人	10.00	0.44	制造部部长
22	陈思皓	有限合伙人	10.00	0.44	缺陷改善课副理
23	简瑞荣	有限合伙人	10.00	0.44	助理
24	陈依柏	有限合伙人	8.00	0.35	故障分析课主任工程师
25	王振择	有限合伙人	8.00	0.35	制程二课技术副理
26	张正一 <sup>2</sup>	有限合伙人	7.90	0.35	量测技术部部长

<sup>1</sup> 黄浩玮已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 21 日办理完成工商变更。

<sup>2</sup> 张正一已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 21 日办理完成工商变更。



序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
27	张琳琳	有限合伙人	5.00	0.22	逻辑四课主任工程师
28	江冬冬	有限合伙人	5.00	0.22	扩散生产课生产线主任
29	李晗飞	有限合伙人	5.00	0.22	制程二课主任工程师
30	翟伟	有限合伙人	5.00	0.22	设备三课主任工程师
31	张振华	有限合伙人	5.00	0.22	设备一课主任工程师
合计			<b>2,254.10</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶炯的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶焯”。

合肥晶炯为员工持股平台，无实际控制人。

#### （16）合肥晶咖

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶咖的基本情况如下：

企业名称	合肥晶咖企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 21 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1110-1
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶咖的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.02	/
2	林滔天	有限合伙人	50.00	5.81	逻辑一部部经理
3	简瑞荣	有限合伙人	50.00	5.81	协理
4	杨子亿	有限合伙人	47.00	5.46	洗净开发部部经理
5	林群证	有限合伙人	42.00	4.88	洗净工程部部长
6	曲厚任	有限合伙人	42.00	4.88	制程整合二部部长

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
7	陈义元	有限合伙人	40.00	4.64	化学机械研磨工程部部经理
8	柯孟志	有限合伙人	36.00	4.18	制造部部经理
9	柯家宇	有限合伙人	36.00	4.18	品质工程部部经理
10	魏郁忠	有限合伙人	36.00	4.18	全面品质管理部部经理
11	杨智强	有限合伙人	36.00	4.18	蚀刻开发部部经理
12	陈文棋	有限合伙人	36.00	4.18	蚀刻工程部技术经理
13	邱浩源	有限合伙人	30.00	3.48	蚀刻工程部副理
14	刘文彬	有限合伙人	30.00	3.48	化学机械研磨开发部部经理
15	洪启恭	有限合伙人	30.00	3.48	电脑整合制造部部经理
16	秦典昇	有限合伙人	30.00	3.48	黄光工程部副理
17	杨国栋	有限合伙人	30.00	3.48	黄光工程部技术经理
18	王嘉祥	有限合伙人	30.00	3.48	蚀刻工程部副理
19	张凯帆	有限合伙人	25.00	2.90	营运系统课副理
20	方建智	有限合伙人	24.00	2.79	薄膜工程部副理
21	林祐丞	有限合伙人	21.00	2.44	制程一课副理
22	徐柏谦	有限合伙人	20.00	2.32	招募任用部代部经理
23	罗国基	有限合伙人	20.00	2.32	制造部副理
24	黄惠春	有限合伙人	20.00	2.32	自动化课专案副理
25	范振富	有限合伙人	20.00	2.32	扩散生产课副理
26	黄凯全	有限合伙人	20.00	2.32	策略规划组部经理
27	曾文钦	有限合伙人	20.00	2.32	薄膜生产课副理
28	许信忠	有限合伙人	20.00	2.32	黄光生产课副理
29	李昶材	有限合伙人	20.00	2.32	设备二课副理
合计			<b>861.20</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶咖的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶焯”。

合肥晶咖为员工持股平台，无实际控制人。

**(17) 合肥晶珏**

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶珏的基本情况如下：

企业名称	合肥晶珏企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 20 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1111-2
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶珏的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	蔡俊郎	有限合伙人	50.00	6.70	良率提升部部长
3	梁君丽	有限合伙人	40.00	5.36	元件技术部部长
4	庄逢杰	有限合伙人	40.00	5.36	薄膜工程部部长
5	陈世昌	有限合伙人	40.00	5.36	整合支援组部部长
6	苏贤钧	有限合伙人	40.00	5.36	代工业务二部部长
7	丁明邦	有限合伙人	40.00	5.36	企划部部长
8	龚柏铎 <sup>1</sup>	有限合伙人	40.00	5.36	逻辑二部部长
9	洪春田	有限合伙人	40.00	5.36	黄光工程部部长
10	何毓纬	有限合伙人	40.00	5.36	设备整合部部长
11	黄世豪	有限合伙人	36.00	4.82	安全管理二组部部长
12	洪国利	有限合伙人	36.00	4.82	安全管理一部部部长
13	谢文智	有限合伙人	20.00	2.68	营运企划处副处长
14	谢琦山	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部技术副理
15	宋振睿 <sup>2</sup>	有限合伙人	20.00	2.68	水处理课副理
16	吴真良	有限合伙人	20.00	2.68	设备自动化课副理
17	董允文	有限合伙人	20.00	2.68	厂务二部技术经理
18	陈信华 <sup>3</sup>	有限合伙人	20.00	2.68	厂务二部部长
19	蔡杰良	有限合伙人	20.00	2.68	制程二课副理

<sup>1</sup> 龚柏铎已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 24 日办理完成工商变更。

<sup>2</sup> 宋振睿已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 24 日办理完成工商变更。

<sup>3</sup> 陈信华已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 24 日办理完成工商变更。

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
20	李泽育	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部部经理
21	苏智源	有限合伙人	20.00	2.68	空调课副理
22	吴耀杉	有限合伙人	20.00	2.68	故障分析课副理
23	彭昱治	有限合伙人	20.00	2.68	气体化学课副理
24	杨帛霖	有限合伙人	12.00	1.61	设备一课副理
25	林育兴	有限合伙人	12.00	1.61	洗磨生产课副理
26	黄君杰	有限合伙人	12.00	1.61	设备三课技术副理
27	詹益轩	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课技术副理
28	彭科津	有限合伙人	12.00	1.61	设备一课技术副理
29	苏圣哲	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课技术副理
30	周中行	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课副理
合计			<b>746.20</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶珏的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶焯”。

合肥晶珏为员工持股平台，无实际控制人。

#### （18）合肥晶梢

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶梢的基本情况如下：

企业名称	合肥晶梢企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 20 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1112-2
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶梢的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	蔡国智	有限合伙人	78.00	11.24	董事长
2	杨宗凯	有限合伙人	70.00	10.08	核心技术一部部经理
3	苏深池	有限合伙人	50.00	7.20	资安室部经理
4	许宗能	有限合伙人	50.00	7.20	先进整合处代处长
5	林士程	有限合伙人	50.00	7.20	总经理室特助
6	吴桂茶	有限合伙人	40.00	5.76	储运部副理
7	雷滢仁	有限合伙人	40.00	5.76	稽核室部经理
8	李旭昇	有限合伙人	40.00	5.76	行政与网络系统部部经理
9	张世琛	有限合伙人	20.00	2.88	设备二课副理
10	杨安立	有限合伙人	20.00	2.88	设备一课副理
11	朱哲仪	有限合伙人	20.00	2.88	设备课副理
12	彭泽昌	有限合伙人	20.00	2.88	制程一课副理
13	丁笙玳	有限合伙人	20.00	2.88	制程一课副理
14	蔡富吉	有限合伙人	20.00	2.88	化学机械研磨工程部副理
15	陈春安	有限合伙人	20.00	2.88	设备三课副理
16	王柏翔	有限合伙人	16.00	2.30	元件分析改善课副理
17	张馨文	有限合伙人	16.00	2.30	统计制程管制课副理
18	周义亮	有限合伙人	16.00	2.30	副总经理
19	冯文辉	有限合伙人	16.00	2.30	专案课技术副理
20	邓台信	有限合伙人	12.00	1.73	设备二课副理
21	洪素真	有限合伙人	12.00	1.73	采购处技术副理
22	孙浩晏	有限合伙人	12.00	1.73	生产管理课副理
23	谢秉宏	有限合伙人	12.00	1.73	设备三课技术副理
24	黄志淦	有限合伙人	12.00	1.73	设备一课副理
25	黄志贤	有限合伙人	12.00	1.73	专案课副理
合计			<b>694.20</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶梢的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶焮”。

合肥晶梢为员工持股平台，无实际控制人。

### (19) 合肥晶柔

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶柔的基本情况如下：

企业名称	合肥晶柔企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 21 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1112-1
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶柔的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	YAMANAKA TOSHIKI	有限合伙人	65.00	12.74	日本研发处处长
3	KIM KI JUN	有限合伙人	60.00	11.76	模型器件处技术副处长
4	CHOI JOBONG	有限合伙人	50.00	9.80	器件架构部部长
5	JUNG DAE SUB	有限合伙人	40.00	7.84	可靠性元件模拟课技术经理
6	MUTA TETSUYA	有限合伙人	40.00	7.84	日本研发处技术副理
7	TAYA MASATOSHI	有限合伙人	24.00	4.70	Device课技术副理
8	KUMAGAI YASUHIRO	有限合伙人	20.00	3.92	Layout课代副理
9	张伟瑾	有限合伙人	20.00	3.92	N1厂厂长
10	SUGAWARA TOSHIKAZU	有限合伙人	20.00	3.92	PDK课主任工程师
11	OSAKI HIDEFUMI	有限合伙人	10.00	1.96	PDK课主任工程师
12	OTA HIROYUKI	有限合伙人	10.00	1.96	Device课主任工程师
13	鲁传润	有限合伙人	10.00	1.96	传送设备课副理
14	AOKI MIKIO	有限合伙人	10.00	1.96	PDK课代副理
15	李新强 <sup>1</sup>	有限合伙人	8.00	1.57	网络系统课技术副理
16	张纪稳 <sup>2</sup>	有限合伙人	8.00	1.57	器件架构一课技术副理
17	王晓辉	有限合伙人	8.00	1.57	设备一课主任工程师
18	简瑞荣	有限合伙人	7.00	1.37	协理

<sup>1</sup> 李新强已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 21 日办理完成工商变更。

<sup>2</sup> 张纪稳已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 21 日办理完成工商变更。

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
19	黄晋德	有限合伙人	7.00	1.37	分立器件技术中心资深处长
20	郑涛	有限合伙人	5.00	0.98	策略规划组主任工程师
21	蒋丽	有限合伙人	5.00	0.98	基准情报二课主任工程师
22	宫珊珊	有限合伙人	5.00	0.98	制程三课主任工程师
23	徐婷	有限合伙人	5.00	0.98	经营系统课主任工程师
24	曾权飞 <sup>1</sup>	有限合伙人	5.00	0.98	模型器件二课主任工程师
25	包玉威	有限合伙人	5.00	0.98	品质体系稽核课主任工程师
26	项伟 <sup>2</sup>	有限合伙人	5.00	0.98	制程一课主任工程师
27	刘扬	有限合伙人	5.00	0.98	整合三课副理
28	熊小玲	有限合伙人	5.00	0.98	整合二课代副理
29	杨程	有限合伙人	5.00	0.98	元件技术二课代副理
30	沈磊	有限合伙人	5.00	0.98	设备一课主任工程师
31	刘汗青	有限合伙人	5.00	0.98	进料品质控制课代副理
32	王康满	有限合伙人	5.00	0.98	设备一课主任工程师
33	陈云	有限合伙人	4.00	0.78	平台服务课主任工程师
34	徐全柱	有限合伙人	3.00	0.59	出货品质保证课技术副理
35	曹灿	有限合伙人	3.00	0.59	设备三课主任工程师
36	金鹏	有限合伙人	3.00	0.59	元件二课主任工程师
37	王斌	有限合伙人	3.00	0.59	制程二课工程师
38	吴章淦	有限合伙人	3.00	0.59	营运系统课主任工程师
39	童树健	有限合伙人	2.00	0.39	应急管理课主任工程师
40	王建华	有限合伙人	2.00	0.39	水处理课主任工程师
41	蔡国智	有限合伙人	2.00	0.39	董事长
42	张帅	有限合伙人	2.00	0.39	平台服务课主任工程师
43	周其灿	有限合伙人	1.00	0.20	网络系统课主任工程师
合计			510.20	100.00	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶柔的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申

<sup>1</sup> 曾权飞已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 21 日办理完成工商变更。

<sup>2</sup> 项伟已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 4 月 6 日办理完成工商变更。

报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“(13)合肥晶燧”。

合肥晶柔为员工持股平台，无实际控制人。

## (20) 合肥晶悬

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶悬的基本情况如下：

企业名称	合肥晶悬企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 20 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1110-2
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶悬的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	谢承璋	有限合伙人	20.00	3.97	分立器件技术中心技术经理
3	林皓庭	有限合伙人	20.00	3.97	制程一课副理
4	刘棋彬	有限合伙人	20.00	3.97	风险管理处处长
5	施介文	有限合伙人	20.00	3.97	N1A1厂长室副厂长
6	郭琦鋈	有限合伙人	20.00	3.97	业务一课副理
7	卢俊玮	有限合伙人	20.00	3.97	制程三课副理
8	李俊嘉	有限合伙人	20.00	3.97	业务二课副理
9	张永忠	有限合伙人	20.00	3.97	设计服务处副处长
10	沈圣宗	有限合伙人	20.00	3.97	薄膜开发部部经理
11	卓俊麒	有限合伙人	20.00	3.97	电脑辅助设计部部经理
12	官建宏	有限合伙人	20.00	3.97	洗净工程部技术经理
13	张贵财	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课技术副理
14	杨俊杰	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
15	许时斌	有限合伙人	16.00	3.17	设备二课技术副理
16	黄晋德	有限合伙人	16.00	3.17	分立器件技术中心资深处长
17	黄铭仁	有限合伙人	16.00	3.17	系统整合课副理
18	黄彦昌	有限合伙人	16.00	3.17	安全管理课副理



序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
19	齐志翰	有限合伙人	16.00	3.17	光罩课副理
20	陈俊宏	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
21	吴颖麒	有限合伙人	16.00	3.17	设备一课技术副理
22	陈庆鸿	有限合伙人	16.00	3.17	物管课技术副理
23	陈家宏	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
24	廖宥宏	有限合伙人	16.00	3.17	蚀刻生产课副理
25	邓元吉	有限合伙人	16.00	3.17	设备一课技术副理
26	蔡国智	有限合伙人	16.00	3.17	董事长
27	蔡承佑	有限合伙人	16.00	3.17	制程整合三部部经理
28	唐世桦	有限合伙人	16.00	3.17	消防管理课副理
29	洪佐旻	有限合伙人	16.00	3.17	设备四课技术副理
30	孙秉群	有限合伙人	12.00	2.38	设备三课技术副理
合计			<b>504.20</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶曩的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“(五) 申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“(13) 合肥晶煅”。

合肥晶曩为员工持股平台，无实际控制人。

### (21) 合肥晶本

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶本的基本情况如下：

企业名称	合肥晶本企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 17 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1109-1
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶本的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	计豪	有限合伙人	12.00	2.60	营运系统课技术副理
3	凌军	有限合伙人	12.00	2.60	制造信息课技术副理
4	顾炜	有限合伙人	12.00	2.60	业务一课副理
5	王厚有	有限合伙人	12.00	2.60	制程一课副理
6	张润生	有限合伙人	12.00	2.60	专案课副理
7	彭萍	有限合伙人	12.00	2.60	制程一课副理
8	杨排	有限合伙人	12.00	2.60	营运系统课技术副理
9	李强	有限合伙人	12.00	2.60	水处理课技术副理
10	刘秀梅	有限合伙人	12.00	2.60	光学模型组技术副理
11	詹霄飞	有限合伙人	12.00	2.60	客户工程一部代部经理
12	邢志同	有限合伙人	12.00	2.60	设备二课副理
13	封瑞	有限合伙人	10.00	2.17	工业工程二课代副理
14	刘波	有限合伙人	10.00	2.17	洁净及化学分析课副理
15	涂程林	有限合伙人	10.00	2.17	制程一课副理
16	王梦慧	有限合伙人	10.00	2.17	技术一课副理
17	邵迎亚	有限合伙人	10.00	2.17	整合一课副理
18	李倩娣	有限合伙人	10.00	2.17	平台课副理
19	汪高生	有限合伙人	10.00	2.17	网络系统课副理
20	徐东东	有限合伙人	10.00	2.17	大数据分析课副理
21	童佳佳	有限合伙人	10.00	2.17	环保课副理
22	蔡永霞	有限合伙人	10.00	2.17	品质体系稽核课副理
23	金良民	有限合伙人	10.00	2.17	行政系统课副理
24	祝进专	有限合伙人	10.00	2.17	逻辑一课副理
25	严俊生	有限合伙人	10.00	2.17	保安课副理
26	简瑞荣	有限合伙人	10.00	2.17	助理
27	张海英	有限合伙人	8.00	1.73	网络系统课主任工程师
28	李青	有限合伙人	8.00	1.73	生产资源课技术副理
29	张倩倩	有限合伙人	8.00	1.73	行政系统课主任工程师
30	周静	有限合伙人	8.00	1.73	经营系统课主任工程师
31	罗招龙	有限合伙人	8.00	1.73	模组开发处副处长
32	冯维	有限合伙人	8.00	1.73	物管课副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
33	邱显寰	有限合伙人	8.00	1.73	副总经理
34	田春	有限合伙人	8.00	1.73	资安室技术副理
35	胡旺能	有限合伙人	8.00	1.73	制造部技术副理
36	徐国宝	有限合伙人	8.00	1.73	营运系统课主任工程师
37	张兴才	有限合伙人	8.00	1.73	厂务课副理
38	高亮	有限合伙人	8.00	1.73	生产系统课副理
39	刘伟	有限合伙人	8.00	1.73	网络系统课主任工程师
40	未东洋	有限合伙人	8.00	1.73	营运系统课主任工程师
41	黄凤	有限合伙人	8.00	1.73	制程一课技术副理
42	檀翠琴	有限合伙人	8.00	1.73	经营系统课技术副理
43	唐昌玉	有限合伙人	8.00	1.73	工业工程一课副理
44	夏海峰	有限合伙人	8.00	1.73	应急管理课副理
45	巫瑶瑶	有限合伙人	8.00	1.73	生产管理课技术副理
46	黄玉	有限合伙人	8.00	1.73	制程二课主任工程师
47	丁超	有限合伙人	8.00	1.73	光罩课技术副理
48	郑兴华	有限合伙人	8.00	1.73	营运系统课主任工程师
49	王冰	有限合伙人	8.00	1.73	客户工程二部代部经理
50	黎翠綾	有限合伙人	5.00	1.08	企业规划室资深处长
合计			<b>461.20</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶本的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶焯”。

合肥晶本为员工持股平台，无实际控制人。

## （22）合肥晶洛

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶洛的基本情况如下：

企业名称	合肥晶洛企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 17 日
执行事务合伙人	合肥晶策

注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1111-1
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶洛的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.06	/
2	张艳	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课技术副理
3	申政	有限合伙人	8.00	2.32	自动化系统课技术副理
4	张晓亮	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课技术副理
5	吴杰	有限合伙人	8.00	2.32	供应商管理课副理
6	甄福强	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课副理
7	王茹	有限合伙人	8.00	2.32	基准情报二课副理
8	李波	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课技术副理
9	周亚 <sup>1</sup>	有限合伙人	8.00	2.32	空调课主任工程师
10	余建军	有限合伙人	8.00	2.32	技术二课技术副理
11	罗贤福	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课副理
12	索圣涛	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课副理
13	冯玲	有限合伙人	8.00	2.32	IP服务一组技术副理
14	张庆楼	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课主任工程师
15	杨翼虎	有限合伙人	8.00	2.32	设备整合部技术副理
16	周高	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课技术副理
17	陈红军 <sup>2</sup>	有限合伙人	8.00	2.32	可靠性工程课主任工程师
18	李加龙	有限合伙人	8.00	2.32	气体化学课技术副理
19	陈诚	有限合伙人	8.00	2.32	电力课主任工程师
20	李翔	有限合伙人	8.00	2.32	传送设备课主任工程师
21	戴东正	有限合伙人	8.00	2.32	传送设备课技术副理
22	王阳阳	有限合伙人	8.00	2.32	PDK二课代副理
23	胡勤	有限合伙人	8.00	2.32	设备信息课技术副理
24	蒋栋梁	有限合伙人	8.00	2.32	气体化学课主任工程师
25	章淑媛	有限合伙人	8.00	2.32	工程信息课副理

<sup>1</sup>周亚已将其持有的全部出资额转让至朱晓娟，已于 2023 年 3 月 7 日办理完成工商变更。

<sup>2</sup>陈红军已将其持有的全部出资额转让至朱晓娟，已于 2023 年 4 月 6 日办理完成工商变更。

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
26	耿辉	有限合伙人	8.00	2.32	电力课主任工程师
27	田园	有限合伙人	8.00	2.32	专案课主任工程师
28	陈炜	有限合伙人	8.00	2.32	客户品质服务课技术副理
29	丁贤林	有限合伙人	8.00	2.32	逻辑一课副理
30	郑璐	有限合伙人	8.00	2.32	品质体系稽核课主任工程师
31	马杰	有限合伙人	8.00	2.32	水处理课主任工程师
32	葛杨	有限合伙人	8.00	2.32	系统整合课技术副理
33	贺勇	有限合伙人	8.00	2.32	设备二课技术副理
34	葛成海	有限合伙人	7.00	2.03	逻辑二课副理
35	田文星	有限合伙人	7.00	2.03	可靠性工程课副理
36	雷明芹	有限合伙人	7.00	2.03	保健课代副理
37	杨黎	有限合伙人	5.00	1.45	业务二课主任工程师
38	李冉	有限合伙人	5.00	1.45	流程整合组技术副理
39	张亚南	有限合伙人	5.00	1.45	制造信息课技术副理
40	陶磊	有限合伙人	5.00	1.45	制程一课主任工程师
41	李晓刚	有限合伙人	5.00	1.45	制造信息课主任工程师
42	李丽鲜	有限合伙人	5.00	1.45	故障分析课主任工程师
43	程挚	有限合伙人	5.00	1.45	制程三课主任工程师
44	陈宗义	有限合伙人	5.00	1.45	先进整合前端组主任工程师
45	崔一丁	有限合伙人	5.00	1.45	调研一课主任工程师
46	殷赛赛	有限合伙人	5.00	1.45	量测设备课主任工程师
47	薛君	有限合伙人	5.00	1.45	量测设备课主任工程师
48	李可玉	有限合伙人	5.00	1.45	光学模型组主任工程师
49	赵伟	有限合伙人	5.00	1.45	设备信息课主任工程师
50	李文庆	有限合伙人	2.00	0.58	客户品质服务课副理
合计			<b>344.20</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶洛的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶煅”。

合肥晶洛为员工持股平台，无实际控制人。

### (23) 合肥晶辽

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶辽的基本情况如下：

企业名称	合肥晶辽企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 20 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1110-3
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶辽的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.07	/
2	周义亮	有限合伙人	12.00	4.08	副总经理
3	许凯迪	有限合伙人	12.00	4.08	自动化系统课副理
4	林胜雄	有限合伙人	12.00	4.08	水处理课副理
5	刘志铭	有限合伙人	12.00	4.08	系统整合课副理
6	陈宏伟 <sup>1</sup>	有限合伙人	12.00	4.08	制程一课副理
7	钟尚仁	有限合伙人	12.00	4.08	气体化学课技术副理
8	黄晋德	有限合伙人	12.00	4.08	分立器件技术中心资深处长
9	翁文杰	有限合伙人	12.00	4.08	制程二课技术副理
10	邱显寰	有限合伙人	12.00	4.08	副总经理
11	蔡辉堂	有限合伙人	12.00	4.08	layout课副理
12	王曼真	有限合伙人	12.00	4.08	制程三课副理
13	吴德刚	有限合伙人	10.00	3.40	工业工程三课副理
14	林宗晔	有限合伙人	10.00	3.40	设备信息课副理
15	何瑞凤	有限合伙人	10.00	3.40	基准情报一课副理
16	蔡孟孺	有限合伙人	10.00	3.40	代工业务三部技术经理
17	简瑞荣	有限合伙人	10.00	3.40	协理
18	张家玮	有限合伙人	8.00	2.72	逻辑四课主任工程师

<sup>1</sup> 陈宏伟已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 21 日办理完成工商变更。

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
19	黄绍铭	有限合伙人	8.00	2.72	制程一课技术副理
20	黄任逢	有限合伙人	8.00	2.72	设备一课主任工程师
21	林宏展	有限合伙人	8.00	2.72	设备三课技术副理
22	张建烜	有限合伙人	8.00	2.72	空调课技术副理
23	刘铭哲	有限合伙人	8.00	2.72	设备三课技术副理
24	林子荏	有限合伙人	8.00	2.72	制程四课副理
25	丘卓册	有限合伙人	8.00	2.72	空调课主任工程师
26	张伟瑾	有限合伙人	8.00	2.72	N1厂厂长
27	江承达	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课主任工程师
28	蔡志宏	有限合伙人	8.00	2.72	安环体系课副理
29	刘凯文	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课技术副理
30	蔡明洋	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课副理
31	蔡国智	有限合伙人	8.00	2.72	董事长
合计			<b>294.20</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶辽的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶燧”。

合肥晶辽为员工持股平台，无实际控制人。

#### （24）合肥晶确

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶确的基本情况如下：

企业名称	合肥晶确企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 17 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1111-3
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶确的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	简瑞荣	有限合伙人	15.00	6.12	协理
3	刘云	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
4	冉薇	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
5	龚睿	有限合伙人	5.00	2.04	自动化系统课主任工程师
6	夏飞	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
7	王超	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
8	龚超 <sup>1</sup>	有限合伙人	5.00	2.04	制程模拟组主任工程师
9	李晶	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
10	苏翔	有限合伙人	5.00	2.04	水处理课主任工程师
11	王伟	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
12	李伟	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
13	高玉春	有限合伙人	5.00	2.04	设备自动化课主任工程师
14	吴曦	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
15	张悦	有限合伙人	5.00	2.04	结构分析课主任工程师
16	李克飞	有限合伙人	5.00	2.04	逻辑二课主任工程师
17	李建	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
18	章昭	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
19	余学会	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
20	何震	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
21	梁锐	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
22	何春龙	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
23	陈晓红	有限合伙人	5.00	2.04	制程三课主任工程师
24	马统越	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
25	于心礼	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
26	李左军	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
27	丁佳佳	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
28	王永辉	有限合伙人	5.00	2.04	设备四课主任工程师
29	谢泉	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师

<sup>1</sup> 龚超已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2023 年 2 月 21 日办理完成工商变更。



序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
30	李文庆	有限合伙人	5.00	2.04	专案课技术副理
31	陆瑞	有限合伙人	5.00	2.04	水处理课主任工程师
32	潘雨	有限合伙人	5.00	2.04	水处理课技术副理
33	张雷	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
34	范圣罗	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
35	夏晶京	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
36	夏炎照	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
37	顾亚秋	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
38	张克磊	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
39	赵琼	有限合伙人	5.00	2.04	设备整合部主任工程师
40	祖文秀	有限合伙人	5.00	2.04	大数据分析课主任工程师
41	钱发	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
42	王翠	有限合伙人	5.00	2.04	结构分析课主任工程师
43	汪雪春	有限合伙人	5.00	2.04	整合二课代副理
44	程奎	有限合伙人	5.00	2.04	系统整合课主任工程师
45	韦彬	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
46	蒋磊	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
47	李贵徽	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
48	万焜	有限合伙人	5.00	2.04	自动化系统课主任工程师
合计			245.20	100.00	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶确的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶焯”。

合肥晶确为员工持股平台，无实际控制人。

#### （25）合肥晶铁

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶铁的基本情况如下：

企业名称	合肥晶铁企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 17 日

执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1113-2
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶铁的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	宫保友	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课工程师
3	汪丹丹	有限合伙人	5.00	2.04	中段制程整合一课主任工程师
4	王安然	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
5	刘辉	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
6	卜立一	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
7	耿佳	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
8	张乐	有限合伙人	5.00	2.04	设备二课代副理
9	吴宣	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
10	张凯	有限合伙人	5.00	2.04	生产资源课主任工程师
11	刘刚	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
12	黄未来	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
13	王璇	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
14	陈博	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
15	沈毛振	有限合伙人	5.00	2.04	专案课主任工程师
16	吴东东	有限合伙人	5.00	2.04	设备二课主任工程师
17	王光宇	有限合伙人	5.00	2.04	逻辑一课主任工程师
18	牛保林	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻生产课主任工程师
19	王璐璐	有限合伙人	5.00	2.04	生产资源课主任工程师
20	邱明记	有限合伙人	5.00	2.04	设备课技术副理
21	张晗	有限合伙人	5.00	2.04	大客户课代副理
22	王龙	有限合伙人	5.00	2.04	黄光生产课主任工程师
23	吴数林	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
24	邵风展	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
25	王亮	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
26	陆舒楠	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
27	范成健	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
28	简瑞荣	有限合伙人	5.00	2.04	助理
29	陈建龙	有限合伙人	5.00	2.04	设备课主任工程师
30	胡亚东	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
31	王昆	有限合伙人	5.00	2.04	设备二课主任工程师
32	单洪亮	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
33	苗洁	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课技术副理
34	熊健	有限合伙人	5.00	2.04	生管一课副理
35	赵昆	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
36	李孙峰	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
37	汪小敏	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
38	戴惠敏	有限合伙人	5.00	2.04	物管课主任工程师
39	金满根	有限合伙人	5.00	2.04	制造部主任工程师
40	高攀	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
41	董骏	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课技术副理
42	冯静	有限合伙人	5.00	2.04	生产系统课主任工程师
43	金志欢	有限合伙人	5.00	2.04	专案课主任工程师
44	方小峰	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
45	蒋建新	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
46	方娟	有限合伙人	5.00	2.04	生管一课主任工程师
47	黄瑞宇	有限合伙人	5.00	2.04	光罩课主任工程师
48	代阳阳	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
49	张亚楠	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
50	刘小东	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
合计			245.20	100.00	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶铁的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）合肥晶煨”。

合肥晶铁为员工持股平台，无实际控制人。

**(26) 合肥晶妥**

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶妥的基本情况如下：

企业名称	合肥晶妥企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 17 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1115-1
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶妥的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	黄晋德	有限合伙人	15.00	6.24	分立器件技术中心资深处长
3	黎翠綾	有限合伙人	5.00	2.08	企业规划室资深处长
4	谢烈翔	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑三课代副理
5	刘利娟	有限合伙人	5.00	2.08	异常管理课主任工程师
6	孙航海	有限合伙人	5.00	2.08	设备信息课主任工程师
7	柯焱	有限合伙人	5.00	2.08	制程一课主任工程师
8	邱显寰	有限合伙人	5.00	2.08	副总经理
9	马忠祥	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑一课副理
10	丁璇璇	有限合伙人	5.00	2.08	行政与网络系统部技术副理
11	吴俊	有限合伙人	5.00	2.08	行政系统课主任工程师
12	张静	有限合伙人	5.00	2.08	整合一课代副理
13	侯丹丹	有限合伙人	5.00	2.08	变更管理课主任工程师
14	程洋	有限合伙人	5.00	2.08	技术二课副理
15	郝利兰	有限合伙人	5.00	2.08	制程二课副理
16	王丽雅	有限合伙人	5.00	2.08	失效分析课代副理
17	张永仓	有限合伙人	5.00	2.08	专案课副代理
18	许飞 <sup>1</sup>	有限合伙人	5.00	2.08	技术一课主任工程师
19	俞佩佩	有限合伙人	5.00	2.08	失效分析课主任工程师
20	周芹芹	有限合伙人	5.00	2.08	营运系统课主任工程师

<sup>1</sup> 许飞已将其持有的全部出资额转让至江英和，已于 2023 年 4 月 6 日办理完成工商变更。

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
21	陈国彬	有限合伙人	5.00	2.08	异常管理课代副理
22	张国庆	有限合伙人	5.00	2.08	设备一课主任工程师
23	叶秀平	有限合伙人	5.00	2.08	总经理室主任管理师
24	颜传奇	有限合伙人	5.00	2.08	安全管理二组主任工程师
25	谭倩倩	有限合伙人	5.00	2.08	营运系统课主任工程师
26	蔡国智	有限合伙人	5.00	2.08	董事长
27	马婷	有限合伙人	5.00	2.08	元件二课副理
28	高创	有限合伙人	5.00	2.08	制程二课主任工程师
29	李磊	有限合伙人	5.00	2.08	安全管理二组主任工程师
30	晶晶	有限合伙人	5.00	2.08	可靠性工程课主任工程师
31	葛祥福	有限合伙人	5.00	2.08	变更管理课主任工程师
32	葛键	有限合伙人	5.00	2.08	流程整合组主任工程师
33	王博	有限合伙人	5.00	2.08	出货品质保证课主任工程师
34	操梦雅	有限合伙人	5.00	2.08	整合二课代副理
35	吕玉波	有限合伙人	5.00	2.08	供应商管理课主任工程师
36	崔洁	有限合伙人	5.00	2.08	平台服务课主任工程师
37	宋明明	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑三课代副理
38	朱晓娟	有限合伙人	5.00	2.08	董事、副总经理
39	郑鹏	有限合伙人	5.00	2.08	设备二课主任工程师
40	王云龙	有限合伙人	5.00	2.08	消防管理课主任工程师
41	孟娟	有限合伙人	5.00	2.08	技术一课代副理
42	马成	有限合伙人	5.00	2.08	经营管理组主任工程师
43	彭涛	有限合伙人	5.00	2.08	工业工程三课主任工程师
44	张东杰	有限合伙人	5.00	2.08	设备信息课主任工程师
45	韩小琴	有限合伙人	5.00	2.08	制程一课主任工程师
46	徐恩杰	有限合伙人	5.00	2.08	网络系统课主任工程师
47	曹文强	有限合伙人	5.00	2.08	经营系统课主任工程师
合计			240.20	100.00	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶妥的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“（13）”

合肥晶燬”。

合肥晶妥为员工持股平台，无实际控制人。

### (27) 合肥晶雄

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶雄的基本情况如下：

企业名称	合肥晶雄企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 20 日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1115-2
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶雄的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.13	/
2	黄南翔	有限合伙人	36.00	23.97	生管物管部部长
3	陈文璟	有限合伙人	20.00	13.32	制程整合一部部长
4	李维泽	有限合伙人	12.00	7.99	制程一课副理
5	简瑞荣	有限合伙人	10.00	6.66	助理
6	蔡君正	有限合伙人	8.00	5.33	整合二课副理
7	陈欣蕙	有限合伙人	8.00	5.33	元件一课技术副理
8	罗招龙	有限合伙人	6.00	3.99	模组开发处副处长
9	邱显寰	有限合伙人	6.00	3.99	副总经理
10	郑淙徽	有限合伙人	5.00	3.33	量测设备课主任工程师
11	姚怡雯	有限合伙人	5.00	3.33	整合四部一课代副理
12	陈俊雄	有限合伙人	5.00	3.33	统计设备管制课副理
13	谢文智	有限合伙人	5.00	3.33	营运企划处副处长
14	林岳煌	有限合伙人	5.00	3.33	扩散生产课主任工程师
15	葛年翔	有限合伙人	5.00	3.33	制程二课主任工程师
16	李奇威	有限合伙人	5.00	3.33	薄膜生产课生产线主任
17	蔡国智	有限合伙人	5.00	3.33	董事长
18	黄晋德	有限合伙人	3.00	2.00	分立器件技术中心资深处长
19	郭千琦	有限合伙人	1.00	0.67	模型器件一课副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
合计			150.20	100.00	-

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥晶雄的普通合伙人为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构，无实际控制人，其基本情况请参见本节之“九、发行人股本有关情况”之“(五) 申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”之“(13) 合肥晶燧”。

申报前一年新增股东中，部分董事、监事、高级管理人员通过员工持股平台间接持有发行人股份，具体情况请参见本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(八) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况”。

中金浦成为本次发行的中介机构中金公司的全资子公司。根据国家企业信用信息公示系统公开信息显示，中金公司通过其以自有或投资的已经基金业协会备案的相关金融产品等形式间接持有股东集创北方、宁波华淳的股权/财产份额（穿透后持有发行人股份的比例不超过 0.01%），该等投资行为并非中金公司主动针对公司进行投资，具体持股情况详见本招股意向书“附件二 与投资者保护相关的承诺”之“十、其他承诺事项”之“(六) 股东信息披露的相关承诺”。

除前述外，发行人申报前一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他关联关系。

### 3、战略投资者情况

截至本招股意向书签署之日，申报前一年发行人新增股东均不属于战略投资者。

#### (六) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

##### 1、合肥建投与合肥芯屏

合肥建投直接持有合肥芯屏 47.44%的出资额，并通过合肥建投资本管理有限公司（以下简称“建投资本”）控制合肥芯屏，具体情况如下：

##### (1) 建投资本对合肥芯屏具有控制力

根据合肥芯屏持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，截至本招股意向书签署之日，合肥芯屏的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	建投资本	普通合伙人	1,000.00	0.04
2	合肥建投	有限合伙人	1,159,000.00	47.44
3	合肥瀚和投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,033,125.00	42.29
4	合肥瀚屏投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	250,000.00	10.23
合计		-	<b>2,443,125.00</b>	<b>100.00</b>

根据合肥芯屏的合伙协议，普通合伙人建投资本为执行事务合伙人，有限合伙人 not 执行合伙事务；合肥芯屏设立投资决策委员会，5 名委员均由执行事务合伙人委派，投资决策委员会负责合伙企业投资项目决策。建投资本作为合肥芯屏的执行事务合伙人对外代表合伙企业、执行合伙事务，并通过委派投资决策委员会委员能够控制合肥芯屏投资项目决策。因此，建投资本对合肥芯屏具有控制力。

## （2）合肥建投对建投资本具有控制力

根据建投资本持有的《营业执照》、现行有效的《公司章程》，截至本招股意向书签署之日，建投资本的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	7,083.00	70.83
2	合肥德轩投资管理有限公司	2,917.00	29.17
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据建投资本的《公司章程》，股东会是公司的最高权力机构，股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、修改章程、解散或者变更公司形式等重大事项作出决议必须经全体股东通过，其他事项必须经代表 1/2 以上表决权的股东通过；建投资本设董事会，由 5 名董事组成，董事人选由股东推荐，其中合肥建投推荐 4 名，合肥德轩投资管理有限公司推荐 1 名，董事会对相关事项作出决议，必须经全体董事 2/3 以上同意通过。合肥建投持有建投资本 70.83% 的股权，是建投资本的控股股东，且合肥建投推荐的董事占建投资本全体董事的 2/3 以上。因此，合肥建投对建投资本具有控制力。



基于上述，合肥建投通过建投资本能够控制合肥芯屏。合肥建投及合肥芯屏的具体情况详见本招股意向书本节之“五、持有发行人 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一) 控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、控股股东的基本情况”及本节之“五、持有发行人 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(四) 其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“1、合肥芯屏”。

## 2、员工持股平台

员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构。员工持股平台的具体情况详见本招股意向书本节之“十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排”。

除上述外，本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。

### (七) 公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次发行不存在公司股东公开发售股份的情形。

## 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

#### 1、董事

本公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，全体董事均由公司股东大会选举产生。董事任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过 6 年。

截至本招股意向书签署之日，本公司董事会成员情况如下表所示：

姓名	职位	任期	提名人
蔡国智	董事长	2020 年 11 月至 2023 年 11 月	力晶科技
陆勤航	副董事长	2020 年 11 月至 2023 年 11 月	合肥建投
陈小蓓	董事	2021 年 12 月至 2023 年 11 月	合肥建投
郑素芬	董事	2020 年 11 月至 2023 年 11 月	力晶科技
朱晓娟	董事、副总经理	2020 年 11 月至 2023 年 11 月	合肥建投
朱才伟	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理	2020 年 11 月至 2023 年 11 月	合肥建投

姓名	职位	任期	提名人
安广实	独立董事	2020年11月至2023年11月	合肥建投
陈绍亨	独立董事	2020年11月至2023年11月	力晶科技
BEICHAO ZHANG (张北超)	独立董事	2020年11月至2023年11月	合肥建投

本公司各位董事的简历如下：

**蔡国智**，男，1953年出生，中国台湾，本科学历。蔡国智先生1977年9月至1978年4月，任大同股份有限公司设计工程师；1978年4月至1983年7月，任宏碁股份有限公司产品策略规划经理；1983年7月至1984年12月，任明基股份有限公司业务与采购协理；1985年1月至1987年12月，任美国宏碁股份有限公司总经理；1988年1月至1988年12月，任美国宏碁康点公司业务行销副总经理；1989年1月至1990年10月，任Esprit System, Inc.执行长、总经理；1990年11月至1994年12月，任美国精英电脑股份有限公司董事长、执行长；1990年11月至1994年12月，兼任世群创投有限公司美国代表；1995年1月至2012年11月，历任力晶科技资深副总经理、总经理、副董事长；2008年4月至2019年4月，任钜晶电子股份有限公司董事长；2019年5月至2020年3月任力积电副董事长兼国际策略总监；2020年3月至2020年6月，任力晶科技副执行长兼国际策略总监；2020年4月至2020年11月，任晶合有限董事长；2020年11月至今，任晶合集成董事长。

**陆勤航**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。陆勤航先生1995年8月至2006年9月，历任合肥市淮河路改造工程指挥部办公室科长、主任助理、副主任；2006年9月至2007年12月，任合肥城投房地产发展有限公司董事、总经理；2007年12月至今，历任合肥建投副总经理、董事兼副总经理、董事兼总经理；2015年5月至2020年11月，历任晶合有限执行董事、副董事长；2020年11月至今，任晶合集成副董事长。

**陈小蓓**，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈小蓓女士1994年7月至1998年1月，任合肥动力机械总厂宣教处员工；1998年2月至2000年11月，任合肥晚报社编辑部员工；2000年11月至2001年4月，任新站开发区管委会员工；2001年5月至2002年2月，任合肥市排水办公室政秘科员；2002年2月至2006年6月，任合肥城建投资控股有限公司办公室员工；2006年6月至今，历任合肥

建投办公室副主任、办公室主任、监事兼办公室主任、董事兼副总经理兼董事会秘书、副总经理；2021年12月至今，任晶合集成董事。

**郑素芬**，女，1959年出生，中国台湾，本科学历。郑素芬女士1997年10月至2002年6月，任力捷电脑股份有限公司协理；2002年6月至2011年4月，任力仁电子股份有限公司总经理；2011年4月至今，任智丰科技股份有限公司总经理；2019年12月至2020年11月，任晶合有限董事；2020年11月至今，任晶合集成董事。

**朱晓娟**，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。朱晓娟女士1986年2月至1990年3月，任合肥市教育工业公司办公室办事员；1990年3月至1995年3月，任合肥市教育委员会办公室办事员；1995年3月至2000年7月，任合肥市合九铁路实业公司财务部会计；2000年7月至2006年6月，任合肥市建设投资公司财务部会计；2006年6月至2015年11月，历任合肥建投法律审计部副部长、法律审计部部长、纪检监察室主任；2015年11月至2017年9月，任合肥金太阳能源科技股份有限公司党支部书记；2017年9月至2020年11月，历任晶合有限董事、董事兼审计师、董事兼行政副总；2020年11月至今，任晶合集成董事、副总经理。

**朱才伟**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。朱才伟先生2002年7月至2004年12月，任中国电子科技集团公司第四十三研究所财务处职员；2005年1月至2006年9月，任中国网络通信集团安徽省分公司财务部财务主管；2006年10月至2016年6月，历任合肥建投财务部主管、副部长；2016年3月至2020年11月，历任晶合有限总会计师、董事兼财务副总经理兼董事会秘书；2020年11月至今，任晶合集成董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理。

**安广实**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。安广实先生1981年7月至1991年7月，历任安徽省蚌埠粮食学校助教、讲师；1991年7月至今，历任安徽财经大学讲师、副教授、教授；2020年11月至今，任晶合集成独立董事。

**陈绍亨**，女，1957年出生，中国台湾，研究生学历。陈绍亨女士1978年7月至1980年8月，任嘉庆船务代理股份有限公司文件部职员；1980年8月至1982年10月，任美商大陆银行台北分行国外部专员；1982年10月至1987年2月，任美商汉华银行股份有限公司台北分行国外部资深襄理；1988年5月至1992年2月，任英商渣打银行

股份有限公司台北分行国外部资深副理；1992年1月至1999年2月，任中华商业银行国外部资深副理；1999年1月至2002年2月，任联邦商业银行国外部资深副总裁；2002年2月至2013年2月，任宜龙实业股份有限公司总经理；2004年2月至今，任亮群股份有限公司总经理；2020年11月至今，任晶合集成独立董事。

**BEICHAO ZHANG（张北超）**，男，1960年出生，澳大利亚籍，博士学历。张北超先生1991年8月至1993年11月，任澳大利亚堪培拉大学助理讲师；1995年2月至1998年1月，任悉尼大学博士后；1998年2月至2010年4月，任格罗方德半导体股份有限公司经理；2010年5月至2018年8月，任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司总监；2018年9月至2021年12月，历任上海佑磁信息科技有限公司资深总监、协理；2022年1月至今，任杭州积海半导体有限公司协理；2020年11月至今，任晶合集成独立董事。

## 2、监事

本公司监事会现由3名监事组成，其中1名职工代表监事，由职工代表大会选举产生。监事任期3年，可连选连任。

截至本招股意向书签署之日，本公司监事会成员情况如下表所示：

姓名	职位	任期	提名人
杨国庆	监事会主席	2020年11月至2023年11月	合肥建投
胡竞英	监事	2020年11月至2023年11月	力晶科技
王燕	职工代表监事	2020年11月至2023年11月	职工代表大会

本公司各位监事的简历如下：

**杨国庆**，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。杨国庆女士2003年7月至2005年3月，任合肥月宝酒店管理有限责任公司职员；2005年4月至2008年4月，任合肥市公路桥梁工程有限公司职员；2008年5月至2015年9月，历任合肥建投职员、业务主管；2015年9月至2020年4月，任合肥蓝科财务部部长；2019年7月至今，历任合肥建投财务部副部长、法律审计部副部长、法律审计部部长兼监事；2016年3月至2020年11月，任晶合有限监事；2020年11月至今，任晶合集成监事会主席。

**胡竞英**，女，1959年出生，中国台湾，研究生学历。胡竞英女士2003年12月至2009年1月，任纬来电视网副董事长兼总经理；2005年1月至2020年7月，任汇俊会计师事务所有限公司董事；2009年2月至2010年12月，任亚洲电视有限公司行政总裁；2011年1月至2012年2月，任PGMA基金亚洲区行政总裁；2011年3月至2020年6月，任企展控股有限公司独立董事；2011年7月至2011年12月，任金牌大风音乐文化集团总裁；2013年12月至2019年4月，任嘉年华国际控股有限公司独立董事；2014年1月至2019年3月，任金宝生物科技股份有限公司董事；2014年5月至2017年6月，任宏基股份有限公司全球财务长；2017年7月至2020年6月，任益宠生医股份有限公司董事长；2018年9月至2019年9月，任力积电监察人；2020年6月至今，任英达投资股份有限公司董事长；2019年12月至2020年11月，任晶合有限监事；2020年11月至今，任晶合集成监事。

**王燕**，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王燕女士2009年6月至2010年10月，任中建一局集团建设发展有限公司行政专员；2010年11月至2019年12月，历任合肥彩虹蓝光科技有限公司人事专员、人事主管；2019年12月至2020年11月，任晶合有限人力资源部主任管理师；2020年11月至今，任晶合集成职工代表监事、人力资源部主任管理师。

### 3、高级管理人员

本公司现有高级管理人员9名，由董事会聘任。本公司高级管理人员情况如下表所示：

姓名	职务
蔡辉嘉	总经理
朱才伟	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
詹奕鹏	副总经理
朱晓娟	董事、副总经理
邱显寰	副总经理
周义亮	副总经理
李迦谕	协理
简瑞荣	协理
李庆民	协理

**蔡辉嘉**，男，1965年出生，中国台湾，本科学历。蔡辉嘉先生1992年至1995年5月，任华隆微电子股份有限公司工程师；1995年6月至2016年6月，历任力晶科技工程师、课长、代副理、经理、部经理、副处长、副厂长、厂长、协理；2016年4月至2020年11月，历任晶合有限营运副总经理、执行副总经理、总经理；2020年11月至今，任晶合集成总经理。

**朱才伟**，简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“1、董事”。

**詹奕鹏**，男，1970年出生，中国台湾，研究生学历。詹奕鹏先生1997年7月至2001年8月，任联华电子股份有限公司主任工程师；2001年8月至2018年5月，任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司资深技术总监；2018年5月至2019年4月，任中国科学院上海微系统与信息技术研究所顾问；2019年4月至2020年11月，历任晶合有限研发协理、研发副总经理；2020年11月至今，任晶合集成副总经理。

**朱晓娟**，简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“1、董事”。

**邱显寰**，男，1969年出生，中国台湾，研究生学历。邱显寰先生1996年6月至2007年6月，历任力晶科技工程师、黄光工程部副理、黄光工程部经理；2007年6月至2013年8月，历任瑞晶电子股份有限公司黄光工程部经理、制程模组工程一处处长；2013年8月至2015年9月，历任台湾美光记忆体股份有限公司制程模组工程处处长、新技术处处长；2015年9月至2016年6月，任力晶科技技术处长；2016年6月至2020年11月，历任晶合有限N1厂厂长、协理、营运副总经理；2020年11月至今，任晶合集成副总经理。

**周义亮**，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。周义亮先生2005年6月至2006年7月，任硕中科技（苏州）有限公司工程师；2006年8月至2007年10月，任紫光宏茂微电子（上海）有限公司工程师；2007年11月至2010年10月，任安靠封装测试（上海）有限公司高级工程师；2011年1月至2011年9月，任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司高级工程师；2011年9月至2014年10月，任江苏汇成光电有限公司经理；2014年11月至2016年3月，任江苏纳沛斯半导体有限公司总监；2016年3月至2020年11月，历任晶合有限销售副总监、采购副总监、

业务协理；2020年11月至今，历任晶合集成协理、副总经理。

**李迦谕**，女，1977年出生，中国台湾，本科学历。李迦谕女士1999年7月至2000年6月，任广和会计师事务所查账员；2000年8月至2002年7月，任资诚联合会计师事务所查账员；2003年11月至2009年8月，历任勤业众信会计师事务所组长、副理、经理；2011年12月至2013年8月，任欣铨科技股份有限公司会计经理；2013年9月至2014年10月，任第一鞋业有限公司稽核总监；2014年11月至2018年11月，任鼎固控股有限公司稽核副总监；2019年1月至2020年11月，历任晶合有限专案处长、副总会计师、财务协理；2020年11月至今，任晶合集成协理。

**简瑞荣**，男，1970年出生，中国台湾，本科学历。简瑞荣先生1995年9月至1997年10月，任科林研发股份有限公司客服工程师；1997年10月至2000年7月，任世大积体电路股份有限公司设备工程师；2000年7月至2001年10月，任台湾积体电路制造股份有限公司设备工程师；2001年10月至2004年2月，任东元电机股份有限公司营销副理；2004年2月至2007年9月，任台湾积体电路制造股份有限公司采购主任工程师；2007年12月至2017年6月，任欣兴电子股份有限公司采购经理；2017年6月至2020年11月，任晶合有限采购处处长；2020年11月至今，任晶合集成协理。

**李庆民**，男，1962年出生，中国台湾，研究生学历。李庆民先生1992年8月至1993年3月，任工业技术研究院（光电所）工程师；1993年3月至1994年3月，任华邦电子股份有限公司制程整合工程师；1994年3月至1996年10月，任台湾茂矽电子股份有限公司元件开发工程师；1996年10月至1997年11月，任联瑞电子股份有限公司副理；1997年10月至1999年4月，任联华电子有限公司技术开发副理；1999年4月至1999年12月，任合泰电子股份有限公司整合经理；1999年12月至2012年2月，历任联华电子有限公司整合经理、资深经理；2012年2月至2016年10月，历任力晶科技开发处经理、开发部经理；2016年10月至2020年11月，任晶合有限技术开发处处长；2020年11月至今，历任晶合集成技术开发处处长、协理。

#### 4、公司核心技术人员

发行人综合考虑（1）拥有相关行业多年从业经历，专业背景较强；（2）在公司产品、营运、研发等岗位上担任重要职务；（3）任职期间对公司核心技术形成做出重要贡献，认定以下5名核心技术人员，该等人员情况如下表所示：

姓名	职务
蔡辉嘉	总经理
詹奕鹏	副总经理
邱显寰	副总经理
李庆民	协理
张伟瑾	N1厂厂长

**蔡辉嘉**，简历详见本招股意向书本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“3、高级管理人员”。

**詹奕鹏**，简历详见本招股意向书本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“3、高级管理人员”。

**邱显寰**，简历详见本招股意向书本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“3、高级管理人员”。

**李庆民**，简历详见本招股意向书本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“3、高级管理人员”。

**张伟瑾**，男，1965年出生，中国台湾，本科学历。张伟瑾先生1995年9月至2013年7月，任力晶科技制造部课长；2013年8月至2013年12月，任台湾美光记忆体股份有限公司制造部经理；2013年11月至2016年6月，任力晶科技制造部经理；2016年6月至2020年11月，历任晶合有限N1厂制造部经理、N1厂副厂长、N1厂厂长；2020年11月至今，任晶合集成N1厂厂长。

## （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股意向书签署之日，除在本公司及控股子公司任职外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	在发行人处担任职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的其他关联关系
----	-----------	------	------	-----------------



姓名	在发行人处担任职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的其他关联关系
蔡国智	董事长	启基科技股份有限公司	独立董事	-
		Diodes Inc.	独立董事	-
陆勤航	副董事长	合肥建投	董事兼总经理	发行人控股股东，陈小蓓担任副总经理
		启迪控股股份有限公司	董事	-
陈小蓓	董事	合肥建投	副总经理兼董事会秘书	发行人控股股东，陆勤航担任董事兼总经理
		合肥建投资本管理有限公司	董事	合肥建投控制
		安徽省合肥联合发电有限公司	董事	-
		合肥市大数据资产运营有限公司	董事	-
		合肥丰乐种业股份有限公司	董事	合肥建投控制
		合肥中科微电子创新中心有限公司	董事	-
		合肥百货大楼集团股份有限公司	董事	合肥建投控制
		合肥京东方显示技术有限公司	董事长	-
		合肥维信诺科技有限公司	董事	-
		蔚来控股有限公司	董事	-
		合肥德轩投资管理有限公司	董事	-
		京东方科技集团股份有限公司	监事	-
郑素芬	董事	智丰科技股份有限公司	总经理	-
		新相科技股份有限公司	董事长	-
		顺立投资股份有限公司	董事	-
		瑞相科技股份有限公司	董事	-
		晶相光电股份有限公司	董事	-
		宏丽数位创意股份有限公司	董事	力晶科技控制
		智成电子股份有限公司	董事	力晶科技控制
		力晶微元电子股份有限公司	董事长	力晶科技控制
		集邦科技股份有限公司	董事	-
		富硕投资股份有限公司	董事	力晶科技控制
		智仁科技开发股份有限公司	董事	力晶科技控制
		智慧记忆科技股份有限公司	董事	力晶科技控制
安广实	独立董事	淮南润成科技股份有限公司	独立董事	-
		凯盛科技股份有限公司	独立董事	-
		山东奥福环保科技股份有限公司	独立董事	-
		安徽昊方机电股份有限公司	独立董事	-

姓名	在发行人处担任职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的其他关联关系
		安徽财经大学	教授	-
陈绍亨	独立董事	亮群股份有限公司	总经理	-
BEICHAO ZHANG (张北超)	独立董事	杭州积海半导体有限公司	协理	-
杨国庆	监事	合肥建投	法律审计部部长 兼监事	发行人控股股东，陆勤航担任董事兼总经理，陈小蓓担任副总经理
		合肥鼓楼商厦有限责任公司	监事	合肥建投控制
		安徽中安智通科技股份有限公司	监事	合肥建投控制
		合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	监事	合肥建投控制
		合肥建翔投资有限公司	职工监事	-
		合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司	董事	合肥建投控制
		合肥市住房租赁发展股份有限公司	董事	合肥建投控制
		合肥市建设投资有限公司	监事	合肥建投控制
胡竞英	监事	英达投资股份有限公司	董事长	-
		智联服务股份有限公司	独立董事	-
		维格饼家股份有限公司	独立董事	-
		疯狂秀股份有限公司	董事	-
		中兴农林开发股份有限公司	董事	-
		天脉科技股份有限公司	监察人	-
		合富润生企业管理咨询（上海）有限公司	董事	-
		合润生活国际有限公司	董事	-
		智仁科技开发股份有限公司	顾问	力晶科技控制
		绿景（中国）地产投资有限公司	独立董事	-
		合美展业股份有限公司	监察人	-
		先量企业管理咨询（上海）有限公司	监事	-
周义亮	副总经理	安徽大学	技术顾问	-

### （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

截至本招股意向书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

**（四）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年违法违规情况**

最近三年，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

**（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重要协议及其履行情况**

截至本招股意向书签署之日，发行人的董事、监事与公司已签订《聘任合同》；发行人高级管理人员及核心技术人员与公司已签订《劳动合同》及《保密、竞业限制、知识产权保护及诚信行为协议》。截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行协议约定的义务和职责，遵守相关承诺。除上述协议外，发行人未与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。

**（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近 2 年内的变动情况****1、董事的变动情况**

最近两年，发行人董事变化情况如下：

变动情况	原因	影响
2021年12月20日，晶合集成召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司更换董事的议案》，同意选举陈小蓓为公司董事	股东更换委派董事	不构成重大不利变化

**2、监事的变动情况**

最近两年，发行人监事未发生变化。

**3、高级管理人员的变动情况**

最近两年，发行人高级管理人员变化情况如下：

变动情况	原因	影响
2021年11月30日，发行人召开第一届董事会第八次会议，周义亮由协理变更为公司副总经理	发行人内部培养产生	不构成重大不利变化

#### 4、核心技术人员的变动情况

发行人核心技术人员最近两年未发生变化。

上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的变更均依法履行了《公司法》及《公司章程》规定的程序，且该等变动未对发行人的法人治理结构、经营政策的延续性产生重大不利影响，不属于董事、监事、高级管理人员、核心技术人员发生重大变化的情形。

#### (七) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至本招股意向书签署之日，除员工持股平台外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如下：

姓名	在发行人处担任职务	投资企业名称	出资额/持股数量	出资比例/持股比例
蔡国智	董事长	力积电	278,695 股	0.0071 %
		Xsense Technology Corporation	1,623,431 股	7.06%
		Diodes Inc.	43,055 股	0.088%
蔡辉嘉	总经理	力积电	191,804 股	0.0049%
		力晶科技	135,873 股	0.0099%
郑素芬	董事	智丰科技股份有限公司	3.052 万元新台币	0.0021%
		顺立投资股份有限公司	788.60 万元新台币	73.73%
		智合精准医学科技股份有限公司	46.03 万元新台币	0.11%
		智成电子股份有限公司	0.78 万元新台币	0.0018%
		集邦科技股份有限公司	4.22 万元新台币	0.03%
胡竞英	监事	英达投资股份有限公司	600 万元新台币	60%
		合富润生企业股份有限公司	123.44 万元新台币	5.56%
		中兴农林开发股份有限公司	50 股	5%
		合富润生企业管理咨询（上海）有限公司	200 万元	7%
		合润生活国际有限公司	210.87 万元港币	10%
		益宠生医股份有	229,730 股	14%

姓名	在发行人处担任职务	投资企业名称	出资额/持股数量	出资比例/持股比例
		限公司		
		蓝石管理顾问有限公司	100 万元新台币	25%
		力积电	210,000 股	0.0053%
张伟瑾	N1 厂厂长	力晶科技	73 股	0.0000053%
		力积电	105 股	0.0000027%

发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资与发行人不存在利益冲突。

#### (八) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

截至本招股意向书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不直接持有发行人股份，前述人员间接持有发行人股份的情况如下表所示：

姓名	职务/亲属关系	间接持股情况
蔡国智	董事长	持有合肥晶炯 27.10% 的出资额，合肥晶炯持有发行人 0.25% 的股份；持有合肥晶梢 11.24% 的出资额，合肥晶梢持有发行人 0.08% 的股份；持有合肥晶辽 6.80% 的出资额，合肥晶辽持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶柔 5.49% 的出资额，合肥晶柔持有发行人 0.06% 的股份；持有合肥晶妥 2.08% 的出资额，合肥晶妥持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶雄 3.33% 的出资额，合肥晶雄持有发行人 0.02% 的股份；持有合肥晶煨 1.63% 的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35% 的股份；持有合肥晶悬 3.17% 的出资额，合肥晶悬持有发行人 0.06% 的股份；持有合肥晶遂 0.81% 的出资额，合肥晶遂持有发行人 0.28% 的股份；持有合肥晶珏 10.72% 的出资额，合肥晶钰持有发行人 0.08% 的股份；持有合肥晶确 2.04% 的出资额，合肥晶确持有发行人 0.03% 的股份
周锦绒	蔡国智兄弟姐妹之配偶	持有力晶科技 0.0086% 的股份，力晶科技持有发行人 27.44% 的股份
朱晓娟	董事、副总经理	持有合肥晶遂 16.77% 的出资额，合肥晶遂持有发行人 0.28% 的股份；持有合肥晶妥 2.08% 的出资额，合肥晶妥持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶煨 0.81% 的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35% 的股份；持有合肥晶洛 4.65% 的出资额，合肥晶洛持有发行人 0.03% 的股份
朱才伟	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理	持有合肥晶遂 18.14% 的出资额，合肥晶遂持有发行人 0.28% 的股份
蔡辉嘉	总经理	持有合肥晶炯 22.63% 的出资额，合肥晶炯持有发行人 0.25% 的股份；持有力晶科技 0.0099% 的股份，力晶科技持有发行人 27.44% 的股份；持有合肥晶煨 2.12% 的出资额，合肥晶煨

姓名	职务/亲属关系	间接持股情况
		持有发行人0.35%的股份
邱显寰	副总经理	持有合肥晶炯 16.86% 的出资额，合肥晶炯持有发行人 0.25% 的股份；持有合肥晶辽 4.08% 的出资额，合肥晶辽持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶雄 3.99% 的出资额，合肥晶雄持有发行人 0.02% 的股份；持有合肥晶妥 2.08% 的出资额，合肥晶妥持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶本 1.73% 的出资额，合肥晶本持有发行人 0.05% 的股份
詹奕鹏	副总经理	持有合肥晶煨 14.65% 的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35% 的股份
简瑞荣	助理	持有合肥晶煨 7.85% 的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35% 的股份；持有合肥晶遂 0.81% 的出资额，合肥晶遂持有发行人 0.28% 的股份；持有合肥晶炯 0.44% 的出资额，合肥晶炯持有发行人 0.25% 的股份；持有合肥晶咖 5.81% 的出资额，合肥晶咖持有发行人 0.1% 的股份；持有合肥晶柔 1.37% 的出资额，合肥晶柔持有发行人 0.06% 的股份；持有合肥晶本 2.17% 的出资额，合肥晶本持有发行人 0.05% 的股份；持有合肥晶辽 3.40% 的出资额，合肥晶辽持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶确 6.12% 的出资额，合肥晶确持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶铁 2.04% 的出资额，合肥晶铁持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶雄 6.66% 的出资额，合肥晶雄持有发行人 0.02% 的股份
周义亮	副总经理	持有合肥晶遂 15.31% 的出资额，合肥晶遂持有发行人 0.28% 的股份；持有合肥晶辽 4.08% 的出资额，合肥晶辽持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶梢 2.30% 的出资额，合肥晶梢持有发行人 0.08% 的股份
李迦谕	助理	持有合肥晶炯 8.87% 的出资额，合肥晶炯持有发行人 0.25% 的股份
李庆民	助理	持有合肥晶煨 3.26% 的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35% 的股份
张伟瑾	N1 厂厂长	持有合肥晶煨 4.88% 的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35% 的股份；持有合肥晶辽 2.72% 的出资额，合肥晶辽持有发行人 0.03% 的股份；持有合肥晶柔 3.92% 的出资额，合肥晶柔持有发行人 0.06% 的股份；持有力晶科技 0.0000053% 的股份，力晶科技持有发行人 27.44% 的股份

## （九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

### 1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序

2020 年 11 月 20 日，发行人召开创立大会，审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事薪酬的议案》，发行人不在公司内部任职的公司董事、监事不领取董事、监事职务报酬；在公司内部任职的董事、监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为每年

10 万元人民币。

2020 年 11 月 20 日，发行人召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，公司的高级管理人员、核心技术人员的薪酬由固定薪酬、奖金及其他薪酬组成。

## 2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期发行人利润总额的比例

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额在发行人各期利润总额中的占比如下：

年份	薪酬总额（万元）	利润总额（万元）	占比（%）
2020 年度	1,703.34	-125,746.81	-
2021 年度	2,376.14	172,926.30	1.37
2022 年度	3,889.04	315,640.42	1.23

截至本招股意向书签署日，公司内部任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在关联企业领取薪酬。

除领取上述收入外，公司未制定公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员享受的其他待遇和退休金计划。

## 十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排

公司骨干人员通过员工持股平台间接持有发行人股份。截至本招股意向书签署之日，15 家员工持股平台合计持有发行人 1.47% 的股份。

### （一）股权激励的人员构成

员工持股平台的人员构成详见本招股意向书本节之“九、发行人股本有关情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”之“2、申报前一年新增股东的基本情况”。

### （二）股权激励的决策流程

2020 年 9 月 10 日，晶合有限召开董事会会议，审议通过员工持股方案和员工持股管理办法，同意员工持股平台对公司增资 13,100.00 万元。

本次员工激励的认缴情况如下表所示：

序号	员工持股平台名称	认缴出资额（万元）	增资价款（万元）
1	合肥晶焮	519.54	3,071.00
2	合肥晶遂	419.74	2,481.10
3	合肥晶炯	381.31	2,253.90
4	合肥晶咖	145.66	861.00
5	合肥晶珏	126.21	746.00
6	合肥晶梢	117.41	694.00
7	合肥晶柔	86.28	510.00
8	合肥晶悬	85.26	504.00
9	合肥晶本	77.99	461.00
10	合肥晶洛	58.20	344.00
11	合肥晶辽	49.74	294.00
12	合肥晶确	41.45	245.00
13	合肥晶铁	41.45	245.00
14	合肥晶妥	40.60	240.00
15	合肥晶雄	25.38	150.00
	<b>合计</b>	<b>2,216.21</b>	<b>13,100.00</b>

本次股权激励的价格参考深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（鹏信资评报字[2020]第 080 号），并经各方友好协商，确定入股价格为 5.91 元/注册资本；该入股价格经 2020 年 9 月 7 日合肥市国资委出具《关于同意对合肥晶集成电路有限公司增资的批复》（合国资产权[2020]84 号）确认。

### （三）股权激励的主要安排

#### （1）加入员工持股平台

除非另有规定，在经批准的员工持股计划实施方案范围内，公司相关员工达到公司考核标准后，经员工持股平台管理人书面同意，可以取得员工持股平台的股权/出资份额。如直系亲属多人在公司的，只能一人持股。员工持股计划实行以岗定股，相关员工不得存在以下情形：最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；最近 36 个月内存在损害公司利益的情形的；存在《中华人民共和国公司法》第 148 条规定的行为，违反其对公司、子公司或任职关联



企业的忠实义务的；为各级党委、政府及其部门、机构任命的国有企业领导人员；为公司外部董事、监事（含职工代表监事）；法律法规规定不得参与员工持股计划的。

## （2）员工持股平台的退出

除非另有规定，并经员工持股平台管理人事先书面同意，于禁售期届满前员工不得向第三人（包括员工持股平台的其他员工）转让其在员工持股平台中的全部或部分股权/财产份额。员工违反本办法擅自转让的，该转让行为无效并应当赔偿由此给员工持股平台造成的损失。

于禁售期届满前，员工因任何原因（包括但不限于解除或终止劳动合同关系、退休、丧失民事行为能力、死亡等）自公司或其子公司或关联企业离职的，则该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应当向员工持股平台管理人（或其指定的符合条件的人士；下同）转让其持有的员工持股平台全部股权/财产份额，但另有约定或员工持股平台管理人书面同意的除外。员工（或其继承人、法定代理人或监护人）按照本款之规定向员工持股平台管理人转让其股权/财产份额的，转让价格由交易双方协商确定，员工持股平台向该等员工支付转让价款时将扣减相应的税费。

于禁售期届满后，员工因任何原因（包括但不限于解除或终止劳动合同关系、退休、丧失民事行为能力、死亡等）自公司或其子公司或关联企业离职的，则该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应当向员工持股平台管理人转让其持有的、尚未完全解除出售限制的全部员工持股平台股权/财产份额，但另有约定或员工持股平台管理人书面同意的除外。员工（或其继承人、法定代理人或监护人）按照本款之规定向员工持股平台管理人转让其股权/财产份额的，转让价格由交易双方协商确定，员工持股平台向该等员工支付转让价款时将扣减相应的税费。

除另有约定或员工持股平台管理人书面同意的，无论员工因任何原因离职，该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应于其提出离职之日起 15 个自然日内（以下简称“出售期限”）向员工持股平台管理人发出指示，按前款规定出售/减持其持有的员工持股平台股权/财产份额。出售期限届满后，员工未向员工持股平台管理人发出出售/减持指示的，员工持股平台管理人有权自主决定出售/减持上述员工持有的股权/财产份额，且无须对此承担法律责任。离职员工持有的未经解除出售限制的股权/财产份额，依照前述规定办理。

#### （四）是否履行登记备案程序

员工持股平台不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的行为，其资产未委托基金管理人进行管理，因此，员工持股平台不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二条所定义的私募投资基金，不需进行登记和备案。

#### （五）减持承诺

员工持股平台作为发行人股东，均出具了《关于股份锁定的承诺函》，主要内容请参见本招股意向书“附件二 与投资者保护相关的承诺”之“一、股份锁定的承诺”。

#### （六）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排

发行人实施股权激励，有利于形成对核心员工的有效激励与约束，增强公司凝聚力，与公司共担风险，保持公司在市场、技术及管理方面的竞争力。

公司上市前已实施的股权激励计划，单个激励对象通过股权激励计划持有的发行前后公司股权比例不超过 1%，对公司的股权结构不存在重大影响，股权激励不影响公司控制权。

发行人股权激励计划涉及的股份支付具体请参见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、重要会计政策和会计估计”之“（二十二）股份支付”。

## 十二、发行人员工及其社保情况

### （一）公司员工结构

截至报告期各期末，发行人及子公司员工人数和变化情况如下：

项目	2022年12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
员工总人数（人）	4,224	2,720	1,666

### 1、员工专业结构

截至报告期各期末，员工按专业结构划分情况如下：

2022年12月31日		
岗位类别	员工人数(人)	所占比例(%)
研发人员	1,388	32.86
制造人员	2,331	55.18
销售人员	102	2.41
管理人员	403	9.54
<b>合计</b>	<b>4,224</b>	<b>100.00</b>
2021年12月31日		
岗位类别	员工人数(人)	所占比例(%)
研发人员	480	17.65
制造人员	1,857	68.27
销售人员	70	2.57
管理人员	313	11.51
<b>合计</b>	<b>2,720</b>	<b>100.00</b>
2020年12月31日		
岗位类别	员工人数(人)	所占比例(%)
研发人员	280	16.81
制造人员	1,073	64.41
销售人员	50	3.00
管理人员	263	15.79
<b>合计</b>	<b>1,666</b>	<b>100.00</b>

## 2、员工学历结构

截至报告期各期末，员工按学历划分情况如下：

2022年12月31日		
学历	员工人数(人)	所占比例(%)
硕士及以上	1,403	33.22
本科	1,773	41.97
大专及以下	1,048	24.81
<b>合计</b>	<b>4,224</b>	<b>100.00</b>
2021年12月31日		
学历	员工人数(人)	所占比例(%)
硕士及以上	829	30.48

本科	1,249	45.92
大专及以下	642	23.60
合计	<b>2,720</b>	<b>100.00</b>
<b>2020年12月31日</b>		
学历	员工人数（人）	所占比例（%）
硕士及以上	494	29.65
本科	836	50.18
大专及以下	336	20.17
合计	<b>1,666</b>	<b>100.00</b>

### 3、劳务派遣情况

报告期内，公司不存在聘用劳务派遣人员的情形。

## （二）发行人执行社会保险制度、住房公积金制度情况

### 1、报告期内社会保险的缴纳情况

报告期内，发行人为员工按照中国大陆法律法规在境内缴纳社会保险的情况如下：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
员工总人数（人）	4,224	2,720	1,666
已缴纳人数（人）	3,844	2,186	1,297
已缴纳人数占比	91.00%	80.37%	77.85%
未缴纳人数（人）	380	534	369
未缴纳人数占比	9.00%	19.63%	22.15%

报告期内，发行人及其子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为：（1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；（2）在境内任职的中国台湾员工按照中国台湾地区相关规定缴纳了劳健保；（3）在境内任职的中国香港员工、外籍员工未缴纳社会保险；（4）境外子公司员工遵循当地法律相关规定缴纳社会保险。

### 2、报告期内住房公积金的缴纳情况

报告期内，发行人按照中国大陆法律法规在境内为员工缴纳住房公积金的情况如

下：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
员工总人数（人）	4,224	2,720	1,666
已缴纳人数（人）	3,842	2,277	1,352
已缴纳人数占比	90.96%	83.71%	81.15%
未缴纳人数（人）	382	443	314
未缴纳人数占比	9.04%	16.29%	18.85%

报告期内，发行人及其子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：（1）存在个别当月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；（2）在境内任职的中国台湾员工、中国香港员工、外籍员工未缴纳住房公积金；（3）境外子公司员工遵循当地法律相关规定无需缴纳住房公积金。

## 第五节 业务与技术

### 一、公司的主营业务、主要产品及服务

#### （一）主营业务概况

晶合集成主要从事 12 英寸晶圆代工业务，致力于研发并应用行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。

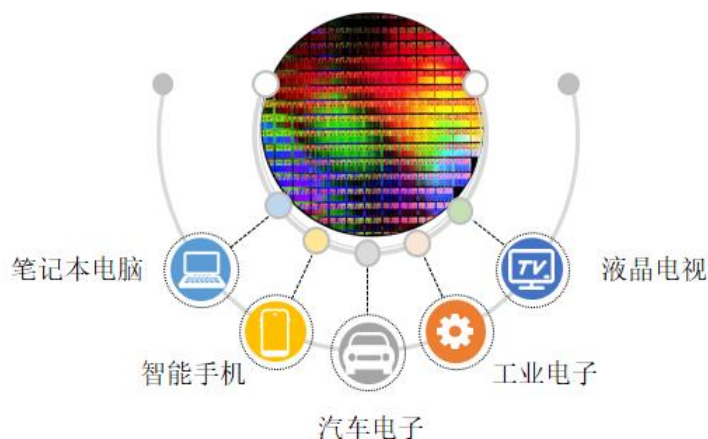
公司重视技术创新与工艺研发，建立了完善的研发创新体系，打造了一支经验丰富、勤勉专业的研发团队，搭建了 150nm、110nm、90nm、55nm 等制程的研发平台，涵盖了 DDIC、CIS、MCU、PMIC、E-Tag、Mini LED 以及其他逻辑芯片等领域。截至本招股意向书签署日，公司目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的风险量产。公司已具备 DDIC、CIS、MCU、PMIC、Mini LED、E-Tag 等工艺平台晶圆代工的技术能力。

报告期内，公司主要提供 150nm 至 90nm 的晶圆代工服务，所代工的主要产品为面板显示驱动芯片，其被广泛应用于液晶面板领域，包括电视、显示屏、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备等产品中，获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可。2020 年度，公司 12 英寸晶圆代工年产能达约 26.62 万片；2021 年度，公司 12 英寸晶圆代工产能为 57.09 万片；2022 年度，公司 12 英寸晶圆代工产能为 126.21 万片。根据 Frost & Sullivan 的统计，截至 2020 年底，晶合集成已成为中国大陆收入第三大、12 英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业（不含外资控股企业）。根据市场研究机构 TrendForce 的统计，2022 年第二季度，在全球晶圆代工企业中，公司营业收入排名全球第九。

#### （二）主要产品及服务

晶合集成主要向客户提供 12 英寸晶圆代工服务，按照客户的设计需求，运用半导体专用设备和材料，制造符合客户预期功能和质量的集成电路产品。截至本招股意向书签署之日，在晶圆代工制程节点方面，公司已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的风险量产；在晶圆代工工艺平台方面，公司致力于提供多元化工艺平台服务。

公司所代工的主要产品为 DDIC，DDIC 通过高压元件对电压的控制与调整，实现对液晶分子的转向控制，从而达成对液晶面板的显示控制；同时，搭配上后段电容，通过计算电场、电流等一系列特征的变化，可以同时实现显示功能与触控功能，公司目前所代工的 DDIC 等产品被广泛应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、可穿戴设备以及应用在智能家电、智慧办公等场景的显示面板和显示触控面板之中。未来，公司将进一步拓展工业控制、车载电子等更为广泛的应用场景之中。



### （三）主营业务收入构成

报告期内，发行人主营业务收入来源为晶圆代工服务。

#### 1、按制程节点分类

报告期内，发行人主要向客户提供制程节点为 150nm 至 90nm 晶圆代工服务。发行人按照制程节点分类的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
55nm	3,912.65	0.39%	4.99	0.00%	-	-
90nm	521,240.66	51.99%	303,310.46	55.95%	80,268.82	53.09%
110nm	316,507.96	31.57%	132,328.41	24.41%	40,725.48	26.94%
150nm	160,888.68	16.05%	106,440.58	19.64%	30,191.80	19.97%
合计	<b>1,002,549.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,084.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,186.11</b>	<b>100.00%</b>

注：发行人 55nm 技术平台正在风险量产阶段

## 2、按工艺平台分类

报告期内，发行人向客户提供 DDIC 及其他工艺平台的晶圆代工服务。发行人按照工艺平台分类的主营业务收入构成如下：

单位：万元

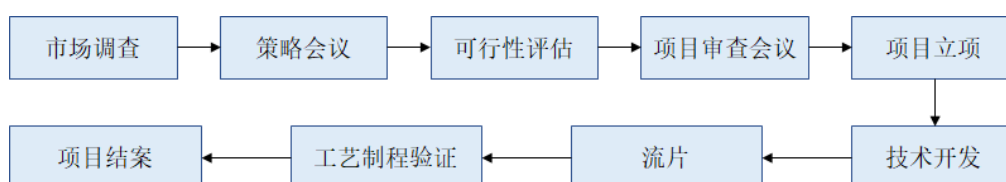
项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDIC 工艺平台晶圆代工	714,261.58	71.24%	467,914.67	86.32%	148,394.24	98.15%
其他工艺平台晶圆代工	288,288.37	28.76%	74,169.78	13.68%	2,791.87	1.85%
合计	1,002,549.95	100.00%	542,084.44	100.00%	151,186.11	100.00%

### （四）主要经营模式

公司主营业务为 12 英寸晶圆代工服务，专注于集成电路制造环节，经营模式为晶圆代工模式，具体如下：

#### 1、研发模式

发行人制定了研发管理制度，明确了研发过程中各部门的权责关系与作业流程，确保研发过程符合公司策略发展方向，实现经营效益最大化。发行人研发模式流程如下：



为保证研发效率及成本控制，公司制定了严格的研发进度管控方案，覆盖前期产品市场信息汇整、策略方向讨论、可行性评估、项目审查以及研发的各个环节。其中，研发过程中主要环节的具体含义如下：

环节	含义
策略会议	依据公司发展规划及策略方向，对技术研发进行讨论
项目审查会议	根据市场需求及工程技术，针对研发项目可行性及效益进行审查，以认定研发项目是否可行
技术开发	依据项目目标产品应用所需的工艺技术规格，对组件、电路、制程进行设计，并透过模拟仿真确认设计完整度



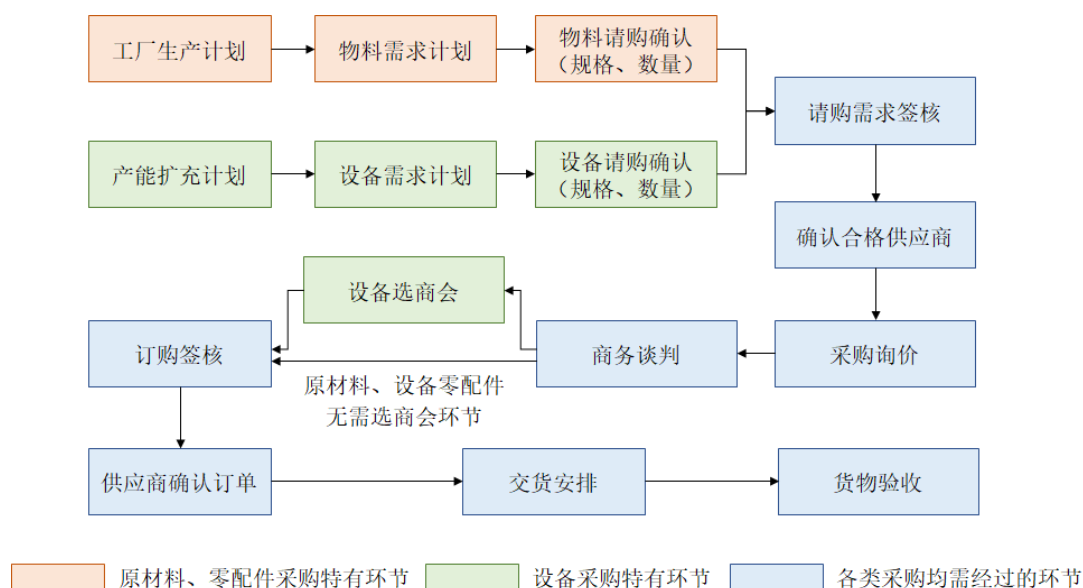
环节	含义
流片	将开发出的所有组件、电路以及第三方授权 IP 进行整合，产出芯片设计图，交由光罩厂制作光罩，并在硅片上进行制程加工生产
工艺制程验证	利用性能测试、老化实验等手段，对流片环节加工完成的功能、效能及质量进行全方位验证，以确保开发完成的芯片满足规格标准

## 2、采购模式

公司的供应商主要包括原材料供应商和设备供应商，公司通常采用直接采购模式，如果终端供应商采取经销模式进行销售，则公司也可通过经销商向终端供应商进行采购。

### (1) 采购流程

为加强成本控制、保证晶圆代工服务质量、提高生产效率和存货周转效率，公司建立了严格的采购流程，具体如下：



#### ①原材料

发行人原材料采购流程如下：

序号	步骤	内容
1	请购签核	发行人依据生产计划的需求，结合库存量及未来需求量，确定需要购买的物料项目、数量、规格等信息，并综合考虑订货批量、生产周期等因素，发起内部请购流程，由内部权责部门逐级签核
2	确认合格供应商	请购签核完成后，发行人采购部门在合格供应商名录中选择供应商进行

序号	步骤	内容
		询价，并开展商务谈判，结合价格、品质、交期等因素，最终选择一家或多家供应商
3	采购	发行人采购部门根据采购金额、交期等因素发起采购签核流程，由内部权责部门逐级签核，核准后出具采购订单给相应的供应商，发行人根据生产计划安排交货计划，并跟踪供应商交货进度
4	验收	供应商按照发行人的交货计划交货，并提供送货单、发票等文件，发行人检查货物包装情况后入库，发起验收签核流程，发行人品质部门检验合格后，完成验收签核

## ②设备

发行人设备采购流程如下：

序号	步骤	内容
1	请购签核	发行人根据产能扩充计划和年度预算情况，确定需要采购的设备类型、数量、型号及相关服务，选择合适的供应商，签订规格确认书，明确所需设备与服务的具体要求，发起请购单，请购单由发行人内部权责部门逐级签核
2	议价协商	发行人采购部门对合格供应商进行询价，结合价格、品质、交期等因素进行价格谈判
3	设备选商会	发行人采购部门将最终议价协商结果报设备选商会，设备选商会审议并结合供应商价格、交期等因素，作出设备采购决议
4	采购	依据设备选商会的决议，经发行人内部权责部门逐级签核后，向供应商发出设备采购合同/订单，跟进供应商生产进度，并及时安排提货、进口清关和送货到厂等工作
5	验收	设备到厂后，发行人根据与供应商签订的规格确认书进行验收

## (2) 供应商管理体系

公司建立了完善的供应商认证准入机制和供应商考核评价体系，以保证原材料、设备零配件及设备质量的稳定性和供应的持续性。

供应商经过资质评估、采购效益评估、入厂评估等环节评估通过后，方可成为公司的合格供应商，公司主要向进入公司合格供应商名单的供应商进行采购。

为对合格供应商进行有效管理，保证采购质量，发行人建立了严格的供应商考核评价体系和有效的供应商沟通机制，由相关部门对采购产品的质量、价格、服务等进行考核评价，若存在不符合公司供应商考核要求的情形，则与供应商进行沟通整改。

### 3、生产模式

#### (1) 生产阶段

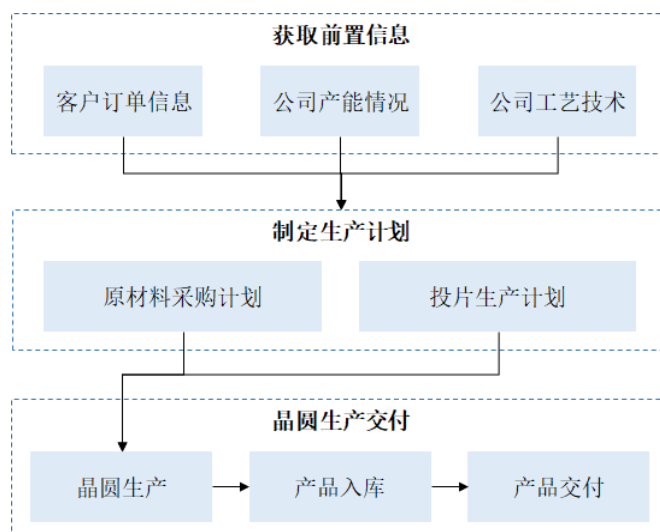
发行人接到客户需求后，首先进行小规模试产；在良率及工艺条件稳定后，进入风险量产阶段；在各项交付指标达标后，与客户签订正式的销售合同或接受批量订单，按照客户需求分配产能、制定生产计划、进行大批量生产，具体如下：



序号	生产阶段	具体内容
1	小规模试产	发行人基于现有工艺平台，向客户提供完整的技术设计套件，客户基于发行人的设计规则进行产品设计。客户设计完成后，发行人根据客户需求进行小规模试产
2	风险量产	在小规模试产的良率等指标满足客户对小规模试产阶段的要求、并经过客户同意后，发行人进入风险量产阶段，进一步扩大生产规模、优化生产流程和生产工艺，提高产品良率
3	大批量生产	在风险量产的良率等指标满足客户对风险量产阶段的要求、并经过客户同意后，发行人与客户签订正式的销售合同或接受批量订单，进入大批量生产阶段，按照客户需求分配产能、制定生产计划、进行大批量生产

#### (2) 生产流程

公司的生产流程图如下：



### ①获取前置信息

发行人接收客户订单后，根据客户订单信息、公司产能情况及公司工艺技术，对客户需求和公司生产能力进行综合分析。

### ②制定生产计划

发行人根据获取的前置信息制定生产计划，具体包括原材料采购计划和投片生产计划等。

### ③晶圆生产交付

发行人按照生产计划完成晶圆生产、产品入库，并按照客户需求完成产品交付。

## 4、营销模式

公司建立了规范、完整的销售团队，拥有多元化的营销渠道，通过不同的营销方式拓展客户，主要方式如下：

(1) 通过市场分析，挖掘潜在客户，并主动与潜在客户进行沟通，举行业务洽谈会，主动向客户推荐符合客户需求的技术平台；

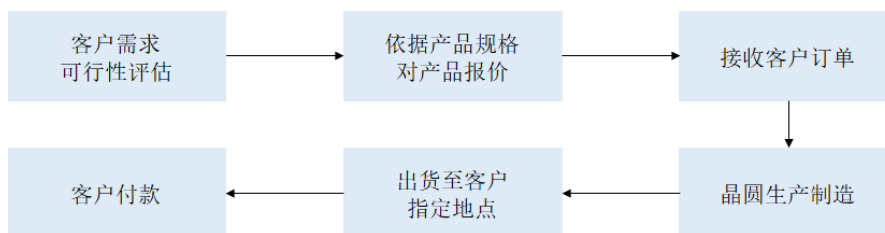
(2) 通过与晶圆代工上下游的企业（例如：集成电路设计企业、封装测试厂商等）及行业协会沟通交流，开发潜在客户；

(3) 通过参与学术交流、半导体峰会、行业展会、技术论坛、企业论坛等活动，塑造公司形象，获取潜在客户；

(4) 通过公司官网、新闻媒体等公开渠道，展示公司的工艺平台与技术水平，由潜在客户主动联系公司开展业务合作。

## 5、销售模式

公司采用直销模式进行销售，并制定了相应的销售管理制度，对销售流程进行规范。公司销售流程如下：



(1) 客户需求可行性评估：公司与客户进行沟通，客户对制程、工艺平台等提出明确需求，公司对客户需求进行可行性评估。

(2) 依据产品规格对产品报价：综合考虑生产成本、市场价格、产能安排、工艺开发等因素后，公司向客户提供报价单、预计交货时间表等信息。

(3) 接收客户订单：客户向公司下达订单，公司对订单审查无误后，接收客户订单。

(4) 生产制造：公司按照订单要求安排生产，并就生产状态与客户及时沟通。

(5) 出货至客户指定地点：公司按照客户指定的地点安排出货，开立发票。

(6) 客户付款：客户按照约定的付款方式进行付款。

## (五) 主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

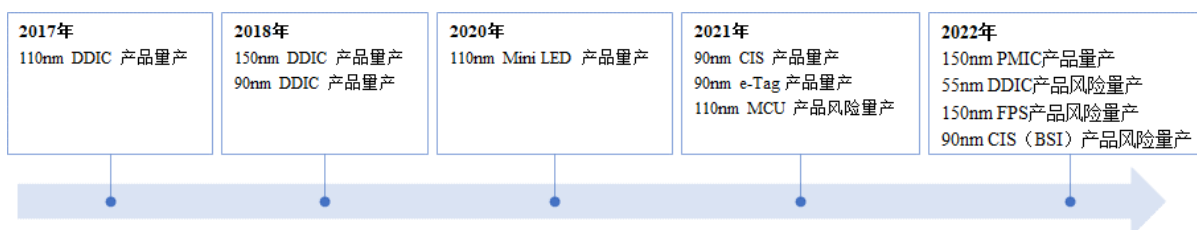
### 1、主营业务的演变情况

发行人主营业务为 12 英寸晶圆代工服务，自设立以来未发生改变。

### 2、主要产品及服务的演变情况

自设立以来，晶合集成的主营业务始终为 12 英寸晶圆代工服务，公司目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产，已具备 DDIC、Mini LED、CIS、e-Tag 等工艺平台的量产能力。

截至本招股意向书签署日，公司主要制程及工艺平台的演进情况如下：



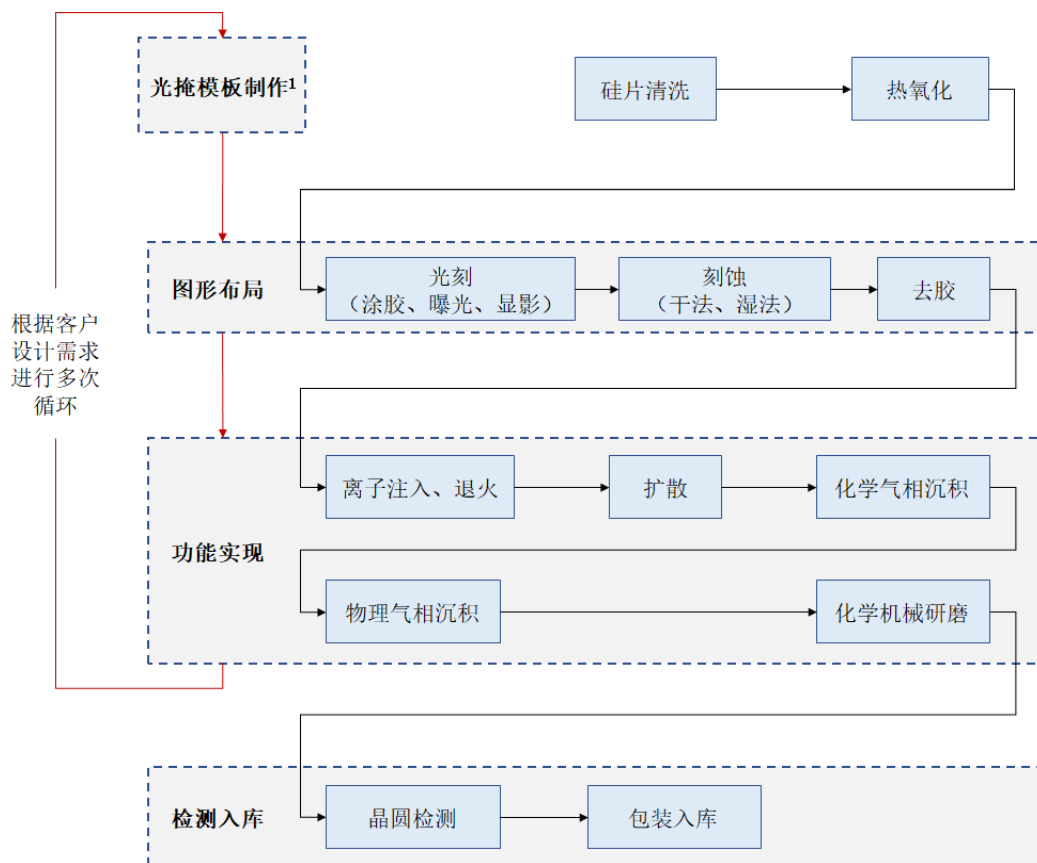
### 3、主要经营模式的演变情况

自设立以来，发行人始终采用晶圆代工模式，经营模式未发生变化。在晶圆代工模式下，发行人主营业务不涵盖集成电路设计环节，专门负责集成电路制造，为集成

电路设计公司提供晶圆代工服务。

## （六）工艺流程图

发行人的主营业务为晶圆代工，生产过程包括清洗、氧化、扩散等环节，其生产工艺流程图如下：



注：光掩模板由其他专业厂商生产，发行人不涉及光掩模板制造业务

公司的核心技术在图形布局、功能实现、检测入库等生产环节中均有使用，使用情况良好,核心技术的使用有助于提升公司产品的市场竞争力。公司的核心技术情况详见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发情况”之“（一）公司的核心技术情况”。

### 1、前期处理

#### （1）硅片清洗

使用喷淋或沉浸的方式，先用多种化学品对半导体硅片进行清洗，再用超纯水对半导体硅片进行二次清洗去除残留的化学液。清洗工序的目的是去除半导体硅片表面

的尘埃颗粒、残留有机物、表面金属离子等杂质，提高后续生长热氧化层的质量，保证后续工艺的稳定性。

## **(2) 热氧化**

在高温氧气和惰性气体的环境下，在半导体硅片表面生成二氧化硅薄膜。

## **2、图形布局**

### **(1) 光刻**

光刻主要由涂胶、曝光和显影三个步骤组成：1) 涂胶：将光刻胶均匀地涂布在旋转的半导体硅片上；2) 曝光：利用光刻机，通过特定波长的光线的照射，改变光刻胶的性质，将光掩模板上的电路图形转移到光刻胶上；3) 显影：利用显影液，去除曝光后光刻胶中的可溶解部分，准确地使光刻胶上形成图形。

### **(2) 刻蚀**

刻蚀是在光刻后，有选择性地去除半导体硅片上未被光刻胶覆盖区域的材料。常见的刻蚀方法包括湿法刻蚀和干法刻蚀，其中：湿法刻蚀使用液态化学品进行刻蚀，干法刻蚀利用等离子体进行刻蚀。

### **(3) 去胶**

刻蚀完成后，去除半导体硅片上未被溶解的光刻胶。

## **3、功能实现**

### **(1) 离子注入、退火**

在真空、低温的环境下，将特定种类的杂质离子以高能离子束的形式植入晶圆表面的特定区域，常见的离子元素种类包括硼、磷、砷等。离子注入后，在高温环境下消除离子注入导致的晶格缺陷，改变晶圆表面及内部的微观结构，以实现特定性能。

### **(2) 扩散**

在高温环境下，使杂质离子在不同离子浓度的区域间发生转移，改变和控制晶圆内杂质的类型、浓度和分布，形成不同电特性的区域，改变晶圆的电特性。

### **(3) 化学气相沉积**

利用不同分压的气态化学原材料在晶圆表面发生化学反应，并在晶圆表面沉积一

层固态薄膜。

#### **(4) 物理气相沉积**

利用溅射镀膜、真空蒸发、离子体镀膜、分子束外延等物理方法，轰击靶材，在晶圆表面沉积一层固态薄膜。

#### **(5) 化学机械研磨**

利用机械摩擦和化学反应对晶圆进行抛光，使晶圆表面平坦化。

### **4、检测入库**

#### **(1) 晶圆检测**

晶圆加工完成后，使用探针等检测设备对晶圆性能进行测试，验证其功能是否符合客户的产品规格要求。

#### **(2) 包装入库**

将检测合格的晶圆真空包装后入库。

## **二、行业基本情况**

### **(一) 发行人所属行业及确定依据**

公司主要从事晶圆代工业务。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为第 39 大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），发行人所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）及“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2012）（试行）》，发行人所处行业为战略性新兴产业分类中的“基础电子元器件及器材制造”（分类代码：2.2.5）及“集成电路”（分类代码：2.2.6）。

### **(二) 行业主管部门及管理体制、主要法律法规及政策**

#### **1、行业主管部门及管理体制**

公司所处行业的主管部门为工信部，主要职责为：研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按



国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资等项目等。

## 2、主要法律法规及产业政策

公司所处行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。各相关部委相继出台了多项政策支持行业的发展，相关文件的主要内容如下：

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
1	2000年	国务院	《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2000]18号）	首次专门针对软件和集成电路产业制定了鼓励政策，对集成电路行业的发展具有重要意义。
2	2010年	国务院	《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）	提出着力发展集成电路、高端服务器等核心基础产业的决定。
3	2011年	国务院	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）	从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七个方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政策。
4	2011年	全国人民代表大会	《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	提出大力发展新一代信息技术产业的要求，其中重点发展集成电路等产业。
5	2012年	工信部	《集成电路产业“十二五”发展规划》	作为集成电路行业发展的指导性文件和加强行业管理的依据，为“十二五”期间集成电路产业发展指明了方向。
6	2014年	工信部、发改委、科技部、财政部	《国家集成电路产业发展推进纲要》	到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距缩小，全行业收入年均增速超20%；到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。
7	2015年	国务院	《中国制造2025》	将集成电路作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维组装技术。
8	2016年	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）	明确了集成电路企业的税收优惠资格认定的非行政许可审批取消，规定了享受税收优惠的条件，进一步从政策上支持集成电路产业发展。
9	2016年	国务院	《国家创新驱动发展战略纲要》	加大集成电路等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度；全力攻克集成电路装备等方面的关键技术。
10	2016年	中共中央办公厅、国务院办公厅	《国家信息化发展战略纲要》	构建先进技术体系，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路，核心元件等薄弱环节实现根本性突破。
11	2016年	国务院	《“十三五”国家科技创新规划》（国发[2016]43号）	支持面向集成电路等优势产业领域建设若干科技创新平台；推动我国信息光电

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
			号)	子器件技术和集成电路设计达到国际先进水平。
12	2016年	质检总局、国家标准委、工信部	《装备制造业标准化和质量提升规划》(国质检标联[2016]396号)	加快完善集成电路标准体系,推进高密度封装,三维微组装、处理器、高端存储器、网络安全、信息通信网络等领域集成电路重大创新技术标准修订,开展集成电路设计平台、IP核等方面的标准研究。
13	2016年	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发[2016]67号)	启动集成电路重大生产力布局规划工程,实施一批带动作用强的项目,推动产业能力实现快速跃升。
14	2016年	国务院	《“十三五”国家信息化规划》(国发[2016]73号)	大力推进集成电路创新突破,加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片设计研发部署,推动32/28nm,15/14nm工艺生产线建设,加快10/7nm工艺技术研发。
15	2016年	发改委、工信部	《信息产业发展指南》(工信部联规[2016]453号)	着力提升集成电路设计水平;建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系;重点发展12英寸集成电路成套生产线设备。
16	2017年	科技部	《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》(国科发高[2017]90号)	优化产业结构,推进集成电路及专用装备关键核心技术突破和应用。
17	2017年	国务院办公厅	《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》(国办发[2017]79号)	提出发挥财政性资金带动作用,通过投资补助、资本金注入、设立基金等多种方式,广泛吸纳各类社会资本,支持企业加大技术改造力度,加大寸集成电路等关键领域和薄弱环节重点项目的投入。
18	2018年	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2018]27号)	对集成电路生产企业所得税优惠政策做了进一步规定和调整。
19	2019年	发改委	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	半导体、光电子器件、新型电子元器件(片式元器件、电力电子元器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等)等电子产品用材料,依然属于国家鼓励类产业之一。
20	2020年	国务院	《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予集成电路产业和软件产业诸多优惠政策。明确在一定时期内,线宽小于0.25微米(含)的特色工艺集成电路生产企业(含掩模版、8英寸及以上硅片生产企业)进口自用生产性原材料、消耗品,净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
				备零配件，免征进口关税。
21	2020年	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	国家鼓励的线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业，属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前5个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损，准予向以后年度结转，结转年限最长不得超过10年。 国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。 国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。
22	2021年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。

上述相关监管体制和法律法规、行政令的发布和实施，积极推动、规范行业发展，不存在对行业或行业内企业重大不利影响的变化，对公司经营资质、准入门槛的监管未发生重大变化，对公司的运营模式不直接产生具体影响，对行业竞争格局等不存在重大不利影响。

### （三）所属行业发展现状及未来发展趋势

#### 1、集成电路行业概况

##### （1）集成电路简介

集成电路（Integrated Circuit，IC）是一种具备完整、复杂电路功能的微型电子器件，该器件通过专门的集成电路制造工艺，实现晶体管、电阻、电容、电感等元器件及金属布线的互连，并将其集成在一块或若干块半导体晶片上。集成电路被广泛应用于通信、安防、军事、工业、交通、消费电子（例如：手机、电视、电脑等）等领域，在国家安全、经济建设和人民的日常生活中发挥着重要的作用，是社会信息化、产业

数字化的基石。

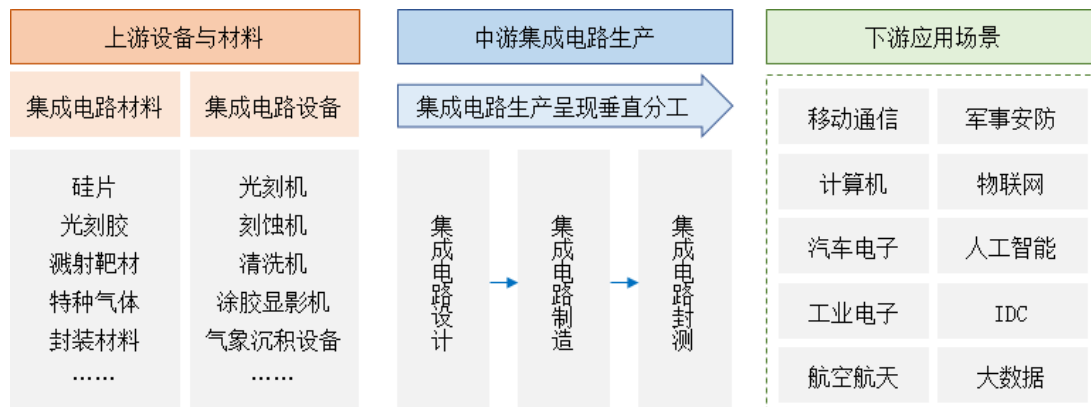
发行人所处的晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。

半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，与宏观经济及下游应用市场需求波动有较大关联，同时国家政策对行业的发展亦有较大影响。根据TrendForce的统计与分析，2021年，5G及新能源汽车兴起带动半导体需求增加，晶圆厂产能又无法快速投产，产能缺口不断扩大。但是在2022年，智能手机、消费电子需求下行，受到消费性终端需求疲软的影响，整体而言，2022年第三季度起产能缺口情况有所缓解，使得晶圆代工产能利用率面临挑战。

## （2）集成电路产业链

集成电路行业呈现垂直化分工格局，上游包括集成电路材料、集成电路设备等；中游为集成电路生产，集成电路生产环节亦呈现垂直化分工格局，可以具体划分为集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测；集成电路产业下游为各类终端应用。

集成电路产业链图



其中，集成电路生产的主要环节如下：

### ①集成电路设计

集成电路设计是通过系统及电路设计，按照预期的产品功能、产品性能等形成电路设计版图，是后续集成电路制造环节的基础。

## ②集成电路制造

集成电路制造是根据电路设计版图，通过光刻、刻蚀、离子注入、退火、扩散、化学气相沉积、物理气相沉积、化学机械研磨、晶圆检测等工艺流程，在半导体硅片上生成电路图形，产出可以实现预期功能的晶圆片。

## ③集成电路封测

集成电路封测包含封装、测试，其中：封装是通过切割、焊线、塑封等工艺，为制造环节产出的晶圆提供物理保护，并使之与外部器件实现电气连接；测试是在晶圆封装后，利用专业设备和工具，对其功能和性能进行测试。

发行人所处的晶圆代工行业处于产业链中的集成电路制造环节，专门负责集成电路制造，为集成电路设计公司提供晶圆代工服务，所代工的相关产品最终应用于消费电子等行业。

### (3) 集成电路行业经营模式

根据所包含的集成电路生产环节的不同，集成电路厂商可分为垂直整合模式（IDM 模式）、晶圆代工模式（Foundry 模式）和无晶圆厂模式（Fabless 模式）。

序号	项目	模式	代表企业
1	垂直整合模式（IDM 模式）	涵盖集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测以及后续的产品销售等环节	英特尔、三星电子
2	晶圆代工模式（Foundry 模式）	不涵盖集成电路设计环节，专门负责集成电路制造，为集成电路设计公司提供晶圆代工服务	台积电、格罗方德、中芯国际、晶合集成
3	无晶圆厂模式（Fabless 模式）	不涵盖集成电路制造环节和集成电路封测环节，专门负责集成电路设计和后续的产品销售，将集成电路制造和封测外包给专业的集成电路制造、封测企业	高通、英伟达

### (4) 全球集成电路行业市场规模

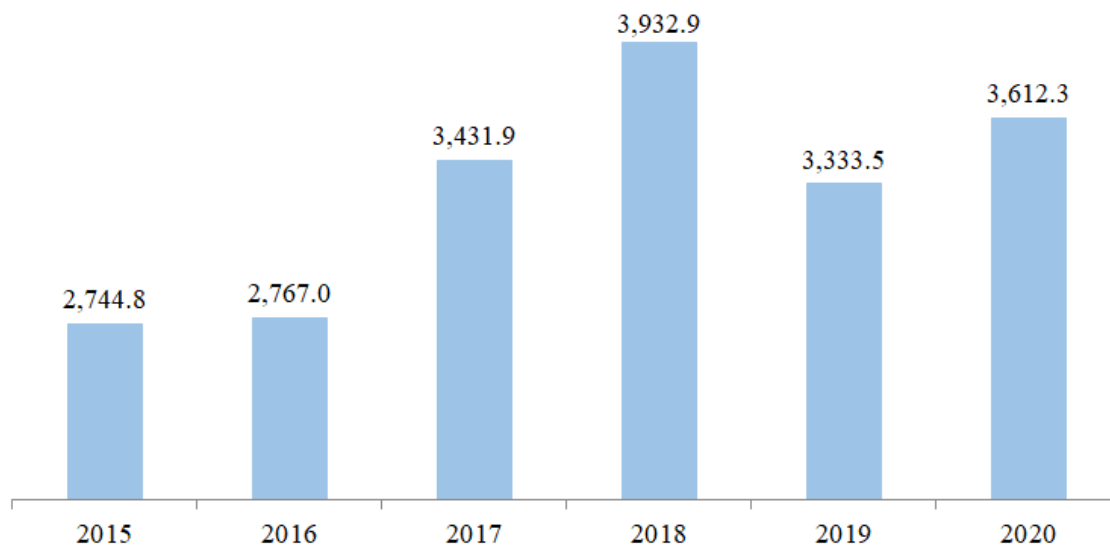
随着全球信息化和数字化的持续发展，新能源汽车、人工智能、消费电子、移动通信、工业电子、物联网、云计算等新兴领域的快速发展带动了全球集成电路行业规模的不断增长。

根据 Frost & Sullivan 的统计，2015 年至 2020 年，按照销售额口径，全球集成电路市场规模从 2,744.8 亿美元增长至 3,612.3 亿美元，年均复合增长率为 5.6%。未来，

在 5G、物联网、云计算、新能源汽车等领域的驱动下，全球集成电路市场规模有望实现增长趋势。

2015-2020 年全球集成电路市场规模（销售额口径）

单位：亿美元



数据来源：Frost & Sullivan，本招股意向书中涉及第三方数据均非专门为本次发行准备，数据出处权威、可靠。发行人向第三方专业咨询公司 Frost & Sullivan 付费购买了《中国晶圆代工行业·独立市场研究》报告。除上述情况外，发行人未就其他第三方数据支付费用或提供帮助。

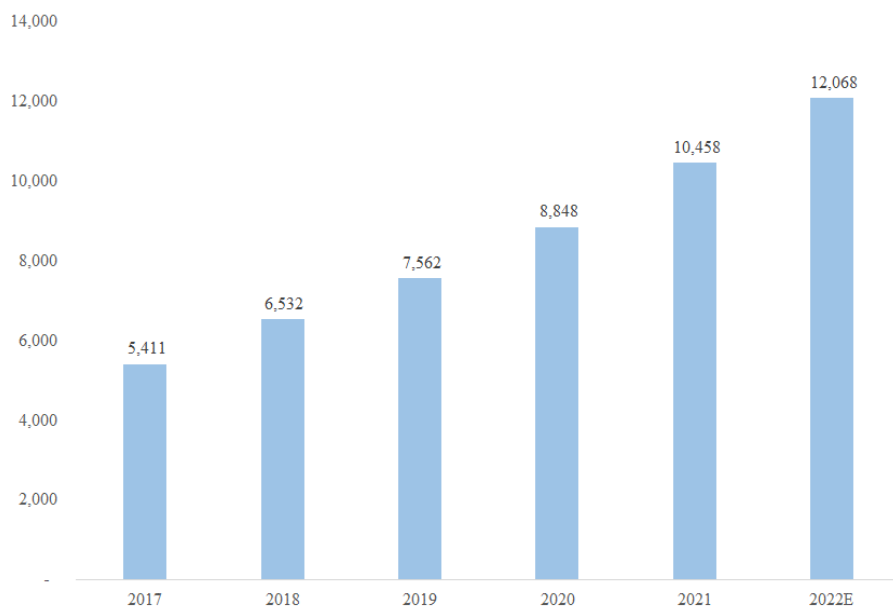
### （5）中国大陆集成电路行业市场规模

在稳定的经济增长、有利的政策支持和巨大的市场需求等因素的推动下，中国集成电路行业实现了快速的发展。

根据 Frost & Sullivan 等机构统计，预计从 2017 年至 2022 年，按照销售额口径，中国大陆集成电路市场规模从 5,411 亿元增长至 12,068 亿元，年均复合增长率为 17.4%，增速高于全球水平。未来，随着集成电路产业国产替代的推进，以及新基建、信息化、数字化的持续发展，中国大陆集成电路市场规模有望持续增长。

**2017-2022 年中国集成电路市场规模（销售额口径）**

单位：亿人民币



数据来源：Frost &amp; Sullivan、上市公司公开披露信息

虽然中国大陆集成电路行业市场规模持续增长，但集成电路国产化程度仍然处于较低水平，集成电路产品仍然严重依赖进口。根据国家海关总署统计，2019 年中国大陆集成电路进口金额位居中国大陆进口商品第一位，存在巨大的国产化替代空间。

**2、晶圆代工行业概况****(1) 晶圆代工行业简介**

晶圆代工行业源于集成电路产业链的专业化分工，晶圆代工企业不涵盖集成电路设计环节，专门负责集成电路制造，为集成电路设计公司提供晶圆代工服务，代表企业包括台积电、格罗方德、联华电子、中芯国际、晶合集成等。

晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。根据 Frost & Sullivan 的统计，按照销售额口径，2020 年全球晶圆代工行业市占率前五名企业分别为台积电（61.9%）、联华电子（9.3%）、格罗方德（8.7%）、中芯国际（5.4%）和力积电（2.4%），其市场集中度达 87.7%。

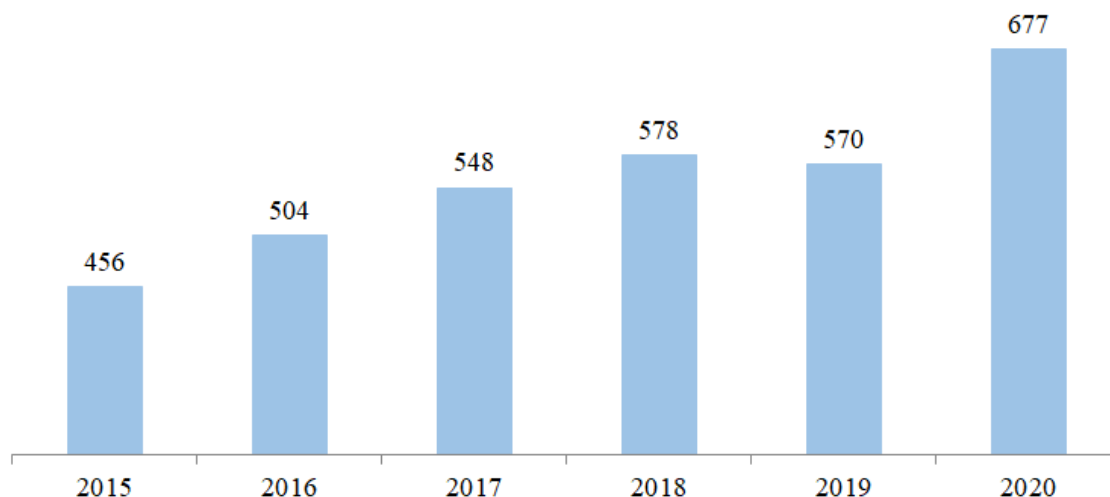
**(2) 全球晶圆代工行业市场规模**

根据 Frost & Sullivan 的统计，2015 年至 2020 年，按照销售额口径，全球晶圆代工市场规模从 456 亿美元增长至 677 亿美元，年均复合增长率为 8.2%。未来随着 5G、

人工智能、云计算等技术的进步与发展，全球集成电路行业对晶圆代工服务的需求将进一步提升，预计全球晶圆代工行业市场规模将进一步增长。

2015-2020 年全球晶圆代工行业市场规模（销售额口径）

单位：亿美元



数据来源：Frost & Sullivan

### （3）中国大陆集成电路代工行业市场规模

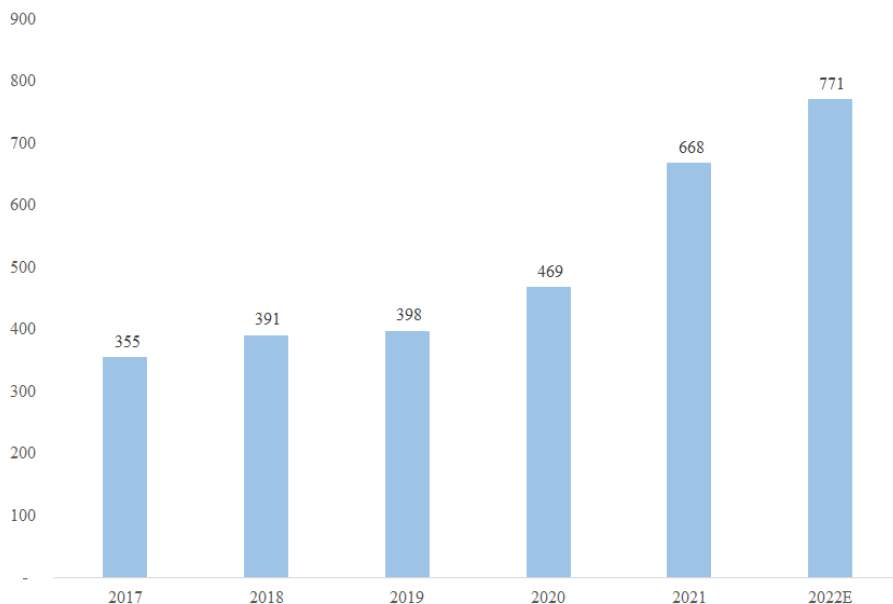
中国大陆晶圆代工行业起步较晚，但在国家政策的支持下，随着国内经济的发展和科学技术水平的提高，国内芯片设计公司对晶圆代工服务的需求日益提升，中国大陆晶圆代工行业实现了快速的发展。

根据 IC Insights 的统计，2017 年至 2022 年，中国大陆晶圆代工市场规模预计从 355 亿元增长至 771 亿元，年均复合增长率为 16.78%。在近年国际贸易摩擦日益加剧的情况下，一方面，提高晶圆代工行业国产化的重要性日益凸显，国家陆续出台政策支持境内晶圆代工行业的发展；另一方面，部分境内集成电路设计企业亟需寻找可以满足其需求的境内晶圆代工产能，以保证其生产安全。预计未来中国大陆晶圆代工行业市场规模将保持增长趋势。



**2017-2022 年中国大陆晶圆代工行业市场规模**

单位：亿人民币



数据来源：IC Insights

**(4) 全球显示驱动领域晶圆代工市场竞争状况**

根据 Frost & Sullivan 的统计，2020 年，不考虑三星电子等同时具备设计能力和晶圆产能的 IDM 企业，仅考虑晶圆代工企业，全球晶圆代工企业在显示驱动芯片领域的年产量约 200 万片（约当 12 英寸晶圆），联华电子、世界先进、力积电、东部高科等晶圆代工企业在显示驱动芯片晶圆代工领域均有布局，2020 年发行人显示驱动领域晶圆代工产量（约当 12 英寸晶圆）达 25.98 万片，市场份额约为 13%，在晶圆代工企业中排名第三，仅次于联华电子和世界先进，属于行业头部企业之一。2021 年，发行人显示驱动领域晶圆代工产量（约当 12 英寸晶圆）达 51.29 万片，行业竞争力进一步提升。

**(5) 150nm至90nm制程节点晶圆代工市场竞争情况**

报告期内，发行人主要提供150nm至90nm制程节点的12英寸晶圆代工服务，发行人在150nm至90nm制程节点晶圆代工领域有诸多竞争对手，同行业主要可比公司在相关制程节点的营收情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	制程	2022年	2021年	2020年
发行人	90nm	521,240.66	303,310.46	80,268.82
	110nm	316,507.96	132,328.41	40,725.48
	150nm	160,888.68	106,440.58	30,191.80
台积电	90nm	913,386.16	742,631.83	681,918.11
	110/130nm	1,318,165.62	933,657.45	770,505.55
	150/180nm	2,513,283.88	1,995,840.61	1,996,256.70
联华电子 <sup>1</sup>	90nm	未披露	386,200.57	453,449.08
	110/130nm	未披露	541,622.75	437,676.94
	150/180nm	未披露	588,720.38	504,708.55
中芯国际 <sup>2</sup>	90nm	未披露	102,829.61	67,168.17
	110/130nm	未披露	179,951.81	127,139.75
	150/180nm	未披露	922,253.03	782,029.40
华虹半导体	90/95nm	351,874.58	178,669.43	65,454.53
	110/130nm	296,961.49	193,132.70	150,049.86
	150/180nm	143,981.27	104,727.25	92,207.93
世界先进 <sup>3</sup>	180nm至110nm	549,057.17	532,246.52	361,060.96

注1：联华电子未直接披露各制程营收情况，系根据其披露的各制程收入占比计算得到。

注2：中芯国际2020年、2021年系根据其披露的各制程收入占比计算得到。

注3：根据世界先进2020年年报，世界先进不从事110nm以下制程节点晶圆代工服务。

### 3、显示驱动芯片行业概况

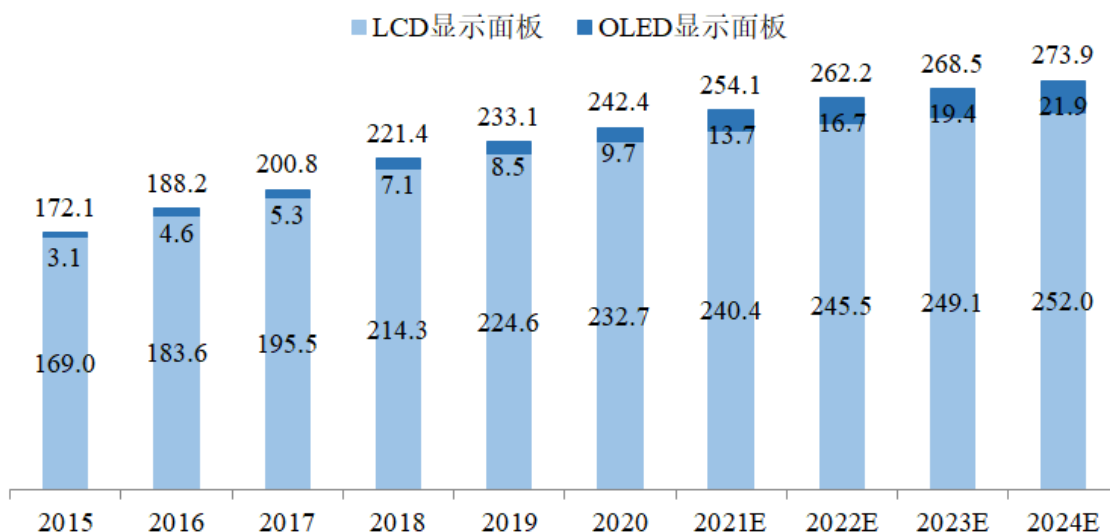
#### (1) 显示面板市场概况

显示面板是实现信息显示的重要部件，被广泛应用于显示器、电视、智能手机、笔记本电脑、平板电脑、汽车等领域。

随着全球终端需求的持续增加，根据 Frost & Sullivan 的统计，2015年至2020年，按照产量口径，全球显示面板行业市场规模从1.72亿平方米增长至2.42亿平方米，年均复合增长率为7.1%。随着显示面板技术的发展和下游需求的增长，预计2024年全球显示面板市场规模将达到2.74亿平方米。

2015-2024 年全球显示面板行业市场规模（产量口径）

单位：百万平方米

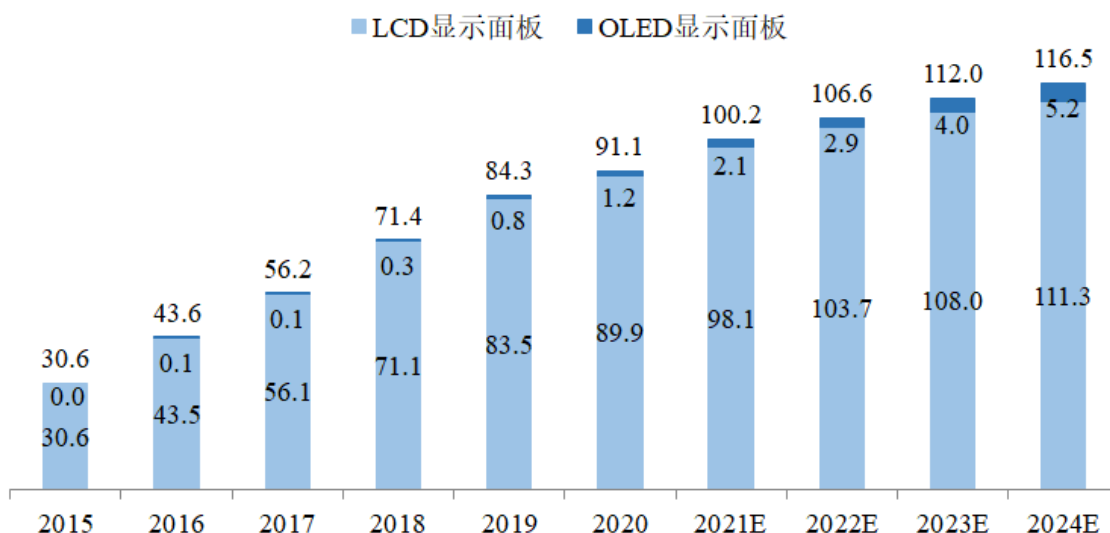


数据来源：Frost & Sullivan

中国大陆显示面板行业起步较晚，但受益于国家政策的支持，以及全球显示面板行业的整体增长和中国大陆市场的强劲需求，中国显示面板行业实现了稳健的增长。根据 Frost & Sullivan 的统计，2015 年至 2020 年，按照产量口径，中国大陆显示面板行业市场规模从 0.31 亿平方米增长至 0.91 亿平方米，年均复合增长率为 24.4%，预计 2024 年中国大陆显示面板市场规模将达到 1.17 亿平方米。

2015-2024 年中国大陆显示面板行业市场规模（产量口径）

单位：百万平方米



数据来源：Frost & Sullivan

## (2) 显示面板主要终端应用领域市场概况

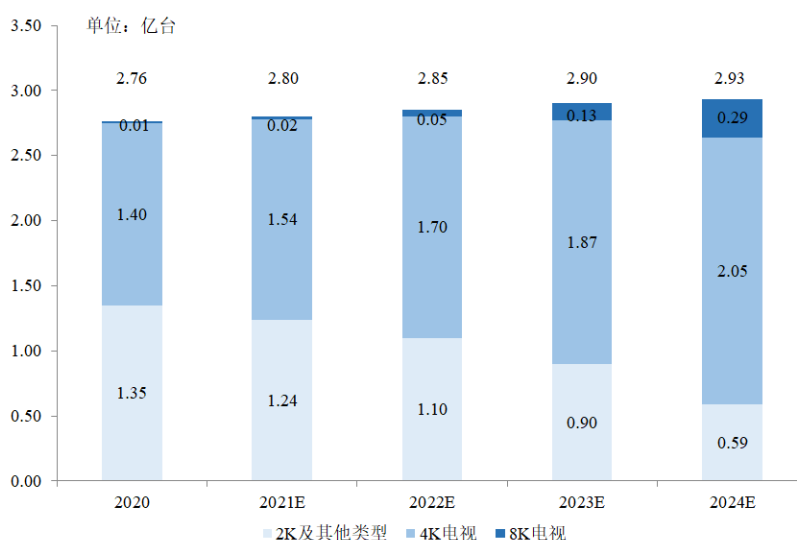
根据尺寸大小进行划分，显示面板终端应用领域及未来发展趋势如下：

面板尺寸大小	主要终端应用领域	未来发展趋势
大尺寸 (大于 30 英寸)	电视、LED 广告牌等	面板尺寸进一步扩大、解析度及动态图像渲染要求提高
中尺寸 (10-30 英寸)	电脑显示器、笔记本电脑屏幕等	除高解析度、高刷新率、高动态图像渲染等共性需求外，还包括曲面屏，带鱼屏等差异化需求
小尺寸 (小于 10 英寸)	手机、可穿戴设备等	高刷新率、宽色域，屏下指纹技术、屏下摄像头技术进一步发展

### 1) 大尺寸面板终端

2020年，大尺寸DDIC占DDIC总需求的70%以上，为DDIC需求量最大的终端面板产品。同时，随着显示驱动技术的进步以及家用电器的发展，用户对电视清晰度等需求将会进一步提升，也将推动DDIC使用量的持续提升。2020年，全球电视出货量约为2.76亿台，其中4K电视出货量约为1.40亿台，8K电视出货量约为100万台；预计到2024年，全球电视出货量约为2.93亿台，其中4K电视约为2.05亿台，8K电视约为0.29亿台。

全球电视市场规模（出货量），2020-2024E

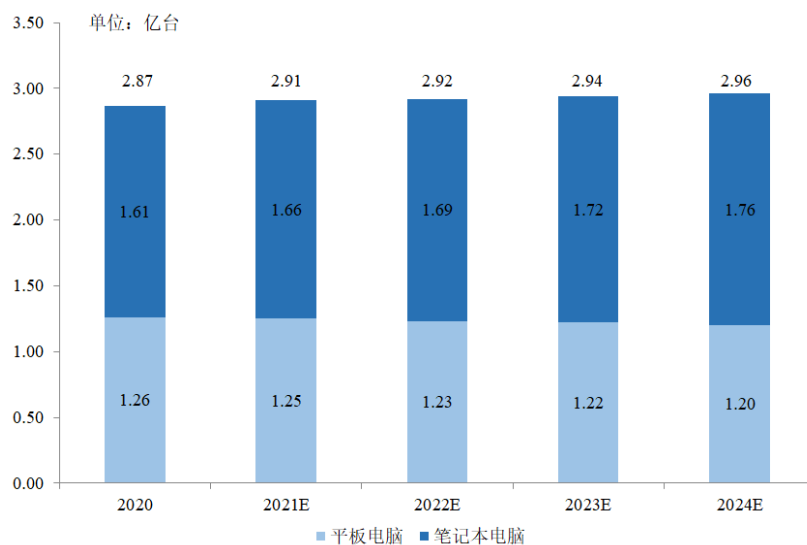


数据来源：Frost & Sullivan

## 2) 中小尺寸面板终端

中小尺寸面板需求量与面板终端需求量相匹配。随着5G、物联网、相关技术的逐渐落地，以及消费电子、车载电子行业的蓬勃发展，中小尺寸终端设备的市场规模也将不断扩大。2020年，全球平板与笔记本电脑合计出货量约为2.87亿台；预计到2024年，全球平板电脑与笔记本电脑合计出货量可达到2.96亿台。

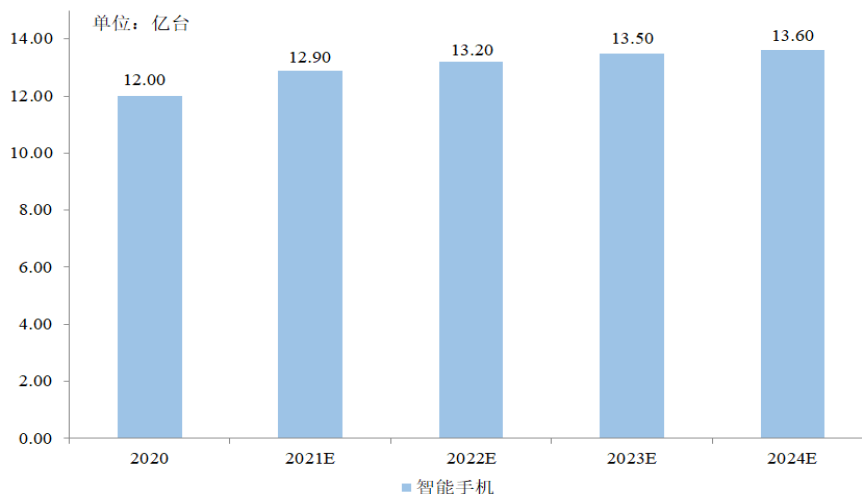
全球平板电脑与笔记本电脑市场规模（出货量），2020-2024E



数据来源：Frost & Sullivan

2020年，受到外部环境影响，全球智能手机出货量为12亿台，预计随着5G网络布局展开和新兴市场的需求增长，全球智能手机增长将维持平稳增长态势，预计2024年全球智能手机出货量将达到13.6亿台。

全球智能手机市场规模（出货量），2020-2024E



数据来源：Frost & Sullivan

### 3) 终端产品与DDIC的关系

各终端产品所需DDIC数量具体如下：

终端应用领域	所需 DDIC 数量 (颗/台)
高清或 2K 电视	4-6
4K 电视	10-12
8K 电视	大于 20
笔记本电脑	3-5
平板电脑	2-3
手机	1

终端所需DDIC数量与面板尺寸、分辨率高低成正比，面板尺寸越大，分辨率越高、所需DDIC数量越多。未来随着大面板屏幕尺寸继续增加，各类屏幕分辨率、色域要求不断提升，每台终端产品所需的DDIC数量还将进一步增长。

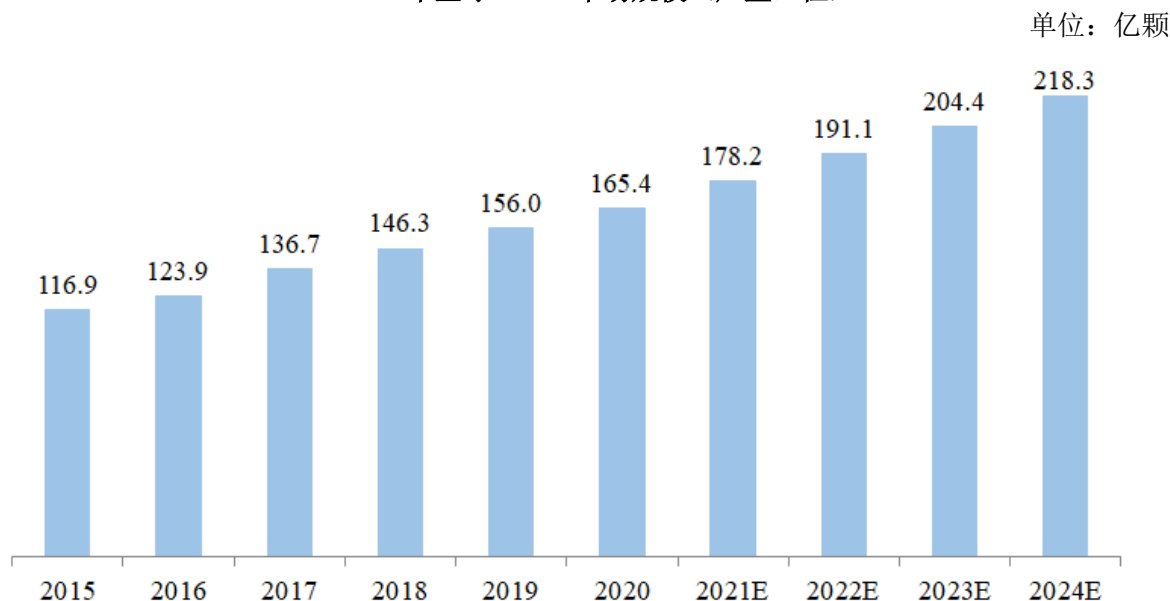
### (3) DDIC 市场概况

#### 1) 整体市场情况

DDIC，即面板显示驱动芯片，是显示面板不可或缺的重要组成部分，位于显示面板的主电路和控制电路之间，通过对电位信号特征（例如：相位、峰值、频率等）的调整与控制，完成对驱动电场的建立与控制，进而实现面板信息显示。

受益于全球显示面板出货量的增长，全球 DDIC 市场规模也快速增长。根据 Frost & Sullivan 的统计，2015 年至 2020 年，按照产量口径，全球 DDIC 市场规模从 116.9 亿颗增长至 165.4 亿颗，年均复合增长率为 7.2%。

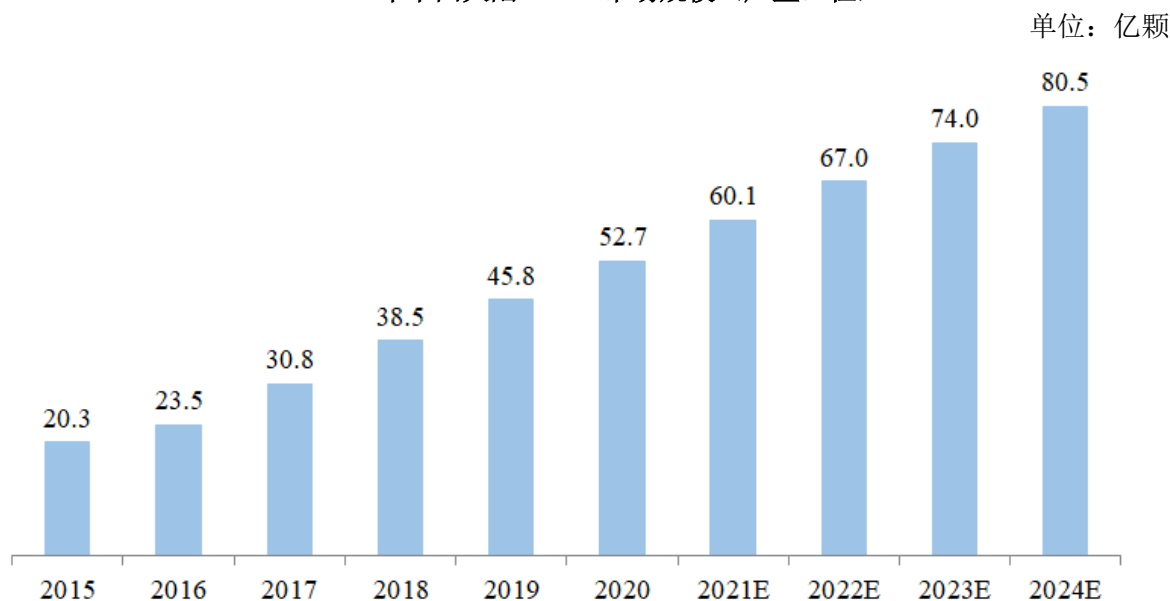
2015-2024 年全球 DDIC 市场规模（产量口径）



数据来源：Frost & Sullivan

在下游显示面板市场增长的驱动和国家政策支持的驱动下，中国大陆 DDIC 市场规模持续增长。根据 Frost & Sullivan 的统计，2015 年至 2020 年，按照产量口径，中国大陆 DDIC 市场规模从 20.3 亿颗增长至 52.7 亿颗，年均复合增长率为 21.0%，高于全球同期的年均复合增长率。根据公开信息披露，中国大陆 DDIC 市场规模从 2017 年的 118.3 亿元增长至 2022 年的 368.2 亿元，预计未来随着 OLED 领域及车载领域应用需求的增长，市场规模将进一步扩大。

2015-2024 年中国大陆 DDIC 市场规模（产量口径）

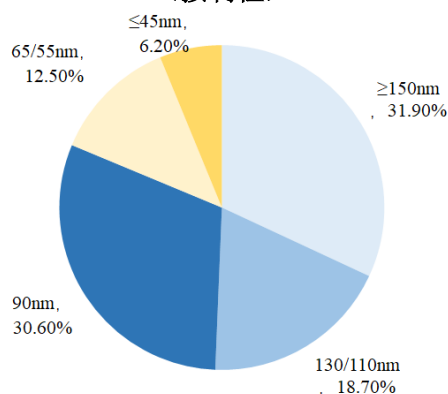


数据来源：Frost & Sullivan

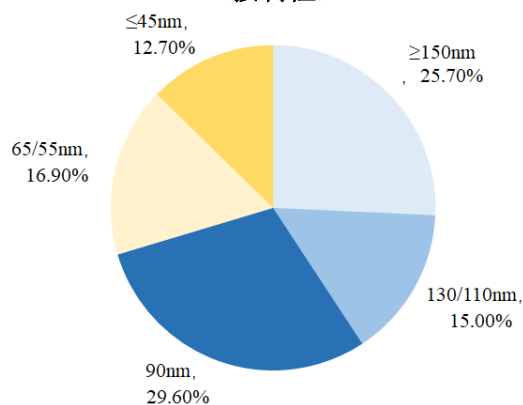
## 2) 按制程分布市场情况

由于大、中尺寸面板终端产品显示技术已较为成熟，对于集成度要求较手机屏幕要求更低，多用 90nm 及以上的成熟制程 DDIC 即可生产。且由于大、中尺寸面板所需芯片数量较多，因此其所使用的 90nm 及以上制程的 DDIC 仍占全球 DDIC 市场的主要部分，2020 年市占率达到约 80%；在芯片整体向更先进制程节点推进的趋势下，90nm 及以上制程的 DDIC 市占率将逐渐下降，但仍将占据大部分市场份额，根据 Frost&Sullivan 预测，在 2024 年 90nm 及以上制程的 DDIC 市占率仍将保持 70%左右。

2020 年全球显示驱动芯片市场分布  
(按制程)



2024 年预测全球显示驱动芯片市场分布  
(按制程)



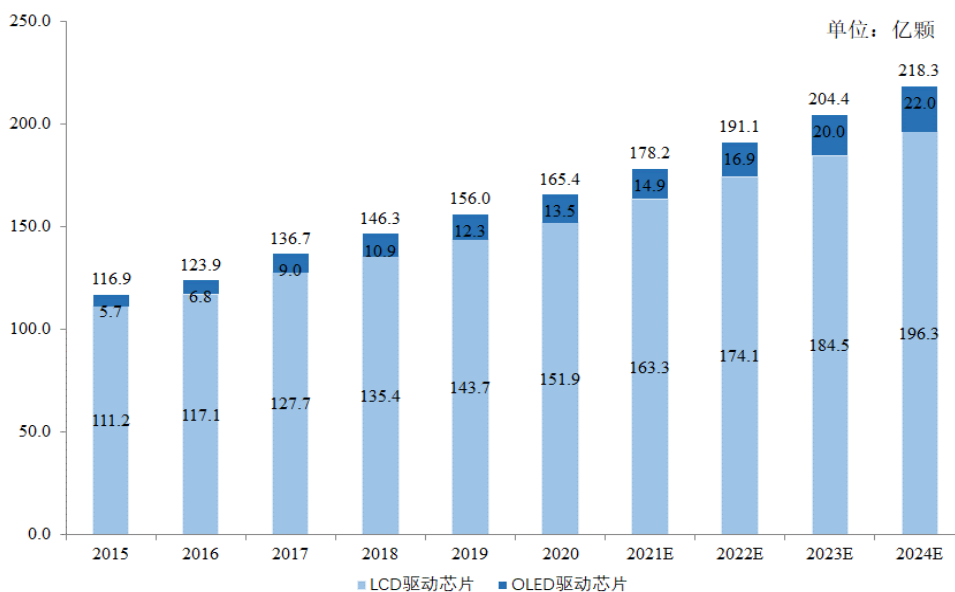
数据来源: Frost & Sullivan

## 3) 按产品类型分布市场情况

2020 年-2024 年间，预计全球 DDIC 市场规模年均复合增长率约为 7%。LCD 驱动芯片增幅与整体增长率相同，且市占率将持续维持在 90%左右。由于柔性材料的应用场景持续增加，2020 年-2024 年间，预计 OLED 显示驱动芯片市场规模年均复合增长率将达到 12%，高于整体增幅。



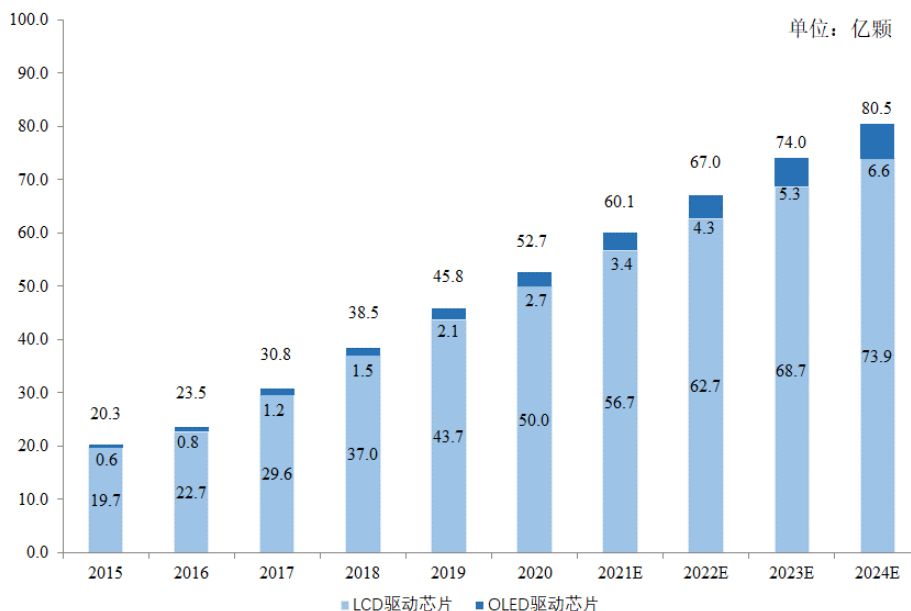
全球显示驱动芯片市场规模（出货量），2015-2024E



数据来源：Frost & Sullivan

2020年-2024年间，中国大陆集成电路行业的高景气度仍将持续，预计DDIC市场规模年均复合增长率将达到11%，仍高于全球平均水平。在产品方面，OLED显示驱动芯片增速较快，2020年-2024年间预计年均复合增长率将达到25%。

中国显示驱动芯片市场规模（出货量），2015-2024E



数据来源：Frost&Sullivan

#### (4) DDIC 技术水平

##### 1) 集成电路设计企业 DDIC 技术水平

集成电路设计企业主要关注 DDIC 在使用时的速度及稳定性。速度主要体现在信号释放的输出速度快慢，速度越快则 DDIC 放大控制电路信号驱动功率晶体管的能力越强。稳定性主要体现在 DDIC 工作时的抗干扰能力，例如防静电能力、温度管控能力等，抗干扰能力强的 DDIC 最大工作电压上限更高，且在高速运转时产生的热量更少。

根据实际应用的终端面板产品不同，DDIC 的功能需求也会产生区别。对于大尺寸面板终端，目前主要采用 LCD 屏幕，使用的 DDIC 制程在 200nm-110nm 之间。对于中小尺寸面板终端，集成度要求高于大尺寸面板，目前主要使用 110nm-90nm 制程的 DDIC，部分高端产品会用到 65nm 及以下制程。随着未来智能手机的空间集成要求更高，除 DDIC 自身制程提高外，同时需要集成其他如触控功能、电源管理功能等模块。

集成电路设计企业通过改良电路布图、模块组合等整体设计方案来实现芯片速度、集成度、抗干扰性能的优化。

##### 2) 集成电路代工企业 DDIC 技术水平

集成电路代工企业负责根据设计企业提供的设计图纸进行芯片生产，与设计企业的轻资产运营模式不同，需要进行大量资本投入购置生产设备并建设产线。代工企业根据自身产线的晶圆尺寸，所能实现的制程节点、电压大小为设计公司提供整体代工方案。

集成电路代工企业的技术实力主要反映在可代工产品种类及代工成本上。代工企业的产线制程节点越先进，元器件电压区间越广，则能实现的技术平台种类越多，能够有效满足更高的空间集成度、模块功能整合需求。对于大、中尺寸面板，由于目前技术已经较为成熟，且相较小尺寸面板对于集成度要求较低，对于 DDIC 的需求主要集中在成本管控和产能稳定性上，能够使用更大尺寸晶圆、更具性价比的原材料进行代工的企业在该类 DDIC 代工上更具优势。

#### 4、集成电路行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势

##### (1) 集成电路行业近三年发展情况

###### 1) 全球晶圆代工行业市场规模持续增长

随着全球信息化和数字化的持续发展，新能源汽车、人工智能、消费电子、移动通信、工业电子、物联网、云计算等新兴领域的快速成长带动了全球集成电路和晶圆代工行业市场规模的持续增长。根据 Frost & Sullivan 的统计，2018 年至 2020 年，按照销售额口径，全球晶圆代工行业市场规模从 578 亿美元增长至 677 亿美元，年均复合增长率为 8.2%。

###### 2) 全球晶圆代工产业逐渐向中国大陆转移

中国大陆是全球最大且增速最快的集成电路市场之一，在市场需求、国家政策、资本投入的驱动下，全球晶圆代工产业逐渐向中国大陆转移。根据 Frost & Sullivan 的统计，2016 年至 2020 年，全球新增投产的晶圆厂为 62 座，其中有 26 座建设于中国大陆，占全球总数的 42%。产业的转移将给中国大陆集成电路行业带来新的发展机遇，促进中国大陆集成电路行业的革新与发展。

###### 3) 大陆晶圆代工市场处于快速发展阶段

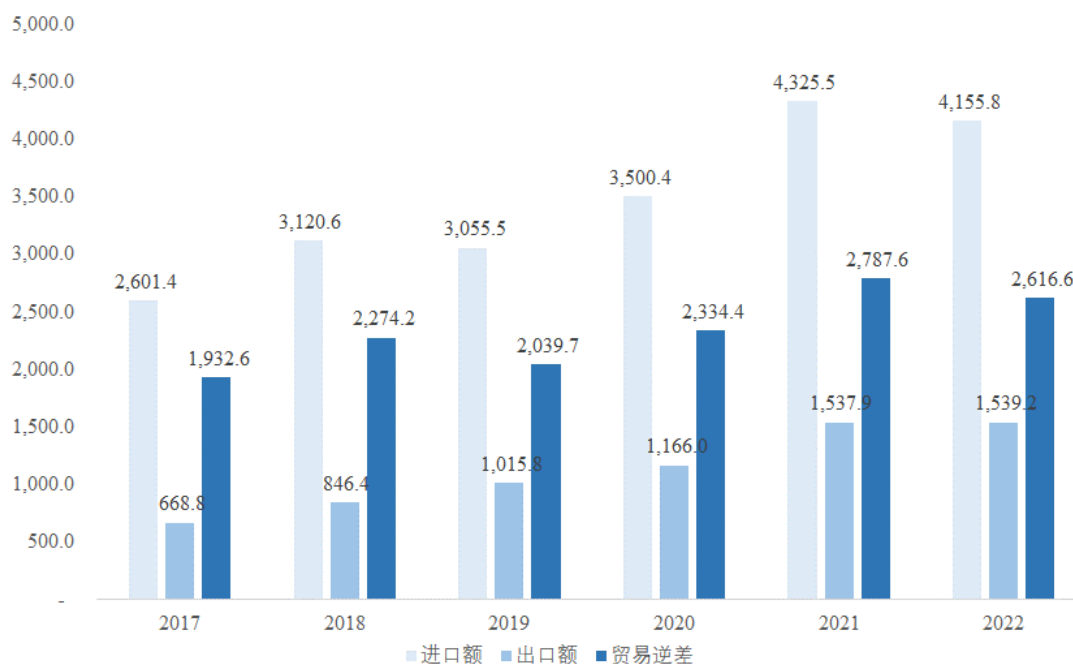
中国大陆晶圆代工行业起步较晚，但随着国内经济的发展和科学技术水平的提高，国内芯片设计公司对晶圆代工服务的需求日益提升，在国家政策的支持下，中国大陆晶圆代工行业实现了快速的发展。根据 Frost & Sullivan 的统计，2018 年至 2020 年，按照销售额口径，中国大陆晶圆代工市场规模从 107.3 亿美元增长至 148.9 亿美元，年均复合增长率为 17.8%。

###### 4) 中国大陆集成电路国产替代空间巨大

近年来，中国大陆集成电路行业高速发展，但仍无法满足快速增长的市场需求，大量集成电路产品仍要依赖进口。根据中国半导体行业协会统计，2022 年中国大陆集成电路进口额达 4,155.8 亿美元，同期中国大陆集成电路出口额为 1,539.2 亿美元，贸易逆差达 2,616.6 亿美元，仍有巨大的国产替代空间。

## 2017-2022 年中国大陆集成电路行业进出口情况

单位：亿美元



数据来源：中国半导体行业协会、中国海关总署

## 5) 国家陆续出台政策推动集成电路行业发展

集成电路是信息化、数字化的基石，被广泛应用于通信、安防、军事、工业、交通、消费电子等领域，在国家安全、经济建设和人民的日常生活中发挥着重要的作用。为保证国家经济安全，提高中国大陆集成电路行业的国产化程度，国家相继出台产业政策推动中国大陆集成电路行业发展。具体国家支持政策及行业监管法规参见“第五节 业务与技术”之“二、行业基本情况”之“（二）行业主管部门及管理体制、主要法律法规及政策”。

## 6) 2022 年第三季度起，产能缺口情况有所缓解

根据 TrendForce 的统计与分析，2021 年，5G 及新能源汽车兴起带动半导体需求增加，晶圆厂产能又无法快速投产，产能缺口不断扩大。但是在 2022 年，智能手机、消费电子需求下行，受到消费性终端需求疲软的影响，整体而言，2022 年第三季度起产能缺口情况有所缓解，使得晶圆代工产能利用率面临挑战。

## (2) 集成电路行业未来发展趋势

### ①技术水平持续提升

近年来，中国大陆集成电路市场的快速发展推动了中国大陆集成电路领域的技术进步与革新，未来，中国大陆晶圆代工企业在晶圆代工领域的技术水平将持续突破，工艺平台将持续丰富，并逐渐缩小与国外龙头晶圆代工企业的差距，将为中国大陆集成电路产业的发展以及国产化程度的提高奠定坚实的基础。

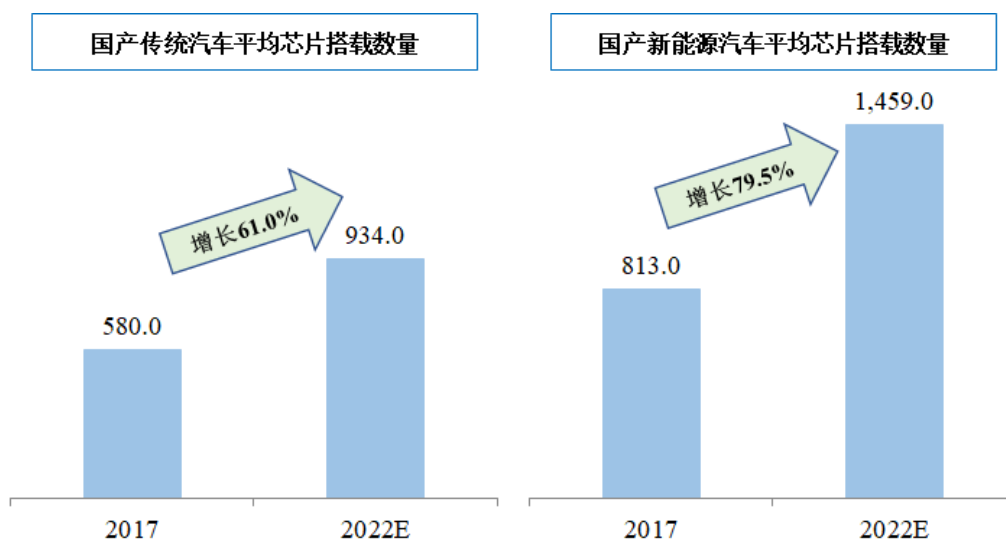
### ②新兴领域带来增量空间

物联网、5G 通信、人工智能等新技术的发展带来了诸多产业的革新，工业电子、消费电子、汽车电子等集成电路下游应用产业升级为集成电路行业带来增量空间。

例如：在汽车电子领域，根据 Frost & Sullivan 的统计，2017 年至 2022 年，国产传统汽车平均芯片搭载数量将从 580 颗/辆增长至 934 颗/辆，增长率为 61.0%，国产新能源汽车平均芯片搭载数量从 813 颗/辆增长至 1,459 颗/辆，增长率为 79.5%。

2017-2022 年国产汽车芯片搭载数量变化

单位：颗/辆



数据来源：Frost & Sullivan

### ③国产化替代趋势日益明显

在近年国际贸易摩擦日益严重的情况下，一方面，提高晶圆代工行业国产化的重要性日益凸显，国家陆续出台政策支持境内晶圆代工行业的发展；另一方面，部分境内集成电路设计企业亟需寻找可以满足其需求的境内晶圆代工产能，以保证其生产安

全。晶圆代工行业国产化替代的重要性越发凸显，国产化替代将成为中国大陆集成电路发展的重要趋势。

#### （四）发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

发行人持续进行研发投入，致力追求技术突破，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人已取得了 316 项发明专利，专利分布在中国大陆、中国台湾地区、美国、日本等各个国家及地区。

发行人积极推动上述专利技术的实际应用，形成了特色工艺平台，为联咏科技、集创北方等业内知名公司提供代工服务。此外，发行人根据下游产品应用领域的演变趋势，正在进行 55nm 等平台的研发、风险量产工作，通过技术创新促进产品迭代，实现产业发展。

### 三、公司的行业地位及竞争优势

#### （一）发行人与同行业可比公司的经营情况与市场地位

发行人属于晶圆代工行业，在集成电路产业链中属于集成电路制造环节，所选可比公司均为晶圆代工或集成电路制造行业知名企业。

##### 1、同行业可比公司情况

###### （1）台积电（2330.TWSE）

台积电的主营业务为集成电路及其他半导体装置的制造、销售、封装测试与电脑辅助设计及光罩制造等代工服务。台积电的产品包括互补金属氧化物半导体（CMOS）、逻辑芯片、混合信号芯片、射频（RF）芯片、嵌入式存储器等，工艺平台包括手机平台、高性能计算平台、IoT 平台、汽车电子平台和数字消费电子平台。根据 Frost & Sullivan 统计，台积电是全球排名第一的晶圆代工企业，2019 年全球市占率为 54.3%。

2020 年、2021 年及 2022 年，台积电营业收入分别为 1.34 万亿新台币、1.59 万亿新台币和 2.26 万亿新台币。

###### （2）联华电子（2303.TWSE）

联华电子的主营业务为晶圆制造整合服务，主要产品包括逻辑/射频芯片、嵌入式

高压解决方案、嵌入式闪存、RFSOI/BCD 等。根据 Frost & Sullivan 统计，联华电子是全球排名第三的晶圆代工企业，2019 年全球市占率为 8.8%。

2020 年、2021 年及 2022 年，联华电子营业收入分别为 1,768.21 亿新台币、2,130.11 亿新台币和 2,787.05 亿新台币。

### **(3) 世界先进 (5347.TWO)**

世界先进的主营业务为晶圆代工集成电路以及其他晶圆半导体装置的制造、销售、封装测试与电脑辅助设计及光罩制造与设计服务，主要产品包括 PMIC 电源管理器、LCD 面板驱动 IC、NVM 非挥发记忆体、Discrete 分离式元件等。

2020 年、2021 年及 2022 年，世界先进营业收入分别为 331.31 亿新台币、439.51 亿新台币和 516.94 亿新台币。

### **(4) 中芯国际 (688981.SH)**

中芯国际的主营业务为晶圆代工集成电路晶圆代工及配套服务，主要产品包括逻辑、混合信号及射频、CMOS、高电压器件、SoC、闪存、EEPROM、CIS、电源管理 IC、MEMS 逻辑电路、电源及模拟、高压驱动、嵌入式非挥发存储、非易失性存储、混合信号及射频和图像传感器等。根据 Frost & Sullivan 统计，中芯国际是全球排名第四、大陆排名第一的晶圆代工企业，2019 年全球市占率为 5.0%。

2020 年、2021 年及 2022 年，中芯国际营业收入分别为 274.71 亿元、356.31 亿元和 495.16 亿元。

### **(5) 华虹半导体 (1347.HK)**

华虹半导体主营业务为晶圆制造服务 集成电路研发制造、电子元器件分销、智能化系统应用等，主要产品包括嵌入式非易失性存储器、分立器件、模拟和电源管理、逻辑和射频。根据 Frost & Sullivan 统计，华虹半导体是中国大陆排名第二的晶圆代工企业。

2020 年、2021 年及 2022 年，华虹半导体营业收入分别为 9.61 亿美元、16.31 亿美元和 24.76 亿美元。

### **(6) 华润微 (688396.SH)**

华润微主营业务为芯片设计、晶圆制造、封装测试等，主要产品包括功率半导体、

智能传感器、智能控制等。

2020年、2021年及2022年，华润微营业收入分别为69.77亿元、92.49亿元和100.60亿元。

## 2、同行业可比公司经营情况

单位：亿元人民币

序号	公司	主要经营地	2022年度	2021年度	2020年度
1	台积电	中国台湾	5,145.82	3,654.23	3,108.41
2	联华电子	中国台湾	633.50	490.35	410.40
3	世界先进	中国台湾	117.50	101.18	76.90
4	中芯国际	中国大陆	495.16	356.31	274.71
5	华虹半导体	中国大陆	172.44	103.97	62.72
6	华润微	中国大陆	100.60	92.49	69.77

注1：数据来源为可比公司定期报告、业绩快报或其招股说明书。

注2：境外公司销售收入根据每期期末的汇率进行折算。

## 3、发行人的市场地位

根据Frost & Sullivan的统计，截至2020年底，晶合集成已成为中国大陆收入第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业（不含外资控股企业），有效提高了中国大陆晶圆代工行业的自主水平，具体如下：

中国大陆晶圆代工企业排名（销售额口径）

排名	公司
1	中芯国际
2	华虹半导体
3	晶合集成

注：排名不包括采用IDM模式的半导体企业；收入口径截至2020年，数据来源：Frost & Sullivan

根据市场研究机构TrendForce的统计，2022年第二季度，在全球晶圆代工企业中，公司营业收入排名全球第九。

截至2020年底，发行人12英寸晶圆代工产能达3万片/月。2021年度，公司12英寸晶圆代工产能为57.09万片。根据Frost & Sullivan的统计，在中国大陆，拥有12英寸晶圆代工生产线且实现量产的中国大陆纯晶圆代工企业目前仅有中芯国际、华虹



集团、晶合集成等少数企业，该口径不包括华润微等采用 IDM 模式的企业，亦不包括台积电南京等外资控股的晶圆代工企业，在该等条件下，仅考虑中国大陆企业控股的、具备 12 英寸晶圆代工产能的纯晶圆代工企业，截至 2020 年底，发行人产能在中国大陆纯晶圆代工企业中 12 英寸晶圆代工产能排名第三。具体情况如下：

**2020 年中国大陆企业控股的纯晶圆代工企业排名（12 英寸晶圆代工产能口径）**

单位：片/月

排名 <sup>1</sup>	公司	12 英寸晶圆代工产能
1	中芯国际	135,000
2	华虹集团 <sup>2</sup>	118,000
3	晶合集成	30,000

注 1：排名不包括采用 IDM 模式的半导体企业；产能只统计 12 英寸晶圆的代工产能，不考虑 6 英寸、8 英寸等晶圆的代工产能；产能口径截至 2020 年底，数据来源：Frost & Sullivan

注 2：华虹集团包括华虹半导体和上海华力

#### 4、技术实力对比及衡量公司核心竞争力的关键业务数据、指标

发行人 DDIC、CIS 等特色工艺平台均使用国际主流技术，为客户提供完善的全平台解决方案，上述技术平台主要参数指标如下，其中制程节点、晶圆尺寸、电压等指标均为衡量产品特性的重要依据，对于产品的适用范围、产品的生产成本及技术含量具备决定性的作用，相关可比公司亦对工作电压区间、制程节点、制程工艺等主要指标进行了披露，具备行业代表性：

序号	技术平台	参数指标/技术工艺		指标含义	选取依据及衡量标准
1	DDIC 工艺平台	核心元件电压	LDDI: 1.8v-3.3v SDDI: 1.2v-1.5v TDDI: 1.2v-1.32v	可以使芯片逻辑运算器件正常工作的电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以逻辑运算工作的电压区间来衡量。核心元件电压越小越好
		模拟电压	LDDI: 13.5v-18v SDDI: 5v-6v TDDI: 5v-6v	可以使芯片面板模拟讯号器件正常工作的电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以面板模拟讯号工作的电压区间来衡量。依产品特性和功能需求进行匹配
		扫描电压	SDDI: 30v TDDI: 40v	扫描面板的闸极电压，是可以使芯片高压器件正常工作的电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以扫描面板闸极工作的电压区间来衡量。依产品特性和功能需求进行匹配
		制程节点	150nm-90nm	代表芯片最小制程线宽	该指标为衡量产品特性的重要依据，以制程最小线宽的宽度来衡量。制程节点越小越好
		制程工艺	12 英寸铝制程	1、“12 英寸”代表晶圆直径为 12 英寸 2、“铝制程”代表芯片制程导线所用的金属为铝	该指标代表制程工艺下晶圆的尺寸和导线的金属类型，反映了产品的导电能力、制程工艺等特性，以晶圆的直径和导线所用的金属来衡量。晶圆尺寸越大越先进，铝制程具备成本优势
2	CIS 工艺平台	工作电压	1.2v-3.3v	可以为芯片所有器件提供的电压，其中：1.2v 为逻辑运算器件电压，3.3v 为像素电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以提供芯片所有元件正常工作所需要的电压来衡量。依产品特性和功能需求进行匹配
		像素尺寸	1.4 $\mu$ m (FSI)	单个像素物理尺寸	该指标为衡量芯片像素大小的核心指标，以单个像素的物理尺寸来衡量。像素尺寸越小越好
		制程节点	90nm	代表芯片最小制程线宽	该指标为衡量产品特性的重要依据，以制程最小线宽的宽度来衡量。制程节点越小越好
		制程工艺	12 英寸铝制程	1、“12 英寸”代表晶圆直径为 12 英寸 2、“铝制程”代表芯片制程导线所用的金属为铝	该指标代表制程工艺下晶圆的尺寸和导线的金属类型，反映了产品的导电能力、制程工艺等特性，以晶圆的直径和导线所用的金属来衡量。晶圆尺寸越大越先进，铝制程具备成本优势
3	LED 工艺平台	工作电压	1.5v-5v,1.2v-6v	可以使芯片逻辑运算器件正常工作的电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以提供芯片所有元件正常工作所需要的电压来衡量。依产品特性和功能需求进行匹配

序号	技术平台	参数指标/技术工艺		指标含义	选取依据及衡量标准
		输入/输出电压	5v	芯片输入/输出电路的接入/输出电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以芯片输入/输出电路的接入/输出电压来衡量。依产品特性和功能需求进行匹配
		制程节点	110nm	代表芯片最小制程线宽	该指标为衡量产品特性的重要依据，以制程最小线宽的宽度来衡量。制程节点越小越好
		制程工艺	12 英寸铝制程	1、“12 英寸”代表晶圆直径为 12 英寸 2、“铝制程”代表芯片制程导线所用的金属为铝	该指标代表制程工艺下晶圆的尺寸和导线的金属类型，反映了产品的导电能力、制程工艺等特性，以晶圆的直径和导线所用的金属来衡量。晶圆尺寸越大越先进，铝制程具备成本优势
4	E-Tag 工艺平台	核心元件电压	1.5v	可以使芯片逻辑运算器件正常工作的电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以低压器件正常工作的电压区间来衡量。依产品特性和功能需求进行匹配
		输入/输出电压	6v, 并提供高压 40v	1、6V: 显示模拟的电压 2、40V: E-Tag 的输出电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以芯片输入/输出电路的接入/输出电压来衡量。依产品特性和功能需求进行匹配
		制程节点	110nm	代表芯片最小制程线宽	该指标为衡量产品特性的重要依据，以制程最小线宽的宽度来衡量。制程节点越小越好
		制程工艺	12 英寸铝制程	1、“12 英寸”代表晶圆直径为 12 英寸 2、“铝制程”代表芯片制程导线所用的金属为铝	该指标代表制程工艺下晶圆的尺寸和导线的金属类型，反映了产品的导电能力、制程工艺等特性，以晶圆的直径和导线所用的金属来衡量。晶圆尺寸越大越先进，铝制程具备成本优势
5	MCU 工艺平台 (MTP)	工作电压	1.5v-5v	可以使芯片逻辑运算器件正常工作的电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以提供芯片所有元件正常工作所需要的电压来衡量。工作电压越小越好
		核心 IP-MTP 规格	容量大小: 32k8 bits 读写次数: 10k cycles	分别代表 MCU 的记忆容量与可操作次数	该指标为衡量产品特性的重要依据，以记忆容量的最大值和允许读写次数的平均值来衡量。容量大小和读写次数越大越好
		制程节点	110nm	代表芯片最小制程线宽	该指标为衡量产品特性的重要依据，以制程最小线宽的宽度来衡量。制程节点越小越好
		制程工艺	12 英寸铝制程	1、“12 英寸”代表晶圆直径为 12 英寸	该指标代表制程工艺下晶圆的尺寸和导线的金属类型，反映了产品的导电能力、制程工艺等特

序号	技术平台	参数指标/技术工艺		指标含义	选取依据及衡量标准
				2、“铝制程”代表芯片制程导线所用的金属为铝	性，以晶圆的直径和导线所用的金属来衡量。晶圆尺寸越大越先进，铝制程具备成本优势
6	PMIC 工艺平台	核心元件电压	1.2V, 1.5V	可以使芯片逻辑运算器件正常工作的电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以逻辑运算工作的电压区间来衡量。核心元件电压越小，器件效能越好
		输入/输出电压	5V	芯片输入/输出电路的接入/输出电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以芯片输入/输出电路的接入/输出电压来衡量。依产品特性和功能需求进行匹配
		高压电压	12V-200V	可以使芯片面板模拟讯号器件正常工作的电压	该指标为衡量产品特性的重要依据，以电源管理芯片模拟讯号工作的电压区间来衡量。开关电路追求低阻抗, 高击穿电压
		制程节点	150nm-90nm	代表芯片最小制程线宽	该指标为衡量产品特性的重要依据，以制程最小线宽的宽度来衡量。制程节点越小越好
		制程工艺	12 英寸铝制程	1、“12 英寸”代表晶圆直径为 12 英寸 2、“铝制程”代表芯片制程导线所用的金属为铝	该指标代表制程工艺下晶圆的尺寸和导线的金属类型，反映了产品的导电能力、制程工艺等特性，以晶圆的直径和导线所用的金属来衡量。晶圆尺寸越大越先进，铝制程具备成本优势

### (1) 制程节点对比

在制程节点方面，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人与同行业公司所达到技术水平的对比情况如下：

公司名称	制程节点
发行人	150nm、110nm、90nm、55nm <sup>1</sup>
台积电	5nm 及以上
联华电子	14nm 及以上
中芯国际	14nm 及以上
华虹集团	28nm 及以上
华润微	1um 至 110nm
世界先进	500nm 至 110nm

资料来源：上市公司信息披露等公开资料

注：发行人 55nm 技术平台正在进行风险量产

### (2) 工艺平台参数对比

在 DDIC 晶圆代工领域，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人与可比公司的工艺平台参数对比情况如下：

公司名称	制程节点 (越小越好)	低压器件电压 (越小越好)	中压器件电压 (依产品特性和功能需求进行匹配)	高压器件电压 (依产品特性和功能需求进行匹配)
发行人	55nm <sup>1</sup>	1.2V	6V	32V
	90nm	1.32V	6V	32V (即±16V)
		1.32V	6V	-
	110nm	1.5V	6V	32V (即±16V)
		1.5V	7V	-
	150nm	3.3V	-	13.5V
		3.3V	-	18V
1.8V		-	18V	
中芯国际	40nm	1.1V	8V	±16V
	95nm	1.5V	7.2V	±16V
		1.5V	6V	±16V
	160nm	1.8V	5.5V	±20V
300nm	3.3V	6.75V	13.5V	

公司名称	制程节点 (越小越好)	低压器件电压 (越小越好)	中压器件电压 (依产品特性和功能需求进行匹配)	高压器件电压 (依产品特性和功能需求进行匹配)
联华电子	28nm	1.0V	8V	±10V
		1.0V	8V	±13.5V
	40nm	1.1V	6V	±16V
		1.1V	8V	±10V
		1.1V	8V	±16V
	55nm	1.2V	6V	±16V
		1.2V	8V	±16V
	80nm	1.2V	6V	±16V
		1.2V	8V	±16V
	110nm	1.2V	6.75V	13.5V
		1.2V	6V	±16V
	130nm	1.5V	5.5V	±16V
	150nm	1.8V	4.5V	9V
		1.8V	6.75V	13.5V
		1.8V	9V	18V
		3.3V	9V	18V
	162nm	3.3V	6.75V	13.5V
		3.3V	9V	18V
		1.8V	5.5V	±16V
		1.8V	5.5V	±20V
	250nm	2.5V	5.5V	±12V
		3.3V	3.3V	24V
	280nm	3.3V	6.75V	13.5V
		3.3V	9V	18V
	300nm	3.3V	6.75V	13.5V
		3.3V	9V	16.5V
	350nm	3.3V	5.5V	±9V
3.3V		3.3V	±20V	
800nm	5V	5V	±20V, 12V, 18V, 30V, 40V	

资料来源：上市公司信息披露等公开资料

注：发行人 55nm 技术平台正在进行风险量产

## （二）发行人的竞争优势

### 1、完善的技术体系和高效的研发能力

公司重视技术创新与工艺研发，建立了完善的研发创新体系，在研发平台、研发团队、技术体系等方面形成了较强的优势。公司研发中心根据总体战略与技术发展战略，以客户需求为导向，进行成熟工艺精进开发，多个领域掌握领先的特色工艺，搭建了 150nm、110nm、90nm、55nm 等制程的研发平台，涵盖了 DDIC、CIS、MCU、PMIC、E-Tag、Mini LED 以及其他逻辑芯片等领域。截至本招股意向书签署日，公司目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的风险量产。未来，发行人将利用上市募集资金投入至 40nm、28nm 等更先进制程平台的自主研发，进一步增强先进制程服务能力，拓宽产品结构。

此外，公司通过持续对研发人才的招聘和培养，组建了由境内外资深专家组成的研发核心团队，其拥有在行业内多年的技术研发经验。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 1,388 人，占员工总数的 32.86%。

报告期内，发行人持续进行研发投入，致力追求技术突破，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人已取得了 316 项发明专利，专利分布在中国大陆、中国台湾地区、美国、日本等各个国家及地区。

### 2、以面板显示驱动芯片为基础，覆盖国际一线客户

公司立足于晶圆代工领域，以面板显示驱动芯片为基础，已与境内外领先芯片设计厂商特别是面板显示驱动芯片设计厂商建立了长期稳定的合作关系，能够掌握行业、产品最新技术动态，及时了解和把握客户最新需求，准确地进行晶圆代工服务更新升级，确保公司产品在市场竞争中保持竞争优势，同时积累产品行业应用经验，完善产品性能，提高产品质量水平。根据 Frost & Sullivan 的统计，截至 2020 年底，公司已成为中国大陆收入第三大、12 英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业（不含外资控股企业）。根据市场研究机构 TrendForce 的统计，2022 年第二季度，在全球晶圆代工企业中，公司营业收入排名全球第九。

公司向客户提供 DDIC 等多个工艺平台的晶圆代工服务，已经成功开发了 150nm 至 90nm 多种制程节点、用于不同工艺技术平台的晶圆代工核心技术。报告期各期，

公司 150nm、110nm 及 90nm 产品已经实现大批量生产，2020 年度、2021 年度及 2022 年度，营业收入分别为 151,237.05 万元、542,900.93 万元和 1,005,094.86 万元，呈现快速增长趋势，且 90nm 制程产品收入持续提升，产品结构持续优化。报告期内，公司已经覆盖国际一线客户，且正在积极开发新客户资源。

### 3、依托新兴产业，拓展丰富的工艺平台

公司所在地合肥拥有新型显示器件、集成电路和人工智能 3 个国家战略性新兴产业集群，显示面板、白色家电等芯片需求较为旺盛的重点产业已经形成，新能源汽车等新兴产业初步形成。此外，随着 5G、物联网、云计算、智能汽车等新兴产业的驱动下，全球集成电路市场规模有望持续增长。

此外，合肥是集电路设计、制造、封装测试及设备材料产业链于一体的城市之一，公司所处的半导体代工环节为半导体产业链中最为重要的环节之一。公司依靠成熟的制程制造经验，已经具备 DDIC、MCU、CIS、E-Tag、Mini-LED、PMIC 等工艺平台晶圆代工的技术能力，可为客户提供通讯产品、消费品、汽车、工业等不同领域集成电路晶圆代工服务。公司在显示面板驱动芯片为基础，已有国际一线客户的覆盖，并获得了良好的行业认知度，为公司进一步利用工艺平台拓展业务范围打下了坚实的基础。

### 4、国际化经营理念以及本土化人才策略

公司顺应半导体产业链格局，初步建立了海外研发团队与运营网络，并在日本设立了研发中心。公司研发团队成员来自于中国、日本、韩国等国家，以便更好拓展市场，快速响应客户需求。公司持续通过多元化激励持续吸引晶圆代工行业高端人才的加入，提升公司技术水平。

公司以国际一线的资源为基础，从 EDA 供应商，到光罩供应商、封测合作厂商，公司均选择与国内外一流企业合作，保证优质的产品输出。通过对产品质量的严格要求，公司主要产品的良率一直保持较高水平。

晶圆代工行业属于人才密集型行业。公司制定了多元化的激励策略，持续吸引晶圆代工行业高端人才的加入，提升公司技术水平。公司持续加强人才培养，通过一系列的机制吸引并留住人才，增加员工的本地归属感。此外，公司坚持本土化人才策略，员工中的境内人员比例持续增长，人才梯队逐步形成。



## 5、完善的质量管理体系

公司致力于打造完善的质量管理系统，在生产、研发、安全、环保等生产各环节积极进行国际标准验证，公司目前已经建立了从工艺研发到产品交付的全流程质量管理体系，并在具体的日常工作中严格按照国际标准的要求执行。

截至本招股意向书签署日，公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、QC080000 环境有害物质管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证；2020 年 6 月已启动 IATF16949 汽车业管理体系认证程序，并于 2021 年 1 月通过审查，取得资质确认，2022 年 12 月通过第三方（BSI）认证机构审查，2023 年 1 月取得符合性证明函。

## 6、深谙行业发展和具有创新精神的管理团队

公司管理层由来自中国大陆和中国台湾地区的资深半导体行业专业人士组成，董事长蔡国智先生拥有数十年高科技产业的经验，在多家国内外科技及半导体相关公司担任高管及董事职务。总经理蔡辉嘉先生在知名晶圆代工企业工作 21 年，历任工程师、部经理、厂长等职务。研发副总经理詹奕鹏先生曾于联华电子、中芯国际担任研发与管理职务，曾任中国科学院上海微系统国家重点实验室顾问。

### （三）发行人的竞争劣势

#### 1、融资渠道亟待拓展

半导体行业是资本密集型行业，产能扩充和持续研发投入都需要大量的资金投入。随着终端市场的快速发展和行业技术的迭代革新，公司需持续拓展产品种类，顺应行业发展方向。公司当前融资渠道有限，亟待继续拓展融资渠道，以进一步提高市场占有率、盈利能力以及可持续发展能力。

#### 2、综合实力与国际晶圆代工巨头尚存在差距

公司在先进制程、工艺积累、产品多样性、公司规模、品牌知名度等各方面与台积电、格罗方德等国际晶圆代工巨头相比尚存在一定差距。面对激烈的市场竞争，公司仍需加大研发投入、市场化招聘研发团队、提高自主创新能力、加强产品多元性和客户服务能力，以进一步提高市场占有率。

#### 3、国内半导体产业链配套相对薄弱

当前，国内半导体产业链还相对薄弱，与半导体集成电路制造行业配套的相关产

业目前尚不成熟。公司生产 12 英寸晶圆代工产品所需的光刻机、离子注入机、刻蚀机、清洗机等设备以及半导体硅片、气体等重要原材料大多需从国外进口，国内半导体产业链配套欠缺也在一定程度制约了公司的技术研发与产能扩张。

#### 4、在技术和产品结构方面与同行业先进公司存在差距

报告期内，和同行业先进可比公司相比：在制程节点方面，半导体晶圆代工行业先进制程持续缩小，发行人可提供150nm至90nm的半导体晶圆代工服务，正在进行55nm制程节点的风险量产，台积电、联华电子、中芯国际等行业领先企业已达5nm、14nm等制程节点，发行人与之存在差距；在产品结构方面，报告期内发行人主要营业收入来自DDIC晶圆代工服务，与台积电、联华电子、中芯国际等行业领先企业相比，产品结构较为单一。

#### 5、在市场占有率和盈利水平方面与可比公司存在差距

报告期内，发行人处于产能快速扩充期，2020年度毛利率为负，2021年和2022年的综合毛利率为45.13%和46.16%，市场占有率较低，而台积电、联华电子等行业领先企业的盈利能力和市场占有率高于发行人，发行人在盈利能力和市场占有率上与之存在差距。

### （四）发行人面临的机遇与挑战

#### 1、发行人面临的机遇

##### （1）中国大陆集成电路行业持续快速增长

中国大陆晶圆代工行业起步较晚，但随着国内经济的发展和科学技术水平的提高，国内芯片企业对晶圆代工服务的需求日益提升，在国家政策的支持下，中国大陆晶圆代工行业实现了快速的发展。

根据 Frost & Sullivan 的统计，2015 年至 2020 年，按照销售额口径，中国大陆集成电路市场规模从 3,609.8 亿元增长至 8,848.0 亿元，年均复合增长率为 19.6%。随着未来集成电路产业国产替代的推进，以及新基建、信息化、数字化的持续发展，中国大陆集成电路市场规模有望持续增长，在 2024 年中国集成电路市场规模将达到 14,426.5 亿元。

## **(2) 中国大陆集成电路行业国产替代需求显著**

近年来，中国大陆集成电路行业高速发展，但仍无法满足快速增长的市场需求，大量集成电路产品仍要依赖进口。根据中国半导体行业协会统计，2022 年中国大陆集成电路进口额达 4,155.8 亿美元，同期中国大陆集成电路出口额为 1,539.2 亿美元，贸易逆差达 2,616.6 亿美元，仍有巨大的国产替代空间。

在近年国际贸易摩擦日益严重的情况下，一方面，提高晶圆代工行业国产化的重要性日益凸显，国家陆续出台政策支持境内晶圆代工行业的发展；另一方面，境内芯片企业亟需寻找可以满足其需求的境内晶圆代工产能，以保证其生产安全。晶圆代工行业国产化替代的重要性越发凸显，国产化替代将成为中国大陆集成电路发展的重要趋势。

## **(3) 国家重点支持集成电路行业发展**

集成电路是信息化、数字化的基石，被广泛应用于通信、安防、军事、工业、交通、消费电子等领域，在国家安全、经济建设和人民的日常生活中发挥着重要的作用。为保证国家经济安全，提高中国大陆集成电路行业的国产化程度，国家相继出台产业政策推动中国大陆集成电路行业发展。具体国家支持政策及行业监管法规参见“第五节 业务与技术”之“二、行业基本情况”之“（二）行业主管部门及管理体制、主要法律法规及政策”。

## **2、发行人面临的挑战**

### **(1) 不断提升晶圆代工工艺水平**

报告期各期，发行人 DDIC 工艺平台晶圆代工收入占主营业务收入的比重分别为 98.15%、86.32%和 71.24%。为提高行业竞争力、把握下游应用增长带来的增量空间，发行人目前已投入大量资源，积极从事 MCU、CIS、PMIC、Mini LED 等晶圆代工工艺平台的研发工作，并持续优化现有工艺平台，提高产品稳定性和良率。

未来，随着发行人制程工艺的不断提高、工艺平台的不断演进，技术进步对研发投入资金和研发人员水平的要求将显著提升，发行人需要持续投入资金与人力，才能在激烈的行业竞争中占据优势。

## (2) 持续吸引晶圆代工行业高端人才

晶圆代工行业属于人才密集型行业。中国大陆晶圆代工行业发展较晚，和中国台湾地区、韩国、日本、欧洲相比，高端人才较为稀缺。发行人需要制定合理的激励策略，持续吸引晶圆代工行业高端人才的加入，提升公司技术水平。

## (3) 2022年第三季度起，产能缺口情况有所缓解

根据 TrendForce 的统计与分析，2021 年，5G 及新能源汽车兴起带动半导体需求增加，晶圆厂产能又无法快速投产，产能缺口不断扩大。但是在 2022 年，智能手机、消费电子需求下行，受到消费性终端需求疲软的影响，整体而言，2022 年第三季度起产能缺口情况有所缓解，使得晶圆代工产能利用率面临挑战。

## 四、公司主营业务经营情况

### (一) 公司销售情况

#### 1、主要产品和服务的产能、产量及销量规模

报告期内，发行人 12 英寸晶圆代工服务的产能、产量、销量情况如下：

单位：片

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
产能	1,262,110	570,922	266,237
产量	1,084,444	605,582	264,893
销量	1,060,498	602,712	264,069

注：产能、产量、销量以 12 英寸晶圆片数为计量单位。

#### 2、主营业务收入分产品构成

##### (1) 按制程节点分类

报告期内，发行人主要向客户提供制程节点为 150nm、110nm、90nm 的晶圆代工服务。发行人按照制程节点分类的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
55nm	3,912.65	0.39%	4.99	0.00%	-	-
90nm	521,240.66	51.99%	303,310.46	55.95%	80,268.82	53.09%
110nm	316,507.96	31.57%	132,328.41	24.41%	40,725.48	26.94%
150nm	160,888.68	16.05%	106,440.58	19.64%	30,191.80	19.97%
合计	<b>1,002,549.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,084.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,186.11</b>	<b>100.00%</b>

注：发行人 55nm 技术平台正在风险量产阶段

## (2) 按工艺平台分类

报告期内，发行人向客户提供 DDIC 及其他工艺平台的晶圆代工服务。发行人按照工艺平台分类的主营业务收入构成如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDIC 工艺平台晶圆代工	714,261.58	71.24%	467,914.67	86.32%	148,394.24	98.15%
其他工艺平台晶圆代工	288,288.37	28.76%	74,169.78	13.68%	2,791.87	1.85%
合计	<b>1,002,549.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,084.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,186.11</b>	<b>100.00%</b>

## 3、销售价格的总体变动情况

报告期内，发行人的产品平均销售价格及其变动情况如下：

单位：元/片

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	单价	变动比例	单价	变动比例	单价	变动比例
产品平均销售价格	9,453.58	5.11%	8,994.09	57.10%	5,725.25	2.30%

注：销售均价=主营业务收入/销量。

报告期各期，公司产品销售均价为 5,725.25 元/片、8,994.09 元/片和 9,453.58 元/片，呈持续上升趋势，主要原因一方面公司产品结构持续优化，单价较高的 90nm 制程及 110nm 制程产品收入占比提高；另一方面公司根据市场行情有所调价。2022 年度，公司均价较低的非 DDIC 工艺平台晶圆代工类产品收入占比提高，导致公司产品销售均

价涨幅较 2021 年度有所下降。

#### 4、各销售模式收入占比情况

报告期内，发行人全部采用直销模式进行销售。

#### 5、报告期内前五大客户销售情况

发行人的主要客户群体为半导体行业设计公司。报告期内，发行人的前五大客户情况如下：

单位：万元

期间	序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2022年	1	联咏科技股份有限公司	166,546.87	16.57%
	2	集创北方及其关联方	155,500.65	15.47%
	3	思特威（上海）电子科技股份有限公司及其关联方	110,604.95	11.00%
	4	奕力科技股份有限公司及其关联方	104,361.61	10.38%
	5	合肥捷达微电子有限公司及其关联方	71,944.93	7.16%
			<b>合计</b>	<b>608,959.01</b>
2021年	1	联咏科技股份有限公司	168,073.68	30.96%
	2	集创北方及其关联方	102,416.76	18.86%
	3	合肥捷达微电子有限公司及其关联方	42,302.47	7.79%
	4	奕力科技股份有限公司	37,281.71	6.87%
	5	奇景光电股份有限公司	30,732.84	5.66%
			<b>合计</b>	<b>380,807.45</b>
2020年	1	联咏科技股份有限公司	77,864.57	51.49%
	2	集创北方及其关联方	15,044.35	9.95%
	3	奇景光电股份有限公司	14,872.50	9.83%
	4	奕力科技股份有限公司	14,558.70	9.63%
	5	合肥捷达微电子有限公司及其关联方	13,464.36	8.90%
			<b>合计</b>	<b>135,804.49</b>

注：

1、受同一控制的客户，已合并计算销售金额

2、2020 年度、2021 年度，集创北方及其关联方未包含北京欧徕德微电子技术有限公司、OLED VICTORY INTERNATIONAL LIMITED，主要系北京欧徕德微电子技术有限公司、OLED VICTORY INTERNATIONAL LIMITED 为 2021 年 10 月集创北方重组后新纳入合并报表范围内的企业。2022 年集创北方及其关联方包含前述两家企业

报告期内，发行人前五大客户的销售收入合计分别为 135,804.49 万元、380,807.45 万元和 608,959.01 万元，占营业收入的比例分别为 89.80%、70.14%和 60.59%，客户集中度仍然较高。上述情形主要系由于报告期内发行人处于产能爬坡阶段和客户逐步导入阶段，不同制程节点及工艺平台的晶圆代工服务逐步量产，仅能向有限的客户提供大批量生产服务。

报告期各期，发行人 DDIC 工艺平台晶圆代工收入占主营业务收入的比重分别为 98.15%、86.32%和 71.24%。根据第三方咨询机构 Omdia 的统计，2020 年大尺寸显示驱动芯片市场份额排名前八的企业的市占率为 92.3%，市场集中度较高；排在前八名的企业中，芯片设计（Fabless）企业共有六名，包括：联咏科技（24.1%）、奇景光电（14.2%）、Silicon Works（14.2%）、瑞鼎科技（9.1%）、天钰科技（8.7%）、集创北方（3.2%），市占率合计达 73.5%。其中，联咏科技、奇景光电、集创北方为发行人报告期内的前五大客户，发行人前五大客户之一的合肥捷达微是天钰科技合并财务报告范围内的子公司。上述客户主要为境内外知名半导体行业设计公司，不存在重大不确定性，发行人已与上述客户建立了长期稳定的合作关系，并与联咏科技、集创北方等部分客户签署了长期合作协议，并与其它主要客户签署了产能预约合同，业务合作具有持续性，且发行人的产能也在逐步扩充，发行人在客户稳定性与业务持续性方面没有重大风险，客户集中的情况不会导致发行人未来持续经营能力存在重大不确定性。

截至本招股意向书签署日，发行人前五大客户中，集创北方为发行人股东，持有发行人8,801,412股，持股比例0.58%；发行人前五大客户与发行人、实际控制人和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。报告期内，发行人的晶圆代工服务受到客户广泛认可，公司目前正在进行55nm制程工艺平台的风险量产，已实现Mini LED、CIS、E-Tag等工艺平台的量产，旨在向客户提供更加丰富的晶圆代工服务，发行人具备独立面向市场获取业务的能力，业务获取方式不影响独立性。

根据同行业公司中芯国际（688981.SH）公开资料，2020年至2022年，中芯国际前五大客户占年度销售总额的比例分别为46.3%、31.2%和29.2%，前五大客户集中度低于发行人，主要原因系中芯国际已发展多年，可以提供多个制程节点、多个工艺平台的晶圆代工服务，同时，作为在中国香港上市多年的半导体晶圆代工企业，拥有更高的知名度，积累了大量的客户基础。

发行人已在招股意向书“第三节 风险因素”中对客户集中度较高可能带来的风险

进行了提示。

## （二）公司采购情况

### 1、主要原材料采购情况

报告期内，发行人生产经营所需的原材料主要包括硅片、化学品、气体、靶材、零配件以及光阻等，主要原材料采购情况如下：

种类	项目	2022年	2021年度	2020年度
生产性硅片	数量（万片）	120.63	73.72	35.03
	金额（万元）	70,567.63	38,056.62	18,993.43
	平均单价（元/片）	585.02	516.20	542.22
化学品	数量（吨）	59,306.27	29,860.01	13,453.61
	金额（万元）	24,101.16	13,361.31	5,547.67
	平均单价（元/吨）	4,063.85	4,474.65	4,123.55
气体	数量（吨）	120,502.58	79,819.96	45,081.46
	金额（万元）	26,076.76	14,680.00	8,925.08
	平均单价（元/吨）	2,164.00	1,839.14	1,979.77
靶材	数量（件）	2,658.00	2,252.00	998.00
	金额（万元）	5,968.68	5,481.75	2,688.20
	平均单价（万元/件）	2.25	2.43	2.69
零配件	数量（个）	275,932.00	171,505.00	80,682.00
	金额（万元）	54,263.20	31,826.40	17,181.97
	平均单价（元/个）	1,966.54	1,855.71	2,129.59
光阻	数量（千升）	1,744.65	1,211.92	645.68
	金额（万元）	11,872.81	8,772.66	4,537.58
	平均单价（元/升）	68.05	72.39	70.28

注：列示的硅片为用于生产晶圆的硅片，不包含挡控片等非生产用硅片。

### 2、主要能源供应情况

报告期内，发行人生产经营所需的能源主要包括电和水，主要能源采购情况如下：

种类	项目	2022年度	2021年度	2020年度
电	数量（万度）	50,526.61	28,749.25	14,030.37
	金额（万元）	32,126.41	15,952.95	7,736.00



种类	项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
	平均单价（元/度）	0.64	0.55	0.55
水	数量（万吨）	387.23	189.46	110.18
	金额（万元）	1,294.45	633.39	368.42
	平均单价（元/吨）	3.34	3.34	3.34

### 3、报告期内前五大原材料供应商采购情况

报告期内，发行人前五大原材料供应商情况如下：

单位：万元

期间	序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占比
2022 年	1	GlobalWafers Co., Ltd.、GlobalWafers Singapore PTE LTD	硅片	45,415.36	22.27%
	2	Applied Materials South East Asia、应用材料（中国）有限公司	零配件	18,102.54	8.88%
	3	中环领先半导体材料有限公司、天津中环领先材料技术有限公司	硅片	12,395.82	6.08%
	4	Rohm and Haas Electronic Materials CMP,LLC、罗门哈斯电子材料（上海）有限公司、Rohm and Haas Electronic Materials CMP Asia Inc., Taiwan Branch、杜邦国际商贸（上海）有限公司	光阻、化学品、零配件	8,751.02	4.29%
	5	广钢气体（广州）有限公司、合肥广钢气体有限公司	气体	8,443.52	4.14%
小计				<b>93,108.26</b>	<b>45.65%</b>
2021 年	1	GlobalWafers Co., Ltd.、GlobalWafers Singapore PTE LTD	硅片	32,085.81	25.59%
	2	Applied Materials South East Asia、应用材料（中国）有限公司	零配件	9,842.13	7.85%
	3	杜邦国际商贸（上海）有限公司、罗门哈斯电子材料（上海）有限公司、Rohm and Haas Electronic Materials CMP, LLC、Rohm and Haas Electronic Materials CMP Asia Inc.Taiwan Branch	光阻、化学品、零配件	6,065.46	4.84%
	4	Wah Lee Industrial Corp.、上海怡康化工材料有限公司	光阻、化学品、气体	5,733.33	4.57%
	5	Siltronic Singapore Pte.Ltd	硅片	5,636.86	4.50%
小计				<b>59,363.58</b>	<b>47.35%</b>
2020 年	1	GlobalWafers Co., Ltd.、GlobalWafers Singapore PTE LTD	硅片	18,301.23	28.93%
	2	Applied Materials South East Asia、应用材料（中国）有限公司	零配件	6,493.13	10.26%
	3	Wah Lee Industrial Corp.、上海怡康化	光阻、化学品、	3,660.35	5.79%

期间	序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占比
		工材料有限公司	气体		
	4	液化空气（上海）国际贸易有限公司、液化空气（合肥）工业气体有限公司	气体	2,741.94	4.33%
	5	杜邦国际商贸（上海）有限公司、罗门哈斯电子材料（上海）有限公司、Rohm and Haas Electronic Materials CMP, LLC、Rohm and Haas Electronic Materials CMP Asia Inc. Taiwan Branch	光阻、化学品、零配件	2,698.72	4.27%
<b>小 计</b>				<b>33,895.37</b>	<b>53.58%</b>

注 1：受同一控制的供应商，已合并计算采购金额；占比指占当年度原材料采购总额的比重

注 2：杜邦贸易（上海）有限公司更名为杜邦国际商贸（上海）有限公司，

## 五、与发行人业务相关的主要资产情况

### （一）主要固定资产情况

发行人固定资产主要包括房屋及建筑物、厂务设备、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等，目前使用状况良好。根据《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产类别	固定资产原值	折旧年限	固定资产净值
房屋及建筑物	4,353.82	20-30 年	3,902.22
机器设备	2,635,523.87	5-10 年	2,126,441.03
运输工具	273.88	4 年	-
电子设备及其他	26,406.67	3-5 年	13,393.57
<b>合计</b>	<b>2,666,558.24</b>	-	<b>2,143,736.82</b>

### （二）房屋情况

#### 1、自有房产

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司无自有房产。

#### 2、租赁房产

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 4 处，总面积约为 215,785.43 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	房屋位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途
1	晶合集成	合肥蓝科	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号	215,270.61	2017/06/28-2037/06/27	生产办公
2	晶合集成	深圳市唐庄实业有限公司	深圳市福田区深南西路车公庙工业区	130.96	2021/06/01-2023/05/31	办公
3	日本晶合	マスター・プロパティーズ株式会社	東京都立川市喀町一丁目13番11号	242.71	2021/05/01-2023/04/30	办公
4	上海晶合	上海莘泽创业投资管理股份有限公司	上海市张江高科技园区盛夏路608号2幢5层502室	141.15	2022/04/01-2023/03/31	办公

### (三) 主要无形资产

#### 1、土地使用权

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司未拥有土地使用权。

#### 2、专利

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有境内专利共计 349 项，境外专利共计 67 项。该等专利不存在相关诉讼或仲裁、担保或其他权利限制。该等专利的具体情况参见本招股意向书“附件六 发行人主要无形资产。”

#### 3、商标

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的境内注册商标共计 35 项，境外注册商标共计 91 项。该等商标的具体情况参见本招股意向书“附件六 发行人主要无形资产。”

#### 4、域名

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的域名共计 1 项，具体情况参见本招股意向书“附件六 发行人主要无形资产。”

发行人所持有的专利等知识产权与主营业务的关系请参见本节之“六、公司的技术与研发情况”之“(一) 公司的核心技术情况”。

## 5、被授权使用的知识产权

随着集成电路行业分工的日益细化，部分厂商分化为专门向市场提供不同功能模块授权的 IP 供应商。IP 供应商设计特定功能的集成电路模块，以 IP 授权的形式提供给集成电路企业使用。IP 供应商向获得授权的集成电路企业收取技术使用费，通常包括一次性起始费用和按芯片或晶圆生产数量收取的提成费用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在使用的授权 IP 情况如下：

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或定价依据	有效期限
1	美商矽成积体电路股份有限公司	110纳米嵌入式闪存技术	开发服务费用、权利金	最晚至 2025/01/30
2	昇星科技股份有限公司	90纳米编译器IP、150纳米标准单元库、90纳米编译器IP、150纳米编译器IP	开发服务费、权利金	最晚至 2032/10/15
3	力旺电子股份有限公司	单次可编程IP、单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费、权利金等	最晚至 2027/10/16
4	智成电子股份有限公司	110纳米标准单元库	量产权利金	最晚至 2027/12/31
5	寅通科技股份有限公司	80、90、110、55纳米集成电路IP	技术开发费、量产权利金、开发及授权服务费	最晚至 2027/09/14
6	亿而得微电子股份有限公司	多次可编程电路模块、集成电路模块	产品开发费用、权利金或权利金	最晚至 2027/01/20
7	成都锐成芯微科技股份有限公司	110纳米低功耗嵌入式存储工艺平台模拟IP、110纳米多次可编程电路 90纳米多晶硅熔丝IP 150纳米多晶硅熔丝IP、55纳米多晶硅熔丝IP、55纳米多次可编程电路	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用或支付版税费用或产品开发费用及权利金	最晚至2032/11/24
8	珠海创飞芯科技有限公司	110、90纳米单次可编程（反熔丝）技术、55纳米单次可编程（反熔丝）技术、40纳米单次可编程（反熔丝）技术	授权产品的使用提成费用、产品开发费用	2021/06/01起至达成新协议前永久有效或最晚至 2027/08/14
9	IMEC VZW	28纳米集成电路IP	分期支付使用费	2021/12/24- 2023/06/23
10	南京华大九天科技有限公司	40纳米集成电路IP	产品开发费用、权利金	最晚至2032/11/24
11	Synopsys Inc.	28纳米集成电路IP	产品开发费用、权利金	2022/4/17-永久有效或最晚至 2027/07/26
12	芯耀辉科技有限公司	28纳米集成电路IP	产品开发费用	2022/11/29-永久有效
13	ARM WESTERN TECHNOLOGY RESEARCH DEVELOPMENT	28纳米集成电路IP	产品开发费用	2022/12/16- 2027/12/15

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或定价依据	有效期限
	CO.,LTD			
14	苏州腾芯微电子有限公司	110纳米集成电路IP	权利金	2022/5/20-2032/5/20

#### （四）公司的业务许可资质

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司主要拥有如下业务许可和资质：

序号	资质主体	资质名称	证书/登记编号	授予单位/登记机关	有效期限
1	晶合集成	辐射安全许可证	皖环辐证[A0390]	安徽省生态环境厅、合肥市生态环境局	至 2027/05/21
2	晶合集成	排污许可证	91340100343821433Q001W	合肥市生态环境局	2022/01/04-2027/01/03
3	晶合集成	对外贸易经营者备案登记表	02360936	-	-
4	晶合集成	海关进出口货物收发货人备案	3401660005	庐州海关	2020/07/08-长期
5	新品集成	海关进出口货物收发货人备案	3401668001	合肥综合保税区	2021/10/12-长期
6	晶合集成	高新技术企业证书	GR202034003384	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局	2020/10/30-2023/10/30
7	新品集成	辐射安全许可证	皖环辐证[A0813]	安徽省生态环境厅、合肥市生态环境局	至 2027/01/03
8	新品集成	排污许可证	91340100MA8N4PFB89001V	合肥市生态环境局	2022/02/11-2027/02/10

#### （五）发行人的特许经营情况

截至本招股意向书签署之日，公司无特许经营权。

## 六、公司的技术与研发情况

### （一）公司的核心技术情况

#### 1、主要核心技术及技术来源

截至报告期末，发行人的主要核心技术平台情况如下：

序号	产品应用领域类别	技术平台	技术参数与工艺特点	终端应用领域	技术先进性	技术来源
1	LCD 显示驱动	55nm 触控与显示驱动整合技	核心组件电压：1.2V 输入/输出电压：6V,并提供高	高阶智能手机、穿戴设备等电子	国际主流	自主研发

序号	产品应用领域类别	技术平台	技术参数与工艺特点	终端应用领域	技术先进性	技术来源
		术平台	压 32V 采用铜制程技术	产品		
		90nm 触控与显示驱动整合芯片平台	核心组件电压: 1.2/1.32V 输入/输出电压: 6V,并提供高压 32V 采用铝制程技术	高阶智能手机、平板电脑、手表等电子产品	国际主流	技术引进并创新升级
		90nm 中大尺寸显示驱动芯片	核心组件电压: 1.2-1.5V 输入/输出电压: ±6V 采用铝制程技术	笔记本电脑	国际主流	技术引进并创新升级
		110nm 显示驱动芯片平台	核心组件电压: 1.2V/1.5V 输入/输出电压: 6V,并提供高压 32V 采用铝制程技术	智能手机、笔记本电脑、平板电脑	国际主流	技术引进并创新升级
		110nm 高阶显示驱动芯片平台	核心组件电压: 1.5V 输入/输出电压: 6V,并提供高压 32V 金属层进行 90% 尺寸微缩, 采用铝制程技术 采用低漏电元件技术	智能手机、笔记本电脑、平板电脑	国际主流	技术引进并创新升级
		150nm 显示驱动芯片平台	核心组件电压: 1.8V/3.3V 输入/输出电压: 13.5V/18V	4K/8K 电视显示屏、电脑显示屏	国际主流	技术引进并创新升级
2	LED 显示驱动	110nmLED 显示驱动芯片平台	核心组件电压: 1.5V 输入/输出电压: 5V	LED 广告牌、LED 背光	国际主流	自主研发
		110nmLED 驱动芯片平台	核心组件电压: 5V	LED 灯带	国际主流	自主研发
3	CIS	90nmCMOS 图像传感器平台	核心组件电压: 1.2V 输入/输出电压: 3.3V 像素尺寸: 1.4μm 采用前照度 (FSI) 技术	手机摄像头芯片、3D 识别芯片、安防监控芯片等	国内领先	自主研发
4	E-tag	110nm 中高阶电子标签驱动芯片平台	核心组件电压: 1.5V 输入/输出电压: 6V,并提供高压 40V 高压元件为沟道隔离元件, 可大幅缩小尺寸	电子标签及便携式装置	国内领先	自主研发
5	MCU	新一代 110nm 加强型微控制器平台	核心组件电压: 1.5V 输入/输出电压: 5V MTP 容量大小: 32kx8 bits; 读写次数: 10k cycles	智能家电芯片、物联网芯片	国内主流	自主研发
6	PMIC	150nm PMIC 手机高压电源管理芯片技术平台	核心组件电压: 1.8V 输入/输出电压: 3.3V	智能手机电源管理芯片	国内领先	自主研发

上述技术引进并创新升级的平台中, 涉及的技术为力晶科技以无形资产出资等方

式向发行人提供的技术。发行人取得力晶科技相关技术后，由自身研发团队进行研发改进，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了发行人现有技术平台。

上述核心技术参数的含义如下，相关可比公司亦对工作电压区间、制程工艺等主要指标进行了披露，具备行业代表性：

技术参数与工艺特点	含义	选取依据及衡量标准
核心组件电压	可以使芯片逻辑运算器件正常工作的电压	衡量产品特性的重要依据，以逻辑运算工作的电压区间来衡量，核心元件电压越小越好
输入/输出电压	芯片输入/输出电路的接入/接出电压	衡量产品特性的重要依据，以芯片输入/输出电路的接入/接出电压衡量，依产品特性和功能需求进行匹配
采用铝制程技术	代表芯片制程导线所用的金属	导线的金属类型反映了产品的导电能力、制程工艺等特性，以导线所用的金属来衡量，铝制程具备成本优势
采用低漏电元件技术	代表芯片待机时的耗电较低	衡量产品特性的重要依据，芯片待机时的耗电越低越好
金属层进行 90% 尺寸微缩	通过尺寸微缩，增加晶圆单位面积芯片的数量	衡量晶圆代工服务的性价比，在保证芯片性能的前提下，微缩程度越高，晶圆单位面积芯片的数量越多，性价比越高
像素尺寸	单个像素物理尺寸	衡量芯片像素大小的核心指标，以单个像素的物理尺寸来衡量，像素尺寸越小越好
采用前照度（FSI）技术	指使用正面入射光成像技术	代表了图像传感器的技术路径
高压元件为沟道隔离元件	采用沟道隔离结构增加高压元件耐压能力	衡量产品特性的重要依据，为增加 40V 高压元件耐压需求，采用沟道隔离元件技术可进一步缩小元件面积，同时延长电子漂移长度
MTP 容量	代表 MCU 的记忆容量	衡量产品特性的重要依据，以记忆容量的最大值来衡量，容量越大越好
读写次数	代表 MCU 的可操作次数	衡量产品特性的重要依据，以允许读写次数的平均值来衡量，读写次数越大越好

## 2、核心技术在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况

报告期内，发行人核心技术广泛应用于发行人各类技术平台中。发行人应用核心技术生产的产品收入及其占营业收入比重情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
核心技术产品和服务收入	1,002,549.95	542,084.44	151,186.11
营业收入	1,005,094.86	542,900.93	151,237.05
占营业收入的比重	99.75%	99.85%	99.97%

### 3、核心技术的保护措施

#### (1) 知识产权保护

发行人为保护无形资产完整，明确科研成果归属，制定了《专利管理办法》《商标管理办法》等规定，建立了注册专利、商业秘密保护的多层次的知识产权管理体系。根据上述规定，对于通过公司内部专利评审会审查的技术发明，以公司为主体向国家知识产权局申请注册专利，并对专利发明人发放奖金激励；如技术发明不适宜进行公开披露，由专利评审会审议通过后可将其列为商业秘密保护，并依其潜在价值对发明人进行奖励。

#### (2) 保密与竞业禁止制度

为确保职务作品归属，避免员工流动导致的技术秘密外泄，防范与员工之间的知识产权争议，发行人与其主要技术人员签署保密及竞业禁止协议，约定员工在工作过程中研发的或利用发行人生产工具制造的任何性质的知识产权均属于员工的职务成果，该等职务成果归属于发行人所有。员工与公司的劳动关系结束后的 12 个月内，应遵守竞业限制义务，不得设立、经营、参与任何与发行人竞争的实体，不得在该等实体工作。

#### (3) 员工持股激励

为打造稳定、高效、专业的研发团队，促进研发人员的科研创新热情，锁定高级管理人员及核心员工，发行人制定了一系列员工激励计划，通过员工持股、期权激励等方式实现对核心员工有效激励，以稳固公司的高级管理人员及核心技术团队。该等激励计划的情况参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排”。



#### 4、公司核心技术形成过程及技术先进性的具体表征

公司主要核心技术平台及核心技术的形成过程与其先进性的具体表征如下：

序号	产品应用领域类别	技术平台	核心技术的形成过程	技术先进性的具体表征
1	LCD 显示驱动	55nm 触控与显示驱动整合技术平台	发行人基于自身开发中的 55nm 铜制程研发技术，增加中高压器件开发，再嵌入电容、记忆体等元件，并调试元件后，研发形成发行人的 55nm 触控与显示驱动芯片。	利用专门设计的后段金属制程，解决后段金属蚀刻困难的问题；利用特殊化合物作为接触材料，有效提升产品性能。
		90nm 触控与显示驱动整合芯片平台	发行人与力晶科技签订技术转让协议，导入了 90nm M+ 技术平台，该技术虽然可以用于部分 90nm 工艺的生产，但无法直接用于触控与显示驱动整合芯片晶圆代工，发行人参考联咏科技对触控与显示驱动整合芯片晶圆代工服务的需求，在导入技术的基础上，对 90nm 晶圆代工平台进行了独立研发，改造工艺流程，新增自主研发的水平双极电晶体元件设计，打造全新高压元件架构，自主设计栅极制程，以铝金属制程加厚达到铜制程效能，从而满足触控与显示驱动整合芯片晶圆代工的技术指标要求，有效提升了平台技术的效能，进而形成了发行人的 90nm 触控与显示驱动整合芯片平台。	1、新增自主研发的水平双极电晶体元件设计，打造全新高压元件架构，安全操作范围得到大幅提升； 2、自主设计栅极制程，使输出匹配性大幅优化； 3、以铝金属制程加厚达到铜制程效能，从而满足触控与显示驱动整合芯片晶圆代工的技术指标要求。
		90nm 中大尺寸显示驱动芯片	在目前的中大尺寸显示驱动芯片领域，通常在 150nm 制程节点进行制造，在该制程下，芯片功耗较高、布局面积较大，因此，发行人客户对 90nm 的中大尺寸显示驱动芯片存在需求。发行人在 90nm 触控与显示驱动整合芯片平台的基础上，改造制程工艺，在原平台已有低压与中压元件的基础上，优化中压元件的驱动模式，使之更适配客户对中大尺寸显示驱动芯片的生产需求，进而形成了发行人的 90nm 中大尺寸显示驱动芯片工艺平台。	1、和市场上通常的 150nm 中大尺寸显示驱动芯片技术平台相比，发行人通过采用 90nm 节点制造，使得芯片功耗更小、布局面积更小，性能和性价比得到有效提高，具备更强的市场竞争力； 2、采用 90nm 制程节点制造的中大尺寸显示驱动芯片，可以更好地适配中大尺寸显示面板高刷新频率及窄边框的需求。
		110nm 显示驱动芯片平台	发行人通过与力晶科技签订技术转让协议，导入 110nm 显示驱动芯片相关技术，该技术对接触层阻值的控制能力、MOS 电性稳定性、均匀性仍有进步空间。因此，为满足客户对质量的需求、提升公司在市场中的竞争力，发行人自主改造工艺流程，对已有的 110nm 显示驱动芯片相关技术进行独立自主的技术升级，增加新型 TiN 镀膜工艺流程，自主设计多个元件架构以及退火、刻	1、在接触层工艺环节增加新型 TiN 镀膜工艺流程，有效提升接触层阻值控制能力； 2、自主设计元件架构，并采用更加环保的新型光阻，有效提高制程稳定性，提升工艺制程的良率，减少对环境的污染； 3、自主设计快速退火制程，改造 Spacer etch

序号	产品应用领域类别	技术平台	核心技术的形成过程	技术先进性的具体表征
			蚀、硅化钴等多个工艺环节，使技术平台的阻值控制能力、电性稳定性、均匀性得到有效提升，良率更有保障，进而形成了发行人现有的 110nm 显示驱动芯片平台。	（侧壁蚀刻）工艺环节的生产方式，使晶圆整体均匀度得到有效提升； 4、自主设计硅化钴工艺流程，有效减少晶圆缺陷，提高阻值稳定性； 5、自主设计浅沟道制程工艺流程，改善提升核心电压的 MOS 元件特性。
		110nm 高阶显示驱动芯片平台	在目前 110nm 制程节点的显示驱动芯片市场中，部分客户对产品的性能、布局面积大小等指标有更加严格的需求，这对晶圆代工企业的技术平台和生产能力提出了更高的要求。为进一步满足这类客户的进阶需求，发行人在 110nm 显示驱动芯片平台的基础上，进一步优化工艺流程，自主设计全新的工艺结构，采用低漏电元件技术，新增 P 型深阱隔离的独特设计，大幅缩减后段层次的设计规则，创新使用铝制程工艺技术，并充分优化曝光流程，减少曝光次数，在提升性能的同时，有效地缩小了布局面积，降低了生产环节的复杂度，进而形成了发行人现有的 110nm 高阶显示驱动芯片平台。	1、采用低漏电元件技术，有效提高元件工作效率；新增 P 型深阱隔离的独特设计，提升器件的隔离特性； 2、大幅缩减后段层次的设计规则，创新使用铝制程工艺技术，对金属层进行了 90% 的尺寸微缩，降低后段金属绕线电阻；充分简化曝光流程，减少一次曝光工艺，有效地缩小了布局面积，降低了生产环节的复杂度和生产成本，在满足客户进阶需求的同时，提升工艺平台的质量和性价比。
		150nm 显示驱动芯片平台	发行人通过与力晶科技签订技术转让协议，导入 150nm 显示驱动芯片相关技术，然而，随着电视、电脑等产品显示屏清晰度的提升，特别是 4K/8K 电视显示屏以及中尺寸电脑显示屏，对显示驱动芯片的性能提出了更高、更多元化的需求，仅依靠力晶导入的相关技术无法满足市场对 150nm 显示驱动芯片提出的更高的要求。因此，发行人独立自主地对工艺流程进行了优化，自主设计全新的元件构造，使技术平台能够提供更加多元化的核心组件电压以及输入输出电压，有效提高性能，使之能够用于高阶 4K/8K 电视显示屏以及中尺寸电脑显示屏等领域，进而形成了发行人的 150nm 显示驱动芯片平台，根据电压特性的不同，该平台可以应用于 3.3_18V、1.8_18V、3.3_13.5V 三个领域。	可以根据客户需求，提供多种核心组件电压以及输入/输出电压半导体晶圆代工服务，使之能够应用在高阶 4K/8K 电视显示屏以及中尺寸电脑显示屏等多个领域，应用更加多元化。
2	LED 显示驱动	110nmLED 显示驱动芯片平台	为拓展工艺平台种类，提升公司的技术水平和市场竞争力，发行人充分总结和利用其在 110nm LCD 显示驱动的元件设计和研发经验，独立开展 110nm LED 显示驱动芯片平台的技术研发，自主设	利用自主设计的中压器件与低压器件，减少器件离子注入，减少生产过程中的光罩数量；缩减后段层次设计规则，缩小后端金属制程工艺，使布

序号	产品应用领域类别	技术平台	核心技术的形成过程	技术先进性的具体表征
			计了适用于 110nm LED 显示驱动芯片的低压器件与中压器件，有效降低了器件的离子注入，减少了生产所需的光罩数量，并通过缩减后段层次设计规则，在保证性能的前提下，简化生产流程，满足客户的相关需求，进而形成了发行人的 110nm LED 显示驱动芯片平台。	局面积和后段金属绕线电阻得到有效降低，在保证性能的条件下，有效提升了性价比，充分满足客户的相关需求。
		110nmLED 驱动芯片平台	随着 LED 显示技术的普及与发展，市场对高性能 Mini LED 产品的需求显现，如何低成本地提供具有高性能的 Mini LED 技术平台，成为晶圆代工企业的重要发展方向之一。为满足市场对高性能 Mini LED 的晶圆代工需求，发行人在其 110nmLED 显示驱动芯片平台的基础上，独立自主地对工艺流程进行了优化，引入 120A Gate 氧化膜中压（5V）元件，降低中压栅氧厚度和工艺，进一步缩小后端金属制程工艺，降低后段金属绕线电阻，有效提升了性能和稳定性，进而形成了发行人的 110nmLED 驱动芯片平台。	1、通过提供 120A Gate 氧化膜中压（5V）元件，有效提升性能表现； 2、通过缩小后端金属制程工艺，降低后段金属绕线电阻，缩小了布局面积，提升了性价比。
3	CIS	90nmCMOS 图像传感器平台	由于国内图像传感器领域知名企业思特威对 90nm CMOS 图像传感器晶圆代工服务存在需求，发行人自 2020 年开始与思特威合作开发 CMOS 图像传感器工艺平台。发行人充分总结和利用其在 90nm 和 150nm 显示驱动领域的技术能力和研发经验，以其低压技术、感光元件、像素 IP 等技术为基础，设计了一套 CIS 特有的工艺，并通过持续的工艺结构设计、制程优化、工艺流程改进，精简光罩层数，在提升性能、质量和稳定性的同时，降低成本，开发出的 1.2V/3.3V 90nm FSI 前照式图像传感器工艺平台可以满足思特威对 90nm CMOS 图像传感器晶圆代工服务的需求，进而形成发行人的 90nm CMOS 图像传感器平台。	1、设计了一套 CIS 特有的工艺，有效避免了像素损伤，降低了金属离子污染，使关键特性像素白点和噪声问题降至较低水平，性能表现达到主流水平； 2、通过优化设计方案，改进工艺制程，使光罩层数得以精简，降低生产成本，提高性价比。
4	E-tag	110nm 中高阶电子标签驱动芯片平台	E-tag 作为高压器件，部分客户对 40V 高压制程的电子标签存在需求。为满足客户需求，拓展工艺平台种类，提升公司的技术水平和市场竞争力，发行人充分利用已有的 110nm 制程节点领域的相关技术和研发经验，针对现有元件耐高压能力不足的问题，自主研发了 40V FDMOS 元件，满足客户对 E-tag 的相关需求，进而形成发行人的 110nm 中高阶电子标签驱动芯片平台。	自主研发的 40V FDMOS 元件实现了稳定的 40V 高压工作，和 DDDMOS 元件架构相比，在耐高压能力方面有了较为明显的提升。
5	MCU	新一代 110nm	MCU 被广泛应用于工业、家电、消费电子等领域，具有较为广泛	1、独立开发的 5V MTP 与 3.3V MTP 具有数据

序号	产品应用领域类别	技术平台	核心技术的形成过程	技术先进性的具体表征
		加强型微控制器平台	的应用，市场对高性能、低成本的 MCU 产品存在一定的需求。为满足客户需求，拓展工艺平台种类，提升公司的技术水平和市场竞争力，发行人充分利用已有的 110nm 制程节点领域的相关技术和研发经验，独立开发了 5V MTP（非易失可多次编程存储器）与 3.3V MTP，有效提升性能，并在保证性能的前提下，优化工艺流程，精简光罩层数，降低生产成本，进而形成发行人的新一代 110nm 加强型微控制器平台。	可擦写次数高、数据保存时间长、数据读写速度快等优势； 2、优化工艺流程，精简光罩层数，降低生产成本，具备成本优势，提升性价比。
6	PMIC	150nm PMIC 手机高压电源管理芯片技术平台	市场对手机电源管理芯片存在需求，发行人结合公司自身在 110nm、150nm 制程平台的技术基础和金属极板电容设计，制定了行之有效的工艺流程，满足了客户对于芯片效能的需求,进而形成了发行人的 150nm PMIC 手机高压电源管理芯片技术平台。	1、通过提供超薄栅极氧化膜中压元件，有效提升性能表现； 2、可依据客户需求，提供多种后段金属层工艺，产品应用更多元化。

## 5、力晶科技在发行人技术发展过程中的作用

2015年，力晶科技依据技术转让协议，将驱动芯片代工相关的90纳米、110纳米、150纳米工艺制程的基础技术文件及规格文件提供给发行人，为发行人后续技术开发奠定了基础。根据发行人与力晶科技的《技术移转完成证明书》，力晶科技于2018年3月31日已完成技转。

2018年，发行人同力晶科技签订了《90nm项目技术协议》，导入90nm M+技术平台，该技术虽然可以用于部分90nm工艺的生产，但无法直接用于触控与显示驱动整合芯片晶圆代工，发行人参考联咏科技对触控与显示驱动整合芯片晶圆代工服务的需求，在导入技术的基础上，对90nm晶圆代工平台进行了独立研发，改造工艺流程，新增自主研发的水平双极电晶体元件设计，打造全新高压元件架构，自主设计栅极制程，以铝金属制程加厚达到铜制程效能，从而满足触控与显示驱动整合芯片晶圆代工的技术指标要求，有效提升了质量与性价比，进而形成了发行人的90nm触控与显示驱动整合芯片平台。

同时，为使发行人的晶圆代工业务顺利运行，在发行人营运初期，力晶科技在工艺技术及生产制造等方面对发行人进行了人员培训。力晶科技在入股晶合集成后，还向其内部员工告知在中国大陆合资设立公司的信息，部分员工考虑到更好的职业发展空间，从力晶科技离职并加入晶合集成，该等员工自力晶科技离职后与力晶科技及下属公司不再存在劳动关系、雇佣关系或其他受力晶科技管控的关系。

除此之外，力晶科技未在发行人技术发展过程中发挥作用。

### （二）科研实力和成果情况

#### 1、承担的重大科研项目

截至2022年12月31日，公司已承担以下项目的研发工作，具体情况如下：

序号	项目（课题）名称	项目类别	主管单位	项目执行期	财政预算	报告期内收到的政府补助金额（万元）	计入报告期损益金额（万元）
1	高集成度 CMOS 图像传感器设计与制造关键技术研发	省级	安徽省科技厅	2020/10-2023/9	1,800.00	1,800.00	-
2	110nmMCU 项目	省级	安徽省发改委	2018/1-2020/11	1,023.00	1,023.00	712.49

注：上表“高集成度 CMOS 图像传感器设计与制造关键技术研发”项目收到的政府补助 1,800.00

万元，为政府支付给发行人和合作方的合计金额

## 2、核心学术期刊论文发表情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司核心技术人员在集成电路相关重要学会及主要期刊上发表的主要论文情况如下：

序号	论文名称	会议/期刊名称	作者	发表时间
1	High Endurance Phase Change Memory Chip Implemented based on Carbon-doped Ge <sub>2</sub> Sb <sub>2</sub> Te <sub>5</sub> in 40 nm Node for Embedded Application	IEEE	Z. T. Song D. L. Cai X. Li L. Wang Y. F. ChenH. P. Chen Q. Wang Y. P. Zhan (詹奕鹏) M. H. Ji	2018
2	A 40-nm 16-Mb Contact-Programming Mask ROM Using Dual Trench Isolation Diode Bitcell	IEEE	Yong Ye Yong Kang Chao Zhang Yipeng Chan (詹奕鹏) Hanming Wu Shiuhwu Lee Zhitang Song Bomy Chen	2016
3	Failure Analysis of Nitrogen-Doped Ge <sub>2</sub> Sb <sub>2</sub> Te <sub>5</sub> Phase Change Memory	IEEE	Dan Gao Bo Liu Zhen Xu Ying Li Lei Wang Zhitang Song Nanfei Zhu Yipeng Zhan (詹奕鹏) Songlin Feng	2016

### （三）研发项目

#### 1、在研项目

截至报告期末，发行人在从事的研发项目包括在现有的已实现量产的核心技术平台基础上进一步提升产品良率，以及进行更先进制程技术平台的研发，该等主要在研项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	产品应用领域类别	研发项目名称	研发目标	研发进度	研发模式	参与研发人员	预计经费投入
1	逻辑平台	28nm 高效能精简型芯片工艺平台	①完成 28nm 0.9V/1.8V/2.5V 元件开发 ②完成金属栅极工艺开发	技术开发阶段	自主研发	发行人研发团队	247,392.00
		55nm 铜制程研发	①完成 55nm 1.2V/2.5V 元件开发 ②提供 SRAM 的硅智财供客户设计使用 ③完成 55nm 铜制程开发，优化器件性能，提高集成度	工艺制程验证阶段	自主研发	发行人研发团队	152,460.00
2	显示驱动	40nm OLED 芯片工艺平台	①完成 40nm 1.1V/8V/32V 元件开发 ②提供业界最小的 SRAM 规格	技术开发阶段	自主研发	发行人研发团队	130,217.30
		55nm OLED 显示驱动芯片技术平台（55HVA）	①完成 55nm 1.2V/8V/32V 元件开发 ②提供手机 OLED/OLED NB/OLED Tablet/车载用显示驱动芯片	工艺制程验证阶段	自主研发	发行人研发团队	3,400.00
		110nm 车载显示驱动芯片技术平台	①在 110nm 1.5V/6V/32V 器件工艺基础上，开发耐击穿电压的器件 ②在现有标准 CMOS 工艺基础上，提高操作电压 ③确保工艺制程满足 IATF16949 Grade1 质量要求	工艺制程验证阶段	自主研发	发行人研发团队	2,469.40
		145nm 低功耗高速显示驱动平台	①完成 145nm 1.8V/18V 元件开发； ②优化整合不同工艺层，减少工艺层所需的光罩、降低成本 ③在保证组件性能的基础上，提高单	工艺制程验证阶段	自主研发	发行人研发团队	2,800.00

序号	产品应用领域类别	研发项目名称	研发目标	研发进度	研发模式	参与研发人员	预计经费投入
			位面积的组件数量，使产品性价比更高				
		150nm 大尺寸面板显示驱动芯片技术平台	①完成 1.8/13.5V 元件开发 ②在标准 CMOS 工艺基础上，以湿法生长氧化层的方式形成低压与高压的器件，节约成本，节省工艺时间	技术开发阶段	自主研发	发行人研发团队	1,600.00
3	CIS	55nm CMOS 后照度图像传感器平台 (55BSI)	①于 55nm 平台上加入后照度感光元件开发，提供最小像素尺寸及最高解析度的高阶后照度图像传感器 ②完成后照度后段研磨制程工艺	工艺制程验证阶段	自主研发	发行人研发团队	19,500.00
		90nm CMOS 前照度图像传感器技术平台 (90FSI)	② 完成自有像素 IP 开发 ②90nm 节点下元件 (1.32V/3.3V) 开发 ③90nm CMOS 图像传感器 FSI (前置照度) 技术 ④与客户合作于 90nm 平台上加入感光元件，并调整流片程序以满足客户规格需求	工艺制程验证阶段	合作开发	发行人与合作方团队共同研发	2,800.00
4	MCU	110nm 微控制器平台 (110LP/eflash)	①完成 110nm 1.5V/5V 电微控制器开发； ②通过改善 1.5V 低压元件，使得芯片效能提升约 20% ③完成 OTP、MTP、eFlash 等多种智慧财产验证	风险量产阶段	自主研发	发行人研发团队	16,043.00
5	PMIC	150nm 高压电源管理芯片技术平台 (150BCDHV)	①基于现有 5V 工艺基础进行开发，结合嵌入电容等被动元件，并进一步优化元件相容性 ②将双极器件和 CMOS 器件同时制作在同一芯片上	工艺制程验证阶段	合作开发	发行人与合作方团队共同研发	6,251.00
		150nm 超高压电源管理芯片技术平台	①开发高效能并满足耐高压与实现功率控制等方面的要求	技术开发阶段	自主研发	发行人研发团队	895.00



序号	产品应用领域类别	研发项目名称	研发目标	研发进度	研发模式	参与研发人员	预计经费投入
			②超高电压 BCD 工艺把将双极器件和 CMOS 器件同时制作在同一芯片上				
		150nm 通用 PMIC 电源管理芯片技术平台	①高压器件达到低导通电阻 ②完成核心元器件、I/O 元件以及电源管理关键元件开发 ③耐压达成业界标准，并通过可靠度测试	工艺制程验证阶段	自主研发	发行人研发团队	5,372.40
		110 纳米高压电源管理芯片技术平台 (110BCD)	①平台亦可搭载 OTP (一次性可编程)、MTP (多次性可编程)、eFlash (嵌入式非挥发性记忆体) 等多种智慧财产，极大丰富平台产品用途 ②平台提供多种高压供客户选择，兼容性更强	工艺制程验证阶段	自主研发	发行人研发团队	1,869.40
		90nm BCD 电源管理芯片技术平台	平台开发高效横向扩散金属氧化物半导体，满足功率控制要求，以及多种嵌入式储存元件，极大丰富平台产品用途	技术开发阶段	自主研发	发行人研发团队	2,820.00
6	功率半导体	沟槽式功率半导体技术平台	完成沟槽式半导体器件开发	工艺制程验证阶段	自主研发	发行人研发团队	1,289.40
7	光罩	光罩研发项目	完成半导体晶圆代工所需的光罩制造开发	技术开发阶段	自主研发	发行人研发团队	80,400.00

#### （四）合作研发情况

截至报告期末，发行人正在从事的合作研发项目具体情况如下：

序号	合作方	合作内容	研发成果归属	合作期间	保密措施
1	合肥海图微电子有限公司	高集成度 CMOS 图像传感器设计与制造关键技术研发	项目执行过程中产生的知识产权，与制程技术、PDK 相关的知识产权归属于晶合集成，与产品设计相关的知识产权归属于海图微电子，后续基于项目所开发、修改、增进、改良、衍生或更新的相关设计及技术成果的知识产权和相应权益为各自独有	2020/10/1-2023/9/30	签署保密协议
2	杰华特微电子（杭州）有限公司	150nm 高压/超高压电源管理芯片技术平台	杰华特享有优先在发行人工艺线上联合开发 BCD 产品，杰华特拥有项目工艺技术的独家使用权，发行人对杰华特在本项目的器件结构、工艺流程及子流程等工艺技术严格保密，在独家使用权期间不得将此揭露、应用于其他方，不得对外直接、间接变相公开、转让	2020/11/01-2027/06/29	签署保密协议
3	思特威（上海）电子科技有限公司	90 纳米 CMOS 后照度图像传感器平台（90BSI）	双方合作期间涉及的各类知识产权，如果属于一方独立开发或拥有的，则该部分知识产权始终为一方所专有，另一方如需使用该部分知识产权应当事先征得一方的书面同意或授权	2020/3/20-2025/12/31	签署保密协议
4	合作方一	150nm BCD 电源管理芯片技术平台	双方合作期间合作开发的技术和相关的信息参数仅适用于双方合作的项目，任何其他第三方使用需要经合作方一同意	2021/3/18-2024/3/17	签署保密协议

##### 1、高集成度CMOS图像传感器设计与制造关键技术研发项目

2021年1月16日，发行人与合肥海图微电子有限公司（以下简称“海图微电子”）签署《高集成度CMOS图像传感器设计与制造关键技术研发战略合作框架协议》，并于2021年4月签署补充协议，相关协议主要内容如下：

项目	主要内容
合作内容	<p>1、海图微电子将规划设计的产品交由晶合集成代工生产，并提供 IP 及其工艺技术和电路设计文件，在生产过程中需要积极配合发行人进行工艺调整和优化，最终目标达成具备规模量产的能力；</p> <p>2、发行人负责提供逻辑平台技术开发和制造工艺流程，并运用海图微电子按本项目规划设计的产品及提供的 IP 和工艺技术生产芯片样片；</p> <p>3、项目执行过程中产生的知识产权，与制程技术、PDK 相关的知识产权归属于晶合集成，与产品设计相关的知识产权归属于海图微电子，后续基于项目所开发、修</p>

项目	主要内容
	改、增进、改良、衍生或更新的相关设计及技术成果的知识产权和相应权益为各自独有。
保密约定	双方对保密内容负有保密责任

## 2、150nm高压/超高压电源管理芯片技术平台项目

2020年11月1日，发行人与杰华特微电子（杭州）有限公司（以下简称“杰华特”）签署《电源管理芯片技术开发合同》，主要内容如下：

项目	合同主要内容
合作内容	1、双方在发行人工厂工艺线上联合开发，杰华特需成立联合开发团队与发行人专案合作，在技术开发和产品导入完成后，后续基于新的产品市场规划，适时进一步启动更先进技术之合作开发； 2、发行人提供有关制程能力参数及其相关的基础工艺模块的信息，并为联合设计开发的工艺技术、工艺流程及子流程提供相关技术支持及资源投入，为量产产品的产能支持； 3、杰华特享有优先在发行人工艺线上联合开发 BCD 产品，杰华特拥有项目工艺技术的独家使用权，发行人对杰华特在本项目的器件结构、工艺流程及子流程等工艺技术严格保密，在独家使用权期间不得将此揭露、应用于其他方，不得对外直接、间接变相公开、转让。
保密约定	双方对保密内容负有保密责任

## 3、90纳米CMOS后照度图像传感器平台（90BSI）

2020年3月20日，发行人与思特威（上海）电子科技有限公司（以下简称“思特威”）签署《合作框架协议》，并于2020年4月2日及2020年9月1日签署补充协议，主要内容如下：

项目	合同主要条款
合作内容	1、双方合作开发具有行业竞争力的产品，同时思特威规划在合作范围内产品委托给晶合集成生产，支付合作开发订金和产能订金，晶合集成需要在约定时间内，保障思特威的产能需求等； 2、双方合作期间涉及的各类知识产权，如果属于一方独立开发或拥有的，则该部分知识产权始终为一方所专有，另一方如需使用该部分知识产权应当事先征得一方的书面同意或授权。
保密约定	双方对保密内容负有保密责任

## 4、150nm BCD 电源管理芯片技术平台

2021年3月18日，发行人与合作方一签署《战略合作框架协议》，主要内容如下：

项目	合同主要条款
合作内容	1、双方基于合作共赢、共同发展的原则，积极协调各自资源，成立联合工作小组统筹双方合作开发具有行业竞争力的产品； 2、发行人在保证品质的情况下，基于合作方一订单需求，优先及时供应其需求的产能；合作方一将在发行人工艺早期阶段，优先并及时启动项目开发和量产； 3、合作开发的技术和相关信息参数仅适用于双方合作的项目，任何其他第三方使用需经合作方一同意。
保密约定	双方对保密内容负有保密责任

## （五）研发投入情况

报告期各期，发行人研发费用分别为 24,467.56 万元及 39,668.49 万元、85,707.00 万元，占营业收入比重分别为 16.18%、7.31%及 8.53%。

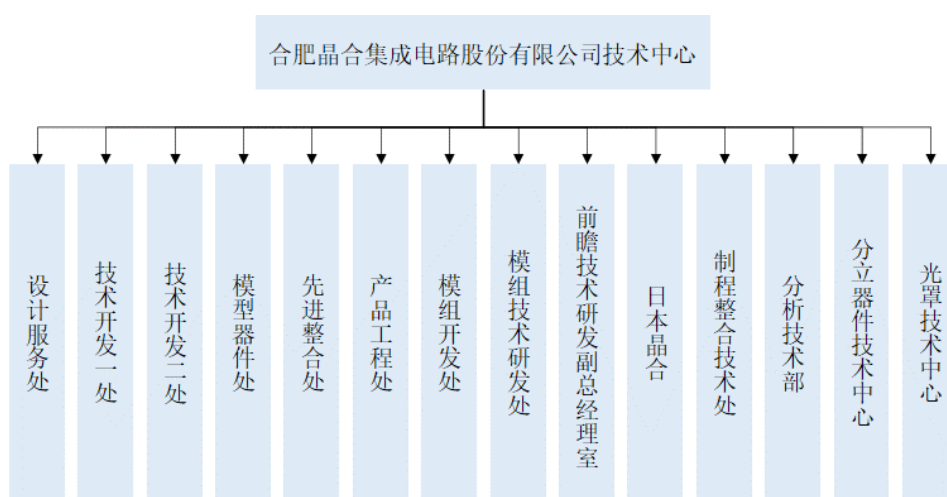
单位：万元

项目	2022 年	2021 年	2020 年
研发费用	85,707.00	39,668.49	24,467.56
营业收入	1,005,094.86	542,900.93	151,237.05
研发费用占营业收入比重	8.53%	7.31%	16.18%

## （六）研发机构及研发人员情况

### 1、研发机构的设置及职能

发行人研发机构组织结构图如下：



公司研发相关职能部门的工作职责及主要研发方向如下：

部门	工作职责/研发方向
设计服务处	负责公司与客户及光罩公司间流片相关事项，并向芯片设计企业提供 IP 服务支持
技术开发一处	主要负责研发显示驱动芯片工艺制程，根据客户需求与公司拓展方向，改良提升公司制程，扩大产品应用范围，进行产品流片及良率提升，最终实现量产
技术开发二处	主要负责 55nm 至 180nm 制程节点的 CIS,MCU, PMIC 等产品开发, 根据客户需求, 改良提升公司制程, 扩大产品应用范围, 进行产品流片及良率提升, 最终实现量产
模型器件处	提供芯片设计公司所需的相关技术文件库, 包含器件模型库 (仿真电路模拟器模型 (SPICE Model)), 完整的工艺设计包 (工艺设计工具包 (PDK))。负责半导体器件开发阶段的各项测试及验证工作, 包括半导体器件及工艺前沿建模流程, 器件开发及标准化特性表征方法, 工艺设计包的优化完善等
先进整合处	建立及验证新工艺平台,包括场效应管 (MOS), 射频 (RF), 双极型-互补金属氧化半导体-双扩散金属氧化半导体 (BCD), 闪存 (Flash) 等
产品工程处	主要针对驱动芯片 (Driver IC), 微控制器 (MCU), CMOS 图像传感器 (CIS), 电源管理芯片 (PMIC) 平台的技术检验装置 (TQV), 智慧财产权 (IP) 进行测试验证并提供测试分析方案, 解析平台 TQV 及量产产品失效分析, 提供良率提升方案
模组开发处	提供平台与产品所需的相关技术工艺条件。为各平台与产品, 如高压 (HV), CIS, PMIC 等, 设计出最佳化的工艺设备、流程和条件, 及优化成本等, 并协助产品开发以达成量产条件
模组技术研发处	导入先进工艺所需新机台设备, 开发相应的技术与材料, 对现有工艺、现有机台参数及生产程序进行优化, 达到未来及现有产品量产良率标准, 使工艺成本具有竞争力
前瞻技术研发副总经理室	主要负责开发先进制程与内嵌特殊器件 (Embedded Devices) 的开发, 提供不同的制程优化与解决方案、标准化工艺平台, 满足多元化的客户需求
日本晶合	负责 PDK 文件协同设计, 元件特性验证, TCAD (工艺及器件模拟) 服务, TEG (测试键) 设计服务
制程整合技术处	针对成熟技术节点产品进行新产品开发及整体电性、良率的提升与改善
分析技术部	主要负责开发阶段的制程工艺结构物性与化性分析及产品性能失效电性分析与建立失效模式, 并反馈分析结果给相关研发与工程单位进行制程工艺与产品良率的优化改善
分立器件技术中心	主要负责分立与功率器件产品开发、公司与客户流片相关事项; 协同技术开发及模组开发等单位合作, 标准化工艺平台, 以满足客户需求
光罩技术中心	主要负责芯片生产所需要的光罩制作及先进制程光罩开发的服务, 缩短光罩交期, 提高公司芯片代工的竞争力

## 2、研发机构认证情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司研发机构被各级政府授予三项资质, 具体情况如下:

序号	研发机构	授予资质	级别	认定/授予单位
1	合肥晶合集成电路股份有限公司技术中心	安徽省企业技术中心	省级	安徽省经济和信息化厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省科学技术厅 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局

序号	研发机构	授予资质	级别	认定/授予单位
				中华人民共和国合肥海关
2	合肥晶合 N1 先进晶圆代工智能工厂	安徽省智能工厂	省级	安徽省经济和信息化厅
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	高新技术企业	-	安徽省科学技术厅 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局

### 3、核心技术人员及研发团队情况

#### (1) 研发人员数量情况

报告期各期，发行人研发人员数量及占公司员工总数的比例情况如下：

项目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
员工总数（人）	4,224	2,720	1,666
研发人员人数（人）	1,388	480	280
研发人员占员工总数的比例	32.86%	17.65%	16.81%

#### (2) 核心技术人员情况

公司核心技术人员共有 5 名，分别为蔡辉嘉（总经理）、詹奕鹏（副总经理）、邱显寰（副总经理）、张伟瑾（N1 厂厂长）、李庆民（协理兼技术开发二处处长）。具体情况参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

上述核心技术人员的学历背景、重要科研成果、获得奖项情况及对公司研发的具体贡献如下：

蔡辉嘉毕业于中国台湾清华大学，拥有化学学士学位，加入发行人后，历任发行人营运副总经理、执行副总经理、总经理。蔡辉嘉负责发行人技术研发、产品制造战略的制定，确定发行人技术路线，协助组建发行人核心技术团队，整体负责发行人 N1、二期厂建设工作。加入发行人前，蔡辉嘉曾任华隆微电子股份有限公司工程师、力晶科技工程师、厂长、协理。蔡辉嘉带领公司实现了 DDIC、CIS 等技术工艺平台的产能扩张。

詹奕鹏先生毕业于中国台湾大学，拥有物理学学士学位，电机所固态电子组硕士。

加入发行人后，担任副总经理，负责全公司自主工艺平台开发，同时管理设计服务处，模型器件处，产品工程处，日本晶合，上海分公司等工程支援单位。詹奕鹏作为发明人参与了发行人数量已注册或申请中的专利技术研发工作，包括“SRAM 器件及其形成方法”“半导体器件的制备方法”“一种反熔丝电路”等，作为共同作者在 IEEE（国际电气与电子工程师学会）发表数篇论文。在加入发行人前，詹奕鹏曾在联华电子、中芯国际、中科院上海微系统所任职，均负责技术研发相关工作。詹奕鹏目前主要负责发行人 55nm 逻辑制程、DDIC、MCU、CIS、PMIC 技术平台开发工作，协助发行人在上述差异化工艺平台上进一步取得技术优势。

邱显寰先生毕业于中国台湾成功大学，拥有控制与导航硕士学位。加入发行人后，历任发行人 N1 厂厂长、营运副总经理室协理、副总经理。邱显寰先生负责发行人建厂、流片、量产到产能拉升等重要环节，在其带领下，发行人 2020 年底产能达到 3 万片每月，原物料本土化比率达到 60%，国产化刻蚀、化学气相沉积设备导入量产，N1 厂取得了“合肥市智能工厂”认证。加入发行人前，邱显寰先生曾于力晶科技、瑞晶电子股份有限公司、美光任职，负责技术开发、良率改善及厂线建设工作。

张伟瑾先生毕业于中国台湾海洋大学，拥有学士学位。加入发行人后，历任发行人制造部经理、N1 厂厂长。张伟瑾负责发行人 N1 厂的整体建设并管理黄光、蚀刻、薄膜、扩散、化学机械研磨、工厂自动化等相关部门约 1,000 名员工。带领发行人进行产能爬坡工作，并完成“智能实时派工”“产品交期改善”相关课题，协助发行人 N1 厂取得“合肥市企业技术中心”认证，并负责搭建二期厂产线。加入发行人前，张伟瑾曾任职于力晶科技、美光，负责集成电路制造工作。

李庆民先生毕业于中国台湾清华大学，拥有物理学学士、应用物理学硕士学位。加入发行人后，担任协理兼技术开发二处处长，协助发行人改进开发了 150nm、110nm、90nm 制程技术，改进了 DDIC、E-TAG 等技术平台工艺，扩展公司产品种类。李庆民作为发明人参与了发行人二十余项已注册或正在申请中的专利技术研发工作，包括“一种存储器及其制造方法”“沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法”“扩散型场效应晶体管及其形成方法”等。加入发行人前，李庆民曾在联华电子、力晶科技等公司任职，从事技术研发工作。李庆民协助发行人突破了 DDIC、CIS、LED、MCU 等平台技术瓶颈，对公司技术进步具有突出贡献。

### **(3) 对核心技术人员的约束激励机制**

公司重视对科研人才、核心技术人员的吸纳与留用，通过公平、全面的业绩考核及创新激励机制，将员工个人收入与研发成果相挂钩，提升员工创新能力及积极性并进一步促进公司的研发实力，形成良性循环。公司一方面对员工注册知识产权进行直接奖励，另一方面在专利评审委员会的主导下建立专利保护伞，持续提升公司专利资产的创造、运用、保护和管理能力。

公司的核心技术人员约束激励机制具体包括以下内容：

#### ①研发项目激励

发行人制定《专利管理办法》对员工技术研发进行激励，以增加员工创新热情，形成公司专利保护伞。发行人对员工提出的专利制定了以下奖励措施：

专利申请奖：员工技术发明经公司专利评审会审核通过，向国家知识产权局提交申请并被受理后，申请发明专利颁发奖金 5,000 元，申请实用新型专利颁发奖金 2,000 元；

专利注册奖：发明专利申请案最终形成注册专利的，颁发奖金 10,000 元；实用新型专利或是外观设计专利最终形成注册专利不颁发额外奖金。

#### ②中长期激励

对核心技术人员进行股权激励，加强核心技术人员的稳定性；该等激励计划的情况参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排”。其中：

蔡辉嘉持有合肥晶炯 22.63%的出资额，合肥晶炯持有发行人 0.25%的股份；持有合肥晶煨 2.12%的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35%的股份；

詹奕鹏持有合肥晶煨 14.65%的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35%的股份；

邱显寰持有合肥晶炯 16.86%的出资额，合肥晶炯持有发行人 0.25%的股份；持有合肥晶辽 4.08%的出资额，合肥晶辽持有发行人 0.03%的股份；持有合肥晶雄 3.99%的出资额，合肥晶雄持有发行人 0.02%的股份；持有合肥晶妥 2.08%的出资额，合肥晶妥持有发行人 0.03%的股份；持有合肥晶本 1.73%的出资额，合肥晶本持有发行人 0.05%的股份；

张伟瑾持有合肥晶煨 4.88%的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35%的股份；持有合肥晶辽 2.72%的出资额，合肥晶辽持有发行人 0.03%的股份；持有合肥晶柔 3.92%的



出资额，合肥晶柔持有发行人 0.06% 的股份；

李庆民持有合肥晶煨 3.26% 的出资额，合肥晶煨持有发行人 0.35% 的股份。

目前公司属于成长期，致力于存量技术平台的改进以及先进制程的突破，每年研发费用均维持在较高水平，为核心技术人员提供明确的晋升制度与自主研发平台，为核心技术人员提供良好的研发环境。

### ③约束措施

公司已与核心技术人员签订《保密、竞业限制、知识产权保护及诚信行为协议》，约定核心技术人员的职务作品归属公司，核心技术人员在离职后一年内不得进入与公司有竞争关系的企业合作。该等约束措施具体情况详见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发情况”之“（一）公司的核心技术情况”之“3、核心技术的保护措施”。

## （七）技术创新机制、技术储备及技术创新的安排

### 1、技术创新机制及安排

公司致力于增强晶圆代工领域的工艺实力，并重点关注面板显示驱动芯片相关产品布局。通过吸纳半导体产业科研人才，建立长效激励机制，优化研发生产流程及与硅智财企业、上下游公司合作的模式，整体提升自身技术实力。公司实施的技术创新机制及安排包括以下方面：

#### （1）科研团队建设及选拔机制

深耕人才梯队，全力组建研发队伍，公司为配合客户需求及自身技术发展，制定研发人才战略，利用各种招聘渠道吸引人才竞聘，再透过标准化选拔流程确保人才符合公司发展需求与尊重、当责、追求卓越的企业文化。公司注重人才培养与技术研发，通过培训机制、带教辅导、行业交流等方式，加强科技人才的培养与使用，以核心技术人员为研发带头人，培养和发展出优秀的研发团队。

此外，公司持续加强对于本地人才的培养，通过一系列的培养机制吸引并留住人才，员工中境内人员比例持续增长。

#### （2）公司持续加大研发投入力度

公司未来除高端先进制程开发投资外，在现有制程技术改善，良率提升及产品多

样化等研发活动方面投入研发经费仍会持续维持在较高水平。公司持续推进先进制程开发及多元化产品开发，为技术创新注入源源不断的动力。

### **(3) 年度业绩考核激励**

公司针对核心技术人员订立明确的年度绩效指标及年度考核，依据考核结果进行调薪及各项奖金发放。

## **2、技术储备**

发行人目前已掌握 150nm 至 90nm 多节点制程技术，涵盖 DDIC、CIS、E-TAG、LED-DRIVER 等特色工艺平台，并向行业内多家知名设计公司提供代工服务。

发行人重视技术创新与先进工艺研发，建立了完善的研发创新体系，在研发平台、研发团队、技术体系等方面形成了较强的优势，以此为依托，并行 55 纳米逻辑芯片平台及 55 纳米触控与显示驱动整合芯片平台开发，预计投入资金达 15.6 亿元人民币。目前平台进展顺利，正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的风险量产。

发行人将在二期厂建设一条产能为 4 万片/月的 12 英寸晶圆代工生产线，主要产品包括面板显示驱动芯片（DDIC）、CMOS 图像传感芯片（CIS），另外，将建设一条微生产线用于 OLED 显示驱动技术开发试产。

发行人本次募集资金也将用于合肥晶合集成电路先进工艺研发项目，主要包括后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目、微控制器芯片工艺平台研发项目、40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目、28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目，具体详见本招股意向书“第七节 募集资金运用及未来发展规划”。

## **七、环保情况**

### **(一) 公司生产经营中涉及的主要环境污染物**

发行人、新晶集成生产经营过程中将产生一定量的废水、废气、危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾、噪音。废水主要包括酸碱废水、含氨废水、含氟废水、研磨废水、有机废水、含铜废水等；废气主要包括酸性废气、碱性废气、有机废气、含砷废气、废水站废气、锅炉废气等；危险废物主要包括化学品废液、废化学品容器、废矿物油、废化学品沾染物等；一般固体废弃物主要包括废污泥、硫酸铵结晶和其他资

源回收类等；生活垃圾主要包括食材包装盒袋、饮料空瓶空罐、清洁废纸等；噪音来源主要为生产设备运转振动等。

## （二）主要环境污染物处理设施及处理能力

截至 2022 年 12 月 31 日，北京晶芯成、南京晶驱、日本晶合、上海晶合未从事具体产品生产。

发行人、新品集成对于主要环境污染物的处理设施及处理能力具体情况如下：

处理设备名称	数量（套）	主要用途	处理能力	运行情况
污水处理站-酸碱废水处理系统	1	处理酸碱废水	7,200 吨/天	正常
污水处理站-含氨废水处理系统	2	处理含氨废水	720 吨/天/套	正常
污水处理站-含氟废水处理系统	2	处理含氟废水	2,400 吨/天或 1,440 吨/天	正常
污水处理站-研磨废水处理系统	1	处理研磨废水	960 吨/天	正常
污水处理站-有机废水处理系统	2	处理有机废水	480 吨/天/套	正常
污水处理站-含铜废水处理系统	1	处理含铜废水	720 吨/天	正常
酸性废气处理设施（44m 排气筒）	14	处理酸性废气	78,000m <sup>3</sup> /h/套或 82,000m <sup>3</sup> /h/套	正常
碱性废气处理设施（44m 排气筒）	7	处理碱性废气	27,000m <sup>3</sup> /h/套或 45,000m <sup>3</sup> /h/套	正常
沸石浓缩转轮、RTO 蓄热燃烧炉（44m 排气筒）	6	处理有机废气	60,000m <sup>3</sup> /h/套或 50,000m <sup>3</sup> /h/套	正常
含砷废气处理吸附塔（44m 排气筒）	2	处理含砷废气	3,000m <sup>3</sup> /h/套	正常
两级酸洗喷淋塔+水喷淋塔（19m 排气筒）	2	处理废水站废气	30,000m <sup>3</sup> /h+9,000 m <sup>3</sup> /h	正常
锅炉低氮燃烧器（35m 排气筒）	4	处理锅炉废气	4589 m <sup>3</sup> /h*2 +2295 m <sup>3</sup> /h+4,015 m <sup>3</sup> /h	正常

## 八、公司境外经营情况

截至本招股意向书签署之日，发行人拥有一家境外全资子公司，具体情况请参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股、参股公司、分公司情况”之“（一）日本晶合”。

## 第六节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据及有关说明反映了公司报告期内经审计财务报表及附注的主要内容。本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0133号）及经审计的财务报告，或根据其中相关数据计算得出，并按合并口径披露。

公司提醒投资者，除阅读本章节内容外，需阅读财务报表及审计报告全文以获取完整财务信息。

### 一、财务报表

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,894,596,939.63	5,295,545,868.35	4,464,381,227.31
交易性金融资产	1,257,160,004.54	-	-
应收账款	506,672,375.18	948,852,726.93	265,220,095.91
预付款项	63,208,824.65	196,720,691.77	9,706,755.36
其他应收款	17,739,474.04	14,785,197.95	4,609,964.89
存货	1,021,653,220.98	787,005,501.09	385,794,196.11
其他流动资产	77,468,389.15	97,055,820.71	56,060,782.98
<b>流动资产合计</b>	<b>10,838,499,228.17</b>	<b>7,339,965,806.80</b>	<b>5,185,773,022.56</b>
非流动资产：			
其他权益工具投资	29,107,294.40	-	-
其他非流动金融资产	301,733,208.33	-	-
固定资产	21,437,368,245.69	16,325,987,525.29	7,766,077,816.88
在建工程	1,385,043,636.61	3,329,058,296.25	1,390,705,017.22
使用权资产	2,866,058,896.16	2,994,810,870.03	-
无形资产	1,433,922,798.57	1,254,226,706.08	1,299,486,368.12

资产	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
长期待摊费用	337,979.60	587,251.28	-
其他非流动资产	472,503,254.43	27,638,224.88	290,167.48
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,926,075,313.79</b>	<b>23,932,308,873.81</b>	<b>10,456,559,369.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>38,764,574,541.96</b>	<b>31,272,274,680.61</b>	<b>15,642,332,392.26</b>
流动负债：			
短期借款	287,073,782.03	2,512,384,284.94	-
应付账款	926,245,358.53	2,487,629,756.02	1,113,785,875.49
预收款项	-	-	-
合同负债	832,694,391.05	1,335,767,714.78	66,591,986.84
应付职工薪酬	368,249,010.83	185,234,288.25	12,773,286.36
应交税费	69,591,698.08	32,729,574.00	15,761,624.12
其他应付款	5,937,693,608.38	5,773,175,260.38	177,912,669.08
一年内到期的非流动负债	710,855,709.18	654,101,544.80	186,218,643.30
其他流动负债	78,944,030.61	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>9,211,347,588.69</b>	<b>12,981,022,423.17</b>	<b>1,573,044,085.19</b>
非流动负债：			
长期借款	8,226,871,870.98	5,176,859,123.84	4,848,790,724.81
租赁负债	1,965,003,454.76	2,088,844,422.38	-
长期应付款	-	-	929,312,245.46
长期应付职工薪酬	39,966,996.45	26,306,395.67	11,393,747.76
预计负债	-	847,053.42	2,748,659.56
递延收益	1,271,422,272.68	1,109,705,327.24	1,119,108,660.15
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,503,264,594.87</b>	<b>8,402,562,322.55</b>	<b>6,911,354,037.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,714,612,183.56</b>	<b>21,383,584,745.72</b>	<b>8,484,398,122.93</b>
所有者权益：			
股本（实收资本）	1,504,601,368.00	1,504,601,368.00	1,504,601,368.00
资本公积	11,209,073,499.23	10,358,077,394.18	10,021,448,833.46
其他综合收益	4,803,486.54	-272,705.48	468,627.68
盈余公积	26,575,971.33	-	-
未分配利润	379,102,268.61	-2,639,752,570.35	-4,368,584,559.81
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>13,124,156,593.71</b>	<b>9,222,653,486.35</b>	<b>7,157,934,269.33</b>
少数股东权益	4,925,805,764.69	666,036,448.54	-

资产	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
所有者权益合计	18,049,962,358.40	9,888,689,934.89	7,157,934,269.33
负债和所有者权益总计	38,764,574,541.96	31,272,274,680.61	15,642,332,392.26

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	10,050,948,608.55	5,429,009,291.12	1,512,370,504.71
其中：营业收入	10,050,948,608.55	5,429,009,291.12	1,512,370,504.71
二、营业总成本	6,715,581,462.55	3,800,289,703.39	2,556,600,384.61
其中：营业成本	5,411,481,665.26	2,978,972,052.02	1,641,908,608.65
税金及附加	23,282,396.83	20,784,021.71	11,305,324.53
销售费用	59,737,022.38	39,687,781.14	19,794,919.01
管理费用	294,924,951.04	242,753,869.12	274,032,797.83
研发费用	857,070,011.90	396,684,911.99	244,675,569.19
财务费用	69,085,415.14	121,407,067.41	364,883,165.40
其中：利息费用	413,864,727.22	285,713,378.40	334,941,761.19
利息收入	77,457,373.16	29,183,209.75	24,277,059.65
加：其他收益	107,897,949.98	90,048,750.26	82,160,583.90
投资收益（损失以“-”号填列）	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,625,879.54	-	-3,265,902.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,829,365.18	-250,094.09	241,830.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-306,613,283.77	-4,886,424.42	-310,267,324.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	2,930.00
三、营业利润	3,142,140,659.85	1,727,230,727.00	-1,262,867,251.73
加：营业外收入	14,348,231.85	8,077,652.66	5,476,116.30
减：营业外支出	84,667.63	6,045,341.22	76,942.48
四、利润总额	3,156,404,224.07	1,729,263,038.44	-1,257,468,077.91
减：所得税费用	207,992.58	431,048.98	128,981.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,156,196,231.49	1,728,831,989.46	-1,257,597,059.28
（一）按经营持续性分类			

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,156,196,231.49	1,728,831,989.46	-1,257,597,059.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,045,430,810.29	1,728,831,989.46	-1,257,597,059.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	110,765,421.20	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>5,076,192.02</b>	<b>-741,333.16</b>	<b>-81,112.27</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,076,192.02	-741,333.16	-81,112.27
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,161,272,423.51</b>	<b>1,728,090,656.30</b>	<b>-1,257,678,171.55</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,050,507,002.31	1,728,090,656.30	-1,257,678,171.55
归属于少数股东的综合收益总额	110,765,421.20	-	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	2.02	1.15	-0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	2.02	1.15	-0.27

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,948,274,620.77	5,949,508,033.83	1,382,969,952.67
收到的税费返还	148,298,619.44	12,856,004.54	12,639,994.47
收到其他与经营活动有关的现金	414,121,997.52	5,831,717,568.82	311,710,478.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,510,695,237.73</b>	<b>11,794,081,607.19</b>	<b>1,707,320,425.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,784,466,288.05	1,405,310,009.95	731,619,617.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,280,438,498.59	694,462,560.71	412,216,889.76
支付的各项税费	28,578,476.18	20,562,349.72	20,710,653.83
支付其他与经营活动有关的现金	137,178,577.52	99,861,680.81	69,944,457.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,230,661,840.34</b>	<b>2,220,196,601.19</b>	<b>1,234,491,618.26</b>
经营活动产生的现金流量净额	6,280,033,397.39	9,573,885,006.00	472,828,807.62

项目	2022年度	2021年度	2020年度
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	2,641,000,000.00	3,771,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	2,930.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,692,333.28</b>	<b>2,654,598,907.52</b>	<b>3,783,493,440.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,890,317,128.25	9,976,702,114.14	4,901,830,363.19
投资支付的现金	1,579,023,949.33	2,641,000,000.00	3,284,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,469,341,077.58</b>	<b>12,617,702,114.14</b>	<b>8,185,830,363.19</b>
投资活动产生的现金流量净额	-8,465,648,744.30	-9,963,103,206.62	-4,402,336,923.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	4,465,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	6,754,041,401.27	5,981,465,128.11	-
收到其他与筹资活动有关的现金	413,549,401.77	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>12,167,590,803.04</b>	<b>6,981,465,128.11</b>	<b>4,465,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	5,806,334,235.50	2,830,595,097.93	116,086,411.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,826,010.16	294,971,073.41	286,198,982.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	718,278,282.70	416,346,775.44	62,352,130.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,844,438,528.36</b>	<b>3,541,912,946.78</b>	<b>464,637,524.79</b>
筹资活动产生的现金流量净额	5,323,152,274.68	3,439,552,181.33	4,000,362,475.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>453,744,625.95</b>	<b>-5,955,308.75</b>	<b>-31,461,347.35</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,591,281,553.72</b>	<b>3,044,378,671.96</b>	<b>39,393,012.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,145,055,816.83	1,100,677,144.87	1,061,284,132.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,736,337,370.55</b>	<b>4,145,055,816.83</b>	<b>1,100,677,144.87</b>



## (二) 母公司财务报表

## 1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,878,771,236.11	4,278,599,053.25	4,460,889,364.41
交易性金融资产	1,257,160,004.54	-	-
应收账款	757,726,323.32	979,359,185.07	265,220,095.91
预付款项	63,190,287.01	196,704,220.78	9,648,020.39
其他应收款	388,150,628.49	4,492,329,048.13	4,164,229.13
存货	893,015,829.52	695,007,102.27	385,794,196.11
其他流动资产	77,075,208.03	96,883,977.97	55,600,738.12
<b>流动资产合计</b>	<b>11,315,089,517.02</b>	<b>10,738,882,587.47</b>	<b>5,181,316,644.07</b>
非流动资产：			
长期股权投资	4,021,127,950.00	4,021,127,950.00	21,127,950.00
其他权益工具投资	29,107,294.40	-	-
其他非流动金融资产	301,733,208.33		
固定资产	9,601,955,391.05	9,853,849,766.12	7,765,520,396.50
在建工程	842,499,850.82	1,404,170,943.89	1,390,705,017.22
使用权资产	2,865,874,890.85	2,994,031,834.55	-
无形资产	1,427,736,640.04	1,247,337,793.78	1,299,480,036.53
长期待摊费用	337,979.60	587,251.28	-
其他非流动资产	466,780,032.25	27,638,224.88	290,167.48
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,557,153,237.34</b>	<b>19,548,743,764.50</b>	<b>10,477,123,567.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>30,872,242,754.36</b>	<b>30,287,626,351.97</b>	<b>15,658,440,211.80</b>
流动负债：			
短期借款	287,073,782.03	2,512,384,284.94	-
应付账款	2,450,608,135.96	2,491,116,848.25	1,116,148,026.85
预收款项	-	-	-
合同负债	832,694,391.05	1,335,767,714.78	66,591,986.84
应付职工薪酬	354,387,576.43	184,258,141.44	11,987,899.50
应交税费	68,136,036.82	30,999,986.24	15,554,671.01
其他应付款	5,937,074,821.34	5,772,857,221.68	177,912,669.08
一年内到期的非流动负债	707,233,782.88	653,483,880.25	186,218,643.30

资产	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
其他流动负债	78,944,030.61	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>10,716,152,557.12</b>	<b>12,980,868,077.58</b>	<b>1,574,413,896.58</b>
非流动负债：			
长期借款	5,079,871,870.98	5,176,859,123.84	4,848,790,724.81
租赁负债	1,965,003,454.76	2,088,709,076.10	-
长期应付款	-	-	929,312,245.46
长期应付职工薪酬	39,966,996.45	26,306,395.67	11,393,747.76
预计负债	-	847,053.42	2,748,659.56
递延收益	1,271,422,272.68	1,109,705,327.24	1,119,108,660.15
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,356,264,594.87</b>	<b>8,402,426,976.27</b>	<b>6,911,354,037.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>19,072,417,151.99</b>	<b>21,383,295,053.85</b>	<b>8,485,767,934.32</b>
所有者权益：			
股本（实收资本）	1,504,601,368.00	1,504,601,368.00	1,504,601,368.00
资本公积	10,024,113,842.72	10,024,113,842.72	10,021,448,833.46
其他综合收益	5,350,678.40	-	-
盈余公积	26,575,971.33	-	-
未分配利润	239,183,741.92	-2,624,383,912.60	-4,353,377,923.98
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,799,825,602.37</b>	<b>8,904,331,298.12</b>	<b>7,172,672,277.48</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>30,872,242,754.36</b>	<b>30,287,626,351.97</b>	<b>15,658,440,211.80</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、营业收入</b>	<b>10,326,152,707.44</b>	<b>5,459,515,749.26</b>	<b>1,512,370,504.71</b>
减：营业成本	6,085,485,834.16	3,009,478,510.16	1,641,908,608.65
税金及附加	19,535,798.60	17,896,353.46	11,295,201.51
销售费用	59,737,022.38	39,687,781.14	19,794,919.01
管理费用	290,402,071.45	241,430,683.09	273,103,121.47
研发费用	808,078,141.17	397,597,702.39	246,181,223.72
财务费用	48,934,076.25	126,027,838.66	364,795,620.77
其中：利息费用	393,668,161.41	285,670,856.86	334,941,761.19
利息收入	72,745,729.67	24,635,171.67	24,276,987.07
加：其他收益	107,897,949.98	90,048,750.26	82,160,583.90
投资收益（损失以“-”	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
”号填列)			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,625,879.54	-	-3,265,902.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,829,255.18	-250,094.09	241,830.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-251,146,507.16	-4,886,424.42	-310,267,324.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	2,930.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,876,220,163.89</b>	<b>1,725,908,019.63</b>	<b>-1,263,345,562.25</b>
加：营业外收入	14,008,129.33	8,057,284.74	5,456,455.85
减：营业外支出	84,667.37	4,971,292.99	76,942.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,890,143,625.85</b>	<b>1,728,994,011.38</b>	<b>-1,257,966,048.75</b>
减：所得税费用	-	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,890,143,625.85</b>	<b>1,728,994,011.38</b>	<b>-1,257,966,048.75</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,890,143,625.85	1,728,994,011.38	-1,257,966,048.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>5,350,678.40</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,895,494,304.25</b>	<b>1,728,994,011.38</b>	<b>-1,257,966,048.75</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	10,002,931,229.66	5,949,508,033.83	1,382,969,952.67
收到的税费返还	148,298,619.44	12,856,004.54	12,639,994.47
收到其他与经营活动有关的现金	408,820,889.06	5,826,621,501.08	311,690,745.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,560,050,738.16</b>	<b>11,788,985,539.45</b>	<b>1,707,300,692.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,940,693,458.99	1,405,047,686.21	730,222,393.79
支付给职工以及为职工支付的现金	1,221,465,169.50	681,367,195.47	400,396,815.48
支付的各项税费	23,853,098.89	18,772,902.76	19,996,859.42
支付其他与经营活动有关的现金	150,367,935.61	112,049,495.86	84,571,799.95

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动现金流出小计	<b>4,336,379,662.99</b>	<b>2,217,237,280.30</b>	<b>1,235,187,868.64</b>
经营活动产生的现金流量净额	6,223,671,075.17	9,571,748,259.15	472,112,824.21
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	2,641,000,000.00	3,771,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,893,342,831.11	3,987,726,220.91	2,930.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,897,035,164.39</b>	<b>6,642,325,128.43</b>	<b>3,783,493,440.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,595,709,932.00	9,976,702,114.14	4,901,705,013.17
投资支付的现金	1,579,023,949.33	6,641,000,000.00	3,284,400,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,174,733,881.33</b>	<b>16,617,702,114.14</b>	<b>8,186,105,013.17</b>
投资活动产生的现金流量净额	722,301,283.06	-9,975,376,985.71	-4,402,611,573.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	4,465,000,000.00
取得借款收到的现金	3,607,041,401.27	5,981,465,128.11	-
收到其他与筹资活动有关的现金	413,549,401.77	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,020,590,803.04</b>	<b>5,981,465,128.11</b>	<b>4,465,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	5,806,334,235.50	2,830,595,097.93	116,086,411.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,123,137.93	294,971,073.41	286,198,982.18
支付其他与筹资活动有关的现金	717,706,982.00	415,706,987.76	62,352,130.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,827,164,355.43</b>	<b>3,541,273,159.10</b>	<b>464,637,524.79</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-2,806,573,552.39	2,440,191,969.01	4,000,362,475.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>453,873,859.46</b>	<b>-5,639,522.69</b>	<b>-31,388,043.75</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,593,272,665.30</b>	<b>2,030,923,719.76</b>	<b>38,475,682.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,128,109,001.73	1,097,185,281.97	1,058,709,599.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,721,381,667.03</b>	<b>3,128,109,001.73</b>	<b>1,097,185,281.97</b>

## 二、财务报告编制基础

### （一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公

司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

## （二）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、财务报表的合并范围及其变化

报告期内，本公司合并财务报表范围内的重要子公司基本情况如下：

子公司名称	是否纳入合并范围		
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
晶合日本株式会社	是	是	是
南京晶驱集成电路有限公司	是	是	是
晶芯成（北京）科技有限公司	是	是	是
合肥新晶集成电路有限公司	是	是	否

### 1、2020 年合并报表范围的变化情况

本期公司出资 20 万元人民币投资设立全资子公司南京晶驱集成电路有限公司，子公司于 2020 年 8 月 24 日成立，法定代表人朱才伟。注册地址：南京市秦淮区江宁路 5 号 D 栋 409-32 号。经营范围：集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计。

本期公司出资 20 万元人民币投资设立全资子公司晶芯成（北京）科技有限公司，子公司于 2020 年 9 月 7 日成立，法定代表人朱才伟。注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 29 号院一区 2 号楼 13 层 1302-C54。经营范围：半导体技术和产品的技术开发、技术服务；销售集成电路、集成电路芯片及产品；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计。

### 2、2021 年合并报表范围的变化情况

本期公司出资 40 亿人民币投资设立子公司合肥新晶集成电路有限公司，子公司于

2021年8月24日成立，法定代表人周义亮。注册地址：合肥市新站区综合保税区内西淝河路88号。经营范围：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

### 3、2022年合并报表范围的变化情况

2022年合并财务报表范围未发生变更。

## 四、审计意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年的财务报告进行了审计，并出具了容诚审字[2023]230Z0133号审计报告，意见如下：

“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶合集成2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2021年度和2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

## 五、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

### （一）与财务会计信息相关的重大事项的判断标准

发行人在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项标准为当年营业收入金额的0.5%，或者虽未达到当年营业收入金额的0.5%，但公司认为较为重要的相关事项。

### （二）关键审计事项

容诚在审计过程中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项是容诚根据职业判断，认为对2022年度、2021年度和2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，容诚不对这些事项单独发表意见。

#### 1、收入确认

相关会计期间：2022年度、2021年度和2020年度。

## (1) 事项描述

晶合集成主要从事晶圆代工业务，2022 年度、2021 年度和 2020 年度营业收入金额分别为 1,005,094.86 万元、542,900.93 万元和 151,237.05 万元，营业收入增幅较大且构成晶合集成利润表重要项目，营业收入的确认是否恰当对晶合集成经营成果产生重大影响，因此容诚将收入确认作为关键审计事项。

## (2) 审计应对

容诚对收入确认实施的相关程序主要包括：

- ①了解晶合集成销售与收款相关的关键内部控制，测试和评估销售与收款相关的关键内部控制设计及运行的有效性；
- ②抽样检查晶合集成与客户签订的销售订单，并对管理层和业务人员访谈，了解和评估收入确认的会计政策；
- ③对营业收入和毛利率情况执行分析程序，复核营业收入及毛利率变动的合理性；
- ④检查主要客户销售订单、销售发票、报关单、运输单、签收单及回款单据等，核实销售收入真实性；
- ⑤对重要客户进行现场或其他形式访谈，进一步核查收入确认的真实性；
- ⑥结合应收账款的审计，向主要客户函证应收账款余额及报告期销售额等；
- ⑦针对资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本核对收入确认的支持性文件，评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## 2、固定资产及在建工程的账面价值

相关会计期间：2022 年度、2021 年度和 2020 年度。

### (1) 事项描述

晶合集成 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的固定资产和在建工程账面价值分别为 2,282,241.19 万元、1,965,504.58 万元和 915,678.28 万元，占资产总额的比例分别为 58.87%、62.85%和 58.54%。由于管理层对确定在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的时点、估计固定资产的经济可使用年限及残值等方面的判断，会对固定资产和在建工程的账面价值确定造成影响，且该影响可能对合并

财务报表具有重要性，因此容诚将固定资产和在建工程账面价值确认作为关键审计事项。

## （2）审计应对

容诚对固定资产账面价值确认实施的相关程序主要包括：

①了解与固定资产和在建工程确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

②对比同行业固定资产的会计政策及会计估计，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计，复核相关会计政策及会计估计是否正确且一贯地运用；

③选取固定资产及在建工程本期增加的样本，检查采购订单、发票、验收单据、付款单据等支持性文件，检查固定资产及在建工程入账价值及会计处理是否正确；

④抽查在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的单据，分析在建工程转入固定资产的时点是否异常；

⑤实地检查重要的固定资产和在建工程；

⑥复核折旧费用的计提与分配是否正确；

⑦结合应付账款函证，向主要供应商函证本期采购额。

## 六、重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### （三）营业周期

本公司正常营业周期为一年。



#### （四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

#### （五）合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

##### 2、关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

（1）该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。

（2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

（3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### 3、合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

(1) 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

(2) 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

(3) 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

(4) 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### 4、报告期内增加子公司的处理

同一控制下企业合并增加的子公司或业务：

①编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

②编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

③编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

## 5、合并抵销中的特殊考虑

(1) 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

(2) “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

(3) 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

(4) 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

(5) 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

### (六) 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (七) 外币业务和外币报表折算

#### 1、外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法

法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

## 2、资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 3、外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

（3）外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

（4）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## （八）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

## 1、金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## 2、金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理

该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

## **(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

## **(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### **3、金融负债的分类与计量**

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### **(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### **(2) 贷款承诺及财务担保合同负债**

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### **(3) 以摊余成本计量的金融负债**

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### 4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### 5、金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### (1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的



预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### ①应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A.应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及

对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**B.应收账款确定组合的依据如下：**

应收账款组合 1：因销货而产生的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

**C.其他应收款确定组合的依据如下：**

其他应收款组合 1：应收利息

其他应收款组合 2：应收股利

其他应收款组合 3：无风险组合（纳入合并范围内的关联方款项、应收退税款、押金及保证金、员工借款及备用金等）

其他应收款组合 4：账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**②债权投资、其他债权投资**

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**(2) 具有较低的信用风险**

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

**(3) 信用风险显著增加**

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在

初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### **（4）已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### **(5) 预期信用损失准备的列报**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### **(6) 核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **6、金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### **(1) 终止确认所转移的金融资产**

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也

没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

## **（2）继续涉入所转移的金融资产**

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险

或报酬的程度。

### **(3) 继续确认所转移的金融资产**

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

## **7、金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## **8、金融工具公允价值的确定方法**

金融资产和金融负债的公允价值确定方法参见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、重要会计政策和会计估计”之“（九）公允价值计量”。

### **（九）公允价值计量**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允

价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

### **(1) 估值技术**

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

### **(2) 公允价值层次**

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## **(十) 存货**

### **1、存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、备品备件、周转材料等。

## 2、发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

## 3、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

## 4、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

(3) 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 5、周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法；



(2) 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### (十一) 合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、重要会计政策和会计估计”之“（八）金融工具”。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### (十二) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

### **(十三) 长期股权投资**

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司联营企业。

#### **1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施

加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## 2、初始投资成本确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### （2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为

初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### (1) 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### (2) 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单

位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### **4、减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法参见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、重要会计政策和会计估计”之“(十八) 长期资产减值”。

#### **(十四) 固定资产**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

##### **1、确认条件**

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## 2、各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	-	5.00-3.33
机器设备	年限平均法	5-10 年	-	20.00-10.00
运输工具	年限平均法	4 年	-	25.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	-	33.33-20.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法（适用 2020 年度及以前）

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### （十五）在建工程

- （1）在建工程以立项项目分类核算；
- （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固

定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## （十六）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### 2、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加

权平均利率计算确定。

## （十七）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### 2、无形资产使用寿命及摊销

#### （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
专利权及非专利技术	10-12年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件及其他	1-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### （3）无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。



### 3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (十八) 长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产及无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十九）长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （二十）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

##### （1）职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### （2）职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

##### （3）医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### **(4) 短期带薪缺勤**

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### **(5) 短期利润分享计划**

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### **2、离职后福利的会计处理方法**

#### **(1) 设定提存计划**

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### **(2) 设定受益计划**

##### **A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本**

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

##### **B.确认设定受益计划净负债或净资产**

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

a.精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

b.计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

c.资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量

应付职工薪酬。

#### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

##### (1) 符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### (2) 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### (二十一) 预计负债

##### 1、预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （二十二）股份支付

### 1、股份支付的种类

本公司股份支付系以权益结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

（1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整；

（2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### 4、股份支付计划实施的会计处理

（1）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### 5、股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司

取消了部分或全部已授予的权益工具。

## 6、股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## （二十三）收入确认原则和计量方法

### 1、一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点

### 履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品。

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。



## 2、具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### (1) 商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务，公司在客户或其委托的其他公司签收后确认收入。

### (2) 提供服务

本公司与客户之间的提供服务合同包含运行维护的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益（或本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项），本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

## 3、关于销售返利

公司销售返利的会计处理：在达到约定的返利条件时，根据销售订单约定的返利条款，计算销售返利金额，计提时，确认为预计负债，同时冲减主营业务收入，实现时，冲减预计负债，同时冲减相应客户的应收账款。

## (二十四) 生产成本核算

公司生产成本下设直接材料、直接人工和制造费用三个项目，生产成本的归集与分配方法如下：

### 1、核算内容

- (1) 直接材料：主要核算直接用于产品生产、构成产品实体的硅片。
- (2) 直接人工：主要核算直接参加产品生产的人工工资、奖金、社保等薪酬费用。
- (3) 制造费用：主要核算为生产产品所发生的各项间接费用，主要包括间接人工、间接材料、折旧费用、燃料及动力费、零配件等。

### 2、具体核算方法

归集：直接材料按照实际领用的原材料计入各月生产成本；每月各车间实际发生的直接人工成本计入各月生产成本；制造费用归集每月生产产品所发生的各项间接费

用。

分配：公司具备完善的信息管理制度，采用标准成本法核算产品成本，标准成本每个季度维护和修订，产品生产过程需经过多道工序，系统对每个工序发生及分摊的成本进行归集和计量，每个工序标准成本的叠加形成产成品标准成本，月末，系统计算出当月各工序所有在产品及最终产成品的标准成本。

系统将各工序的在产品及当月完工产成品标准成本的合计数与当月归集的实际成本的差异作为当月待分摊成本差异，按照各工序的在产品及当月完工产成品的标准成本进行分配。

产品成本分摊比率 = 各产品当月标准成本 /  $\Sigma$  各产品当期标准成本

各产品分摊成本差异 = 待分摊成本差异数  $\times$  产品成本分摊比率。

## （二十五）政府补助

### 1、政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）本公司能够满足政府补助所附条件；
- （2）本公司能够收到政府补助。

### 2、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

### 3、政府补助的会计处理

#### （1）与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### （2）与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### **(3) 政府补助退回**

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## **(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### **1、递延所得税资产的确认**

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 2、递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

**（1）因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：**

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

**（2）本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：**

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3、特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

**（1）与企业合并相关的递延所得税负债或资产**

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整

企业合并中所确认的商誉。

## **(2) 直接计入所有者权益的项目**

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

## **(3) 可弥补亏损和税款抵减**

### **A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减**

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

### **B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损**

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

## **(4) 合并抵销形成的暂时性差异**

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

## **(5) 以权益结算的股份支付**

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## **(二十七) 租赁**

### **1、以下内容自 2021 年 1 月 1 日起适用**

#### **(1) 租赁的识别**

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### **(2) 单独租赁的识别**

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### **(3) 本公司作为承租人的会计处理方法**

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，具体情况参见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、重要会计政策和会计估计”之“（二十一）预计负债”。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30年	-	5.00-3.33
机器设备	年限平均法	5-10年	-	20.00-10.00
运输工具	年限平均法	4年	-	25.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5年	-	33.33-20.00
土地使用权	年限平均法	根据产权证书记载年限确定	-	根据产权证书记载年限确定

### ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，

前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于 2020 年度及以前

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。



初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## **(2) 融资租赁的会计处理方法**

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

## **(二十八) 重要会计政策、会计估计的变更**

### **1、重要会计政策变更**

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》(财会【2017】22 号)（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、重要会计政策和会计估计”之“(二十三) 收入确认原则和计量方法”。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

（2）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、重要会计政策和会计估计”之“（二十七）租赁”。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C.在首次执行日，本公司按照本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、重要会计政策和会计估计”之“（十八）长期资产减值”对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

A. 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

B. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(3) 执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定。

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

(4) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16

号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
预付账款	9,706,755.36	9,653,359.93	-53,395.43
非流动资产：			
固定资产	7,766,077,816.88	6,146,177,842.97	-1,619,899,973.91
使用权资产	-	1,695,127,889.26	1,695,127,889.26
流动负债：			
应付账款	1,113,785,875.49	1,106,744,606.23	-7,041,269.26
一年内到期的非流动负债	186,218,643.30	191,013,156.45	4,794,513.15
非流动负债：			
租赁负债	-	972,657,269.10	972,657,269.10
长期应付款	929,312,245.46	-	-929,312,245.46
递延收益	1,119,108,660.15	1,153,184,912.54	34,076,252.39

### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产：			
固定资产	7,765,520,396.50	6,145,620,422.59	-1,619,899,973.91
使用权资产	-	1,693,572,207.97	1,693,572,207.97
流动负债：			
应付账款	1,116,148,026.85	1,109,106,757.59	-7,041,269.26
一年内到期的非流动负债	186,218,643.30	191,013,156.45	4,794,513.15
非流动负债：			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产:			
租赁负债	-	971,154,983.24	971,154,983.24
长期应付款	929,312,245.46	-	-929,312,245.46
递延收益	1,119,108,660.15	1,153,184,912.54	34,076,252.39

## 七、财务报告事项

### (一) 注册会计师核验的非经常性损益情况

单位：万元

明细项目	2022年度	2021年度	2020年度
非流动资产处置损益	-	-108.25	0.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	731.82	1,359.89	922.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,895.57	18,975.01	8,706.06
股份支付	-	-266.50	-12,105.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97.36	-468.52	49.92
减：所得税影响额	-	-26.85	-
少数股东权益影响额	16.31	-	-
<b>合计</b>	<b>16,708.44</b>	<b>19,518.48</b>	<b>-2,426.29</b>
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	287,834.64	153,364.72	-123,333.42

### (二) 公司适用的税率及优惠政策

#### 1、本公司适用的主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米

注：晶合日本株式会社按日本国内税法缴纳消费税、法人税及其他税费

## 2、本公司享受的税收优惠政策

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《安徽省 2020 年第二批高新技术企业通过认定名单的通知》（皖科高〔2020〕37 号），本公司被认定为安徽省 2020 年第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号为 GR2020003384，有限期：3 年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自 2020 年度起适用 15% 的所得税税率。

## 3、税收优惠政策的影响

报告期内，税收优惠对发行人经营成果影响情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利润总额	315,640.42	172,926.30	-125,746.81
税收优惠金额	17,977.85	-	-
税收优惠占利润总额比例	5.70%	0.00%	0.00%

报告期内，发行人相关税收优惠政策属于行业惯例，具体税收优惠政策详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（六）2022 年度所得税优惠事项说明”。

报告期内，发行人税收优惠金额占利润总额比例较低，报告期各期分别为 0.00%、0.00% 及 5.70%，发行人经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

## 八、财务指标

### （一）公司近三年主要财务指标

主要财务指标	2022年度/ 2022年12月31日	2021年度/ 2021年12月31日	2020年度/ 2020年12月31日
流动比率（倍）	1.18	0.57	3.30
速动比率（倍）	1.07	0.50	3.05
资产负债率（合并）	53.44%	68.38%	54.24%
资产负债率（母公司）	61.78%	70.60%	54.19%
归属于母公司股东的净利润（万元）	304,543.08	172,883.20	-125,759.71
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	287,834.64	153,364.72	-123,333.42
利息保障倍数（倍）	12.20	9.34	-3.40
息税折旧摊销前利润（万元）	621,847.95	339,499.48	-145.66
应收账款周转率（次/年）	13.79	8.94	8.11
存货周转率（次/年）	5.01	4.84	4.28
每股经营活动产生的现金流量（元）	4.17	6.36	0.31
每股净现金流量（元）	2.39	2.02	0.03
归属于公司股东的每股净资产（元）	8.72	6.13	4.76
研发费用占营业收入的比例	8.53%	7.31%	16.18%

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=速动资产 / 流动负债=(流动资产-存货) / 流动负债
- 3、资产负债率=总负债 / 总资产
- 4、利息保障倍数=(利润总额+利息支出) / 利息支出；
- 5、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
- 6、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额
- 7、存货周转率=营业成本 / 存货平均余额
- 8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股份数量
- 9、每股净现金流量=现金流量净额 / 期末股份数量
- 10、归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产 / 期末股份数量
- 11、研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入

### （二）公司近三年净资产收益率及每股收益

本公司按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的近三年净资产收益率和每股收益如下表：

单位：元/股

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2022年度	26.91	2.02	2.02
	2021年度	21.55	1.15	1.15
	2020年度	-28.93	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2022年度	25.44	1.91	1.91
	2021年度	19.12	1.02	1.02
	2020年度	-28.37	-0.27	-0.27

## 九、经营成果分析

报告期各期，公司营业收入分别为 151,237.05 万元、542,900.93 万元和 1,005,094.86 万元；净利润分别为-125,759.71 万元、172,883.20 万元和 315,619.62 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-123,333.42 万元、153,364.72 万元和 287,834.64 万元。

### （一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	1,002,549.95	99.75%	542,084.44	99.85%	151,186.11	99.97%
其他业务收入	2,544.91	0.25%	816.49	0.15%	50.94	0.03%
营业收入合计	1,005,094.86	100.00%	542,900.93	100.00%	151,237.05	100.00%

公司是业内前列的纯晶圆代工企业，主要从事 12 英寸晶圆代工业务。报告期各期，公司主营业务收入占当期营业收入的比例分别为 99.97%、99.85%和 99.75%，主营业务突出。

报告期各期，公司主营业务收入分别为 151,186.11 万元、542,084.44 万元和 1,002,549.95 万元，最近三年年均复合增长率达 157.51%，呈快速增长趋势，主要原因为全球显示面板市场规模快速增长、公司产能稳健提升以及公司持续加强产品研发和



技术创新，具体如下：

### ①市场需求快速增长

近年来随着显示面板技术的快速发展，下游智能手机、平板电脑、台式/笔记本电脑、汽车等终端设备对显示器的需求高速增长，带动了面板显示驱动芯片市场规模的快速提升，有力推动了上游晶圆代工行业规模的持续提高。根据 Frost & Sullivan 的统计，2015 年至 2020 年，全球显示面板行业市场规模从 1.72 亿平方米增长至 2.42 亿平方米，年均复合增长率达 7.1%，并预计 2024 年全球显示面板市场规模将达到 2.74 亿平方米。此外虽然境内显示面板行业起步相对较晚，但受益于近年来全球产品需求的快速增长以及国家政策的大力支持，2015 年至 2020 年，境内显示面板行业市场规模从 0.31 亿平方米快速增长至 0.91 亿平方米，年均复合增长率达 24.4%，并预计 2024 年中国大陆显示面板市场规模将达到 1.17 亿平方米。下游稳健增长的产品需求有力支撑了上游晶圆代工服务行业的快速发展。

### ②公司产能稳健释放

公司产能的稳健提升是推动收入规模增长的重要因素。在产品需求快速增长的有利行业因素推动下，公司近年来持续加大产线设备投入，以维持产能快速扩充。最近三年公司年产能分别达 26.62 万片、57.09 万片和 126.21 万片，最近三年年均复合增长率达 117.73%，产能的快速扩充为公司产品出货量快速增长提供了重要保障，有力推动了报告期收入规模的稳定增长。

### ③持续的产品研发和技术创新

公司高度重视产品研发及技术创新，在前期引进并消化吸收力晶科技入资的相关技术基础上，结合下游行业发展趋势积极推动技术创新升级，在不断完善现有技术平台的同时，持续推出更具竞争力的新产品，推动了公司收入规模的快速提升。公司 150nm、110nm、90nm DDIC 产品已实现量产，同时 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台正在进行风险量产。产品技术的不断创新升级以及更具竞争力的新产品持续推出，是报告期内公司营业收入规模持续快速扩张的重要因素。

## 1、分业务主营业务收入构成分析

### (1) 按工艺平台分类

报告期内，公司主营业务收入按工艺平台类别列示如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDIC 工艺平台晶圆代工	714,261.58	71.24%	467,914.67	86.32%	148,394.24	98.15%
其他工艺平台晶圆代工	288,288.37	28.76%	74,169.78	13.68%	2,791.87	1.85%
<b>合计</b>	<b>1,002,549.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,084.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,186.11</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务收入按工艺平台可分为 DDIC 工艺平台和 CIS、LED、E-tag、MCU、PMIC 等其他新工艺平台。其中 DDIC 工艺平台晶圆代工产品为公司的核心产品，是最主要的收入来源。报告期各期，公司 DDIC 类产品收入分别为 148,394.24 万元、467,914.67 万元和 714,261.58 万元，最近三年年均复合增长率达 119.39%，整体呈快速上升趋势，与下游产品需求及公司产能的稳定增长相匹配。

公司高度重视产品研发及工艺升级，持续加大投入力度，近年来陆续研发 CIS、LED、E-tag、MCU、PMIC 等其他新工艺平台，并取得了一系列重要突破。最近三年公司前述新工艺平台晶圆代工实现的收入呈快速上升趋势，预计未来公司研发升级的新工艺平台将成为重要的收入增长点，收入结构将进一步优化。

### (2) 按产品制程分类

报告期内，公司主营业务收入按制程分类列示如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
55nm	3,912.65	0.39%	4.99	0.00%	-	-
90nm	521,240.66	51.99%	303,310.46	55.95%	80,268.82	53.09%
110nm	316,507.96	31.57%	132,328.41	24.41%	40,725.48	26.94%
150nm	160,888.68	16.05%	106,440.58	19.64%	30,191.80	19.97%
<b>合计</b>	<b>1,002,549.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,084.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,186.11</b>	<b>100.00%</b>

注：发行人 55nm 技术平台正在风险量产阶段

报告期内，公司为客户提供的晶圆代工产品制程主要包括 90nm、110nm 和 150nm 三大类，具体收入变动分析如下：

### ①90nm 制程

报告期内 90nm 制程类产品金额及占比呈快速上升趋势，主要系其中 90nm DDIC 类产品销售规模快速提升所致。90nm 制程产品是 DDIC 类产品的主流制程之一，报告期各期，公司 90nm 制程类产品收入分别为 80,268.82 万元、303,310.46 万元和 521,240.66 万元，最近三年年均复合增长率达 154.83%；占主营业务收入比重分别为 53.09%、55.95%和 51.99%，体现了公司产品收入结构的持续优化。

此外公司基于 90nm 制程技术持续进行相关技术的研发创新，90nm CIS、E-tag 等产品逐步进入量产阶段，预计未来公司 90nm 制程产品将进一步多元化。

### ②110nm 制程

报告期各期，公司 110nm 制程类产品销售收入分别为 40,725.48 万元、132,328.41 万元和 316,507.96 万元，最近三年年均复合增长率为 178.78%，主要系 110nm DDIC 类产品销售规模快速上升所致。在终端设备需求快速增长及公司产能稳步释放的背景下，110nm DDIC 产品销售规模实现了稳步增长。

### ③150nm 制程

公司 150nm 制程产品主要为 DDIC 产品，主要应用于电视、台式电脑等终端设备，随着公司产能的逐步释放，150nm 制程类产品整体呈快速上升趋势。报告期各期，公司 150nm 制程类产品销售收入分别为 30,191.80 万元、106,440.58 万元和 160,888.68 万元，最近三年年均复合增长率为 130.84%。

## 2、分销售模式主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入按照销售模式列示如下：

单位：万元

销售模式	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	1,002,549.95	100.00%	542,084.44	100.00%	151,186.11	100.00%
经销	-	-	-	-	-	-
合计	1,002,549.95	100.00%	542,084.44	100.00%	151,186.11	100.00%

报告期内，公司产品销售均为直销。

### 3、分客户归属地主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入按客户归属地列示如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	548,902.13	54.75%	224,702.20	41.45%	24,932.42	16.49%
境外	453,647.82	45.25%	317,382.24	58.55%	126,253.69	83.51%
中国台湾地区	367,493.71	36.66%	259,858.80	47.94%	109,409.29	72.37%
其他地区	86,154.11	8.59%	57,523.45	10.61%	16,844.39	11.14%
<b>合计</b>	<b>1,002,549.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,084.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,186.11</b>	<b>100.00%</b>

注：客户归属地以其注册地址境内外归属为准。

按客户归属地划分，报告期内公司客户覆盖境内与境外多个地区，其中境外客户中中国台湾地区客户占比较高。

报告期各期，公司境外客户实现主营业务收入分别为 126,253.69 万元、317,382.24 万元和 453,647.82 万元，最近三年年均复合增长率达 89.56%，主要原因为下游产品需求稳定增长及公司产能持续提升；占各期主营业务收入的比例分别为 83.51%、58.55%和 45.25%，整体占比较高但呈下降趋势，主要系境内主营业务收入规模及占比快速提高所致。

报告期各期，公司境内客户实现主营业务收入分别为 24,932.42 万元、224,702.20 万元和 548,902.13 万元，占主营业务收入的比例分别为 16.49%、41.45%和 54.75%，金额及占比均呈逐年上升趋势，主要原因为受益于下游产品需求的快速增长以及国家对集成电路行业的政策支持，境内集成电路行业发展迅速，有力带动了晶圆代工服务的需求增长，公司借助地理位置优势深耕境内市场，持续加强对境内客户的拓展与维护，使得境内客户收入规模快速增长，2022 年度，公司境内客户收入规模已超过境外客户。

#### 4、第三方回款的情况

报告期内，公司产品销售存在第三方回款的情形，主要为同一集团内公司代付货款和委托第三方代付货款，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
第三方回款合计	-	7,618.71	2,241.43
其中：同一集团内公司代付货款	-	1,142.49	922.15
委托第三方代付货款	-	6,476.22	1,319.28
营业收入	1,005,094.86	542,900.93	151,237.05
占比	-	1.40%	1.48%

报告期内，公司第三方回款金额分别为 2,241.43 万元、7,618.71 万元和 0 万元，占当期营业收入的比重分别为 1.48%、1.40%和 0.00%，整体占比较低。第三方回款产生的主要原因如下：

(1) 应客户集团内部付款安排要求，公司以客户支付的产能预约保证金抵扣该客户同一集团内关联方的货款；

(2) 客户综合考虑支付和报关效率，以及与境外主体交易惯例等因素，委托供应链管理企业代为支付货款。

报告期内，公司第三方回款具有真实的业务背景和商业合理性，不存在虚构交易或调节账龄的情形；除集创北方目前持有公司 0.58%股份情形外，公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排。

#### 5、分季度主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入按季度列示如下：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	281,424.41	28.07%	62,876.83	11.60%	31,774.87	21.02%
第二季度	317,001.21	31.62%	97,318.13	17.95%	35,170.05	23.26%
第三季度	249,555.10	24.89%	157,496.02	29.05%	39,297.26	25.99%
第四季度	154,569.23	15.42%	224,393.46	41.39%	44,943.92	29.73%

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	1,002,549.95	100.00%	542,084.44	100.00%	151,186.11	100.00%

报告期内，受产能持续扩充及订单量稳定增长的影响，公司主营业务收入金额持续增长，各年度因订单分布不同分季度收入占比存在一定波动，不存在明显的季节性。2022 年度第三季度及第四季度，受行业景气度影响，主营业务收入占比较以前年度有所下降。

## 6、产品及服务数量和价格情况分析

### (1) 主要产品及服务数量情况分析

报告期内，公司主要从事 12 英寸晶圆代工服务，各期产品销量具体变动情况如下：

单位：片

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	数量	变动比例	数量	变动比例	数量	变动比例
销量	1,060,498	75.95%	602,712	128.24%	264,069	177.08%

报告期各期，公司代工的 12 英寸晶圆产品销量分别为 264,069 片、602,712 片和 1,060,498 片，呈快速增长趋势，最近三年年均复合增长率达 100.40%，主要原因为下游市场规模快速增长、公司产能稳健提升以及公司持续加强产品研发和技术创新。

### (2) 主要产品的价格情况分析

报告期内，公司产品销售均价如下：

单位：元/片

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	单价	变动比例	单价	变动比例	单价	变动比例
销售均价	9,453.58	5.11%	8,994.09	57.10%	5,725.25	2.30%

注：销售均价=主营业务收入/销量。

报告期各期，公司产品销售均价为 5,725.25 元/片、8,994.09 元/片和 9,453.58 元/片，呈持续上升趋势，主要原因一方面公司产品结构持续优化，单价较高的 90nm 制程及 110nm 制程产品收入占比提高；另一方面公司根据市场行情有所调价。2022 年度，公

司均价较低的非 DDIC 工艺平台晶圆代工类产品收入占比提高，导致公司产品销售价格涨幅较 2021 年度有所下降。

## 7、按照制程划分的销量和价格对主营业务收入的影响

报告期内，发行人各制程类产品销售收入均有明显上涨。整体而言，各制程类产品收入增长的主要原因为产品销售数量大幅增长，此外 2021 年以来产品销售价格上升对当期收入增长亦产生重要影响。

### （二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本的具体构成如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	540,284.88	99.84%	297,409.76	99.84%	164,146.19	99.97%
其他业务成本	863.29	0.16%	487.44	0.16%	44.67	0.03%
合计	<b>541,148.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>297,897.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>164,190.86</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司主营业务成本占比分别为 99.97%、99.84%和 99.84%，与主营业务收入结构相匹配，其他业务成本金额及占比均较低。

报告期各期，公司主营业务成本分别为 164,146.19 万元、297,409.76 万元和 540,284.88 万元，最近三年年均复合增长率为 81.42%，与主营业务收入变动趋势一致，但增长率低于主营业务收入 157.51%的增长率水平，主要原因为公司前期固定资产等投入较大，在产销量有限的情况下单位产品分摊的固定成本较高，后续随着公司订单数量的快速增长、产能的稳步提升以及生产工艺的逐步成熟，规模效应的显现使得单位产品成本有所下降，综合导致主营业务成本整体年均复合增长率低于主营业务收入，公司产品销售盈利提升明显。

#### 1、分业务主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本按工艺平台列示如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDIC 工艺平台晶圆代工	358,982.85	66.44%	255,743.83	85.99%	161,631.28	98.47%
其他工艺平台晶圆代工	181,302.03	33.56%	41,665.93	14.01%	2,514.91	1.53%
合计	<b>540,284.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>297,409.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>164,146.19</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务成本以 DDIC 类产品为主。报告期各期，DDIC 类产品占主营业务成本的比例分别为 98.47%、85.99%和 66.44%，其他工艺平台类产品占主营业务成本的比例分别为 1.53%、14.01%和 33.56%，两类产品的主营业务成本占比与主营业务收入相匹配。

报告期内，公司主营业务成本按制程分类列示如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
55nm	8,649.31	1.60%	0.85	0.00%	-	-
90nm	288,696.76	53.43%	174,328.98	58.62%	93,956.58	57.24%
110nm	157,748.14	29.20%	71,240.60	23.95%	41,979.75	25.57%
150nm	85,190.66	15.77%	51,839.33	17.43%	28,209.86	17.19%
合计	<b>540,284.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>297,409.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>164,146.19</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，各制程主营业务成本占比与主营业务收入占比基本一致。

## 2、主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本构成明细如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	66,445.87	12.30%	30,357.16	10.21%	15,500.31	9.44%
直接人工	9,128.95	1.69%	2,854.80	0.96%	1,405.49	0.86%
制造费用	464,523.69	85.98%	264,042.06	88.78%	146,963.68	89.53%
运输费用	186.36	0.03%	155.75	0.05%	276.71	0.17%



项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	540,284.88	100.00%	297,409.76	100.00%	164,146.19	100.00%

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用及运输费用构成，其中制造费用是最主要的构成部分。

报告期各期，公司直接材料成本分别为 15,500.31 万元、30,357.16 万元和 66,445.87 万元，占各期主营业务成本的比例分别为 9.44%、10.21%和 12.30%，金额及占比整体呈上升趋势。报告期内，公司产品销售规模不断扩大，原材料耗用规模整体提升，同时主要原材料硅片价格有所波动，综合导致报告期内公司直接材料规模逐年增加。

报告期各期，公司直接人工成本分别为 1,405.49 万元、2,854.80 万元和 9,128.95 万元，占各期主营业务成本比例分别为 0.86%、0.96%和 1.69%，金额及占比均相对较低。直接人工规模整体呈上升趋势，主要系产品销售规模及生产人员规模扩大等因素所致。

报告期各期，公司制造费用分别为 146,963.68 万元、264,042.06 万元和 464,523.69 万元，占主营业务成本的比例分别为 89.53%、88.78%和 85.98%，占比整体相对稳定但 2021 年度及 2022 年度有所下降，主要系当期直接材料同比提高较大所致。报告期内公司为扩充产能持续加大固定资产等资本性投入，折旧规模持续提升，同时随着生产规模扩大，车间生产辅助人员人工支出及间接材料成本亦有所提高，综合导致制造费用整体上升。

2020 年度，公司根据新收入准则将原通过“销售费用”核算的运输费用调整至“合同履约成本”并进而结转至主营业务成本，当期主营业务成本中运费规模占比为 0.17%。2021 年度及 2022 年度，公司主营业务成本中运费占比分别为 0.05%和 0.03%，整体较低，2021 年以来公司与客户协商后优化了合同货运条款，如部分原出境货物合同由送达中国台湾地区机场改为送达上海机场，部分原送达客户指定地点的合同改为由客户自提等，使得当期在收入大幅增长的同时运费有所下降。

### 3、主要原材料和能源采购情况

请参见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“四、公司主营业务经营情况”之“(二) 公司采购情况”相关内容。

#### (三) 毛利及毛利率分析

##### 1、综合毛利及毛利率情况

报告期内，公司综合毛利构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
主营业务毛利	462,265.08	46.11%	244,674.68	45.14%	-12,960.08	-8.57%
其他业务毛利	1,681.62	66.08%	329.04	40.30%	6.27	12.31%
合计	<b>463,946.69</b>	<b>46.16%</b>	<b>245,003.72</b>	<b>45.13%</b>	<b>-12,953.81</b>	<b>-8.57%</b>

报告期各期，公司综合毛利分别为-12,953.81 万元、245,003.72 万元和 463,946.69 万元，公司综合毛利率分别为-8.57%、45.13%和 46.16%，综合毛利及毛利率整体呈快速改善趋势，2021 年度毛利率由负转正的同时达到 45.13%的较高水平，2022 年度毛利率进一步提升并达到 46.16%，公司整体盈利能力显著增强。

##### 2、主营业务毛利及毛利率情况

###### (1) 整体变动分析

报告期各期，公司主营业务毛利分别为-12,960.08 万元、244,674.68 万元和 462,265.08 万元，2021 年度主营业务毛利由负转正且盈利规模较高，2022 年度主营业务毛利规模进一步延续增长趋势；主营业务毛利率分别为-8.57%、45.14%和 46.11%，主营业务毛利率呈快速改善趋势，且 2021 年度主营业务毛利率由负转正，并达到 45.14%的较高水平，2022 年度主营业务毛利率进一步提升至 46.11%，具体情况如下：

###### ① 2020 年主营业务毛利率为负的主要原因

晶圆代工行业系技术密集型和资本密集型行业，对研发能力和资本实力等要求较高。公司成立以来，为满足产能扩充需求，持续追加生产设备等资本性投入，固定成本规模较高，同时从项目建设到落地达产，再到实现规划产能需要一定周期，因此在

初期产能爬坡、产销规模相对有限的情况下产品单位成本较高，主营业务毛利率为负。

## ②主营业务毛利率快速改善的原因

报告期内，受益于下游市场规模的快速增长、公司产能的稳步提升以及公司持续的产品及技术创新，公司产品产销规模增长迅速，从而使得规模效应逐步显现，单位产品成本快速下降，主营业务毛利率快速改善，2021年度公司主营业务毛利率由负转正，并达到45.14%的较高水平，2022年度主营业务毛利率进一步提升至46.11%。

### (2) 按工艺平台及制程分类变动分析

报告期内，公司主营业务按工艺平台分类的毛利及构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
DDIC 工艺平台晶圆代工	355,278.73	49.74%	212,170.83	45.34%	-13,237.04	-8.92%
其他工艺平台晶圆代工	106,986.35	37.11%	32,503.85	43.82%	276.96	9.92%
合计	<b>462,265.08</b>	<b>46.11%</b>	<b>244,674.68</b>	<b>45.14%</b>	<b>-12,960.08</b>	<b>-8.57%</b>

DDIC 工艺平台晶圆代工产品是公司目前最主要的收入来源。报告期各期，DDIC 工艺平台晶圆代工产品毛利率分别为-8.92%、45.34%和 49.74%，毛利率呈持续快速改善趋势。

报告期内，公司主营业务按制程分类的毛利及构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
55nm	-4,736.66	-121.06%	4.13	82.93%	-	-
90nm	232,543.90	44.61%	128,981.49	42.52%	-13,687.76	-17.05%
110nm	158,759.82	50.16%	61,087.81	46.16%	-1,254.27	-3.08%
150nm	75,698.02	47.05%	54,601.25	51.30%	1,981.94	6.56%
合计	<b>462,265.08</b>	<b>46.11%</b>	<b>244,674.68</b>	<b>45.14%</b>	<b>-12,960.08</b>	<b>-8.57%</b>

报告期内，随着公司产销规模稳步增长，规模效应显现使得单位成本快速下降，

主要制程产品 90nm、110nm、150nm 毛利率均整体改善、产品盈利能力不断增强，2021 年度，公司制程产品毛利均实现扭负为正，且各制程产品毛利率均超过 40%，达到较高水平，2022 年度公司 90nm、110nm 制程产品毛利率均呈持续提升趋势。整体而言，2020 年度、2021 年度及 2022 年度公司 110nm 及 150nm 制程产品毛利率相对优于 90nm 制程产品的毛利率，主要原因为 90nm 制程产品工艺流程较为复杂，固定成本分摊比例较高，2022 年度公司 55nm 制程产品毛利率为负，主要系公司 55nm 技术平台正在风险量产阶段，产量相对较低，规模效应尚未体现。随着公司未来产能持续释放，产销规模将进一步增长，各产品毛利率有望保持在较高水平，整体盈利能力有望持续增强。

### (3) 与可比公司毛利率比较分析

报告期内，公司综合毛利率与可比公司对比情况如下：

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
台积电	59.56%	51.63%	53.10%
中芯国际	38.30%	29.31%	23.78%
华润微	未披露	35.33%	27.47%
华虹半导体	34.08%	27.69%	24.43%
联华电子	45.12%	33.82%	22.05%
世界先进	46.28%	43.58%	33.97%
平均	44.67%	36.89%	30.80%
晶合集成	46.16%	45.13%	-8.57%

注 1：数据来源为可比公司定期报告、业绩快报或其招股说明书；

2020 年度，公司毛利率低于可比公司毛利率的均值，主要系公司投产时间相对较晚，报告期内尚处于产能爬坡阶段，产品单位成本较高；2021 年度，随着公司产销规模的快速增长，规模效应显现使得单位成本持续快速下降，公司综合毛利率由负转正并达到 45.13%，超过可比公司综合毛利率平均水平，2022 年度毛利率进一步提升并达到 46.16%。

### (四) 期间费用分析

报告期内，公司的期间费用及费用率情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	5,973.70	0.59%	3,968.78	0.73%	1,979.49	1.31%
管理费用	29,492.50	2.93%	24,275.39	4.47%	27,403.28	18.12%
研发费用	85,707.00	8.53%	39,668.49	7.31%	24,467.56	16.18%
财务费用	6,908.54	0.69%	12,140.71	2.24%	36,488.32	24.13%
<b>合计</b>	<b>128,081.74</b>	<b>12.74%</b>	<b>80,053.36</b>	<b>14.75%</b>	<b>90,338.65</b>	<b>59.73%</b>

注：费用率=期间费用/当期营业收入。

报告期各期，公司期间费用分别为 90,338.65 万元、80,053.36 万元和 128,081.74 万元，期间费用率分别为 59.73%、14.75%和 12.74%。报告期各期，公司期间费用率呈快速下降趋势，主要系公司营业收入快速增长所致。

### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用主要构成明细如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	5,454.30	91.31%	3,569.06	89.93%	1,694.99	85.63%
专业服务费	151.12	2.53%	109.80	2.77%	113.15	5.72%
业务招待费	111.81	1.87%	71.27	1.80%	25.20	1.27%
差旅费	73.72	1.23%	52.91	1.33%	27.96	1.41%
会务费	52.90	0.89%	40.53	1.02%	44.62	2.25%
保险费	2.76	0.05%	49.30	1.24%	49.73	2.51%
样品费	13.00	0.22%	14.24	0.36%	1.53	0.08%
其他	114.09	1.91%	61.67	1.55%	22.31	1.13%
<b>合计</b>	<b>5,973.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,968.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,979.49</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司销售费用的金额分别为 1,979.49 万元、3,968.78 万元和 5,973.70 万元，占当期营业收入的比例分别为 1.31%、0.73%和 0.59%。报告期内销售费用整体呈上升趋势主要系职工薪酬上涨所致。

公司销售费用主要包括职工薪酬、专业服务费等，报告期内前述费用合计占当期

销售费用的比例分别为 91.35%、92.70%和 93.83%，具体如下：

### （1）职工薪酬

报告期各期，公司销售费用中的职工薪酬分别为 1,694.99 万元、3,569.06 万元和 5,454.30 万元，占销售费用的比例分别为 85.63%、89.93%和 91.31%，是销售费用最主要组成部分。报告期内，公司持续加强业务拓展力度，并扩展了销售团队规模，同时员工薪酬水平持续提高，使得职工薪酬有所提高。

### （2）专业服务费

报告期内，公司销售费用中的专业服务费分别为 113.15 万元、109.80 万元和 151.12 万元，占各期销售费用的比例分别为 5.72%、2.77%和 2.53%，金额较为稳定、占比呈逐年下降趋势。公司销售费用中专业服务费主要为支付给专业机构的市场调研及咨询服务费等。

### （3）销售费用率对比分析

报告期内，公司与可比公司销售费用率比较如下表所示：

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
台积电	0.44%	0.48%	0.53%
中芯国际	0.46%	0.49%	0.73%
华润微	未披露	1.42%	1.52%
华虹半导体	0.50%	0.65%	0.85%
联华电子	1.50%	2.19%	2.35%
世界先进	1.13%	1.30%	1.14%
平均	0.81%	1.09%	1.19%
晶合集成	0.59%	0.73%	1.31%

2020 年度，公司的销售费用率高于同行业可比公司平均水平，主要系公司报告期初期收入规模相对较低，随着公司收入规模的逐步增长，报告期内公司销售费用率整体呈下降趋势，2021 年度及 2022 年度公司销售费用率已低于行业平均水平。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用主要构成明细如下：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	21,282.32	72.16%	15,116.88	62.27%	8,454.37	30.85%
固定资产折旧	1,948.61	6.61%	1,195.26	4.92%	2,320.42	8.47%
专业服务费	1,796.34	6.09%	2,650.58	10.92%	1,774.02	6.47%
环保费用	807.10	2.74%	498.87	2.06%	341.76	1.25%
物业费	517.74	1.76%	442.48	1.82%	394.72	1.44%
使用权资产折旧	440.03	1.49%	1,067.96	4.40%	-	-
无形资产摊销	323.04	1.10%	297.34	1.22%	264.04	0.96%
修理费	343.30	1.16%	413.33	1.70%	381.77	1.39%
保险费	159.39	0.54%	114.62	0.47%	116.71	0.43%
办公楼改造费	100.46	0.34%	535.80	2.21%	291.37	1.06%
邮电费	132.36	0.45%	115.14	0.47%	99.64	0.36%
招聘费	178.92	0.61%	676.72	2.79%	37.80	0.14%
差旅费	59.88	0.20%	62.54	0.26%	12.08	0.04%
股份支付费用	-	-	266.50	1.10%	12,105.02	44.17%
租赁费	-	-	-	-	202.43	0.74%
其他	1,403.01	4.76%	821.37	3.38%	607.12	2.22%
<b>合计</b>	<b>29,492.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,275.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,403.28</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司管理费用分别为 27,403.28 万元、24,275.39 万元和 29,492.50 万元，占当期营业收入的比例分别为 18.12%、4.47%和 2.93%，报告期内，公司管理费用金额总体较为稳定。公司的管理费用主要由职工薪酬、股份支付费用、固定资产折旧、使用权资产折旧、专业服务费等构成，前述五项合计占各期管理费用比例分别为 89.96%、83.61%和 86.35%。

### （1）职工薪酬

职工薪酬是管理费用最主要组成部分。报告期各期，公司管理费用中职工薪酬分别为 8,454.37 万元、15,116.88 万元和 21,282.32 万元，整体呈上升趋势，主要系随着公司生产经营规模扩大，行政管理人员人数及薪酬水平有所上升，致使对应的薪酬支出规模有所上涨。

## (2) 股份支付费用

公司于 2020 年对核心员工进行了持股安排，并于当期一次性确认股份支付费用 12,105.02 万元，此外 2021 年度，因人员变动公司于当期确认股份支付费用 266.50 万元。具体情况请参见本节之“九、经营成果分析”之“(六) 股份支付”。

## (3) 固定资产折旧及使用权资产折旧

报告期各期，公司管理费用中固定资产折旧分别为 2,320.42 万元、1,195.26 万元和 1,948.61 万元，在剔除股份支付费用影响因素后，占各期管理费用的比例分别为 15.17%、4.98%和 6.61%。

公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，将融资租入固定资产原值及累计折旧调整计入使用权资产原值及累计折旧，2021 年度及 2022 年度，公司管理费用中使用权资产折旧分别为 1,067.96 万元和 440.03 万元。

## (4) 专业服务费

公司管理费用中的专业服务费主要包括专利费用、管理系统维护费、人事服务费、审计及资产评估费用等。报告期各期，公司专业服务费分别为 1,774.02 万元、2,650.58 万元和 1,796.34 万元，随着公司规模持续增长，专业服务费规模整体呈上升趋势。

## (5) 管理费用率对比分析

报告期内，公司与可比公司管理费用率比较如下表所示：

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
台积电	2.36%	2.33%	2.12%
中芯国际	6.14%	4.61%	5.69%
华润微	未披露	4.77%	5.30%
华虹半导体	10.77%	12.20%	27.17%
联华电子	3.47%	3.75%	3.77%
世界先进	5.40%	5.30%	5.02%
平均	5.63%	5.49%	8.18%
晶合集成	2.93%	4.47%	18.12%



2020 年度，公司的管理费用率高于同行业可比公司平均水平，主要系公司正处于快速发展阶段，报告期初期收入规模相对较小，随着公司产能逐步释放、收入规模快速提高，管理费用率下降明显，2020 年剔除股份支付费用后，公司的管理费用率为 10.12%，与可比公司平均水平逐渐接近；2021 年度及 2022 年度，随着公司收入规模的快速扩大，公司管理费用率低于行业平均水平，不存在重大差异。

### 3、研发费用

#### (1) 研发费用的构成

报告期内，公司研发费用主要构成明细如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	51,725.21	60.35%	22,370.89	56.39%	9,478.43	38.74%
固定资产折旧	11,840.66	13.82%	9,250.98	23.32%	7,751.17	31.68%
无形资产摊销	6,184.71	7.22%	3,129.59	7.89%	2,111.55	8.63%
材料投入	6,121.00	7.14%	1,806.33	4.55%	1,753.12	7.17%
委托研究开发费	4,209.18	4.91%	895.35	2.26%	1,822.72	7.45%
研究测试费用	4,336.71	5.06%	1,423.48	3.59%	1,140.26	4.66%
专业服务费	198.27	0.23%	241.88	0.61%	107.72	0.44%
修缮费	393.52	0.46%	206.01	0.52%	37.31	0.15%
使用权资产折旧	144.40	0.17%	137.33	0.35%	-	-
其他	553.36	0.65%	206.66	0.52%	265.27	1.08%
<b>合计</b>	<b>85,707.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,668.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,467.56</b>	<b>100.00%</b>

公司高度重视产品研发及技术创新，不断提高研发投入规模，持续推动工艺技术的改善及先进制程产品的开发。报告期各期，公司研发费用分别为 24,467.56 万元、39,668.49 万元和 85,707.00 万元，呈稳步上升趋势，2022 年公司研发费用大幅增长，主要系公司持续增加研发投入，导致职工薪酬、材料投入等增加。公司研发费用主要包括职工薪酬、固定资产折旧、无形资产摊销、材料投入及委托研究开发费等，前述费用合计占各期研发费用的比例分别为 93.67%、94.41%和 93.44%。

#### ①职工薪酬

报告期各期，公司研发费用中的职工薪酬分别为 9,478.43 万元、22,370.89 万元和 51,725.21 万元，占当期研发费用的比例分别为 38.74%、56.39%和 60.35%。公司研发费用中的职工薪酬的增加主要是由于研发人员数量增加及薪酬水平提升所致。

#### ②固定资产折旧和无形资产摊销

报告期各期，公司研发费用中固定资产折旧和无形资产摊销合计金额分别为 9,862.72 万元、12,380.56 万元和 18,025.36 万元，整体呈上升趋势，主要系公司持续增加研发投入，陆续购置研发设备及软件，使得折旧摊销费用逐年上升。占当期研发费用的比例分别为 40.31%、31.21%和 21.03%，占比有所下降。

#### ③委托研究开发费

公司委托开发费主要为支付的 IP 授权费用以及委托专业机构进行的研究开发费用等。报告期各期，公司委托研究开发费用分别为 1,822.72 万元、895.35 万元和 4,209.18 万元，占各期研发费用的比例分别为 7.45%、2.26%和 4.91%，2022 年公司委托研究开发费大幅增加，主要系公司持续增加研发投入，使得委托外部机构的研究开发费有所上升。

#### ④研究测试费用

公司研究测试费用主要为产品测试改善发生的相关费用。报告期各期，公司研究测试费用分别为 1,140.26 万元、1,423.48 万元和 4,336.71 万元，占各期研发费用的比例分别为 4.66%、3.59%和 5.06%，整体有所上升。

#### ⑤材料投入

公司材料投入主要为研发过程中产生的直接及间接材料费用。报告期各期，公司材料投入分别为 1,753.12 万元、1,806.33 万元和 6,121.00 万元，占各期研发费用的比例分别为 7.17%、4.55%和 7.14%。2022 年度材料投入大幅增加，主要系公司持续增加研发投入，部分研发项目材料投入增长所致。

### (2) 研发费用率对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司研发费用率比较如下表所示：

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
台积电	7.21%	7.86%	8.18%

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
中芯国际	10.00%	11.56%	17.01%
华润微	未披露	7.71%	8.11%
华虹半导体	6.50%	5.28%	11.24%
联华电子	4.65%	6.07%	7.29%
世界先进	5.30%	4.89%	5.42%
平均	6.73%	7.23%	9.54%
晶合集成	8.53%	7.31%	16.18%

2020年度，公司的研发费用率高于同行业的平均水平，主要系公司处于快速发展阶段，收入规模较可比公司相对较低，同时公司高度重视研发工作，研发费用投入规模维持在较高水平。2021年度及2022年度，随着公司营业收入规模快速增长，公司研发费用率与可比公司平均水平相近，不存在重大差异。

### (3) 主要研发项目情况

#### ①截至2022年12月31日的主要研发费用情况

单位：万元

研发项目	项目整体预算	当期研发费用支出金额	累计支出	实施进度
55纳米铜制程研发	152,460.00	10,662.56	53,038.25	进行中
110纳米微控制器技术平台	16,043.00	662.68	14,422.92	进行中
145纳米低功耗高速显示驱动平台	2,800.00	1,513.70	2,616.83	进行中
110纳米高阶显示驱动芯片平台（新）	2,000.00	1,066.02	1,938.55	进行中
110纳米加强型微控制器技术平台	2,200.00	1,647.06	2,098.07	进行中
150纳米高压电源管理芯片	6,251.00	719.52	1,886.33	进行中
150纳米超高压电源管理芯片	2,137.00	1,339.31	1,870.41	进行中
55纳米触控与显示驱动整合技术平台	13,000.00	6,756.09	12,779.13	进行中
90纳米CMOS后照度图像传感器平台	32,345.00	8,835.71	10,888.50	进行中
90纳米液晶显示面板Mini-LED背光驱动平台	1,100.00	288.45	953.73	进行中
150纳米BCD电源管理芯片技术平台	3,100.00	2,217.49	2,993.09	进行中
150纳米VFPS指纹辨识芯片技术平台	1,200.00	973.66	1,100.11	进行中
150纳米手机高压电源管理芯片技术平台	4,800.00	2,768.30	4,614.48	进行中

研发项目	项目整体预算	当期研发费用支出金额	累计支出	实施进度
90 纳米 CMOS 前照度图像传感器平台	2,800.00	1,969.43	2,641.68	进行中
110 纳米车载显示驱动芯片技术平台	2,469.40	719.42	805.72	进行中
40 纳米 OLED 芯片工艺平台	130,217.30	14,389.15	14,852.93	进行中
55 纳米 CMOS 后照度图像传感器平台	19,500.00	4,117.94	5,858.01	进行中
55 纳米 OLED 显示驱动芯片技术平台	3,400.00	3,105.90	3,237.53	进行中
110 纳米高压电源管理芯片技术平台	1,869.40	1,506.85	1,603.61	进行中
28nm 高效能精简型芯片工艺平台	247,392.00	13,098.39	13,526.82	进行中
量子芯片联合实验室专案一	2,300.00	2,114.28	2,120.01	进行中
光罩研发项目	80,400.00	520.85	520.85	进行中
150nm 通用 PMIC 电源管理芯片技术平台	5,372.40	1,615.69	1,615.69	进行中
沟槽式功率半导体技术平台	1,289.40	846.02	846.02	进行中
90nmBCD 电源管理芯片技术平台	2,820.00	326.03	326.03	进行中
150 纳米大尺寸面板显示驱动芯片技术平台	1,600.00	1,467.84	1,467.84	进行中
150nm BCD 超高压电源管理芯片技术平台	895.00	193.36	193.36	进行中
150nm PMIC 手机高压电源管理芯片技术平台	2,518.00	35.91	35.91	进行中
110nm Micro OLED 芯片技术平台	722.60	112.58	112.58	进行中
90nm 40V-50V 电子纸显示驱动芯片工艺平台	633.00	116.81	116.81	进行中
<b>合计</b>	<b>735,634.50</b>	<b>85,707.00</b>	<b>161,081.80</b>	-

## ②截至 2021 年 12 月 31 日的主要研发费用情况

单位：万元

研发项目	项目整体预算	当期研发费用支出金额	累计支出	实施进度
55 纳米铜制程研发	152,460.00	18,241.18	42,375.69	进行中
110 纳米微控制器技术平台	16,043.00	1,021.66	11,234.23	进行中
110 纳米中高阶电子标签驱动芯片平台	373.00	31.47	371.88	已完成
145 纳米低功耗高速显示驱动平台	545.00	658.93	1,103.13	进行中
90 纳米 CMOS 图像传感器平台	3,667.00	4,405.69	6,556.45	已完成
110 纳米高阶显示驱动芯片平台（新）	590.00	464.27	872.53	进行中
110 纳米加强型微控制器技术平台	480.00	389.24	451.01	进行中
150 纳米高压电源管理芯片	6,251.00	1,116.54	1,166.81	进行中

研发项目	项目整体 预算	当期研发费用 支出金额	累计支出	实施进度
150 纳米超高压电源管理芯片	2,137.00	477.59	531.10	进行中
55 纳米触控与显示驱动整合技术平台	4,081.00	3,867.89	6,023.04	进行中
90 纳米 CMOS 后照度图像传感器平台	32,345.00	1,961.59	2,052.79	进行中
90 纳米液晶显示面板 Mini-LED 背光驱动平台	192.00	659.27	665.28	进行中
150 纳米 BCD 电源管理芯片技术平台	910.60	775.60	775.60	进行中
150 纳米 VFPS 指纹辨识芯片技术平台	594.80	126.45	126.45	进行中
150 纳米手机高压电源管理芯片技术平台	1,075.70	1,846.18	1,846.18	进行中
90 纳米 CMOS 前照度图像传感器平台	706.40	672.25	672.25	进行中
110 纳米车载显示驱动芯片技术平台	1,158.00	86.30	86.30	进行中
40 纳米 OLED 芯片工艺平台	97,118.30	463.78	463.78	进行中
55 纳米 CMOS 后照度图像传感器平台	19,500.00	1,740.07	1,740.07	进行中
55 纳米 OLED 显示驱动芯片技术平台	1,133.40	131.63	131.63	进行中
110 纳米高压电源管理芯片技术平台	1,619.40	96.76	96.76	进行中
28 纳米 OLED 芯片平台	204,536.60	428.43	428.43	进行中
量子芯片联合实验室专案一	101.00	5.73	5.73	进行中
<b>合计</b>	<b>547,618.20</b>	<b>39,668.50</b>	<b>79,777.12</b>	-

## ③截至 2020 年 12 月 31 日的主要研发费用情况

单位：万元

研发项目	项目整体 预算	当年研发费用 支出金额	累计支出	实施进度
55 纳米铜制程研发	152,460.00	15,417.75	24,134.51	进行中
110 纳米微控制器技术平台	16,043.00	2,263.53	12,738.58	进行中
150 纳米低功耗高速显示驱动平台	3,316.00	260.12	3,577.57	已完成
90 纳米非易失性闪存芯片开发	3,310.00	102.32	3,107.45	已完成
90 纳米触控与显示驱动整合技术平台	5,200.00	748.35	5,111.58	已完成
90 纳米高阶有机发光二极管驱动平台	755.00	87.28	200.51	已完成
110 纳米中高阶电子标签驱动芯片平台	373.00	177.43	340.41	进行中
110 纳米低功耗显示驱动平台	338.00	59.49	320.90	已完成
145 纳米低功耗高速显示驱动平台	545.00	374.36	444.20	进行中
90 纳米 CMOS 图像传感器平台	3,667.00	2,150.76	2,150.76	进行中
110 纳米高阶显示驱动芯片平台（新）	590.00	408.26	408.26	进行中

研发项目	项目整体 预算	当年研发费用 支出金额	累计支出	实施进度
110 纳米加强型微控制器技术平台	480.00	61.77	61.77	进行中
150 纳米高压电源管理芯片	6,251.00	50.27	50.27	进行中
150 纳米超高压电源管理芯片	2,137.00	53.51	53.51	进行中
55 纳米触控与显示驱动整合技术平台	4,081.00	2,155.15	2,155.15	进行中
90 纳米 CMOS 后照度图像传感器平台	32,345.00	91.20	91.20	进行中
90 纳米液晶显示面板 Mini-LED 背光驱动平台	192.00	6.01	6.01	进行中
<b>合计</b>	<b>232,083.00</b>	<b>24,467.56</b>	<b>54,952.64</b>	-

#### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用主要构成明细如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利息支出	28,180.39	20,740.43	28,601.02
减：利息收入	7,745.74	2,918.32	2,427.71
利息净支出	20,434.65	17,822.11	26,173.31
减：汇兑收益	27,458.14	14,346.43	-3,246.73
银行手续费	393.49	702.98	399.65
未确认融资费用摊销	13,206.08	7,830.91	4,893.16
长期薪酬财务费用	332.46	131.14	5.89
股权融资费用	-	-	1,769.58
<b>合计</b>	<b>6,908.54</b>	<b>12,140.71</b>	<b>36,488.32</b>

报告期各期，公司财务费用分别为 36,488.32 万元、12,140.71 万元和 6,908.54 万元，占当期营业收入的比例分别为 24.13%、2.24%和 0.69%。公司财务费用包括利息收支、汇兑损益、未确认融资费用摊销等。其中，未确认融资费用摊销主要系公司向合肥蓝科融资租赁厂房及配套厂务设备形成。

2021 年度，公司财务费用同比下降 24,347.61 万元，主要系汇兑收益增加及收到财政贴息所致。2022 年度，公司财务费用同比下降 5,232.17 万元，主要系受汇兑收益增加影响所致。

## （五）利润表其他主要项目分析

### 1、资产减值损失

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
存货跌价损失	30,661.33	405.75	1,238.24
无形资产减值损失	-	-	29,573.92
其他流动资产-应收退货成本减值损失	-	82.90	214.58
<b>合计</b>	<b>30,661.33</b>	<b>488.64</b>	<b>31,026.73</b>

报告期内，公司资产减值损失金额为 31,026.73 万元、488.64 万元和 30,661.33 万元，主要由存货跌价损失和无形资产减值损失构成。其中，无形资产减值损失主要系 2020 年度公司基于外部环境、产品结构规划调整等因素影响计提的无形资产减值准备；存货跌价损失描述参见本节之“十、资产质量分析”之“（一）公司资产结构分析”。

### 2、投资收益

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
理财产品投资收益	369.23	1,359.89	1,249.05
<b>合计</b>	<b>369.23</b>	<b>1,359.89</b>	<b>1,249.05</b>

最近三年，公司投资收益的金额分别为 1,249.05 万元、1,359.89 万元和 369.23 万元，均为购买理财产品所产生的收益。

### 3、其他收益

报告期内，公司其他收益的具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
递延收益摊销	9,379.71	7,032.96	6,205.30
直接计入当期损益的政府补助	1,410.09	1,971.92	2,010.75
<b>合计</b>	<b>10,789.79</b>	<b>9,004.88</b>	<b>8,216.06</b>

报告期内，公司其他收益的金额分别为 8,216.06 万元、9,004.88 万元和 10,789.79

万元，均为政府补助项目。其中，直接计入当期损益的政府补助的具体情况如下表所示：

单位：万元

补助项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度	与资产/收益相关
人才补贴	500.00	1,000.00	1,000.00	与收益相关
高管住房补贴	-	84.00	84.00	与收益相关
降低企业引进高科技人才成本资金	54.47	28.01	23.07	与收益相关
承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金-加工贸易物流补贴	-	65.20	83.91	与收益相关
合肥市外贸促进政策项目-物流补贴	195.00	218.31	250.20	与收益相关
集成电路产业政策资金-购买 IP 补助	300.00	-	300.00	与收益相关
稳定就业补贴	-	-	50.00	与收益相关
知识产权政策奖补	21.80	16.00	6.00	与收益相关
外经贸发展专项资金-国际认证、商标注册和专利申请费补贴	24.80	47.00	30.00	与收益相关
“三代” 税款手续费返还	106.97	83.84	112.66	与收益相关
失业保险费返还	-	-	35.46	与收益相关
稳岗补贴	82.76	55.55	35.46	与收益相关
首次认定高企及辅导费补贴	-	29.00	-	与收益相关
海峡两岸集成电路产业合作试验区展示馆补助	-	195.00	-	与收益相关
智能工厂奖补	-	100.00	-	与收益相关
企业购买省外先进技术成果补助	50.00	50.00	-	与收益相关
政策兑现科技保险补助	30.00			与收益相关
政策兑现合同转化与技术合同交易补助	10.00			与收益相关
新录入人员岗前技能培训	25.84			与收益相关
高质量发展政策知识产权专利授权奖补	8.45			与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,410.09</b>	<b>1,971.91</b>	<b>2,010.75</b>	<b>-</b>

#### 4、营业外收入

报告期内，公司营业外收入的明细如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------	---------



项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
与企业日常活动无关的政府补助	1,329.00	780.00	490.00
罚款收入	25.09	13.75	8.44
其他	80.73	14.02	49.17
<b>合计</b>	<b>1,434.82</b>	<b>807.77</b>	<b>547.61</b>

报告期内，公司的营业外收入金额分别为 547.61 万元、807.77 万元和 1,434.82 万元，主要由与企业日常活动无关的政府补助构成，具体情况如下表所示：

单位：万元

补助项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度	与资产相关/与收益相关
省人才资助奖补	60.00	30.00	35.00	与收益相关
集成电路产业政策资金-鼓励知识产权创造	-	-	100.00	与收益相关
集成电路产业政策资金-促进企业加速成长（企业上台阶奖励）	-	-	200.00	与收益相关
企业表彰-绿色发展奖	-	5.00	5.00	与收益相关
集成电路产业政策资金-企业上台阶奖励	-	-	50.00	与收益相关
创新型省份建设资金-R&D 经费支出“双百强”规上企业奖励	-	50.00	50.00	与收益相关
新站经贸发展局财政性奖励-一次性股改奖励	-	-	50.00	与收益相关
企业上市奖励	200.00	300.00	-	与收益相关
引进高层次人才奖补	165.00	165.00	-	与收益相关
企业直接融资省级财政奖励资金	-	120.00	-	与收益相关
支持企业挂牌上市奖励	-	50.00	-	与收益相关
技术合同交易额奖补	-	50.00	-	与收益相关
首次认定高新技术企业奖补	-	10.00	-	与收益相关
稳企增效政策奖补	334.00	-	-	与收益相关
制造业增产增收政策奖补	500.00	-	-	与收益相关
高质量发展政策-激励企业扩大规模	70.00	-	-	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,329.00</b>	<b>780.00</b>	<b>490.00</b>	<b>-</b>

## 5、营业外支出

报告期内，公司营业外支出的明细如下表所示：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
捐赠支出	5.54	-	-
非流动资产毁损报废损失	-	108.25	-
存货报废损失	-	487.20	6.60
其他	2.93	9.09	1.10
<b>合计</b>	<b>8.47</b>	<b>604.53</b>	<b>7.69</b>

报告期内，公司的营业外支出的金额分别为 7.69 万元、604.53 万元和 8.47 万元，主要为非流动资产毁损报废损失和存货报废损失等。2021 年度因生产电压不稳导致部分批次产品报废，公司将该部分产品报废处理，使得当期产生了较大金额的存货报废损失。

### （六）股份支付

2020 年 9 月，公司实施了员工持股计划，设立合肥晶焮、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶愆、合肥晶辽、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶炯、合肥晶雄、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶确、合肥晶遂、合肥晶铁及合肥晶妥共 15 个员工持股平台，合计持有本公司 13,100.00 万元出资额的股权，对应股改后股份公司 2,216.21 万股股份，占公司总股本的 1.4729%。2020 年 9 月公司引入外部投资者，故以该次增资的投前估值为计算股份支付的公允价值作为参考依据，在 2020 年当期一次性确认股份支付费用 12,105.02 万元并计入管理费用。2021 年度，因人员变动公司于当期确认股份支付费用 266.50 万元。员工持股计划的具体内容请参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排”。

### （七）主要税种的纳税情况

报告期内，公司主要税种的纳税情况如下：

#### 1、企业所得税

单位：万元

期 间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2022 年度	17.50	20.80	19.39	18.90
2021 年度	-36.43	43.10	-10.83	17.50
2020 年度	57.48	12.90	106.81	-36.43

注：上表为合并口径数据，各子公司报告期期末未交企业所得税负数财务报表中由应交税费改列至其他流动资产。

报告期内，公司企业所得税缴纳金额较低，主要系 2020 年及 2021 年公司主要经营主体存在未弥补亏损，无需缴纳企业所得税。2022 年，根据《国家发展改革委工业和信息化部财政部海关总署税务总局关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2022〕390 号）规定：企业可依据税务有关管理规定，先行按照企业条件和项目标准享受相关国内税收优惠政策。

公司结合实际情况对税收优惠政策中所列的要求逐项对比分析，判断预计很可能享受五免五减半的税收优惠政策，公司已提出申请，2022 年度作为五免五减半的第一年依据上述税收优惠政策享受所得税减免。

## 2、增值税

单位：万元

期 间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2022 年度	-8,798.61	2,719.67	-	-6,078.94
2021 年度	-5,553.19	-3,245.43	-	-8,798.61
2020 年度	-3,504.41	-2,048.78	-	-5,553.19

注：1、上表为合并口径数据，各子公司报告期期末未交增值税负数财务报表中由应交税费改列至其他流动资产；2、本期应交数计算方式为“本期销项税+本期进项税额转出+本期收到的增值税留抵退税款-本期进项税额”。

2020 年及 2021 年，公司增值税期末未交数为负数，主要系公司待抵扣及待认证增值税进项税较高所致，2022 年度，当期应交数由负转正，主要系公司收到增值税留抵退税款增加所致。

## 十、资产质量分析

### （一）公司资产结构分析

#### 1、资产的构成及变化

报告期各期末，本公司的资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	789,459.69	20.37%	529,554.59	16.93%	446,438.12	28.54%
交易性金融资产	125,716.00	3.24%	-	-	-	-
应收账款	50,667.24	1.31%	94,885.27	3.03%	26,522.01	1.70%
预付款项	6,320.88	0.16%	19,672.07	0.63%	970.68	0.06%
其他应收款	1,773.95	0.05%	1,478.52	0.05%	461.00	0.03%
存货	102,165.32	2.64%	78,700.55	2.52%	38,579.42	2.47%
其他流动资产	7,746.84	0.20%	9,705.58	0.31%	5,606.08	0.36%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,083,849.92</b>	<b>27.96%</b>	<b>733,996.58</b>	<b>23.47%</b>	<b>518,577.30</b>	<b>33.15%</b>
其他权益工具投资	2,910.73	0.08%	-	-	-	-
其他非流动金融资产	30,173.32	0.78%	-	-	-	-
固定资产	2,143,736.82	55.30%	1,632,598.75	52.21%	776,607.78	49.65%
在建工程	138,504.36	3.57%	332,905.83	10.65%	139,070.50	8.89%
使用权资产	286,605.89	7.39%	299,481.09	9.58%	-	-
无形资产	143,392.28	3.70%	125,422.67	4.01%	129,948.64	8.31%
长期待摊费用	33.80	0.00%	58.73	0.00%	-	-
其他非流动资产	47,250.33	1.22%	2,763.82	0.09%	29.02	0.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,792,607.53</b>	<b>72.04%</b>	<b>2,393,230.89</b>	<b>76.53%</b>	<b>1,045,655.94</b>	<b>66.85%</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,876,457.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,127,227.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,564,233.24</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 1,564,233.24 万元、3,127,227.47 万元和 3,876,457.45 万元。其中，流动资产占比分别为 33.15%、23.47%和 27.96%，非流动资产占比分别为 66.85%、76.53%和 72.04%。报告期内，随着业务规模持续扩大，公司资产总额呈上升趋势。

2021 年年末，公司资产总额为 3,127,227.47 万元，较 2020 年末增加 1,562,994.23

万元，为顺应下游产品需求快速增长的行业趋势，2021年度公司持续购置生产设备以扩充产能，使得当年末固定资产及在建工程同比增长较大，同时2021年度公司产品需求快速增长，收到的客户产能保证金规模大幅增加，综合导致公司资产规模同比大幅增长。2022年末，随着公司经营规模不断扩大，货币资金、固定资产等规模持续增加，导致资产总额较2021年末增加749,229.99万元。

## 2、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产的具体构成如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	789,459.69	72.84%	529,554.59	72.15%	446,438.12	86.09%
交易性金融资产	125,716.00	11.60%	-	-	-	-
应收账款	50,667.24	4.67%	94,885.27	12.93%	26,522.01	5.11%
预付款项	6,320.88	0.58%	19,672.07	2.68%	970.68	0.19%
其他应收款	1,773.95	0.16%	1,478.52	0.20%	461.00	0.09%
存货	102,165.32	9.43%	78,700.55	10.72%	38,579.42	7.44%
其他流动资产	7,746.84	0.71%	9,705.58	1.32%	5,606.08	1.08%
流动资产合计	1,083,849.92	100.00%	733,996.58	100.00%	518,577.30	100.00%

报告期各期末，公司流动资产金额分别为518,577.30万元、733,996.58万元和1,083,849.92万元，占各期末公司资产总额的比例分别为33.15%、23.47%和27.96%，公司流动资产规模呈上升趋势，但占比有所波动。报告期内，公司流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、预付账款、其他应收款、存货及其他流动资产，具体情况分析如下：

### (1) 货币资金

报告期各期末，公司的货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	-	-	-
银行存款	773,633.74	414,505.58	110,067.71
其他货币资金	15,825.96	115,049.01	336,370.41

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
合计	789,459.69	529,554.59	446,438.12

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 446,438.12 万元、529,554.59 万元和 789,459.69 万元，占各期末流动资产比例分别为 86.09%、72.15%和 72.84%。公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金。2021 年末货币资金较 2020 年末增加 83,116.47 万元，主要系随着公司产品需求的快速增长，2021 年度收到客户产能保证金较多所致。2022 年末货币资金较 2021 年末增加 259,905.11 万元，主要原因为子公司新晶集成收到少数股东投资款。

报告期各期末，公司其他货币资金主要包括押汇保证金、信用证保证金、保函保证金，主要为公司采购进口设备开具的信用证保证金和海关通关所缴纳的保函保证金。

## (2) 交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,716.00	-	-
其中：结构性存款投资	95,660.27	-	-
可转让大额存单	30,055.73	-	-
合计	125,716.00	-	-

2020 年末及 2021 年末，公司未有交易性金融资产。2022 年末，公司交易性金融资产账面价值为 125,716.00 万元，占当年流动资产比例为 11.60%，主要为公司为提高闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购入的保本浮动收益型结构性存款及可转让大额存单。

## (3) 应收账款

### ①应收账款规模与变动情况分析

报告期各期末，应收账款账面价值分别为 26,522.01 万元、94,885.27 万元和 50,667.24 万元，占各期末流动资产的比例分别为 5.11%、12.93%和 4.67%，公司应收

账款规模随着公司业务规模的扩大而有所增加。

公司应收账款构成情况及应收账款账面余额占营业收入比例的变动情况如下所示：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款账面余额	50,874.52	94,885.30	26,522.01
坏账准备	207.29	0.03	-
应收账款账面价值	50,667.24	94,885.27	26,522.01
营业收入	1,005,094.86	542,900.93	151,237.05
应收账款账面余额占营业收入比例	5.06%	17.48%	17.54%
应收账款增长率	-46.60%	257.76%	146.68%
营业收入增长率	85.13%	258.97%	183.26%

最近三年末，公司应收账款余额占营业收入比例分别为 17.54%、17.48%和 5.06%，整体呈下降趋势，主要系公司在营业收入快速增长的同时加大应收账款回款力度所致。

公司最近三年内应收账款增长率分别为146.68%、257.76%、-46.60%，营业收入增长率分别为183.26%、258.97%、85.13%。2021年末，公司应收账款期末余额随着营业收入规模的扩张而增长，应收账款的增长与营业收入增长情况相匹配；2022年末，公司在全年营业收入增长的同时，应收账款余额下降，主要系公司第四季度受市场景气度影响收入规模及占比有所下降。

## ②应收账款账龄和坏账准备的计提情况

报告期各期末，公司应收账款账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	50,874.52	94,885.30	26,522.01
小计	50,874.52	94,885.30	26,522.01
减：坏账准备	207.29	0.03	-
合计	50,667.24	94,885.27	26,522.01

公司应收账款质量较高，账龄均位于一年以内，应收账款对应的主要客户信用良好。报告期内，公司制定了稳健的坏账准备计提政策，并已按会计准则要求及时足额

计提坏账准备。

### ③公司应收账款前五名情况

报告期各期末，公司应收账款前五名客户具体情况如下：

单位：万元

2022年12月31日			
序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例
1	联咏科技股份有限公司	15,739.26	30.94%
2	深圳天德钰科技股份有限公司	9,133.15	17.95%
3	深圳市爱协生科技股份有限公司	6,865.76	13.50%
4	合肥奕斯伟计算技术有限公司	2,056.02	4.04%
5	合肥豪迪微电子有限公司	1,904.47	3.74%
合计		<b>35,698.67</b>	<b>70.17%</b>
2021年12月31日			
序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例
1	联咏科技股份有限公司	31,772.88	33.49%
2	北京集创北方科技股份有限公司	18,785.64	19.80%
3	奇景光电股份有限公司	8,965.66	9.45%
4	思特威（合肥）电子科技有限公司	6,724.91	7.09%
5	敦泰电子股份有限公司	5,950.67	6.27%
合计		<b>72,199.76</b>	<b>76.09%</b>
2020年12月31日			
序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例
1	联咏科技股份有限公司	19,594.94	73.88%
2	集创北方（香港）有限公司	3,278.23	12.36%
3	合肥捷达微电子有限公司	1,717.11	6.47%
4	奇景光电股份有限公司	841.66	3.17%
5	NewVisionMicro. (HK) Limited	365.52	1.38%
合计		<b>25,797.46</b>	<b>97.26%</b>

报告期各期末，公司应收账款前五名客户应收账款余额占比分别为 97.26%、76.09%和 70.17%，应收账款余额集中度整体较高但报告期内呈下降趋势。



## ④公司应收账款信用政策

公司对主要客户的信用政策评定综合考虑业务部门评估及财务部门评估两方面，业务部门根据客户的市场占有率、产品市场竞争力、对公司产能贡献率综合评判提出授信额度，财务部门根据客户提供的经审计财务报表/盖章财务报表，计算客户短期偿债能力、盈利能力等关键指标，并根据计算指标进行评分，经综合评估后确定客户信用政策。

报告期内，发行人主要客户销售情况及对应信用政策列示如下：

单位：万元

客户名称	收入金额（万元）			信用政策		
	2022年度	2021年度	2020年度	2022年度	2021年度	2020年度
联咏科技股份有限公司	166,546.87	168,073.68	77,864.57	月结 45 天	月结 45 天	月结 60 天
集创北方及其关联方	155,500.65	102,416.75	15,044.35	月结 30 天	月结 30 天	月结 30 天
合肥捷达微电子有限公司及其关联方	71,944.93	42,302.46	13,464.36	月结 30 天	月结 30 天	月结 30 天、月结 45 天
奇景光电股份有限公司	28,597.70	30,732.84	14,872.50	月结 45 天	月结 45 天	月结 60 天
奕力科技股份有限公司	104,361.61	37,281.71	14,558.70	月结 30 天	月结 30 天	月结 30 天
思特威（合肥）电子科技有限公司及其关联方	110,604.95	29,993.63	94.25	月结 30 天	月结 30 天	月结 30 天

由上表可见，报告期内发行人对主要客户的信用政策未发生重大变化。

## ⑤公司应收账款期后回款及坏账风险分析

报告期内，公司应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款账面余额	50,874.52	94,885.30	26,522.01
期后回款金额（截至2023年3月24日）	49,082.27	94,885.30	26,522.01
期后回款比例	96.48%	100.00%	100.00%

截至 2023 年 3 月 24 日，公司报告期各期末应收账款回款情况良好，不存在较大

坏账风险。

#### (4) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1年以内	6,320.65	100.00%	19,672.07	100.00%	969.59	99.89%
1至2年	0.24	0.00%	-	-	1.08	0.11%
合计	<b>6,320.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,672.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>970.68</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司预付款项金额分别为 970.68 万元、19,672.07 万元和 6,320.88 万元，占各期末流动资产比例分别为 0.19%、2.68%和 0.58%，金额及占比相对较低。公司预付款项主要为预付供应商的款项。

#### (5) 其他应收款项

报告期各期末，公司其他应收款项构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,773.95	1,478.52	461.00
合计	<b>1,773.95</b>	<b>1,478.52</b>	<b>461.00</b>

报告期各期末，公司其他应收款项的账面价值分别为 461.00 万元、1,478.52 万元和 1,773.95 万元，占各期末流动资产的比例分别为 0.09%、0.20%和 0.16%，金额及占比相对较低。

##### ①其他应收款明细情况

报告期各期末，其他应收款余额主要包括押金及保证金、员工借款和应收退税款等。具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收退税款	1,002.05	644.06	15.63
押金及保证金	404.23	194.14	228.71
员工借款及备用金	352.64	163.32	214.17
其他	15.82	502.11	2.61
<b>小计</b>	<b>1,774.74</b>	<b>1,503.63</b>	<b>461.13</b>
减：坏账准备	0.79	25.11	0.13
<b>合计</b>	<b>1,773.95</b>	<b>1,478.52</b>	<b>461.00</b>

报告期各期末，押金及保证金金额分别为 228.71 万元、194.14 万元和 404.23 万元，主要系公司为员工租赁宿舍支付的保证金；员工借款及备用金分别为 214.17 万元、163.32 万元和 352.64 万元，主要系员工借支的子女教育费、返乡、租房等款项，该等款项均已按照公司内控管理制度履行了必要的审批程序；2021 年末公司其他应收款中其他项目主要为尚未收到的保险公司关于被投保机器设备损坏的赔付款。

## ②账龄及坏账准备情况

报告期各期末，公司其他应收款账龄及坏账准备情况具体如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	1,703.08	1,359.42	272.40
1至2年	16.93	40.00	83.75
2至3年	40.00	6.74	10.25
3年以上	14.73	97.46	94.72
<b>小计</b>	<b>1,774.74</b>	<b>1,503.63</b>	<b>461.13</b>
减：坏账准备	0.79	25.11	0.13
其他应收款净额	1,773.95	1,478.52	461.00

## (6) 存货

### ①存货构成情况分析

报告期各期末，公司存货账面价值具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	45,586.93	44.62%	29,970.08	38.08%	18,583.93	48.17%
在产品	44,963.50	44.01%	47,784.88	60.72%	19,081.18	49.46%
库存商品	10,871.03	10.64%	876.50	1.11%	793.32	2.06%
发出商品	743.87	0.73%	69.09	0.09%	120.98	0.31%
<b>合计</b>	<b>102,165.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>78,700.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,579.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 38,579.42 万元、78,700.55 万元和 102,165.32 万元，占各期末流动资产比例分别为 7.44%、10.72%和 9.43%。公司存货包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。报告期内，公司存货账面价值整体呈稳定上升趋势，主要系公司产销量持续增长，业务规模持续扩大，生产和研发所需的原材料备货规模和处于生产过程中的在产品规模相应增长。

## ②存货跌价准备分析

报告期各期末，公司存货账面余额及存货跌价准备的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	跌价计提比例
原材料	58,539.91	12,952.98	45,586.93	22.13%
在产品	61,439.87	16,476.38	44,963.50	26.82%
库存商品	13,108.06	2,237.03	10,871.03	17.07%
发出商品	1,782.64	1,038.77	743.87	58.27%
<b>合计</b>	<b>134,870.49</b>	<b>32,705.17</b>	<b>102,165.32</b>	<b>24.25%</b>
项目	2021年12月31日			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	跌价计提比例
原材料	30,320.14	350.07	29,970.08	1.15%
在产品	47,869.51	84.63	47,784.88	0.18%
库存商品	2,757.24	1,880.73	876.50	68.21%
发出商品	69.09	-	69.09	-
<b>合计</b>	<b>81,015.98</b>	<b>2,315.43</b>	<b>78,700.55</b>	<b>2.86%</b>

项目	2020年12月31日			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	跌价计提比例
原材料	18,768.87	184.94	18,583.93	0.99%
在产品	20,616.94	1,535.76	19,081.18	7.45%
库存商品	2,630.57	1,837.24	793.32	69.84%
发出商品	122.38	1.40	120.98	1.15%
<b>合计</b>	<b>42,138.75</b>	<b>3,559.33</b>	<b>38,579.42</b>	<b>8.45%</b>

报告期各期末，公司按照原材料、在产品、库存商品和发出商品等分类对期末存货进行了减值测试。公司在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益，公司根据不同存货的情况确认其可变现净值，可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法参见本节之“六、重要会计政策和会计估计”之“(十) 存货”相关内容。

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为 8.45%、2.86%和 24.25%。2020 年末及 2021 年末，随着下游市场产品需求的持续增长，公司产品整体售价有所提升，同时公司产销量迅速增长，规模效应显现使得单位产品所分摊固定成本有所下降，使得存货跌价计提比例整体较低。2022 年末，公司存货跌价准备计提比例增长，主要系受公司产能利用率下降等原因影响，导致存货可变现净值降低所致。

### (7) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
待抵扣及待认证增值税进项税	6,078.94	8,798.61	5,553.19
上市费用	1,649.53	886.04	-
预缴税费	16.17	16.90	46.00
其他	2.19	4.03	6.89
应收退货成本	-	82.90	214.58
<b>小计</b>	<b>7,746.84</b>	<b>9,788.48</b>	<b>5,820.65</b>
应收退货成本减值	-	82.90	214.58
<b>合计</b>	<b>7,746.84</b>	<b>9,705.58</b>	<b>5,606.08</b>

报告期各期末，公司其他流动资产账面金额分别为 5,606.08 万元、9,705.58 万元和 7,746.84 万元，占各期末流动资产的比例分别为 1.08%、1.32%和 0.71%，主要包括待抵扣进项税额和上市费用等。

报告期各期末，公司待抵扣进项税额较大，主要包括：①公司支付设备等长期资产的安装服务费用所形成的待抵扣进项税额；②根据公司与合肥蓝科签订的融资租赁协议，公司每期支付给合肥蓝科相关融资租赁厂房及配套厂务设备租金而形成的待抵扣进项税额。

### 3、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产的具体构成如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他权益工具投资	2,910.73	0.10%	-	-	-	-
其他非流动金融资产	30,173.32	1.08%	-	-	-	-
固定资产	2,143,736.82	76.76%	1,632,598.75	68.22%	776,607.78	74.27%
在建工程	138,504.36	4.96%	332,905.83	13.91%	139,070.50	13.30%
使用权资产	286,605.89	10.26%	299,481.09	12.51%	-	-
无形资产	143,392.28	5.13%	125,422.67	5.24%	129,948.64	12.43%
长期待摊费用	33.80	0.00%	58.73	0.00%	-	-
其他非流动资产	47,250.33	1.69%	2,763.82	0.12%	29.02	0.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,792,607.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,393,230.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,045,655.94</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 1,045,655.94 万元、2,393,230.89 万元和 2,792,607.53 万元，占各期末资产总额的比例分别为 66.85%、76.53%和 72.04%，公司非流动资产规模呈增长趋势。报告期内，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等构成。

#### (1) 固定资产

##### ①生产线情况

公司目前拥有两条 12 英寸晶圆代工生产线，生产线核心设备包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等，可适用 DDIC 及其他工艺平台晶圆代工，与生产工艺相匹配，截至

2022年末公司机器设备成新率为80.39%，整体成新率较高。报告期内，公司资本性支出主要为生产线设备购置等支出。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合计分别为49.02亿元、99.77亿元和68.90亿元。

## ②固定资产构成情况分析

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

固定资产类别	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
房屋及建筑物	3,902.22	2,653.02	164,395.89
机器设备	2,126,441.03	1,618,943.07	608,864.61
运输工具	-	0.07	0.21
电子设备及其他	13,393.57	11,002.59	3,347.06
<b>合计</b>	<b>2,143,736.82</b>	<b>1,632,598.75</b>	<b>776,607.78</b>

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为776,607.78万元、1,632,598.75万元和2,143,736.82万元，占各期末非流动资产的比例分别为74.27%、68.22%和76.76%，公司固定资产规模逐年增加，主要系随着生产规模的扩大，公司新购置机器设备所致。

截至2022年12月31日，公司固定资产的成新率如下：

单位：万元

固定资产类别	固定资产原值	折旧年限	固定资产净值	成新率
房屋及建筑物	4,353.82	20-30年	3,902.22	89.63%
机器设备	2,635,523.87	5-10年	2,126,441.03	80.68%
运输工具	273.88	4年	-	0.00%
电子设备及其他	26,406.67	3-5年	13,393.57	50.72%
<b>合计</b>	<b>2,666,558.24</b>	<b>-</b>	<b>2,143,736.82</b>	<b>80.39%</b>

截至2022年末，公司固定资产原值为2,666,558.24万元，累计折旧金额为522,821.42万元，固定资产净值为2,143,736.82万元，综合成新率为80.39%，相对较高。公司于资产负债表日对各项固定资产进行减值测试，经测试未发现减值迹象，未计提减值准备。

## ③融资租赁租入的固定资产情况

单位：万元

固定资产类别	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
房屋及建筑物	-	-	161,909.47
电子设备及其他	-	-	80.53
<b>合计</b>	-	-	<b>161,990.00</b>

2020年末，公司融资租入固定资产账面价值为161,990.00万元，主要为根据公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》所租入的厂房及配套厂务设备。

公司于2021年1月1日执行新租赁准则，将融资租入固定资产原值及累计折旧调整计入使用权资产原值及累计折旧，具体情况参见本节之“六、重要会计政策和会计估计”之“(二十八)重要会计政策、会计估计的变更”相关内容。

#### ④固定资产折旧政策及同行业比较分析

报告期内，公司与同行业可比公司的固定资产折旧政策比较情况如下：

单位：年

	发行人	台积电	联华电子	世界先进	中芯国际	华虹半导体	华润微
房屋及建筑物	20-30	10-20	7-56	20	25	25	25
机器设备	5-10	5	6-9	3-5	5-10	5-10	8
运输工具	4	未披露	5-7	未披露	未披露	未披露	5
电子设备及其他	3-5	5	1-9	3-7	3-5	5	3-5

注：华虹半导体折旧政策系根据其2019年度审计报告披露的折旧率匡算。

由上表所示，公司主要固定资产折旧年限与同行业可比公司基本一致，符合所处行业生产经营的特点。

## (2) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
在建工程	138,504.36	332,905.83	139,070.50
工程物资	-	-	-
<b>合计</b>	<b>138,504.36</b>	<b>332,905.83</b>	<b>139,070.50</b>



报告期各期末，公司在建工程余额分别为 139,070.50 万元、332,905.83 万元和 138,504.36 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 13.30%、13.91%和 4.96%，主要为公司新购置待安装机台设备，2022 年末在建工程余额较 2021 年末有所减少，主要系当期部分在安装设备完工达到预定可使用状态进而转入固定资产所致。

报告期内，公司主要在建工程变动情况如下：

单位：万元

2022 年度						
项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少	期末余额
在安装设备	-	332,905.83	551,910.12	746,311.58	-	138,504.36
合计	-	<b>332,905.83</b>	<b>551,910.12</b>	<b>746,311.58</b>	-	<b>138,504.36</b>
2021 年度						
项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少	期末余额
在安装设备	-	139,070.50	1,319,998.20	1,126,162.87	-	332,905.83
合计	-	<b>139,070.50</b>	<b>1,319,998.20</b>	<b>1,126,162.87</b>	-	<b>332,905.83</b>
2020 年度						
项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少	期末余额
在安装设备	-	40,327.46	230,302.97	131,559.93	-	139,070.50
合计	-	<b>40,327.46</b>	<b>230,302.97</b>	<b>131,559.93</b>	-	<b>139,070.50</b>

报告期各期末，公司在建工程未发生减值情形，故未计提减值准备。

### (3) 使用权资产

报告期各期，公司使用权资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
土地使用权	6,824.17	7,081.68	-
房屋及建筑物	279,781.72	292,372.56	-
电子设备及其他	-	26.84	-
合计	<b>286,605.89</b>	<b>299,481.09</b>	-

2021 年末及 2022 年末，公司使用权资产账面价值分别为 299,481.09 万元和 286,605.89 万元，占各期末非流动资产比例分别为 12.51%和 10.26%。报告期内，公司使用权资产主要为土地使用权、房屋及建筑物和电子设备及其他等。

报告期内，公司使用权资产的折旧、减值情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
使用权资产原值	334,628.81	334,100.98	-
累计折旧	48,022.92	34,619.90	-
减值准备	-	-	-
账面价值	286,605.89	299,481.09	-

#### (4) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
专利权及非专利技术	111,494.39	105,763.98	119,404.95
软件及其他	31,897.88	19,658.69	10,543.68
<b>合计</b>	<b>143,392.28</b>	<b>125,422.67</b>	<b>129,948.64</b>

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 129,948.64 万元、125,422.67 万元和 143,392.28 万元，占各期末非流动资产比例分别为 12.43%、5.24%和 5.13%。报告期内，公司无形资产主要为专利权、非专利技术及生产经营相关软件等。

报告期内，公司无形资产的摊销、减值情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
无形资产原值	273,099.98	233,378.30	219,743.06
累计摊销	100,133.78	78,381.71	60,220.50
减值准备	29,573.92	29,573.92	29,573.92
账面价值	143,392.28	125,422.67	129,948.64

2020 年度，受外部环境、产品结构规划调整等因素影响，公司无形资产计提减值

准备 29,573.92 万元。

### (5) 长期待摊费用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
装修费支出	33.80	58.73	-
<b>合计</b>	<b>33.80</b>	<b>58.73</b>	<b>-</b>

报告期内，公司长期待摊费用主要为房屋装修费支出。

### (6) 其他非流动资产

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
预付长期资产购置款	25,339.89	2,532.49	29.02
待验软件	3,038.88	231.33	-
预付产能保证金	18,871.55	-	-
<b>合计</b>	<b>47,250.33</b>	<b>2,763.82</b>	<b>29.02</b>

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 29.02 万元、2,763.82 万元和 47,250.33 万元，公司的其他非流动资产主要为预付长期资产购置款和预付产能保证金。2021 年末及 2022 年末，公司其他非流动资产较上期末大幅增长，主要系预付长期资产购置款及预付产能保证金增加所致。

## (二) 资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款、存货和总资产周转率情况如下：

单位：次/年

项目	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率	13.79	8.94	8.11
存货周转率	5.01	4.84	4.28
总资产周转率	0.29	0.23	0.11

注：上述资产周转率指标计算公式如下：

- 1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 2、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 3、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

**(1) 应收账款周转率分析**

报告期内，公司可比公司应收账款周转率对比情况如下：

单位：次/年

公司名称	应收账款周转率		
	2022年度	2021年度	2020年度
台积电	10.58	9.25	9.35
中芯国际	10.74	9.74	8.83
华润微	未披露	9.26	7.43
华虹半导体	10.40	12.93	6.34
联华电子	7.80	6.90	6.56
世界先进	7.57	6.08	6.19
平均	9.42	9.03	7.45
晶合集成	13.79	8.94	8.11

最近三年，公司应收账款周转率分别为 8.11 次/年、8.94 次/年和 13.79 次/年，呈上升趋势，主要系报告期内，公司经营规模扩大，营业收入快速增长，同时严格执行应收账款管理制度，应收账款整体规模的增速低于营业收入的增速，使得公司应收账款周转率逐年提升，逐渐高于可比公司平均水平。

**(2) 存货周转率分析**

报告期内，公司与可比公司存货周转率对比情况如下：

单位：次/年

公司名称	存货周转率		
	2022年度	2021年度	2020年度
台积电	4.37	4.65	5.70
中芯国际	2.79	3.56	3.61
华润微	未披露	3.63	3.55
华虹半导体	3.23	3.39	3.65
联华电子	5.66	6.19	6.23
世界先进	5.60	6.98	7.08
平均	4.33	4.73	4.97
晶合集成	5.01	4.84	4.28

最近三年，公司存货周转率分别为 4.28 次/年、4.84 次/年和 5.01 次/年，呈上升趋势。公司存货周转率与可比公司相比不存在较大差异。

### (3) 总资产周转率分析

报告期内，公司与同行业可比公司总资产周转率对比情况如下：

单位：次/年

公司名称	总资产周转率		
	2022年度	2021年度	2020年度
台积电	0.52	0.49	0.53
中芯国际	0.19	0.16	0.47
华润微	0.41	0.48	0.52
华虹半导体	0.37	0.30	0.23
联华电子	0.56	0.52	0.47
世界先进	0.62	0.80	0.77
平均	0.45	0.46	0.50
晶合集成	0.29	0.23	0.11

2020 年度，公司总资产周转率为 0.11 次/年。公司作为晶圆代工厂商，资本性支出金额较大，报告期初处于产能爬坡阶段，营业收入规模较小，导致总资产周转率偏低。后续随着公司产销规模的快速增长，公司总资产周转率呈快速上升趋势。2021 年度和 2022 年度，公司总资产周转率分别为 0.23 次/年和 0.29 次/年，继续维持上升趋势。

## 十一、偿债能力与流动性分析

### (一) 公司负债分析

#### 1、负债的构成及变化

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	28,707.38	1.39%	251,238.43	11.75%	-	-
应付账款	92,624.54	4.47%	248,762.98	11.63%	111,378.59	13.13%

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预收款项	-	-	-	-	-	-
合同负债	83,269.44	4.02%	133,576.77	6.25%	6,659.20	0.78%
应付职工薪酬	36,824.90	1.78%	18,523.43	0.87%	1,277.33	0.15%
应交税费	6,959.17	0.34%	3,272.96	0.15%	1,576.16	0.19%
其他应付款	593,769.36	28.66%	577,317.53	27.00%	17,791.27	2.10%
一年内到期的非流动负债	71,085.57	3.43%	65,410.15	3.06%	18,621.86	2.19%
其他流动负债	7,894.40	0.38%	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>921,134.76</b>	<b>44.47%</b>	<b>1,298,102.24</b>	<b>60.71%</b>	<b>157,304.41</b>	<b>18.54%</b>
长期借款	822,687.19	39.72%	517,685.91	24.21%	484,879.07	57.15%
租赁负债	196,500.35	9.49%	208,884.44	9.77%	-	-
长期应付款	-	-	-	-	92,931.22	10.95%
长期应付职工薪酬	3,996.70	0.19%	2,630.64	0.12%	1,139.37	0.13%
预计负债	-	-	84.71	0.00%	274.87	0.03%
递延收益	127,142.23	6.14%	110,970.53	5.19%	111,910.87	13.19%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,150,326.46</b>	<b>55.53%</b>	<b>840,256.23</b>	<b>39.29%</b>	<b>691,135.40</b>	<b>81.46%</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,071,461.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,138,358.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>848,439.81</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司负债主要包括应付账款、长期借款、长期应付款及递延收益等。报告期各期末，公司负债总额分别为 848,439.81 万元、2,138,358.47 万元和 2,071,461.22 万元。

## 2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债主要包括短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款和一年内到期的非流动负债，合计占流动负债比例分别为 98.19%、98.32%和 94.39%，具体情况如下：

### (1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款的明细情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
质押借款	-	20,867.24	-

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
信用借款	28,707.38	230,371.19	-
合计	<b>28,707.38</b>	<b>251,238.43</b>	-

截至2021年末及2022年末，公司短期借款分别为251,238.43万元和28,707.38万元。公司出于生产经营需要，根据资金使用安排于当期借入一定金额的短期借款。

## (2) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款的明细情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付设备工程和软件款	56,812.72	194,958.44	91,013.55
应付货款	12,451.10	18,236.93	11,232.01
应付其他款项	23,360.71	35,567.61	9,133.03
合计	<b>92,624.54</b>	<b>248,762.98</b>	<b>111,378.59</b>

报告期各期末，公司应付账款账面价值分别为111,378.59万元、248,762.98万元和92,624.54万元，主要为采购生产机台设备及材料货款，2021年末应付账款金额整体呈上升趋势，主要系公司产能扩充购买机器设备所致。2022年末，应付账款金额整体呈下降趋势，主要系公司逐步支付应付设备工程和软件款所致。

报告期各期末，按应付对象归集的余额前五名的应付账款情况如下：

单位：万元

2022年12月31日			
序号	单位名称	账面余额	占应付账款余额的比例
1	Nikon Corporation	29,790.46	32.16%
2	IMEC vzw	5,986.21	6.46%
3	国网安徽省电力有限公司合肥供电公司	3,575.09	3.86%
4	Applied Materials South East Asia	3,017.02	3.26%
5	北京北方华创微电子装备有限公司	2,907.17	3.14%
合计		<b>45,275.95</b>	<b>48.88%</b>
2021年12月31日			

序号	单位名称	账面余额	占应付账款余额的比例
1	AppliedMaterialsSouthEastAsia	37,835.39	15.21%
2	NikonCorporation	25,284.37	10.16%
3	TokyoElectronLimited	24,952.31	10.03%
4	LamResearchInternationalSarl	13,631.11	5.48%
5	海程邦达国际物流有限公司	12,887.30	5.18%
合计		<b>114,590.48</b>	<b>46.06%</b>
<b>2020年12月31日</b>			
序号	单位名称	账面余额	占应付账款余额的比例
1	AppliedMaterialsSouthEastAsia	23,018.26	20.67%
2	TokyoElectronLimited	14,168.75	12.72%
3	NikonCorporation	12,059.87	10.83%
4	CanonInc.	10,086.78	9.06%
5	LamResearchInternationalSarl	6,674.68	5.99%
合计		<b>66,008.33</b>	<b>59.27%</b>

### (3) 预收款项和合同负债

报告期各期末，公司预收款项和合同负债的账面价值分别为 6,659.20 万元、133,576.77 万元和 83,269.44 万元，整体呈上升趋势，2021 年末，公司预收款项和合同负债大幅增长，主要系公司主营业务收入大幅增长，客户提前预定公司产能所支付的款项。2022 年末，公司预收款项和合同负债账面价值有所下降，主要系预收部分客户产能保证金冲抵货款所致。

### (4) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司的应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
短期薪酬	36,824.90	18,523.43	1,277.33
离职后福利-设定提存计划	-	-	-
合计	<b>36,824.90</b>	<b>18,523.43</b>	<b>1,277.33</b>



报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,277.33 万元、18,523.43 万元和 36,824.90 万元。2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应付职工薪酬分别较上期末增长 731.93 万元、17,246.10 万元和 18,301.47 万元，主要系公司员工数量及薪酬水平持续提高、未发放的薪酬增加所致。

#### (5) 应交税费

报告期各期末，公司的应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
个人所得税	6,148.73	1,953.38	1,126.53
房产税	121.68	121.68	243.33
代扣代缴税费	416.09	414.81	125.80
土地使用税	26.39	26.39	52.78
印花税	201.83	486.44	27.72
残疾人就业保障金	-	250.81	-
企业所得税	18.90	17.50	-
水利基金	25.55	1.96	-
<b>合计</b>	<b>6,959.17</b>	<b>3,272.96</b>	<b>1,576.16</b>

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 1,576.16 万元、3,272.96 万元和 6,959.17 万元，主要由应交个人所得税、房产税、代扣代缴税费等组成。2021 年末余额较 2020 年末增加 1,696.79 万元，主要系应交个人所得税、应交代扣代缴税费、应交印花税增加所致，2022 年末较 2021 年末增加 3,686.21 万元，主要系公司 2022 年末发放奖金金额增加，导致代扣代缴个人所得税增加所致。

#### (6) 其他应付款项

报告期各期末，公司的其他应付款项情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息	-	-	863.57
应付股利	-	-	-
其他应付款	593,769.36	577,317.53	16,927.69
<b>合计</b>	<b>593,769.36</b>	<b>577,317.53</b>	<b>17,791.27</b>

报告期各期末，公司其他应付款项余额分别为 17,791.27 万元、577,317.53 万元和 593,769.36 万元，占流动负债总额比例分别为 11.31%和 44.47%和 64.46%。

其中，其他应付款明细如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保证金	592,936.31	576,596.12	14,214.31
借转补款项	500.00	500.00	2,110.00
代付款	-	-	496.90
代收代付人才补助	37.70	37.31	89.69
其他	295.35	184.10	16.80
<b>合计</b>	<b>593,769.36</b>	<b>577,317.53</b>	<b>16,927.69</b>

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 16,927.69 万元、577,317.53 万元和 593,769.36 万元，主要由保证金、借转补款项等组成。保证金主要系客户的产能预约保证金及供应商投标、履约保证金；借转补款项主要为待验收确认的政府补助项目款。其他应付款 2021 年末余额较 2020 年末增加 560,389.84 万元，2022 年末较 2021 年末增加 16,451.83 万元，主要系收到客户产能保证金所致。

#### (7) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司的一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款	40,894.99	36,224.14	12,180.04
一年内到期的长期应付款	-	-	6,441.82
一年内到期的租赁负债	26,012.88	25,998.89	-
一年内到期的长期应付职工薪酬	4,177.70	3,187.13	-
<b>合计</b>	<b>71,085.57</b>	<b>65,410.15</b>	<b>18,621.86</b>

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 18,621.86 万元、65,410.15 万元和 71,085.57 万元，占流动负债总额比例分别为 11.84%、5.04%和 7.72%。

### (8) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 0 万元、0 万元及 7,894.40 万元，金额及占比均较低，为尚未结算的返利款。

## 3、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债主要包括长期借款、租赁负债、长期应付款和递延收益，合计占非流动负债期末余额比例分别为 99.80%、99.68%和 99.65%，具体情况如下：

### (1) 长期借款

报告期各期末，公司的长期借款情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
信用借款	49,829.98	19,933.43	-
保证借款	813,752.20	533,976.62	497,059.11
<b>小计</b>	<b>863,582.17</b>	<b>553,910.05</b>	<b>497,059.11</b>
减：一年内到期的长期借款	40,894.99	36,224.14	12,180.04
<b>合计</b>	<b>822,687.19</b>	<b>517,685.91</b>	<b>484,879.07</b>

截至 2022 年末，公司长期借款中的保证借款中 498,704.50 万元由合肥市建设投资控股（集团）有限公司提供担保，担保情况具体参见“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）报告期内的关联交易”。长期借款中的保证借款中 315,047.69 万元系新晶集成借入，由晶合集成为其提供担保。

### (2) 租赁负债

报告期各期末，公司的租赁负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
租赁付款额	321,618.00	347,178.80	-
减：未确认融资费用	99,104.77	112,295.47	-
<b>小计</b>	<b>222,513.23</b>	<b>234,883.33</b>	-
减：一年内到期的租赁负债	26,012.88	25,998.89	-

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
合计	196,500.35	208,884.44	-

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本公司将长期应付款调整计入租赁负债，会计政策变更的具体情况参见本节之“六、重要会计政策和会计估计”之“（二十八）重要会计政策、会计估计的变更”相关内容。

### （3）长期应付款

2020年末，公司的长期应付款为92,931.22万元，占非流动负债总额比例为13.45%，主要为融资租入的厂房及配套厂务设备所形成的融资租赁款，具体情况参见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）报告期内的关联交易”。

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本公司将长期应付款调整计入租赁负债，会计政策变更的具体情况参见本节“六、重要会计政策和会计估计”之“（二十八）重要会计政策、会计估计的变更”相关内容。

### （4）长期应付职工薪酬

2020年末、2021年末及2022年末，公司的长期应付职工薪酬金额分别为1,139.37万元、2,630.64万元和3,996.70万元。长期应付职工薪酬系公司为鼓励人才长期服务推进的设定受益计划，该计划于2020年9月开始实施。

### （5）预计负债

2020年末及2021年末，公司的预计负债金额分别为274.87万元和84.71万元，占非流动负债总额比例分别为0.04%和0.01%，金额与占比较小，主要为尚未结算给客户的销售返利。

### （6）递延收益

公司递延收益均为政府补助。报告期各期末，公司的递延收益分别为111,910.87万元、110,970.53万元和127,142.23万元，占非流动负债总额比例分别为16.19%、13.21%和11.05%。

报告期各期末，涉及政府补助的项目具体如下：

单位：万元

项目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	与资产/收益 相关
合肥市政府招商引资投资厂房	80,565.57	83,844.20	83,715.20	与资产相关
三重一创建设专项引导资金（一事一议）	35,962.71	21,510.33	24,864.71	与资产相关
三重一创重大新兴产业基地新建项目补助	597.28	725.92	855.85	与资产相关
集成电路产业政策资金-研发设备及工具补助	705.17	812.84	920.52	与资产相关
省集成电路新基地建设专项补助	310.51	361.24	411.96	与资产相关
企业购置研发设备补助	663.50	530.94	605.13	与资产相关
外贸发展专项资金-固定资产投入补助	26.39	31.94	37.50	与资产相关
12寸晶圆制造基地项目专项财政扶持资金	1,313.48	1,587.19	-	与资产相关
工业互联网政策研发设备补贴	882.22	990.94	-	与资产相关
2020年创新型省份建设资金	900.00	575.00	500.00	与收益相关
科技创新计划奖补	3,200.00	-	-	与资产及收益相关
先进制造业发展政策资金-企业技术改造补贴	1,853.49	-	-	与资产相关
2022年合肥市集成电路产业政策奖补-EDA工具软件	161.90	-	-	与资产相关
<b>合计</b>	<b>127,142.23</b>	<b>110,970.53</b>	<b>111,910.87</b>	<b>-</b>

## （二）偿债能力分析

### 1、偿债能力指标分析

报告期内，公司主要偿债指标如下：

财务指标	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动比率（倍）	1.18	0.57	3.30
速动比率（倍）	1.07	0.50	3.05
资产负债率（合并）	53.44%	68.38%	54.24%
资产负债率（母公司）	61.78%	70.60%	54.19%

注：上述主要偿债指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货） / 流动负债
- 3、资产负债率=总负债 / 总资产

报告期各期末，公司流动比率分别为 3.30 倍、0.57 倍和 1.18 倍，速动比率分别为 3.05 倍、0.50 倍和 1.07 倍，2021 年末随着流动负债规模的增加有所下降，2022 年末随着流动资产规模增加有所上升。报告期各期末，资产负债率（合并）分别为 54.24%、68.38%和 53.44%，存在一定波动，2021 年末公司资产负债率同比有所上升，主要原因为当期收到客户产能保证金规模较大，导致流动负债规模同比大幅上升所致。2022 年末公司合并资产负债率较 2021 年末有所下降，主要系当期公司经营规模不断扩大及子公司新品集成收到少数股东投资款所致。

## 2、与同行业可比公司的对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司的资产负债率（合并）、流动比率和速动比率对比情况如下：

项目	公司名称	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产负债率 (合并)	台积电	40.37%	42.24%	32.97%
	中芯国际	33.89%	29.56%	23.80%
	华润微	未披露	21.14%	28.62%
	华虹半导体	41.39%	40.59%	26.58%
	联华电子	37.07%	41.37%	37.55%
	世界先进	55.07%	46.35%	32.32%
	平均	41.56%	36.88%	30.31%
	晶合集成	53.44%	68.38%	54.24%
流动比率 (倍)	台积电	2.17	2.12	1.77
	中芯国际	2.42	3.58	4.20
	华润微	未披露	3.41	3.60
	华虹半导体	2.22	2.21	2.11
	联华电子	2.32	2.15	2.10
	世界先进	2.19	2.28	1.94
	平均	2.26	2.63	2.62
	晶合集成	1.18	0.57	3.30
速动比率 (倍)	台积电	1.94	1.86	1.55
	中芯国际	2.14	3.30	3.98
	华润微	未披露	3.05	3.18
	华虹半导体	1.81	1.81	1.77
	联华电子	2.04	1.94	1.81

项目	公司名称	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
	世界先进	1.91	2.01	1.67
	平均	1.97	2.33	2.33
	晶合集成	1.07	0.50	3.05

报告期内发行人资产负债率与同行业可比公司相比偏高，主要系公司所处行业属于技术密集型和资本密集型行业，前期扩充产能需要大量资金，公司通过借款方式筹集资金，形成较大金额的长期借款，同时公司向合肥蓝科租赁厂房形成长期应付款。发行人处于快速成长期，而可比公司基本处于成熟期，同时公司因尚未上市使得融资渠道相对有限，综合导致本公司资产负债率相比偏高。2022年末，随着公司经营规模不断扩大并收到少数股东投资款，公司资产负债率已下降至53.44%，进一步接近于同行业可比公司水平。

2020年末，公司流动比率和速动比率均高于行业可比公司平均水平，短期偿债能力较强。2021年末及2022年末，受客户产能保证金大幅增加因素影响，公司期末流动比率及速动比率低于可比公司均值。

### （三）现金流量分析

报告期内，公司现金流量构成如下所示：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	1,051,069.52	1,179,408.16	170,732.04
经营活动现金流出小计	423,066.18	222,019.66	123,449.16
经营活动产生的现金流量净额	628,003.34	957,388.50	47,282.88
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	369.23	265,459.89	378,349.34
投资活动现金流出小计	846,934.11	1,261,770.21	818,583.04
投资活动产生的现金流量净额	-846,564.87	-996,310.32	-440,233.69
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	1,216,759.08	698,146.51	446,500.00
筹资活动现金流出小计	684,443.85	354,191.29	46,463.75
筹资活动产生的现金流量净额	532,315.23	343,955.22	400,036.25

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,374.46	-595.53	-3,146.13
五、现金及现金等价物净增加额	359,128.16	304,437.87	3,939.30
加：期初现金及现金等价物余额	414,505.58	110,067.71	106,128.41
六、期末现金及现金等价物余额	773,633.74	414,505.58	110,067.71

## 1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动各期的现金净流量情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	994,827.46	594,950.80	138,297.00
收到的税费返还	14,829.86	1,285.60	1,264.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,412.20	583,171.76	31,171.05
经营活动现金流入小计	1,051,069.52	1,179,408.16	170,732.04
购买商品、接受劳务支付的现金	278,446.63	140,531.00	73,161.96
支付给职工以及为职工支付的现金	128,043.85	69,446.26	41,221.69
支付的各项税费	2,857.85	2,056.23	2,071.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,717.86	9,986.17	6,994.45
经营活动现金流出小计	423,066.18	222,019.66	123,449.16
经营活动产生的现金流量净额	628,003.34	957,388.50	47,282.88

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 47,282.88 万元、957,388.50 万元和 628,003.34 万元，经营活动现金流量持续改善，受益于下游市场规模的稳定增长及公司产能快速释放，公司经营活动现金流入总体实现快速增长。2021 年度，公司经营活动产生的现金流量金额同比大幅增长 910,105.62 万元，主要原因为当年度公司营收规模快速增长，同时公司高度重视销售回款的把控，使得当年“销售商品、提供劳务收到的现金”规模同比大幅提高，除此之外，因下游产品需求快速增长，公司当年度收到的客户产能保证金大幅增加，综合导致公司经营活动产生的现金流量净额规模远超同期水平。2022 年度，公司经营活动现金流量净额较 2021 年度减少 329,385.16 万元，主要系公司产能保证金大部分于 2021 年度收取，故公司 2022 年度收到的客户产能保证金大幅下降，导致公司收到其他与经营活动有关的现金金额减少



所致。

报告期各期，公司将净利润调节为经营活动现金流量的过程如下：

单位：万元

补充资料	2022年度	2021年度	2020年度
<b>净利润</b>	<b>315,619.62</b>	<b>172,883.20</b>	<b>-125,759.71</b>
加：资产减值准备	30,661.33	488.64	31,026.73
信用减值损失	182.94	25.01	-24.18
固定资产折旧、投资性房地产折旧、 油气资产折耗、生产性生物资产折旧	242,607.03	118,098.37	77,877.93
使用权资产折旧	13,643.06	9,557.00	-
无形资产摊销	21,752.12	18,161.32	19,112.04
长期待摊费用摊销	24.93	16.06	10.16
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-	-0.29
固定资产报废损失（收益以“-”号 填列）	-	108.25	-
公允价值变动损失（收益以“-”号 填列）	-362.59	-	326.59
财务费用（收益以“-”号填列）	18,035.90	23,433.58	36,854.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-369.23	-1,359.89	-1,249.05
递延所得税资产减少（增加以“-” 号填列）	-	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-” 号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,126.10	-40,609.77	-23,679.55
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	91,395.17	-93,965.49	-18,591.28
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-51,060.84	750,285.74	39,273.53
其他	-	266.50	12,105.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>628,003.34</b>	<b>957,388.50</b>	<b>47,282.88</b>

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在一定差异，主要原因如下：（1）公司处于资本密集型行业，报告期各期固定资产折旧、无形资产摊销的金额较大；（2）报告期内，公司通过借款方式等筹集资金，以实现产能快速扩充，报告期内有息借款产生的利息费用相对较高；（3）报告期内，公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备金额较大；（4）2020年度，公司实施员工持股计划，当期确认管理费用12,105.02万元；（5）2021年度，公司收到客户产能保证金大幅增加，使得当

期现金流量净额增幅较大。

## 2、投资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收回投资收到的现金	-	264,100.00	377,100.00
取得投资收益收到的现金	369.23	1,359.89	1,249.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.29
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>369.23</b>	<b>265,459.89</b>	<b>378,349.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	689,031.71	997,670.21	490,183.04
投资支付的现金	157,902.39	264,100.00	328,400.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>846,934.11</b>	<b>1,261,770.21</b>	<b>818,583.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-846,564.87</b>	<b>-996,310.32</b>	<b>-440,233.69</b>

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-440,233.69 万元、-996,310.32 万元和-846,564.87 万元。报告期内，公司为扩充产能持续购置生产机台设备等长期资产，导致购建固定资产、无形资产和其它长期资产支出的现金规模相对较大。

## 3、筹资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
吸收投资收到的现金	500,000.00	100,000.00	446,500.00
取得借款收到的现金	675,404.14	598,146.51	-
收到其他与筹资活动有关的现金	41,354.94	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,216,759.08</b>	<b>698,146.51</b>	<b>446,500.00</b>
偿还债务支付的现金	580,633.42	283,059.51	11,608.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,982.60	29,497.11	28,619.90
支付其他与筹资活动有关的现金	71,827.83	41,634.68	6,235.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>684,443.85</b>	<b>354,191.29</b>	<b>46,463.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>532,315.23</b>	<b>343,955.22</b>	<b>400,036.25</b>

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 400,036.25 万元、

343,955.22 万元和 532,315.23 万元。其中，筹资活动现金流入分别为 446,500.00 万元、698,146.51 万元和 1,216,759.08 万元，主要为公司综合运用股权及债权融资所筹集的资金。2021 年度，公司取得借款收到的现金同比增幅较大，系公司出于生产经营需要，根据资金使用安排于当期借入一定金额的短期借款。2022 年度，公司子公司晶集成收到少数股东投资款，使得当期吸收投资收到的现金规模较大。

#### （四）股利分配的实施情况

报告期内，公司未实施股利分配。

## 十二、持续经营能力分析

### （一）公司的主要经营情况

晶集成主要从事 12 英寸晶圆代工业务，致力于研发并应用行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。

公司重视技术创新与工艺研发，建立了完善的研发创新体系，打造了一支经验丰富、勤勉专业的研发团队，搭建了 150nm、110nm、90nm、55nm 等制程的研发平台，涵盖了 DDIC、CIS、MCU、PMIC、E-Tag、MiniLED 以及其他逻辑芯片等领域。截至本招股意向书签署日，公司目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的风险量产。公司已具备 DDIC、CIS、MCU、PMIC、MiniLED、E-Tag 等工艺平台晶圆代工的技术能力。

报告期内，公司主要提供 150nm 至 90nm 的晶圆代工服务，所代工的主要产品为面板显示驱动芯片，其被广泛应用于液晶面板领域，包括电视、显示屏、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备等产品中，获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可。2020 年度，公司 12 英寸晶圆代工年产能达约 26.62 万片；2021 年度，公司 12 英寸晶圆代工产能为 57.09 万片，2022 年度，公司 12 英寸晶圆代工产能为 126.21 万片。根据 Frost&Sullivan 的统计，截至 2020 年底，晶集成已成为中国大陆收入第三大、12 英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业（不含外资控股企业）。根据市场研究机构 TrendForce 的统计，2022 年第二季度，在全球晶圆代工企业中，公司营业收入排名全球第九。

## （二）对持续经营有关的重大风险或不利因素

对公司经营能力产生重大不利影响的因素包括技术研发滞后的风险、核心技术失密风险、知识产权风险、公司形成主营业务收入产品应用领域单一的风险等，具体情况请参见本招股意向书“第三节 风险因素”。

## （三）管理层对持续经营能力的自我评判

未来几年，公司的主营业务将持续增长，借助产能扩充、研发创新，实现营业收入的稳步增长。可以预见，未来几年，下列因素决定了公司具有持续经营能力：

### 1、行业市场潜力大

随着全球信息化和数字化的持续发展，新能源汽车、人工智能、消费电子、移动通信、工业电子、物联网、云计算等新兴领域的快速发展带动了全球集成电路行业规模的不断增长。

根据 Frost&Sullivan 的统计，2015 年至 2020 年，按照销售额口径，全球集成电路市场规模从 2,744.8 亿美元增长至 3,612.3 亿美元，年均复合增长率为 5.6%。未来，在 5G、物联网、云计算、新能源汽车等领域的驱动下，全球集成电路市场规模有望持续增长。

在稳定的经济增长、有利的政策支持和巨大的市场需求等因素的推动下，中国集成电路行业实现了快速的发展。

根据 Frost&Sullivan 的统计，2015 年至 2020 年，按照销售额口径，中国大陆集成电路市场规模从 3,609.8 亿元增长至 8,848.0 亿元，年均复合增长率为 19.6%，增速高于全球水平。未来，随着集成电路产业国产替代的推进，以及新基建、信息化、数字化的持续发展，中国大陆集成电路市场规模有望持续增长，预计 2024 年中国集成电路市场规模将达到 14,426.5 亿元。

### 2、研发创新能力强

公司重视技术创新与工艺研发，建立了完善的研发创新体系，在研发平台、研发团队、技术体系等方面形成了较强的优势，搭建了 150nm、110nm、90nm、55nm 等制程的研发平台。公司建立了“研发生产一体”的支撑体系，使项目在研发阶段即具备满足后续量产技术要求的能力，大大加快了从研究开发到项目大规模投产的进程，有

效保证了产出质量与可靠性，缩短了研发周期，提高了公司核心竞争力。

公司通过多年集成电路研发实践，组建了专业化的核心研发团队。研发团队核心成员由境内外资深专家组成，拥有在行业内多年的技术研发经验。截至 2022 年 12 月末，公司共有研发人员 1,388 人，占员工总数的 32.86%。

报告期内，公司研发费用分别为 24,467.56 万元、39,668.49 万元和 85,707.00 万元，占营业收入比重分别为 16.18%、7.31%和 8.53%。

### 3、产能持续扩充

报告期内，随着晶圆代工行业的增长及公司业务的发展，公司产能持续扩充，以满足下游客户不断增长的需求。最近三年公司 12 英寸晶圆代工产能分别为 26.62 万片/年、57.09 万片/年和 126.21 万片/年，有效提升了公司的经营服务能力。

### 4、客户资源优质

基于较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠的产品质量等，公司获得了众多海内外半导体产业链知名企业的认可，在客户资源方面积累了强大的竞争优势。公司对不同应用领域的客户需求有着深刻的理解，能够为客户提供专业、高效、优质且性价比较高的产品及服务，实现了较高的客户粘性。

### 5、现金流持续改善

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 47,282.88 万元、957,388.50 万元和 628,003.34 万元，公司经营活动现金流持续改善。2020 年度以来，随着公司产销量持续增加，公司经营活动产生的现金流量净额由负转正。未来，随着公司营业收入的增长和毛利率的提升，公司具备可持续的经营性现金流入的能力。同时，本次公开发行后，公司净资产将进一步增加，资产负债率将有所降低，偿债能力将进一步提高。随着募集资金的逐步投入，公司研发能力将进一步增强，核心竞争优势更加突出，使得公司处于良性的可持续增长状态，财务状况将更为良好，资本结构将更为合理，为公司未来的快速发展奠定基础。

整体来看，报告期内，公司不存在逾期未偿还债务、无法继续履行重大借款合同中的有关条款、无法获得研发所需资金等严重影响公司持续经营能力的情况。随着公司所处行业的增长及公司业务的发展，公司预计未来业务具有可持续性，不存在对公

司持续经营能力造成重大不利影响的变化和风险。

## 十三、资本性支出分析

### （一）报告期内重大资本性支出情况

公司属于晶圆代工行业，行业及公司生产经营的业务特点决定了公司固定资产中的机台设备金额大、比重高的特点。

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 490,183.04 万元、997,670.21 万元和 689,031.71 万元。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

截至本招股意向书签署之日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的投资支出和二期厂建设项目投资支出，其中：本次募集资金投资项目具体情况详见本招股意向书“第七节 募集资金运用及未来发展规划”；二期厂建设项目规划总投资额约为 165 亿元（其中建设投资为 155 亿元，流动资金为 10 亿元）。

### （三）重大资本开支计划对公司未来发展战略的影响

公司未来发展战略情况详见本招股意向书“第七节 募集资金运用及未来发展规划”之“三、未来发展规划”。

公司上述重大资本性支出计划的实施，有利于提升公司技术实力，扩大公司业务规模，进一步提升公司的行业地位，从而助力公司未来发展战略的实现。

## 十四、重大资产重组

报告期内，公司不涉及重大资产重组事项。

## 十五、重要承诺及或有事项

### （一）厂务及配套项目收购意向协议

2021 年，本公司与合肥蓝科投资有限公司签订了《晶合二厂厂务及配套项目收购

意向协议》，合同约定在项目交付日 5 年内参考第三方机构资产评估价值及本公司已支付之建造成本，一次性完成收购。

## （二）产能预约

客户通过与本公司签订产能保证金合同并支付产能保证金的形式预定本公司未来产品产能。截至 2022 年 12 月 31 日，客户预定本公司未来产品产能的具体情况如下：

单位：片

产品名称	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	合计
28nm	-	-	60,000	60,000	120,000
40nm	-	35,025	62,600	65,800	163,425
55nm	61,200	226,200	250,200	249,600	787,200
90nm	519,605	70,875	75,300	83,100	748,880
110nm	299,710	366,250	416,700	450,500	1,533,160
150nm	459,390	184,225	229,000	235,000	1,107,615
<b>合计</b>	<b>1,339,905</b>	<b>882,575</b>	<b>1,093,800</b>	<b>1,144,000</b>	<b>4,460,280</b>

## （三）开具保函情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司开具保函情况如下所示：

单位：元

开证行	保函编号	受益人名称	保函金额	币种	开立日期	失效日期
中国银行合肥庐阳支行	GC0886922000808	中华人民共和国合肥海关	5,000,000.00	CNY	2022/5/23	2023/5/23
中国银行合肥庐阳支行	GC0886922000139	中华人民共和国合肥海关	10,000,000.00	CNY	2022/1/21	2023/1/21
中国银行合肥庐阳支行	GC0886922001444	中华人民共和国合肥海关	10,000,000.00	CNY	2022/9/14	2023/9/14
<b>合计</b>	-	-	<b>25,000,000.00</b>	-	-	-

注：中国银行股份有限公司合肥北城支行已更名为中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

## (四) 公司开立信用证情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司开立信用证情况如下所示：

单位：元

序号	开证行	信用证号码	受益人	信用证金额	币种	开立日	到期日	未使用金额
1	中国农业银行合肥金寨路支行	121810LC19000372	ThermoKeytekLLC	232,872.00	USD	2019-11-29	2020-5-24	23,287.20
2	平安银行合肥分行营业部	LC2661202000021	MALVERN PANALYTICAL B.V	606,000.00	EUR	2021-1-15	2021-10-30	60,600.00
3	中国银行合肥庐阳支行	LC0886921000654	TECHMAX INTERNATIONAL TRADING(SHANGHAI) CO., LTD	173,265,000.00	JPY	2021-6-11	2022-1-31	17,326,500.00
4	平安银行合肥分行营业部	LC2661202100035	Malvern Panalytical B.V	604,000.00	EUR	2021-7-30	2022-3-31	60,400.00
5	兴业银行望江东路支行	08101LC21003496C	Spirox International Limited	1,550,000.00	USD	2021-9-10	2022-3-31	155,000.00
6	平安银行合肥分行营业部	LC2661202100047	Edwards Limited	1,450,238.00	USD	2021-9-15	2022-11-30	121,500.00
7	中国银行合肥庐阳支行	LC0886921001048	BEIJING NAURA MICROELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.	2,080,000.00	USD	2021-10-9	2022-4-30	208,000.00
8	中信银行合肥分行	732601LC21001064	TECHMAX INTERNATIONAL TRADING(SHANGHAI) CO., LTD	56,680,000.00	JPY	2021-11-1	2022-4-30	5,668,000.00
9	徽商银行蜀山支行	LC40102372100002	BEIJING NAURA MICROELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.	6,000,000.00	USD	2021-12-14	2022-6-30	600,000.00
10	徽商银行蜀山支行	LC40102372100003	BEIJING NAURA MICROELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.	6,000,000.00	USD	2021-12-14	2022-6-30	600,000.00
11	浦发银行合肥分行营业部	LC580121000185	BEIJING NAURA MICROELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.	2,080,000.00	USD	2021-12-8	2022-6-30	208,000.00
12	中国农业银行合肥金寨路支行	121810LC21000300	Edwards Limited	1,015,736.00	USD	2021-12-22	2023-5-31	31,316.00
13	徽商银行蜀山支行	LC40102372100004	BEIJING NAURA MICROELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.	6,360,000.00	USD	2021-12-14	2022-6-30	636,000.00
14	徽商银行蜀山支行	LC40102372100010	BEIJING NAURA MICROELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.	1,050,000.00	USD	2021-12-21	2022-6-30	105,000.00
15	中国银行合肥庐阳支行	LC0886921001344	Canon Inc.	1,406,000,000.00	JPY	2021-12-23	2023-7-31	83,657,000.00



序号	开证行	信用证号码	受益人	信用证金额	币种	开立日	到期日	未使用金额
16	平安银行合肥分行营业部	LC2661202100057	MalvernPanalyticalB.V	606,000.00	EUR	2021-12-22	2022-5-31	60,600.00
17	浦发银行合肥分行营业部	LC580122000054	CanonInc.	484,000,000.00	JPY	2022-4-29	2022-12-31	48,400,000.00
18	徽商银行蜀山支行	LC40102372100031	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMENTCO.,LTD.	2,080,000.00	USD	2022-1-6	2022-7-31	208,000.00
19	徽商银行蜀山支行	LC40102372100032	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMENTCO.,LTD.	3,180,000.00	USD	2022-1-6	2022-7-31	318,000.00
20	平安银行合肥分行营业部	LC2661202100058	BrooksCCSJapanK.K.	1,200,000.00	USD	2022-1-14	2022-7-31	120,000.00
21	平安银行合肥分行营业部	LC2661202200013	MalvernPanalyticalB.V.	606,000.00	EUR	2022-4-26	2022-10-31	60,600.00
22	平安银行合肥分行营业部	LC2661202200007	EdwardsLimited	1,918,216.00	USD	2022-2-18	2023-9-30	103,316.00
23	招商银行合肥分行营业部	551LC2200182	A&BA analytical & BioScienceInstruments	146,800,000.00	JPY	2022-4-24	2022-10-30	14,680,000.00
24	招商银行合肥分行营业部	551LC2200225	EdwardsLimited	526,000.00	USD	2022-4-29	2023-4-29	153,000.00
25	中国银行合肥庐阳支行	LC0886922000127	CanonInc.	1,890,000,000.00	JPY	2022-1-24	2023-7-31	75,924,000.00
26	中信银行合肥分行	732601LC22000411	EVGroupEurope & Asia/PacificGmbH	3,829,000.00	EUR	2022-5-6	2023-2-5	547,000.00
27	中信银行合肥分行	732601KL22000037	迪科特测试科技（苏州）有限公司	4,972,800.00	CNY	2022-6-13	2022-12-31	497,280.00
28	徽商银行蜀山支行	LC40102372200003	ECITechnology,Inc.	1,315,150.00	USD	2022-7-8	2023-4-9	131,515.00
29	浦发银行合肥分行	LC580122000089	TokyoElectronLimited	210,574,000.00	JPY	2022-7-27	2023-2-28	21,057,400.00
30	中信银行合肥分行	732601LC22000827	ADVANTESTCORPORATION	282,005.14	USD	2022-9-1	2023-1-31	28,200.51
31	招商银行合肥分行	551LC2200399	THERMOFISHERSCIENTIFIC(CHINA)CO.,LTD.	160,000.00	USD	2022-9-23	2023-1-31	16,000.00
32	招商银行合肥分行	551LC2200437	AppliedMaterialsSouthEastAsiaPte.Ltd	4,826,500.00	USD	2022-9-21	2023-4-30	482,650.00
33	中国银行合肥庐阳支行	LC0886922001037	KLACORPORATION	2,793,000.00	USD	2022-9-19	2023-2-28	2,793,000.00
34	中国银行合肥庐阳支行	LC0886922001068	KLACORPORATION	3,882,500.00	USD	2022-9-28	2023-3-20	388,250.00

序号	开证行	信用证号码	受益人	信用证金额	币种	开立日	到期日	未使用金额
35	中国民生银行合肥分行	3401LC22000140	AppliedMaterialsSouthEastAsiaPte.Ltd	4,728,000.00	USD	2022-10-27	2023-6-30	472,800.00
36	中国民生银行合肥分行	3401LC22000141	MurataMachinery,Ltd.	657,937,091.00	JPY	2022-11-2	2023-10-20	657,937,091.00
37	中国民生银行合肥分行	3401LC22000154	SHIBAURAMECHATRONICSCORPORATION	191,000,000.00	JPY	2022-12-2	2023-6-30	191,000,000.00
38	兴业银行合肥分行	08101LC22003974C	QUALITAU,INC	1,497,000.00	USD	2022-12-6	2023-9-30	1,497,000.00
39	招商银行合肥分行	LC5512200171	国网通金财（北京）信息科技有限公司	1,461,782.03	CNY	2022-12-9	2023-3-9	1,461,782.03
40	招商银行合肥分行	551LC2200595	AppliedMaterialsSouthEastAsiaPte.Ltd	12,608,000.00	USD	2022-12-28	2023-8-19	12,608,000.00
41	中国农业银行合肥金寨路支行	121810LC22000136	KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	147,032,000.00	JPY	2022-8-5	2023-4-30	14,703,200.00
42	招商银行合肥分行	551LC2200465	NIKON CORPORATION	2,870,000,000.00	JPY	2022-9-30	2023-3-31	287,000,000.00
43	中国徽商银行合肥分行	LC40102372200006	KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	63,900,000.00	JPY	2022-9-15	2023-6-30	6,390,000.00
44	中国徽商银行合肥分行	LC40102372200007	APPLIED MATERIALS SOUTH EAST ASIA PTE.LTD	2,905,750.00	USD	2022-9-21	2023-4-30	290,575.00
45	招商银行合肥分行	551LC2200588	Lam Research International Sdn. Bhd.	4,834,714.00	USD	2022-12-20	2023-6-30	4,834,714.00
46	兴业银行	08101LC22003265C	中微半导体设备（上海）股份有限公司	3,850,000.00	USD	2022-10-9	2023-3-20	3,850,000.00
47	兴业银行	08101LC22003391C	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	6,205,500.00	USD	2022-10-19	2023-5-30	620,550.00

注：中国银行股份有限公司合肥北城支行已更名为中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

### （五）其他重要承诺事项

除上述承诺事项及本招股意向书“附件二 与投资者保护相关的承诺”外，公司无需要披露的其他重要承诺事项。

截至 2022 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大承诺事项及或有事项。

### （六）其他重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十六、资产负债表日后事项

根据本公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订的《动产浮动抵押合同》、《反担保合同》和《反担保合同补充协议》规定，本公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司每年应根据机器设备及原物料当年海关监管期限届满的进度确定办理抵押登记的时间，原则上每年统一办理一次抵押登记。

2023 年 2 月 2 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司对本公司部分机器设备办理抵押登记，对应机器设备账面原值、抵押价值如下：

单位：元

项目	账面原值	抵押价值
固定资产	1,970,747,741.39	1,182,448,644.87

截至 2023 年 3 月 1 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十七、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

## 十八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司总体经营情况良好，经营模式

未发生重大变化；公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，不存在重大不利变化；公司所处晶圆代工行业长期发展前景良好，2022 年第三季度以来晶圆代工行业市场的需求及价格变动属于行业周期性波动，行业的产业政策、税收政策均未发生重大变化。

公司合理预计 2023 年 1-3 月的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动率
营业收入	105,357.84 至 110,861.09	281,828.26	-62.62%至-60.66%
归属于母公司所有者的净利润	-35,497.62 至-27,313.03	130,743.00	-127.15%至-120.89%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-40,037.27 至-31,852.68	129,529.16	-130.91%至-124.59%

根据行业发展态势、市场供需情况以及公司自身经营情况预测等，公司预计 2023 年 1-3 月可实现营业收入的区间为 105,357.84 万元至 110,861.09 万元，同比下降 62.62%至 60.66%；预计 2023 年 1-3 月可实现归属于母公司所有者的净利润区间为-35,497.62 万元至-27,313.03 万元，同比下降 127.15%至 120.89%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为-40,037.27 万元至-31,852.68 万元，同比下降 130.91%至 124.59%。2023 年 1-3 月，公司预计经营业绩同比下降且可能出现亏损，主要系在 2022 年，智能手机、消费电子需求下行，受到消费性终端需求疲软的影响，整体而言，2022 年第三季度起产能缺口情况有所缓解，使得晶圆代工产能利用率面临挑战。发行人作为半导体晶圆代工企业，生产经营受到行业整体需求变化及周期性波动的影响，因产能利用率不足等原因导致经营业绩同比下滑。

基于上述 2023 年 1-3 月业绩预测数据，并结合 2022 年第三季度以来晶圆代工行业市场需求及价格变动趋势，公司提示投资者关注业绩下滑风险。

前述财务数据系公司初步预测的结果，不构成公司所做的盈利预测或业绩承诺。

## 第七节 募集资金运用及未来发展规划

### 一、募集资金投资项目概况

#### (一) 募集资金投资方向和使用安排

2021年8月12日，公司召开2021年第一届第六次董事会审议通过了《关于变更上市募投项目的议案》。2021年8月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟公开发行A股普通股股票，实际募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

为积极开发多元化产品、向更先进制程节点顺利发展，晶合集成选择40纳米、28纳米和后照式CMOS图像传感器芯片制造工艺技术、微控制器芯片工艺平台作为先进工艺研发项目。此外，为加强公司资产完整性、独立性，公司拟向合肥蓝科收购制造基地厂房及厂务设施，收购完成后，公司将拥有主要生产经营厂房、现有土建建成部分对应的土地及配套厂务设施的完整所有权。同时，为补充公司资本金实力，增强公司市场竞争力，拟定15亿元用于补充流动资金及偿还贷款。具体明细见下表：

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金额 (亿元)
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	晶合集成	49.0
1.1	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目 (包含 90 纳米及 55 纳米)	晶合集成	6.0
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目 (包含 55 纳米及 40 纳米)	晶合集成	3.5
1.3	40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	晶合集成	15.0
1.4	28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目	晶合集成	24.5
2	收购制造基地厂房及厂务设施	晶合集成	31.0
3	补充流动资金及偿还贷款	晶合集成	15.0
合计			<b>95.0</b>

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司通过自有资金以及银行贷款等自筹资金方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述拟投入募集资金总额，则公司根据发展规划及实际生产经营需求，将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定

程序后合理使用。

若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据上述投资项目实际进度的需要，以自有资金以及银行贷款等自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金。

## （二）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目为先进制程及多元化平台研发、收购合肥蓝科厂房及补充流动资金，项目实施主体均为发行人。募集资金投资项目与发行人主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标相匹配。本次募集资金项目实施后不会导致发行人与控股股东合肥建投、实际控制人合肥市国资委及其控制的其他企业产生新的同业竞争；公司拟向合肥蓝科收购制造基地厂房及厂务设施，收购完成后，公司将拥有主要生产经营厂房、现有土建建成部分对应的土地及配套厂务设施的完整所有权，有利于增强发行人独立性。

## （三）募集资金使用管理制度以及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

本次募集资金重点投向科技创新领域的具体安排请参见“附件五 募集资金具体运用情况”。

## 二、募集资金投资项目对发行人主营业务的贡献、未来经营战略的影响

### （一）项目可行性和必要性

#### 1、推进先进技术，强化技术竞争力

集成电路产业是按“摩尔定律”快速进步的产业，终端应用的不断升级和多样化推动着工艺技术的持续进步。先进技术节点是未来集成电路晶圆代工行业发展的主要驱动力。

通过实施合肥晶合集成电路先进工艺研发项目，公司将自主开发40/28纳米的更先进工艺及微控制器与后照式CMOS图像传感器芯片工艺技术等，进一步强化公司技术竞争力。公司亦将持续引进业内高级技术人才，从各方面提升公司研发实力。

## 2、填补国内芯片产能空缺，满足市场需求

在高端CMOS图像传感器领域，国内外市场主要被索尼、三星等日韩厂商所主导。公司研发项目所开发的后照式CMOS图像传感器芯片技术，可有效打破国外龙头公司“卡脖子”垄断状态，满足国内庞大的市场需求。受惠于5G、智能汽车及物联网的飞速发展，车用电子、物联网应用的市场需求也日益壮大，该等应用所需的55/40/28纳米制程产能紧缺，尚不足以满足市场需求。公司拟进行的55/40纳米微控制器芯片及28纳米OLED显示驱动及逻辑芯片的开发，将有助于缓解目前国内“缺芯”的情况。

## 3、下游市场空间巨大

受益于物联网、汽车电子、5G等创新应用领域市场蓬勃发展，图像传感器、OLED显示驱动及AIoT的市场规模巨大。图像传感器全球销售规模预计从2020年至2024年间将以7.6%的年复合增长率继续增长，而中国市场规模年复合增长率则达8.1%；OLED显示器方面，2021年，中国OLED产业市场规模为423亿美元，到2026年，这一市场将增长到879亿美元，中国将持续作为世界最大的OLED显示市场；AIoT终端方面，2019年全球AIoT市场规模为51亿美元，2024年将增长至162亿美元，复合年增长率为26.0%。

## 4、公司具备技术储备，可最大程度发挥研发优势

公司已建立完整技术研发团队，并自主开发成功覆盖多种产品应用的工艺技术，具备相关技术储备。

后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台方面，公司将以现有90纳米前照式CMOS图像传感器工艺平台及55纳米工艺平台技术为基础，进行90/55纳米后照式图像传感器技术的开发。

微控制器芯片工艺平台方面，公司将基于现有的55纳米逻辑制程技术，结合现有110纳米微控制器芯片制造工艺技术，自主开发完成40纳米微控制器芯片工艺技术。

40/28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台开发方面，通过研发生产效率更高的多晶硅

栅氮氧化硅绝缘层栅极（Poly/SiON）工艺技术及金属闸极工艺（HKMG）完成工艺平台研发。

### 5、加强资产完整性，收购合肥蓝科土地及厂房

为加强资产完整性和独立性，本次募集资金项目拟包括收购目前由发行人租用的合肥蓝科土地及厂房。收购后将有效加强发行人资产完整性，降低对发行人控股股东和关联方的依赖程度、减少关联交易，降低未来风险。

## （二）与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

### 1、后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台

晶合集成已量产12英寸集成电路90纳米前照度图像传感器芯片。公司将进行开发的90纳米及55纳米后照度图像传感器芯片技术,相比于国内主流的8英寸集成电路110纳米前照式图像传感技术,可获得更高的感亮度和量子效率、更宽广感光角度、更低像素串扰、更高成像品质等优势,可生产超高像素及质量要求的终端产品,广泛用于高端安防监控系统、智能车载环视及后视摄像头及高端智能手机等终端设备。

### 2、微控制器芯片工艺平台

晶合集成计划以目前正在开发中的55纳米逻辑工艺技术,以及已开发完成的110纳米微控制器芯片工艺技术为基础,开展40纳米微控制器芯片工艺平台开发。平台开发完成后,将提供高性能、低功耗、高耐久性和资料保存性能的中高端微控制器芯片。

### 3、40 纳米逻辑芯片工艺平台

公司目前正进行 55 纳米逻辑平台开发,未来将以此技术为基础,进行 40 纳米逻辑芯片工艺平台开发,将运用生产效率更高的多晶硅栅氮氧化硅绝缘层栅极（Poly/SiON）工艺技术,大幅提高生产良率以及运作效率。

### 4、28 纳米逻辑芯片及 OLED 芯片工艺平台

基于公司现有技术储备,公司将自主开发28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台,将运用金属闸极工艺（HKMG）技术。该技术不仅能够大幅减小漏电,而且由于高介电层绝缘层的等效氧化物厚度较薄,因此还能有效降低栅极电容,提升电晶体管驱动能力。在芯片规格方面,晶合集成计划开发0.9V低功耗（LP）核心元器件以提供更快的运算速度以及更低的能耗。



### （三）募集资金投资项目对发行人未来经营战略的影响

合肥晶合集成电路先进工艺研发项目有利于进一步推进发行人制程节点，丰富发行人工艺平台，增强发行人市场竞争力及持续经营能力。与发行人依托核心优势、提升专业技术水平，逐步形成显示驱动、图像传感、微控制器、电源管理四大集成电路特色工艺应用产品线的发展战略相契合。

收购制造基地厂房及厂务设施有利于加强发行人资产完整性，促进发行人长期稳定经营。

补充流动资金及偿还贷款项目能够有效提升公司资金使用效率，提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，并对公司研发投入和人才队伍建设给予有力的支持，有利于增强公司市场竞争力。

## 三、未来发展规划

### （一）公司战略规划

集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业，集成电路制造又是集成电路产业的核心环节。在当前的国内行业上下游仍高度依赖进口的背景下，发行人将抓住 5G、AI、物联网等市场机遇，提升晶圆制造环节的本土企业市场影响力，实现国内显示驱动芯片、微处理器、CMOS 图像传感器等集成电路产品的自主可控供应，进一步提高集成电路行业的国产化水平。

未来，公司将不断依托核心优势、提升专业技术水平，整合行业及客户资源，发挥管理团队和技术团队能动性，进一步向兼顾晶圆代工产品和设计服务能力的综合性晶圆制造企业发展，逐步形成显示驱动、图像传感、微控制器、电源管理四大集成电路特色工艺应用产品线。

### （二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

#### 1、完善健全公司内部治理体系

报告期内，公司不断健全公司治理体系、提高管理水平以匹配公司长期战略发展的需求。2020 年 11 月，发行人召开创立大会完成股份制改造，选举独立董事，公司按照《公司章程》和上市公司的要求，持续完善法人治理结构，规范股东大会、董事

会的运作，建立了股东大会、董事会和监事会议事规则和各项公司治理细则，形成了科学有效的公司决策机制。

## 2、持续加大科研技术投入力度

公司重视技术创新与工艺研发，建立了完善的研发创新体系，打造了一支经验丰富、勤勉专业的研发团队，搭建了 150nm、110nm、90nm、55nm 等制程的研发平台，涵盖了 DDIC、CIS、MCU、PMIC、E-Tag、MiniLED、以及其他逻辑芯片等领域。报告期内，公司研发费用分别为 24,467.56 万元、39,668.49 万元和 85,707.00 万元，占营业收入比重分别为 16.18%、7.31% 和 8.53%。

公司将研发投入所形成的科研成果及核心技术通过申请专利等方式进行保护，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人已形成与主营业务收入相关的发明专利共 316 件。

## 3、引进研发人才，强化激励机制

公司高度重视对行业优秀研发人才的吸引、任用、培养与保留。通过具有市场竞争力的薪酬体系、业绩激励机制激励研发人才队伍不断进取、持续创新，通过专项福利补贴及多样化的人才关爱与发展项目保持研发队伍稳定发展。

2020 年 9 月，公司成立员工持股计划，合计设立 15 个持股平台合计持有发行人 1.47% 股份。

通过上述多项举措，公司在多个方面实现了初步的战略目标。报告期内，公司在产能、产量、销量等方面均超过年度预算目标，并在 2020 年创新高，产量/销量同期增长率超过 100%。2021 年度，公司实现扭亏为盈，综合毛利率为 45.13%，2022 年毛利率进一步提升并达到 46.16%。同时，公司加快产品多样化转型，逐步形成多点支撑的业务和产品格局。根据 Frost&Sullivan 的统计，截至 2020 年底，晶合集成已成为中国大陆收入第三大、12 英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业（不含外资控股企业），有效提高了中国大陆晶圆代工行业的自主水平。根据市场研究机构 TrendForce 的统计，2022 年第二季度，在全球晶圆代工企业中，公司营业收入排名全球第九。

### （三）未来规划采取的措施

未来，公司将继续坚持目前战略规划，积极开展技术研发，逐步形成显示驱动、图像传感、微控制器、电源管理四大集成电路特色工艺应用产品线，不断推出适应客

户需求的产品，持续扩充晶圆代工业务产能，提升公司市场地位和竞争优势。

结合公司发展战略及募集资金投资项目的安排，公司全部募集资金将投入合肥晶合集成电路先进工艺研发项目、收购制造基地厂房及厂务设施，以及补充流动资金及偿还贷款，有利于提升发行人研发实力，进一步改善现金流状况，扩大发行人的业务规模，从而进一步提升公司的行业地位。

## 第八节 公司治理与独立性

### 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

报告期内，发行人在整体变更为股份有限公司之前，董事会是有限公司最高权力机构，未设股东会及监事会，亦无独立董事，未制定关联交易、对外投资、对外担保等专项管理制度。

股份公司设立后，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，并参照《上市公司章程指引》《科创板上市规则》及中国证监会、上交所的其他相关要求，建立健全了公司法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》等规范性文件。

### 二、公司内部控制制度的情况

#### （一）公司内部控制的自我评价

本公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对本公司截至报告期末的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

本公司认为：

本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

本公司按照不断完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点，在公司积累的多年管理经验基础上，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制定内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范运作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

## （二）注册会计师对公司内部控制制度的评价

容诚对公司的内部控制制度进行了审核，并于 2023 年 3 月 1 日出具了《内控鉴证报告》，该报告对公司内部控制制度的结论性评价意见为：晶合集成于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 三、公司报告期内违法违规行及受到处罚的情况

报告期内，发行人不存在重大违法违规行为，也不存在受到相关主管机关重大处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。

## 四、公司报告期内资金占用与对外担保情况

截至本招股意向书签署之日，发行人不存在资金被控股股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。

报告期内，晶合有限存在为控股股东合肥建投提供反担保的情况，具体详见本节“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）报告期内的关联交易”之“2、重大关联交易”之“（3）重大偶发性关联交易”。

## 五、公司独立性

截至本招股意向书签署之日，发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面均具备独立性，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力：

### （一）资产完整

发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

### （二）人员独立

报告期内，发行人存在合肥建投、力晶科技向发行人委派高级管理人员的情形，具体包括：合肥建投曾向发行人委派销售副总监周义亮（曾兼任采购副总监），采购副总监王继武，总会计师朱才伟，审计师、敬业促进委员会委员长、行政副总经理朱晓娟，审计师、敬业促进委员会委员长杨幼玲；力晶科技曾向发行人委派副总会计师邱垂源，副总会计师李迦谕，行政副总经理刘荫，审计师陈美华，审计师潘炯升。截至本招股意向书签署之日，公司高级管理人员均由公司聘任并在公司专职工作。

截至本招股意向书签署之日，发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立

发行人已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

### （四）机构独立

发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### （五）业务独立

发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

## （六）发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定

最近两年内，发行人主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东所持的发行人股份权属清晰，最近两年内，发行人的实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

## （七）对持续经营有重大影响的事项

发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

# 六、同业竞争

## （一）公司与控股股东及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

发行人的经营范围为集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。发行人的主营业务为 12 英寸晶圆代工业务。

发行人控股股东及其控制的其他企业的基本情况参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东控制的其他企业”。

截至本招股意向书签署之日，发行人不存在与控股股东及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形，不存在同业竞争情况。

## （二）避免同业竞争的承诺

发行人控股股东合肥建投已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

本公司目前一直公允地对待本公司直接或间接控制的其他企业，将来也不会利用控股股东地位谋求不正当利益或作出不利于晶合集成而有利于其他下属企业的任何决定，不会损害晶合集成及其他股东的合法权益。因违反本承诺函的任何条款而导致晶合集成及其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。

本公司及本公司直接或间接控制的其他企业，目前不存在、将来也不会在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与晶合集成及其控股子公司所从事的主营业务相同

或相似业务的情形。

如果本公司及本公司直接或间接控制的其他企业从事了与晶合集成业务相同或相似的业务，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将愿意以公平合理的价格将构成竞争业务有关的资产或股权（若有）转让给晶合集成或其控股子公司，晶合集成享有优先受让上述资产或股权的权利。若晶合集成因任何原因决定不行使前述优先受让的权利，应及时通知本公司，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将停止该等业务，或转让该等资产或股权直至不再控制。

如果本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能存在任何与晶合集成业务产生竞争的业务机会，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将通知晶合集成并尽力促使该业务机会首先提供给晶合集成或其控股子公司，晶合集成或其控股子公司享有优先获取上述业务的权利。若晶合集成或其控股子公司因任何原因决定不行使前述优先获取的权利，应及时通知本公司；本公司直接或间接控制的其他企业应确保不会导致与晶合集成产生同业竞争。

本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不向晶合集成业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与晶合集成业务有关之专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本公司保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保晶合集成按照上市公司的规范独立自主经营，保证晶合集成的资产、业务、财务、人员、机构独立。

上述承诺于本公司作为晶合集成的控股股东期间内持续有效。

发行人控股股东合肥建投的一致行动人合肥芯屏已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

本企业目前一直公允地对待本企业直接或间接控制的其他企业，将来也不会利用控股股东一致行动人的地位谋求不正当利益或作出不利于晶合集成而有利于其他下属企业的任何决定，不会损害晶合集成及其他股东的合法权益。因违反本承诺函的任何条款而导致晶合集成及其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。

本企业及本企业直接或间接控制的其他企业，目前不存在、将来也不会在中国境



内外，以任何方式直接或间接从事与晶合集成及其控股子公司所从事的主营业务相同或相似业务的情形。

如果本企业及本企业直接或间接控制的其他企业从事了与晶合集成业务相同或相似的业务，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将愿意以公平合理的价格将构成竞争业务有关的资产或股权（若有）转让给晶合集成或其控股子公司，晶合集成享有优先受让上述资产或股权的权利。若晶合集成因任何原因决定不行使前述优先受让的权利，应及时通知本企业，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将停止该等业务，或转让该等资产或股权直至不再控制。

如果本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将来可能存在任何与晶合集成业务产生竞争的业务机会，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将通知晶合集成并尽力促使该业务机会首先提供给晶合集成或其控股子公司，晶合集成或其控股子公司享有优先获取上述业务的权利。若晶合集成或其控股子公司因任何原因决定不行使前述优先获取的权利，应及时通知本企业；本企业直接或间接控制的其他企业应确保不会导致与晶合集成产生同业竞争。

本企业及本企业直接或间接控制的其他企业不向晶合集成业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与晶合集成业务有关之专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本企业保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保晶合集成按照上市公司的规范独立自主经营，保证晶合集成的资产、业务、财务、人员、机构独立。

上述承诺于本企业作为晶合集成的控股股东的一致行动人期间内持续有效。

## 七、关联方、关联关系及关联交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》《注册管理办法》《科创板上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等规范性文件的有关规定，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的主要关联方及关联关系如下：

## 1、控股股东、实际控制人

发行人控股股东为合肥建投，直接持有发行人 31.14%的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85%的股份，合计控制发行人 52.99%的股份，系发行人的控股股东，其详细情况参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、控股股东的基本情况”。

发行人实际控制人为合肥市国资委，直接持有合肥建投 100%的股权。

## 2、控股股东控制的除发行人及其子公司以外的其他企业

发行人控股股东为合肥建投，合肥建投控制的除发行人及其子公司以外的企业均为发行人关联方。合肥建投控制的主要企业参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东控制的其他企业”。

## 3、发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	蔡国智	发行人董事长
2	陆勤航	发行人副董事长
3	陈小蓓	发行人董事
4	郑素芬	发行人董事
5	朱晓娟	发行人董事、副总经理
6	朱才伟	发行人董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
7	安广实	发行人独立董事
8	陈绍亨	发行人独立董事
9	BEICHAO ZHANG（张北超）	发行人独立董事
10	杨国庆	发行人监事会主席
11	胡竞英	发行人监事
12	王燕	发行人职工代表监事
13	蔡辉嘉	发行人总经理
14	詹奕鹏	发行人副总经理
15	邱显寰	发行人副总经理
16	周义亮	发行人副总经理

序号	关联方姓名	关联关系说明
17	李迦谕	发行人协理
18	简瑞荣	发行人协理
19	李庆民	发行人协理

发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员为公司的关联方，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

4、发行人的董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者发行人的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	合肥建投	陆勤航担任董事兼总经理、陈小蓓担任副总经理
2	启迪控股股份有限公司	陆勤航担任董事
3	合肥建投资本管理有限公司	陈小蓓担任董事
4	安徽省合肥联合发电有限公司	陈小蓓担任董事
5	合肥市大数据资产运营有限公司	陈小蓓担任董事
6	合肥丰乐种业股份有限公司	陈小蓓担任董事
7	合肥中科微电子创新中心有限公司	陈小蓓担任董事
8	合肥百货大楼集团股份有限公司	陈小蓓担任董事
9	合肥京东方显示技术有限公司	陈小蓓担任董事长
10	合肥维信诺科技有限公司	陈小蓓担任董事
11	蔚来控股有限公司	陈小蓓担任董事
12	合肥德轩投资管理有限公司	陈小蓓担任董事
13	智丰科技股份有限公司	郑素芬担任总经理
14	新相科技股份有限公司	郑素芬担任董事长
15	顺立投资股份有限公司	郑素芬担任董事
16	瑞相科技股份有限公司	郑素芬担任董事
17	晶相光电股份有限公司	郑素芬担任董事
18	宏丽数位创意股份有限公司	郑素芬担任董事
19	智成电子股份有限公司	郑素芬担任董事
20	景睿科技股份有限公司	郑素芬担任董事

序号	关联方姓名	关联关系说明
21	智仁科技开发股份有限公司	郑素芬担任董事
22	力晶微元电子股份有限公司	郑素芬担任董事长
23	集邦科技股份有限公司	郑素芬担任董事
24	富硕投资股份有限公司	郑素芬担任董事
25	智慧记忆科技股份有限公司	郑素芬担任董事
26	英达投资股份有限公司	胡竞英担任董事长
27	疯狂秀股份有限公司	胡竞英担任董事
28	中兴农林开发股份有限公司	胡竞英担任董事
29	合富润生企业管理咨询（上海）有限公司	胡竞英担任董事
30	合润生活国际有限公司	胡竞英担任董事
31	合肥市住房租赁发展股份有限公司	杨国庆担任董事
32	合肥市电动汽车充电设施运营有限公司	杨国庆担任董事

#### 5、直接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织及其控制的主要其他企业及间接持有发行人 5%以上股份的法人

序号	关联方名称/姓名	关联关系说明
1	力晶科技	直接持有发行人 5%以上股份
2	合肥芯屏	直接持有发行人 5%以上股份
3	美的创新	直接持有发行人 5%以上股份
4	美的集团股份有限公司	间接持有发行人 5%以上股份
5	力信投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
6	世仁投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
7	富硕投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
8	杭州鑫元企业管理合伙企业（有限合伙）	力晶科技直接或间接控制
9	智典国际股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
10	世成科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
11	智仁科技开发股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
12	智慧记忆科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
13	Deutron Japan Corp.	力晶科技直接或间接控制
14	智翔投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
15	智成电子股份有限公司	力晶科技直接或间接控制

序号	关联方名称/姓名	关联关系说明
16	晶币科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
17	力晶微元电子股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
18	飞圣航空股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
19	瑞相科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
20	宏丽数位创意股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
21	美云智数科技有限公司	美的创新直接或间接控制
22	深圳数智场景定位科技有限公司	美的创新直接或间接控制
23	上海美仁半导体有限公司	美的创新直接或间接控制

#### 6、直接控制公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

序号	关联方名称/姓名	关联关系说明
1	李宏卓	合肥建投董事长
2	陈小蓓	副总经理
3	陆勤航	合肥建投董事兼总经理
4	杨雪蕾	合肥建投董事兼副总经理
5	刘国恺	合肥建投董事
6	苏孙铭	合肥建投董事
7	许一云	合肥建投董事
8	毕功兵	合肥建投董事
9	王志银	合肥建投监事
10	王郑	合肥建投监事
11	郭兆志	合肥建投监事
12	杨国庆	合肥建投监事
13	范红金	合肥建投监事
14	吴子能	合肥建投副总经理
15	罗文萍	合肥建投总会计师
16	嵇小玲	合肥建投副总经理
17	合肥维信诺科技有限公司	李宏卓担任董事长
18	合肥建投资本管理有限公司	李宏卓担任董事长、罗文萍担任董事、杨雪蕾担任董事
19	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表

序号	关联方名称/姓名	关联关系说明
20	合肥市乡村振兴产业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
21	合肥芯屏	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
22	合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
23	合肥供水集团有限公司	刘国铠担任董事
24	合肥市交通控股有限公司	苏孙铭担任董事
25	安徽睿正律师事务所	许一云控制
26	合肥鼓楼商厦有限责任公司	郭兆志担任董事
27	安徽中安智通科技股份有限公司	郭兆志担任董事
28	合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	郭兆志担任董事
29	合肥科融高科技产业投资有限公司	郭兆志担任执行董事、总经理
30	合肥德电新能源汽车股份有限公司	郭兆志担任董事
31	安徽六方深冷股份有限公司	郭兆志担任董事
32	合肥建翔投资有限公司	郭兆志担任董事长、总经理
33	合肥市水务环境建设投资有限公司	郭兆志担任董事、吴子能担任董事长
34	合肥蓝科投资有限公司	郭兆志担任董事
35	合肥金太阳能源科技股份有限公司	郭兆志担任董事
36	合肥市勘察院有限责任公司	郭兆志担任董事
37	中煤新集合肥发电有限公司	郭兆志担任董事
38	合肥泽众城市智能科技有限公司	嵇小玲担任董事、吴子能担任副董事长
39	合安高铁股份有限公司	嵇小玲担任董事
40	辰安天泽智联技术有限公司	嵇小玲担任董事
41	安徽庐铜铁路有限公司	吴子能担任副董事长
42	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	吴子能担任副董事长
43	合肥新桥国际机场有限公司	吴子能担任副董事长
44	安徽合泰新能源发展有限公司	吴子能担任董事
45	合肥市建设投资有限公司	罗文萍担任执行董事、总经理
46	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	杨雪蕾担任执行董事
47	安徽省通航控股集团有限公司	杨雪蕾担任董事

合肥建投董事兼总经理陆勤航、副总经理陈小蓓、监事杨国庆控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织参见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之

“(一) 关联方及关联关系”之“4、发行人的董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者发行人的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织”。

#### 7、发行人控股子公司

序号	关联方名称/姓名	关联关系说明
1	日本晶合	发行人全资子公司
2	北京晶芯成	发行人全资子公司
3	南京晶驱	发行人全资子公司
4	新晶集成	发行人控股子公司

#### 8、其他主要关联方

序号	关联方名称/姓名	关联关系说明
1	黄颢	过去 12 个月曾任公司董事
2	倪敬东	过去 12 个月曾任合肥建投董事
3	黄跃明	过去 12 个月曾任合肥建投监事
4	田胜彬	过去 12 个月曾任合肥建投监事兼副总经理
5	朱庆	过去 12 个月曾任合肥建投监事
6	合肥龙和投资咨询有限公司	黄跃明担任董事兼总经理、倪敬东担任董事
7	安徽省合巢水运建设开发有限公司	黄跃明担任董事
8	合肥二号线轨道交通有限公司	田胜彬担任董事
9	合肥建翔投资有限公司	田胜彬担任董事
10	益宠生医股份有限公司	过去 12 个月胡竞英担任董事
11	合肥高特佳创业投资有限责任公司	过去 12 个月陈小蓓担任董事

除上述外，控股股东的合营企业及其子公司、联营企业及其子公司、过去 12 个月曾任公司董事、监事、高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的企业或其他组织亦为公司的关联方。

#### (二) 报告期内关联方的变化情况

自报告期初至 2022 年 12 月 31 日，发行人新增关联方的具体情况详见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“(一) 关联方及关联关系”。

发行人在报告期内减少的主要关联方如下：

序号	关联方名称/姓名	期初关联关系	关联关系变化原因
1	王刚	曾任晶合有限董事	从发行人处离职
2	王其国	曾任晶合有限董事	从发行人处离职
3	孔亦融	曾任晶合有限董事	从发行人处离职
4	王友军	曾任晶合有限董事	从发行人处离职
5	黎湘鄂	曾任晶合有限高级管理人员	从发行人处离职
6	YI LU (陆祎)	曾任晶合有限董事	从发行人处离职
7	杨幼玲	曾任晶合有限高级管理人员	从发行人处离职
8	孙志明	曾任晶合有限高级管理人员	从发行人处离职
9	王继武	曾任晶合有限高级管理人员	从发行人处离职
10	盛惟健	曾任晶合有限高级管理人员	从发行人处离职
11	安徽冠雅商贸有限公司	合肥建投控制	该企业注销
12	恒耀电子股份有限公司	力晶科技控制	该企业解散
13	Sprout International Limited	力晶科技控制	该企业解散

### (三) 报告期内的关联交易

#### 1、关联交易总体情况及对发行人财务状况、经营成果的影响

报告期内，发行人发生的关联交易情况简要汇总如下：

单位：万元

项目	关联方	2022年度	2021年度	2020年度
经常性 关联交易	合肥建投	-	-	199.69
	合肥供水集团有限公司	1,294.45	633.39	368.42
	合肥燃气集团有限公司	1,295.01	596.20	308.09
	合肥蜀山百大购物中心有限公司	-	-	2.70
	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	-	-	2.28
	合肥市住房租赁发展股份有限公司	15.32	142.80	-
	力晶科技	-	-	160.17
	智成电子股份有限公司	1,615.82	784.48	372.62
	关联采购合计	4,220.60	2,156.87	1,413.97
	关联采购金额占当期营业成本比例	0.78%	0.72%	0.86%



项目		关联方	2022年度	2021年度	2020年度
	向关联方销售商品及提供服务	晶相光电股份有限公司	6.54	6.23	-
		关联销售合计	6.54	6.23	-
		关联销售金额占当期营业收入比例	0.00%	0.00%	-
	关键管理人员薪酬	关键管理人员	3,631.83	2,168.94	1,440.43
关联租赁	合肥蓝科	详见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“(三)报告期内的关联交易”之“2、重大关联交易”之“(2)重大经常性关联交易”之“①与合肥蓝科的租赁”			
	合肥市住房租赁发展股份有限公司	详见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“(三)报告期内的关联交易”之“3、一般关联交易”之“(1)一般经常性关联交易”之“③与合肥市住房租赁发展股份有限公司的租赁”			
偶发性关联交易	关联担保	合肥建投	详见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“(三)报告期内的关联交易”之“2、重大关联交易”之“(3)重大偶发性关联交易”之“①关联担保”		
	受让关联方银行存单	合肥融科项目投资有限公司、合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业(有限合伙)	详见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“(三)报告期内的关联交易”之“2、重大关联交易”之“(3)重大偶发性关联交易”之“②受让关联方银行存单”		
	《委托经营管理合约》的签订与解除	力晶科技	详见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“(三)报告期内的关联交易”之“3、一般关联交易”之“(2)一般偶发性关联交易”之“①《委托经营管理合约》的签订与解除情况”		
	专利所有权转让	力晶科技	详见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“(三)报告期内的关联交易”之“3、一般关联交易”之“(2)一般偶发性关联交易”之“②专利所有权的转让情况”		

报告期各期，发行人向关联方采购商品及接受服务的金额分别为 1,413.97 万元、2,156.87 万元和 4,220.60 万元，占当期营业成本比例分别为 0.86%、0.72%和 0.78%；发行人向关联方销售商品及提供服务的金额分别为 0 万元、6.23 万元和 6.54 万元，占当期营业收入比例分别为 0.00%、0.00%和 0.00%。

报告期内，发行人与关联方的经常性关联交易金额及占比较小。在关联采购方面，主要为发行人因生产经营及研发所需，向关联方采购的咨询服务费用、IP 授权费用、

用水及燃气费用等；在关联销售方面，主要为发行人向晶相光电股份有限公司销售晶圆；在关联租赁方面，主要为发行人向合肥蓝科租赁土地、厂房及配套厂务设备和向合肥市住房租赁发展股份有限公司租赁房屋。报告期内，发行人与关联方所发生的经常性关联交易遵循市场化交易原则，具有合理的商业逻辑与必要性。

报告期内，发行人的偶发性关联交易主要为合肥建投向发行人提供担保、发行人受让关联方银行存单。发行人的偶发性关联交易具有合理的商业逻辑和必要性，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

报告期内，发行人与关联方存在应收关联方款项和应付关联方款项，主要系前述关联交易形成的往来款项余额。报告期内，发行人与关联方均及时清偿对方的应收或应付款项，相关款项回款周期正常。

报告期内，公司不存在对关联方的重大依赖，发生的关联交易遵循市场化交易原则，与关联方发生的关联采购相较于同期市场价格不存在重大差异，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关联交易转移利润的情形。发行人报告期内发生的关联交易对发行人的财务状况和经营成果未产生重大影响。

## 2、重大关联交易

### （1）重大关联交易的判断标准及依据

根据发行人《关联交易实施细则》的规定，发行人与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币以上，且占发行人最近一期经审计总资产或上市后市值绝对值 1%以上的关联交易，需提交股东大会审议；发行人为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。

发行人上述规定符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，发行人将上述关联交易定为重大关联交易。

### （2）重大经常性关联交易

#### ①与合肥蓝科的租赁

2020 年度，发行人作为承租方的土地租赁情况列示如下：

单位：万元

关联方	租赁资产种类	2020 年度确认的租赁费
合肥蓝科	土地	263.24

报告期内，发行人作为承租方租入合肥蓝科厂房及配套厂务设备。2020 年度长期应付款增减变动情况列示如下：

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2020 年度	183,938.79	2,479.31	6,235.21	180,182.88

发行人于 2021 年 1 月 1 日实施新租赁准则，按照新租赁准则相关要求，发行人将上述租入的土地、厂房及配套厂务设备调整计入使用权资产，相关负债调整计入租赁负债。发行人 2021 年度、2022 年度与土地、厂房及配套厂务设备相关的租赁负债原值增减变动情况列示如下：

单位：万元

关联方	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
合肥蓝科	346,449.02	-	25,523.75	320,925.27

(续上表)

单位：万元

关联方	2020 年 12 月 31 日	会计政策变更	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
合肥蓝科	-	188,444.99	188,444.99	174,353.91	16,349.88	346,449.02

报告期内，发行人作为承租方向合肥蓝科租入资产所支付的租金金额分别为 6,498.46 万元、16,349.88 万元和 25,523.75 万元。根据发行人与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及发行人与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》，发行人作为承租方向合肥蓝科租入生产经营所需的土地、厂房及配套厂务设备，上述租入资产均位于安徽省合肥市新站区综合保税区内，为发行人的注册地及主要经营场所。

其中 2020 年度发行人尚未执行新租赁准则，土地租金按照总金额/租赁年限确定

各年土地租赁金额；厂房租赁按照决算价格及相关的税费金额确定为租赁总金额，租赁年限为 32 年，公司按照融资租赁入账。公司对于竣工决算金额与最低租赁付款额现值的差额，确认为政府补助，计入递延收益。

发行人自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，按照土地的公允价值确认使用权资产原值，并根据 2021 年 1 月 1 日前尚未支付的租金金额调整使用权资产入账金额，使用权资产在剩余租赁期内摊销。

### (3) 重大偶发性关联交易

#### ① 关联担保

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人接受关联方的担保情况如下：

单位：万元

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	发行人是否提供反担保
合肥建投	华泰资产管理有限公司	130,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
合肥建投	华泰资产管理有限公司	30,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
合肥建投	华泰资产管理有限公司	42,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
合肥建投	华泰资产管理有限公司	90,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
合肥建投	华泰资产管理有限公司	8,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
合肥建投	平安银行股份有限公司合肥分行	62,080.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
合肥建投	兴业银行股份有限公司合肥分行	15,125.40	借款发放日	2028/1/7	否	是
合肥建投	兴业银行股份有限公司合肥分行	39,000.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
合肥建投	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	63,397.83	借款发放日	2028/1/15	否	是
合肥建投	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	18,292.69	2021/3/19	2027/10/10	否	是

注：中国银行股份有限公司合肥北城支行已更名为中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

2018 年 8 月 20 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与华泰资产管理有限公司签署了《华泰—合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划保证担保合同》，为发行人与华泰资产管理有限公司签署的《投资计划》提供本金不超过 300,000.00 万元的全额

无条件不可撤销连带责任保证担保，保证期间为保证担保合同生效之日起至投资合同项下约定的债务人履行全部债务期限届满之日起两年。

2021年3月17日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与平安银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证担保合同》，为发行人与平安银行股份有限公司合肥分行签署的《综合授信额度合同》提供85,000.00万元连带责任保证担保，保证期间为《最高额保证担保合同》生效日至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后两年。

2017年12月29日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为发行人最高本金限额70,000.00万元提供连带责任保证担保。保证额度有效期自2017年12月29日至2028年1月5日止。

2017年12月14日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与中国银行股份有限公司合肥庐阳支行签署了《最高额保证合同》，为发行人与中国银行股份有限公司合肥庐阳支行签署的《授信额度协议》70,000.00万元提供连带责任保证担保，保证期间为《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日期间主债权发生期间届满之日起两年。

2021年3月17日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与中国银行股份有限公司庐阳支行签署了《保证合同》，为发行人与中国银行股份有限公司合肥庐阳支行签署的《固定资产借款合同》25,000.00万元提供连带责任保证担保，保证期间为《固定资产借款合同》之主债权的清偿期届满之日起三年。

2020年4月29日，发行人与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订《反担保合同》，发行人就合肥市建设投资控股（集团）有限公司为发行人当时相关借款的担保提供反担保。

2021年4月13日，发行人与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订了《反担保合同补充协议》，在符合海关监管相关规定的前提下，合肥市建设投资控股（集团）有限公司对于发行人所有的晶合一期5万片月产能所对应的机器设备及原物料中海关监管期限已届满的部分有权变卖处分和优先受偿。对于发行人其余在海关监管期限内的机器设备及原物料，在海关监管期限届满后，合肥市建设投资控股（集团）有限公司自动享有前述权利。

2021年7月1日，发行人与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订《动产浮动抵押合同》，约定合肥市建设投资控股（集团）有限公司对于发行人所有的晶合一期5万片月产能所对应的机器设备及原物料中海关监管期限已届满的部分有权变卖处分和优先受偿，对于抵押人其余在海关监管期限内的机器设备及原物料，在海关监管期限届满后合肥市建设投资控股（集团）有限公司自动享有前述权利。

合肥市建设投资控股（集团）有限公司对发行人海关监管期限届满的部分机器设备办理抵押登记，已办理抵押登记的机器设备于2022年12月31日的账面原值、累计折旧及账面价值如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	443,871.50	210,391.12	233,480.38

## ②受让关联方银行存单

2022年8月29日，发行人与合肥融科项目投资有限公司签订了3份《徽商银行单位大额存单产品转让协议》，约定发行人按照商定的转让价格受让合肥融科项目投资有限公司持有的3份产品徽商银行股份有限公司单位大额存单，并委托徽商银行合肥蜀山支行办理相关转让事宜，转让信息具体如下：

单位：万元

产品名称	产品本金	转让价格
徽商银行股份有限公司单位大额存单	10,000.00	10,016.26
徽商银行股份有限公司单位大额存单	10,000.00	10,016.26
徽商银行股份有限公司单位大额存单	10,000.00	10,016.26

2022年12月26日，发行人与合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）签订了2份《徽商银行单位大额存单产品转让协议》，约定发行人按照商定的转让价格受让合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）持有的2份产品徽商银行股份有限公司单位大额存单，并委托徽商银行合肥蜀山支行办理相关转让事宜，转让信息具体如下：

单位：万元

产品名称	产品本金	转让价格
徽商银行股份有限公司单位大额存单	10,000.00	10,017.82
徽商银行股份有限公司单位大额存单	5,000.00	5,008.91

### 3、一般关联交易

#### (1) 一般经常性关联交易

##### ①向关联方采购商品及接受服务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年度		2021年度		2020年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
合肥建投	咨询服务	-	-	-	-	199.69	0.12%
合肥供水集团有限公司	采购货物	1,294.45	0.24%	633.39	0.21%	368.42	0.22%
合肥燃气集团有限公司	采购货物	1,295.01	0.24%	596.20	0.20%	308.09	0.19%
合肥蜀山百大购物中心有限公司	采购货物	-	-	-	-	2.70	0.00%
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	采购货物	-	-	-	-	2.28	0.00%
合肥市住房租赁发展股份有限公司	房屋租赁及代缴水电费	15.32	0.00%	142.80	0.05%	-	-
力晶科技	咨询服务	-	-	-	-	152.72	0.09%
力晶科技	专利转让手续费	-	-	-	-	7.45	0.00%
智成电子股份有限公司	采购服务	1,615.82	0.30%	784.48	0.26%	372.62	0.23%
<b>关联采购合计</b>		<b>4,220.60</b>	<b>0.78%</b>	<b>2,156.87</b>	<b>0.72%</b>	<b>1,413.97</b>	<b>0.86%</b>

注：占比为关联采购的金额占当期营业成本的比例

报告期各期，发行人向合肥建投采购商品及接受服务的金额分别为 199.69 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.12%、0.00%和 0.00%。报告期内，根据发行人与合肥建投签署的《咨询服务合约书》，合肥建投通过向发行人委派部分管理人员的方式向发行人提供企业管理、财务、会计及采购、销售等相关咨询服务，发行人向合肥建投支付咨询服务费用，未向该等委派管理人员支付薪酬。上述安排已于 2020 年 3 月 31 日终止。发行人向合肥建投购买的咨询服务费定价系以发行人同等职级岗位的平均薪酬为依据确定，定价合理、公允。

合肥供水集团有限公司为合肥建投控股子公司。报告期各期，发行人向合肥供水集团有限公司采购厂区用水的金额分别为 368.42 万元、633.39 万元和 1,294.45 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.22%、0.21%和 0.24%。上述采购价格均按照合肥市政府指导价格采购。

合肥燃气集团有限公司为合肥建投控股子公司。报告期各期，发行人向合肥燃气集团有限公司采购燃气的金额分别为 308.09 万元、596.20 万元和 1,295.01 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.19%、0.20%和 0.24%。上述采购价格均按照合肥市政府指导价格采购。

合肥市住房租赁发展股份有限公司为合肥建投控股子公司。2020 年度和 2021 年度发行人向合肥市住房租赁发展股份有限公司租赁房屋的交易金额分别为 0.00 万元和 142.80 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.00%和 0.05%，2022 年度发行人就该项房屋租赁交易确认租赁负债，具体情况详见下文“③与合肥市住房租赁发展股份有限公司的租赁”，上述房屋租赁价格参照市场价格确定；2022 年 4 月 27 日，发行人与合肥市住房租赁发展股份有限公司签订了《关于预存水、电费缴纳结算协议》，根据协议约定，为保证智能水电表正常使用，发行人预存水电费至合肥市住房租赁发展股份有限公司账户中，并在合肥市住房租赁发展股份有限公司每月扣款后，于月底前将上述款项再次充值至指定账户，2022 年度该项交易发生额为 15.32 万元。

报告期各期，发行人向力晶科技采购咨询服务的金额分别为 152.72 万元、0.00 万元和 0.00 万元。报告期内，根据发行人与力晶科技签署的《咨询服务合约书》，力晶科技通过向发行人委派部分管理人员的方式向发行人提供半导体产业财务、会计及审计等相关咨询服务，发行人向力晶科技支付咨询服务费用，未向该等委派管理人员支付薪酬。上述安排已于 2020 年 6 月 30 日终止。发行人向力晶科技购买的咨询服务费定价系参考同行业可比公司的高管薪酬，以发行人同等职级的平均工资为依据确定，定价合理、公允。

报告期各期，发行人向智成电子股份有限公司采购服务相关交易金额分别为 372.62 万元、784.48 万元和 1,615.82 万元，主要系发行人向智成电子股份有限公司采购 IP 授权的费用。采购价格系遵循市场化交易原则，双方协商确定，采购价格具备公允性。



## ②向关联方销售商品及提供服务

报告期内，发行人向关联方销售商品及提供服务情况列示如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年度		2021年度		2020年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶相光电股份有限公司	销售商品	6.54	0.00%	6.23	0.00%	-	-
关联销售合计		6.54	0.00%	6.23	0.00%	-	-

注：占比为关联销售的金额占当期营业收入的比例

## ③与合肥市住房租赁发展股份有限公司的租赁

2022年，发行人与合肥市住房租赁发展股份有限公司签订房屋租赁合同，相关的租赁负债增减变动情况列示如下：

单位：万元

关联方	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
合肥市住房租赁发展股份有限公司	-	480.06	425.88	54.18

## ④关键管理人员薪酬

报告期各期，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额分别为 1,440.43 万元、2,168.94 万元和 3,631.83 万元。

## (2) 一般偶发性关联交易

## ①《委托经营管理合约》的签订与解除情况

2015年10月19日，公司与力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理，以协助公司执行于合肥新站区建成12英寸晶圆制造厂项目。2020年1月2日，公司与力晶科技签订了《委托经营管理合约之终止协议》，双方同意自2019年12月25日起即终止《委托经营管理合约》。

《委托经营管理合约》终止前后对发行人经营模式、客户、供应商、技术、日常经营管理等方面的变动及影响如下：

## A. 经营模式

发行人自 2017 年 10 月正式量产以来，经营模式一直为晶圆代工模式，《委托经营管理合约》终止前后，发行人的生产模式、采购模式、研发模式、营销模式、销售模式等未发生变化。《委托经营管理合约》终止前后，发行人的经营模式具体详见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务”之“（四）主要经营模式”。

## B.客户、供应商

报告期内，发行人主要客户、供应商均为境内外知名半导体行业设计公司、相关领域境内外知名公司，发行人已与主要客户、供应商建立了长期稳定的合作关系，并与部分主要客户、供应商签署了长期合作协议，不存在因为终止《委托经营管理合约》而造成客户流失或影响发行人采购的情形，《委托经营管理合约》终止未影响发行人与上述客户、供应商之间的业务合作，对于发行人客户、供应商稳定性与业务持续性方面没有影响。

### a.客户独立开发及维护的依据

在客户开拓方面，力晶科技参与情况如下：

发行人建设初期（2016 年），根据发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》，力晶科技向发行人引荐了奇景光电和奕力科技两家客户，以进行技术平台验证、满足技转完成条件；发行人于 2017 年 9 月、11 月分别和奕力科技及奇景光电确认了技术转让平台的适用性后，与奇景光电、奕力科技独立沟通、谈判签署相关合同订单，并完成后续试产、风险量产、量产以及客户关系维护等工作。2016 年 11 月，发行人独立与联咏科技建立了合作意向，2017 年 3 月，发行人选定联咏科技作为 150nm 工艺平台首个客户，由于当时发行人的工厂尚未竣工，尚不具备生产能力，因此力晶科技应发行人要求在其工厂内配合对 150nm 平台进行了验证。此外，由于发行人在 2018 年 6 月前不具备光罩设计能力，发行人曾委托力晶科技在 2018 年 6 月前协助发行人针对奇景光电、奕力科技、联咏科技、集创北方、敦泰电子等主要客户进行光罩设计；2018 年 7 月后发行人具备光罩设计能力，力晶科技不再参与该环节。

除上述情况外，发行人全部客户均由发行人独立开发、谈判及维护，无力晶科技及力积电参与；报告期初至本招股意向书签署日，发行人新开拓的客户均由发行人独立开发、谈判及维护，无力晶科技及力积电参与。主要包括：发行人与客户对接的销

售人员均为发行人员工，与发行人签署独立劳动关系合同，与力晶科技不存在劳动关系；发行人销售人员与客户通过邮件、电话、现场拜访等方式取得联系，沟通确认需求，正式订单由客户主要通过邮件等方式直接向发行人下达，发行人与客户的销售合同均由发行人与客户直接签署，前述过程无力晶科技及力积电参与。

#### b. 合约终止后发行人独立开拓的新客户及在手订单情况

《委托经营管理合约》终止后，发行人独立开拓的新客户主要包括：联发科技股份有限公司、紫光展锐（上海）科技有限公司及其关联方、比亚迪半导体有限公司、海速芯（杭州）科技有限公司、杰华特微电子股份有限公司、深圳通锐微电子技术有限公司、西安拓尔微电子股份有限公司、晶相光电股份有限公司及其关联方等。

截至 2023 年 3 月 15 日，《委托经营管理合约》终止后发行人独立开拓的新客户向发行人下达的在手订单余量约 47,736 片，在手订单金额约 30,428.32 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，《委托经营管理合约》终止后发行人独立开拓的新客户与发行人签订的产能预约合同中涉及预约 2023 年及之后的产能共 85.34 万片，发行人收取的产能预约金余额共 12.79 亿元。

#### c. 供应商独立开发及维护的依据

发行人建设初期，根据发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》，发行人自力晶科技处取得了相关技术文件，其中的《合格供应商名单》载明了技转平台涉及的所需主要设备、原材料的供应商名称，由于集成电路行业上游设备及原材料行业集中度较高，该名单中供应商主要为行业知名企业。在发行人生产经营初期，为确保技转成功、品质稳定，发行人结合过往行业经验及生产经营的实际需要，主要向《合格供应商名单》中载明的供应商进行采购；该采购过程均为发行人独立谈判、议价，并由发行人与供应商独立签署协议或订单，无力晶科技及力积电参与。

技转完成后，为加强成本控制、保证晶圆代工服务质量、提高生产效率和存货周转效率，公司已建立严格的采购流程和供应商管理体系。截至本招股意向书签署之日，发行人已通过独立开拓的方式，与中微半导体、屹唐半导体、北方华创、液化空气及其关联企业、重庆超硅半导体有限公司等《合格供应商名单》外的知名供应商建立了良好的采购合作关系，扩大供应商范围，降低供应链风险。

发行人与供应商独立联系并建立合作，主要包括：发行人与供应商对接的采购人

员均为发行人员工，与发行人签署独立劳动关系合同，与力晶科技不存在劳动关系；发行人采购人员与供应商通过邮件、电话、现场拜访等方式取得联系，沟通确认发行人需求，正式订单由发行人直接向供应商下达，发行人与供应商的采购合同均由发行人与供应商直接签署，前述过程无力晶科技及力积电参与。

### C.技术

自设立以来，发行人的主营业务始终为 12 英寸半导体晶圆代工服务，目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸半导体晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的风险量产，发行人现有技术平台中，150nm-90nm LCD 显示驱动芯片技术为在力晶科技的技转技术基础上进行改良优化、创新升级后形成，其余 LED 显示驱动、CIS、E-tag、MCU、PMIC 以及 55nm 逻辑及显示驱动芯片等领域核心技术平台均为自主研发。报告期内，公司研发团队均系公司员工，相关研发人员利用公司自有资源独立进行研发工作，力晶科技人员未参与公司研发工作。《委托经营管理合约》终止前后，发行人新产品、项目均在正常研发过程中，《委托经营管理合约》终止对于发行人技术方面没有影响。

### D.日常经营管理

《委托经营管理合约》签订后，发行人未将经营管理权委托予力晶科技，发行人的经营运作仍以发行人自身员工或合肥建投委派高管为主导。《委托经营管理合约》终止前后，发行人日常经营管理方面未发生重大变化，《委托经营管理合约》终止对于发行人日常经营管理没有影响。

#### ②专利所有权的转让情况

2017 年 3 月，力晶科技使用 58 项专利技术使用权等专有技术向晶合集成增资。2020 年 9 月 3 日，力晶科技与晶合集成签署《专利转让协议》，约定将上述 58 项专利中尚在有效期内的 44 项专利的所有权无偿转让给晶合集成。截至本招股意向书签署之日，前述 44 项专利的所有权已转让至晶合集成，相关专利具体情况详见“第五节 业务与技术”之“五、与发行人业务相关的主要资产情况”之“（三）主要无形资产”。

#### 4、关联方往来余额

##### (1) 应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	邱显寰	2.68	-	-	-	13.83	-
其他应收款	詹奕鹏	2.02	-	-	-	2.02	-
其他应收款	简瑞荣	3.24	-	-	-	0.18	-
其他应收款	李迦谕	-	-	1.16	-	-	-
其他应收款	合肥燃气集团有限公司	72.00	-	40.00	-	40.00	-
其他应收款	智成电子	-	-	0.06	0.003	-	-
其他应收款	合肥市住房租赁发展股份有限公司	152.70	-	21.90	-	-	-

报告期各期末，应收关联方款项中涉及关联自然人的其他应收款主要为员工借支的子女教育费、返乡、租房等款项。该等款项均已按照公司内控管理制度履行了必要的审批程序。

##### (2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应付款	蔡辉嘉	1.34	0.51	-
其他应付款	周义亮	-	0.10	0.07
其他应付款	李迦谕	-	-	0.34
其他应付款	朱才伟	-	-	0.05
其他应付款	简瑞荣	-	0.38	-
其他应付款	邱显寰	-	0.34	-
其他应付款	蔡国智	-	0.17	-
其他应付款	合肥蓝科	63.67	129.91	712.94
其他应付款	晶相光电股份有限公司	-	1,821.97	-
应付账款	合肥蓝科	-	-	704.13
应付账款	力晶科技	-	-	7.44

项目名称	关联方	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付账款	合肥燃气集团有限公司	105.69	57.90	27.18
应付账款	智成电子股份有限公司	688.78	583.47	189.74
应付账款	合肥市住房租赁发展股份有限公司	2.40	-	-
应付账款	合肥供水集团有限公司	-	13.36	-
合同负债	晶相光电股份有限公司	1,994.26	-	-
长期应付款	合肥蓝科	-	-	180,182.88
租赁负债	合肥蓝科	320,925.27	346,449.02	-
租赁负债	合肥市住房租赁发展股份有限公司	54.18	-	-

注：其他应付个人款项主要为员工报销款

上表对合肥蓝科的长期应付款、租赁负债系发行人向合肥蓝科租赁土地、厂房及配套厂务设备形成，具体情况参见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）报告期内的关联交易”之“2、重大关联交易”之“（2）重大经常性关联交易”；2021年末对晶相光电股份有限公司的其他应付款系发行人收到的晶相光电股份有限公司的产能保证金，根据双方2022年度签署的补充协议，晶相光电股份有限公司的产能保证金可用于抵扣货款，发行人于2022年末将其确认为合同负债。

#### （四）报告期内关联交易所履行的程序

报告期内，发行人关联交易均已严格履行了《公司章程》规定的程序。报告期内已发生关联交易的审议程序如下：

发行人于2021年2月9日召开第一届董事会第三次会议，审议了关于公司2018-2020年度的关联交易的议案，关联董事在董事会审议该议案时回避表决。发行人全体独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见，认为：（1）2018-2020年度关联交易事项审议程序和表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决；（2）上述关联交易事项均是为了满足公司日常正常业务开展的需要而进行，该等关联交易是必要、合理的；（3）合肥蓝科投资有限公司系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则确认

为政府补助，计入递延收益，该等关联交易符合公司和全体股东的利益；（4）除此之外，公司其他与关联方的交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。

发行人于 2021 年 3 月 16 日召开股东大会，审议了关于确认公司 2018-2020 年度关联交易的议案和关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案，关联股东在股东大会审议该等议案时回避表决。

发行人于 2022 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议，审议了关于确认公司 2021 年度日常关联交易的议案和关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案，关联董事在董事会审议该议案时回避表决。发行人全体独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见，认为：（1）上述关联交易事项审议程序和表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决；（2）上述关联交易事项均是为了满足公司日常正常业务开展的需要而进行，该等关联交易是必要、合理的；（3）合肥蓝科投资有限公司系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房及 N1 厂配套设施，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则确认为政府补助，计入递延收益，该等关联交易符合公司和全体股东的利益；（4）除此之外，公司其他与关联方的交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。

发行人于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议了关于确认公司 2021 年度日常关联交易的议案和关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案，关联股东在股东大会审议该等议案时回避表决。

发行人于 2023 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十六次会议，审议了关于确认公司 2022 年度日常关联交易的议案、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案以及关于对公司 2022 年度偶发性关联交易进行确认的议案，关联董事在董事会审议该议案时回避表决，其中：

就关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案，发行人全体独立董事发表了独立意见，认为：（1）上述关联交易事项审议程序和表决程序合法、合规，公司董事会在

审议上述议案时，关联董事均回避了表决；（2）上述关联交易事项均是为了满足公司日常正常业务开展的需要而进行，该等关联交易是必要、合理的；（3）合肥蓝科投资有限公司系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房及 N1 厂配套设施，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则确认为政府补助，计入递延收益，该等关联交易符合公司和全体股东的利益；（4）除此之外，公司其他与关联方的交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。

就关于对公司 2022 年度偶发性关联交易进行确认的议案，发行人全体独立董事发表了独立意见，认为：公司确认的偶发性关联交易系公司生产经营中正常业务行为，符合市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述关联交易事项。

发行人拟于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述关联交易相关议案。

## （五）规范和减少关联交易的措施

### 1、公司治理对于减少关联交易的措施安排

截至本招股意向书签署之日，发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面均具备独立性，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。发行人将尽量减少关联交易的发生，对于将来可能发生的关联交易，发行人将严格按照法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《关联交易实施细则》《独立董事工作制度》的规定，认真履行关联交易审议程序，并对关联交易予以充分披露。

目前，发行人董事会由 9 名成员组成，其中有 3 名独立董事，有利于发行人董事会的独立性和公司治理机制的完善，独立董事将在规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。

### 2、相关责任主体关于规范和减少关联交易承诺

为规范和减少关联交易，发行人的控股股东合肥建投出具了《关于规范并减少关联交易的承诺函》，承诺如下：



“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

对于与晶合集成经营活动相关的且无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件关于关联交易的相关要求，履行晶合集成公司章程中关联交易决策程序，按照公平合理的原则确定关联交易价格，并依法履行信息披露义务。

本公司保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、晶合集成的公司章程及相关制度行使相应权利，承担相应义务，不会利用控股股东地位谋求晶合集成及其控股子公司在业务经营等方面给予本公司及本公司直接或间接控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害晶合集成及其无关联关系股东的合法权益。

如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给晶合集成造成的实际损失。”

为规范和减少关联交易，发行人的控股股东合肥建投的一致行动人合肥芯屏出具了《关于规范并减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

“本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

对于与晶合集成经营活动相关的且无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件中关于关联交易的相关要求，履行晶合集成公司章程中关联交易决策程序，按照公平合理的原则确定关联交易价格，并依法履行信息披露义务。

本企业保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、晶合集成的公司章程及相关制度行使相应权利，承担相应义务，不会利用控股股东一致行动人的地位谋求晶合集成及其控股子公司在业务经营等方面给予本企业及本企业直接或间接控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害晶合集成及其无关联关系股东的合法权益。

如违反上述承诺，本企业愿意承担由此给晶合集成造成的实际损失。”

为规范和减少关联交易，持有发行人 5%以上股份的股东力晶科技出具了《关于规

范并减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

“本公司及本公司直接或间接控制的公司将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的公司将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

保证将依照有关法律、法规、规范性文件、晶合集成章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不利用关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给晶合集成造成的全部损失。”

为规范和减少关联交易，持有发行人 5%以上股份的股东美的创新出具了《关于规范并减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

“本公司及本公司直接或间接控制的公司将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的公司将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

保证将依照有关法律、法规、规范性文件、晶合集成章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不利用关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给公司造成的全部损失。”

为规范和减少关联交易，发行人全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范并减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

“在本人作为晶合集成的董事、监事及/或高级管理人员期间，本人及本人直接或间接控制的其他企业（不含晶合集成及其子公司）将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其他企业（不含晶合集成及其子公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及晶合集成章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害晶合集成及其无关联关系股东的合法权益。

本人保证将依照有关法律、法规、规范性文件、晶合集成章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用董事、监事及/或高级管理人员的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不利用关联交易损害晶合集成股东的合法权益。

如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的法律责任。”

### **3、相关责任主体关于避免公司资金占用和违规担保的承诺**

发行人的控股股东合肥建投出具了《关于避免资金占用和违规担保的承诺函》，承诺如下：

“截至本承诺函出具日，不存在晶合集成或其控股子公司为本公司或本公司控制的企业进行违规担保的情形，亦不存在本公司或本公司控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用晶合集成资金的情形。

本公司保证依法行使股东权利，不滥用控股股东地位损害晶合集成或者晶合集成其他股东的利益，本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法占用晶合集成或其控股子公司资金及要求晶合集成或其控股子公司违法违规提供担保。”

发行人的控股股东合肥建投的一致行动人合肥芯屏出具了《关于避免资金占用和违规担保的承诺函》，承诺如下：

“截至本承诺函出具日，不存在晶合集成或其控股子公司为本企业或本企业控制的企业进行违规担保的情形，亦不存在本企业或本企业控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用晶合集成资金的情形。

本企业保证依法行使股东权利，不滥用控股股东一致行动人的地位损害晶合集成或者晶合集成其他股东的利益，本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法占用晶合集成或其控股子公司资金及要求晶合集成或其控股子公司违法违规提供担保。”

## 第九节 投资者保护

### 一、本次发行前滚存利润的分配安排

2021年3月16日，发行人召开股东大会，审议通过了《关于<合肥晶合集成电路股份有限公司滚存未分配利润分配方案>的议案》，决议本次发行前公司的滚存未分配利润（累计未弥补亏损）将由公司本次发行上市完成后的全体股东按照各自持股比例共同享有（承担）。

### 二、公司本次发行前后的股利分配政策差异情况

与发行前股利分配政策相比，本次发行后的股利分配政策主要根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定制定，更加合理、完善。公司发行上市后的股利分配方式将优先采用现金分红的方式，符合相关要求，更有利于保护投资者的合法权益。同时，公司对股利分配的实施条件，尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，并进一步完善了利润分配方案的决策程序和机制，增强了股利分配政策的可操作性。

### 三、特别表决权股份、协议控制的特殊安排

根据《公司章程（草案）》，股东按其所持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。《公司章程（草案）》未针对特定股东设置特别表决权股份，公司股东亦不存在协议控制的特殊安排情况。

## 第十节 其他重要事项

### 一、重大合同

#### (一) 销售合同

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司与报告期各期前五大客户签署的正在履行的或已经履行完毕的合同或各期金额最大的订单情况如下：

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合有限	集创北方	2020/01/10-2021/03/31	90nm TDDI、110 nm LED Driver 以及 150 nm LDDI 产品晶圆代工产能预约	350 万美元产能预约金	已履行
2	晶合有限	集创北方	2020/09/15-2021/12/31	90nm、110nm、150nm 产能预留	624 万美元产能预约金	已履行
3	晶合有限	集创北方	2020/11/15-2021/12/31	90nm 产能预留	96 万美元产能预约金	已履行
4	晶合有限	集创北方	2018/01/01-2020/01/01	晶圆代工服务	/	已履行
5	晶合集成	集创北方	2021/05/12-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工产能预约	71,935.55 万元产能预约金	正在履行
6	晶合集成	集创北方	2021/12/25-2026/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm、40nm 等晶圆代工产能预约	102,669.11 万元产能预约金	正在履行
7	晶合集成	集创北方	2022/02/24	0.09um LOGIC Foundry IC WAFER	2,612.50 万美元	正在履行
8	晶合有限	敦泰电子股份有限公司	2020/09/30 前支付保证金生效-2021/12/31	90nm、110nm 产能预留	69.15 万美元产能保证金	已履行
9	晶合有限	敦泰电子股份有限公司	2019/08/22	0.11 um LOGIC Foundry IC WAFER	21.75 万美元	已履行
10	晶合集成	敦泰电子股份有限公司	2021/05/23-2023/12/31	110nm、90nm、55nm 晶圆代工产能预约	1,990.50 万美元产能预约金	正在履行
11	晶合集成	敦泰电子股份有限公司	2021/10/25-2026/12/31	150nm、110nm、55nm 晶圆代工产能预约	1,385.10 万美元	正在履行
12	晶合有限	合肥捷达微电子有限公司	2020/04/30-2021/12/31	90nm、110nm、150nm 产能预留	100 万美元产能保证金	已履行
13	晶合有限	合肥捷达微电子有限公司	2019/08/16	0.11um LOGIC Foundry IC WAFER	432 万美元	已履行
14	晶合集成	深圳天德钰科技股份有限公司	2021/05/12-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工	11,847.89 万元产能预约金	正在履行

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
		限公司				
15	晶合集成	深圳天德钰科技股份有限公司	2021/12/30-2026/12/31	110nm、90nm、55nm、40nm 晶圆代工产能预约	50,890.04 万元产能预约金	正在履行
16	晶合集成	天钰科技股份有限公司	2021/05/12-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工	3,171.12 万美元产能预约金	正在履行
17	晶合集成	深圳天德钰科技股份有限公司	2022/07/28	0.11 um LOGIC Foundry IC WAFER	582.46 万美元	正在履行
18	晶合有限	奕力科技股份有限公司	2020/11/03-保证金结算完毕	2021、2022 年度 90nm 产能预留	2021 年产能预留保证金 96 万美元；2022 年产能预留保证金 360 万美元	已履行
19	晶合有限	奕力科技股份有限公司	2020/09/18-保证金结算完毕	110nm、150nm 产能预留	111 万美元产能保证金	已履行
20	晶合集成	奕力科技股份有限公司	2021/05-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工	7,834 万美元产能预约金	正在履行
21	晶合集成	奕力科技股份有限公司	2021/10/01-2022/12/31	110nm 晶圆代工预约	/	已履行
22	晶合集成	奕力科技股份有限公司	2022/01/12-2026/12/31	110nm、55nm 晶圆代工预约	8,125.92 万美元产能预约金	正在履行
23	晶合有限	联咏科技股份有限公司	2020/06/24	0.09um LOGIC Foundry IC WAFER	2,990.91 万美元	已履行
24	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2021/04/01-2023/03/31	晶圆代工服务及晶圆产品	/	正在履行
25	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2021/05/21-2021/12/31	90nm TDDI、90nm 其他、150nm LDDI	606 万美元产能预约金	已履行
26	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2021/06/02-2023/12/31	150nm、90nm 产能	14,860.80 万美元产能预约金	正在履行
27	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2022/02/10	150nm NB,90nm NB,90nm TDDI LOGIC Foundry IC WAFER	4,443.19 万美元	正在履行
28	晶合有限	奇景光电股份有限公司	2020/09/14-2021/12/31	110nm、150nm 产能预留	280.8 万美元	已履行
29	晶合集成	奇景光电股份有限公司	2021/11/01-2026/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工产能预约	3,821.85 万美元	正在履行
30	晶合集成	奇景光电股份有限公司	2021/05/23-2023/12/31	150nm、110nm 晶圆代工	2,520 万美元产能预约金	正在履行
31	晶合集成	思特威（上海）电子科技股份有限公司	2022/01/30-2027/06/30	90nm、55nm 晶圆代工	28,317.60 万美元	正在履行

## (二) 采购合同

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司与报告期各期前五大原材料供应商签署的正在履行的或已经履行完毕的合同或各期金额最大的采购订单情况如下：

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	环球晶圆股份有限公司	2020/12/11	硅晶圆	2,100 万美元	已履行
2	晶合集成	环球晶圆股份有限公司	2021/06/01	2022、2023 年硅晶圆产能	2,772 万美元预付款	正在履行
3	晶合集成	环球晶圆股份有限公司	2021/06/07	2022 至 2024 年 12 吋磊晶硅晶圆产能	550.80 万美元预付款	正在履行
4	晶合集成	环球晶圆股份有限公司	2022/05/31	硅晶圆	3,439 万美元	已履行
5	晶合有限	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	2020/09/24	零部件	35.07 万美元	已履行
6	晶合集成	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	2021/11/25	零部件	75.84 万美元	已履行
7	晶合集成	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	2022/05/31	零部件	79.82 万美元	已履行
8	晶合有限	Wah Lee Industrial Corp.	2020/01/15	化学品	83.84 万美元	已履行
9	晶合集成	Wah Lee Industrial Corp.	2021/07/14	化学品	103.60 万美元	已履行
10	晶合集成	上海怡康化工材料有限公司	2022/01/13	化学品	753.06 万元	已履行
11	晶合有限	Nikko Metals Taiwan Co. Ltd Science Park Branch	2020/09/28	靶材	7,588.20 万日元	已履行
12	晶合有限	空气产品（昆山）气体有限公司	2019/08/14	工业气体	/	已履行
13	晶合有限	液化空气（合肥）工业气体有限公司	2016/11	氮气、氢气、氧气、氩气、氦气	/	正在履行
14	晶合集成	启钥国际贸易（上海）有限公司	2020/12/31	化学品	65.87 万美元	已履行
15	晶合有限	东电半导体设备（上海）有限公司	2020/11/23	零配件	5,946.34 万日元	已履行
16	晶合集成	Rohmand Haas Electronic Materials CMP Asia Inc.	2021/06/24	化学品	349.07 万美元	已履行
17	晶合集成	Rohmand Haas Electronic Materials CMP Asia Inc.	2022/08/18	化学品	475.29 万美元	正在履行



序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
		Inc.				
18	晶合集成	SiltronicSingaporePte.Ltd	2021/03/16	硅晶圆	270 万美元	已履行
19	晶合集成	中环领先半导体材料有限公司	2022/03/23	硅晶圆	587.50 万美元	已履行
20	晶合集成	合肥广钢气体有限公司、广钢气体（广州）有限公司	2022/02/28	氮气、普通/高纯氧气、高纯氢气、高纯氦气、高纯氩气		正在履行

### （三）授信、借款及担保合同

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行及已履行完毕的单一金额在 5 亿元以上的授信、借款及对应的担保合同如下：

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
1	晶合集成	平安银行股份有限公司合肥分行	2021/11/01	50 亿元授信	2021/11/01-2022/10/31	已履行	合肥建投提供最高额为 8.5 亿元的担保
2	晶合有限	平安银行股份有限公司合肥分行	2018/02/24	11 亿元借款	120 个月	已履行	
3	晶合集成	平安银行股份有限公司合肥分行	2021/03/19	5 亿元借款	2021/04/01-2027/10/10	正在履行	
4	晶合有限	兴业银行股份有限公司合肥分行	2017/05/18	5 亿元授信	2017/05/18-2018/05/17	已履行	合肥建投提供最高额为 7 亿元的担保
5	晶合有限	兴业银行股份有限公司合肥分行	2020/11/17	11.68 亿元授信	至 2021/03/04	已履行	
6	晶合有限	兴业银行股份有限公司合肥分行	2018/01/08	7 亿元借款	2018/01/08-2028/01/07	正在履行	
7	晶合集成	兴业银行股份有限公司合肥分行	2021/04/01	5 亿元授信	2021/04/01-2021/10/29	已履行	
8	晶合集成	兴业银行股份有限公司合肥分行	2021/12/15	19 亿元授信	2021/12/15-2022/12/09	已履行	
9	晶合集成	兴业银行股份有限公司合肥分行	2021/10/11	6 亿元授信	2021/10/11-2021/10/29	已履行	-
10	晶合有限	中国银行股份有限公司合肥	2017/11/14	7 亿元授信	生效之日起至	已履行	合肥建投提供担保

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
		庐阳支行			2018/09/21		
11	晶合有限	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	2017/11/14	7亿元借款	实际提款日起120个月	正在履行	
12	晶合集成	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	2021/03/17	2.5亿元借款	实际提款日起80个月	正在履行	
13	晶合有限	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行（受合肥建投委托提供贷款）	2018/04/28	8.05亿元借款	提款日起6个月	已履行	-
14	晶合有限	华泰资产管理有限公司	2018/08/20	不超过30亿投资本金	10年	正在履行	合肥建投提供担保
15	晶合集成	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	2021/12/30	10亿元授信	2021/12/30-2022/10/15	已履行	-
16	晶合集成	招商银行股份有限公司合肥分行	2021/08/16	10亿元授信	2021/08/16-2022/08/15	正在履行	-
17	晶合集成	平安银行股份有限公司合肥分行	2022/10/28	8亿元授信	2022/11/11-2023/11/10	正在履行	-
18	晶合集成	招商银行股份有限公司合肥分行	2022/07/20	10亿元授信	2022/08/02-2023/08/01	正在履行	-
19	晶合集成	中国光大银行股份有限公司合肥分行	2022/11/14	7.5亿元授信	2022/11/14-2025/11/13	正在履行	-
20	晶合集成	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	2022/11/21	10亿元授信	2022/11/21-2023/10/28	正在履行	-
21	晶合集成	中国民生银行股份有限公司合肥分行	2022/08/24	15亿元授信	2022/08/24-2023/08/23	正在履行	-
22	晶合集成	华夏银行股份有限公司合肥分行	2022/12/13	6亿元授信	2022/09/23-2023/09/23	正在履行	-
23	新品集成	兴业银行股份有限公司合肥分行	2022/09/29	7亿元授信	2022/09/29-2023/01/09	正在履行	晶合集成提供最高7亿担保
24	新品集成	兴业银行股份有限公司合肥分行	2022/09/29	7亿元借款	2022/09/29-2032/09/28	正在履行	
25	新品集成	中国建设银行股份有限公司	2022/11/10	8亿元借款	2022/11/30-2032/05/20	正在履行	晶合集成提供总计为8

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
		合肥城东支行					亿元的担保
26	新晶集成	招商银行股份有限公司合肥分行	2022/09/23	7 亿元借款	2022/09/23-2032/09/22	正在履行	晶合集成提供总计为 7 亿元的担保
27	新晶集成	中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	2022/09/10	8 亿元借款	首次提款日起 120 个月	正在履行	晶合集成提供担保
28	新晶集成	中国农业银行股份有限公司包河区支行、中信银行股份有限公司合肥分行	2022/09/15	15 亿元借款	2022/09/22-2024/01/22	正在履行	晶合集成提供总计为 15 亿元的担保
29	新晶集成	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	2022/08/23	10 亿元借款	首次提款日起 120 个月	正在履行	晶合集成提供总计为 10 亿元的担保

注：中国银行股份有限公司合肥北城支行已更名为中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

鉴于上述合肥建投为晶合有限提供的担保，2020 年 4 月 29 日，晶合有限同合肥建投签订《反担保合同》，具体详见本招股意向书“第八节公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）报告期内的关联交易”之“2、重大关联交易”之“（3）重大偶发性关联交易”之“①关联担保”。

#### （四）其他合同

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行及已履行完毕的其他重大合同如下：

1、2015 年 10 月 19 日，合肥新站综合开发区试验区管委会、晶合有限、力晶科技、合肥蓝科签订了《合肥 12 吋晶圆制造基地项目入区协议》。根据该协议，四方对合肥 12 吋晶圆制造基地项目概况、合肥新站综合开发区试验区管委会向晶合有限提供的基础设施、相关配套与能源供应、四方责任、优惠政策等进行了约定。

2、2017 年 6 月 28 日，合肥蓝科同晶合有限签订了《电子器件厂房设施租赁合同》，约定租赁期间自 2017 年 6 月 28 日起至 2037 年 6 月 27 日。

3、2018 年 4 月 10 日、2021 年 4 月 7 日，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目

技术协议》及其补充协议，约定力晶科技向发行人移转 90nmM+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，发行人向力晶科技合计支付 500 万美元。

4、2021 年 4 月 8 日，发行人与合肥蓝科签订了《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》，约定合肥蓝科在现有已建成的二厂厂房中建设洁净室及相关厂务设施，并建设相关配套设施等，发行人向合肥蓝科租赁二厂洁净室与厂务设施及配套设施，租赁期限为 10 年，具体起租时间以实际交付日为准。租赁期满后，发行人有优先承租权，续租协议由双方另行协商确定。同日，发行人与合肥蓝科签订了《晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议》，约定发行人自愿收购合肥蓝科建设的“晶合二厂厂务及配套项目”，双方将按照国资监管管理相关要求，以及资产转让相关程序，参考第三方机构资产评估价值及发行人已支付之建设成本，一次性全款收购，发行人承诺在项目交付之日起五年内完成收购。

5、2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 2 日，晶合有限同思特威（上海）电子科技有限公司（以下简称“思特威”）签订了《合作框架协议》及其补充协议，约定双方将在 CIS 领域开展合作，合作工艺节点为 90nm，思特威按照约定支付合作开发订金和产能订金，晶合有限需在约定时间内，保障思特威的产能需求和合作开发之平台的技术排他性技术。协议有效期自签订之日起，至 2025 年 3 月 19 日止。

6、2021年12月30日，发行人及晶合集成与北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司签订《增资协议》，约定外部投资者拟以货币方式合计出资60亿元认购晶合集成新增注册资本368,890.26万元，增资完成后，发行人持有晶合集成52.02%的股权。其中：北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）出资20亿元，中国东方资产管理股份有限公司出资4亿元，建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）出资15亿元，农银金融资产投资有限公司出资10亿元，其他投资人出资11亿元。

同日，合肥建投及晶合集成已与北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司签订《增资协议之补充协议》，约定交割日后1.5年起至满3年止，若投资者所持晶合集成股权未能转换为上市公司股票，合肥建投有权自行或指定第三方（第三方不含发行人及其控股子公司）向投资者发出收购通知，以现金方式受

让外部投资者持有晶合集成的全部股权。

7、除本节之“一、重大合同”之“（一）销售合同”已披露的合同外，截至2022年12月31日，发行人签订的产能预约金金额前五大的合同如下：

（1）2021年11月8日，发行人同客户一签订《产能预约合同》，约定发行人为客户一预留2024至2026年150nm晶圆代工产能，合同期限为2021年11月8日至2026年12月31日。

（2）2021年6月10日，发行人同客户二签订《产能预约合同》，约定发行人为客户二预留2022年及2023年150nm晶圆代工产能，合同期限为2021年6月10日至2023年12月31日。

（3）2021年12月2日，发行人同客户三及其关联方签订《产能预约合同》，约定发行人为客户三及其关联方预留150nm、110nm、90nm、55nm、40nm产品，合同期限为2021年12月2日至2026年12月31日。

（4）2021年11月16日，发行人同Sitronix Technology Corporation（矽创电子股份有限公司）签订《产能预约合同》，约定发行人为Sitronix Technology Corporation（矽创电子股份有限公司）预留2024年-2026年110nm、90nm、55nm、40nm晶圆代工产能，合同期限为2021年11月16日至2026年12月31日。

（5）2021年6月1日，发行人同客户四签订《2022-2023产能预约合同》，约定发行人为客户四预留150nm产能，合同期限为2021年6月1日至2023年12月31日。

除上述外，晶合集成签署的被授权使用IP的协议参见本招股意向书“第五节业务与技术”之“五、与发行人业务相关的主要资产”之“（三）主要无形资产”之“5、被授权使用的知识产权”。

## 二、对外担保

报告期内，晶合有限存在为控股股东合肥建投提供反担保的情况，具体详见本招股意向书“第八节公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）报告期内的关联交易”之“2、重大关联交易”之“（3）重大偶发性关联交易”之“①关联担保”。

### 三、重大诉讼或仲裁事项

#### （一）公司的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署之日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

#### （二）公司控股股东的重大诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书签署之日，发行人控股股东不存在作为一方当事人可能对发行人产生重大影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

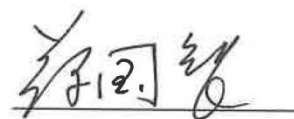
#### （三）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人可能对发行人产生重大影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司董事签名：



蔡国智



合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司董事签名：

  
陆勤航

  
合肥晶合集成电路股份有限公司  
2023年4月12日



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司董事签名：



陈小蓓



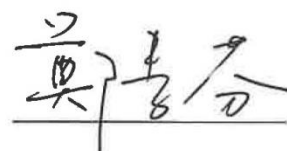
合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司董事签名：

  
郑素芬



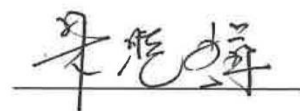
合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司董事签名：



朱晓娟



合肥晶合集成电路股份有限公司

2013年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司董事签名：



朱才伟



合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年 4 月 12 日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司董事签名：



安广实



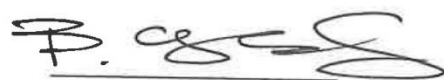
合肥晶合集成电路股份有限公司

2019年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司董事签名：



BEICHAO ZHANG



2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司董事签名：



陈绍亨



2023年 4 月 12 日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司监事签名：



胡竞英

合肥晶合集成电路股份有限公司



2023 年 4 月 12 日



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司监事签名：



杨国庆



合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司监事签名：

王燕

王燕



合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司除董事外的其他高级管理人员签名：



蔡辉嘉



合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司除董事外的其他高级管理人员签名：

詹奕鹏

詹奕鹏



合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司除董事外的其他高级管理人员签名：



邱显寰



合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司除董事外的其他高级管理人员签名：

周义亮

周义亮



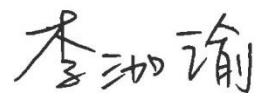
合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司除董事外的其他高级管理人员签名：



李迦谕



合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司除董事外的其他高级管理人员签名：

简瑞荣

简瑞荣



合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司除董事外的其他高级管理人员签名：

李庆民

李庆民



2023年4月12日

## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

声明人（盖章）：合肥市建设投资控股（集团）有限公司



法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

李宏卓

2023年 4月 12日

### 三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股意向书进行核查，确认招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：



沈如军

保荐代表人：



周玉



李义刚

项目协办人：



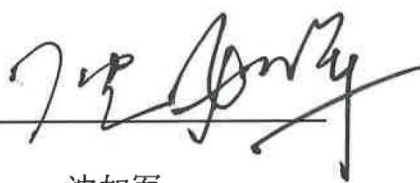
梁晶晶



## 保荐人董事长声明

本人已认真阅读合肥晶合集成电路股份有限公司招股意向书的全部内容，确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股意向书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：\_\_\_\_\_



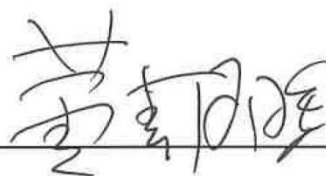
沈如军



## 保荐人首席执行官声明

本人已认真阅读合肥晶合集成电路股份有限公司招股意向书的全部内容，确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股意向书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

首席执行官：\_\_\_\_\_



黄朝晖



#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，确认招股意向书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。



北京市金杜律师事务所

经办律师：

苏 峥

刘东亚

单位负责人：

王 玲


二〇二三年四月十二日

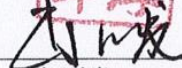
## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读合肥晶合集成电路股份有限公司的招股意向书，确认招股意向书与本所出具的审计报告（容诚审字[2023]230Z0133号）、内部控制鉴证报告（容诚专字[2023]230Z0277号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表（容诚专字[2023]230Z0276号）等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对合肥晶合集成电路股份有限公司在招股意向书中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

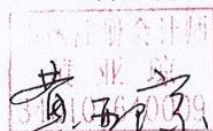
本声明仅供合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

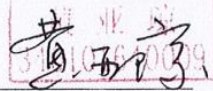
会计师事务所负责人签名：



  
肖厚发

签字注册会计师签名：



  
黄亚琼

中国注册会计师  
姚捷  
110100320276  
  
姚捷

中国注册会计师  
刘荣  
110100320451  
  
刘荣

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年4月12日

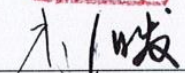


## 验资机构声明

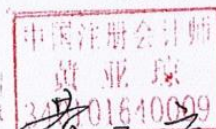
本机构及签字注册会计师已阅读合肥晶合集成电路股份有限公司的招股意向书，确认招股意向书与本机构出具的验资报告（会验字[2018]5985号、容诚验字[2020]230Z0190号、容诚验字[2020]230Z0191号、容诚验字[2020]230Z0205号、容诚验字[2020]230Z0263号验资报告）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对合肥晶合集成电路股份有限公司在招股意向书中引用的上述验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

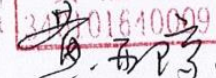


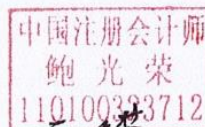
会计师事务所负责人签名：


  
肖厚发

签字注册会计师签名：



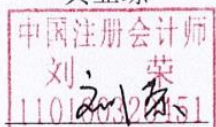
  
黄亚琼



  
鲍光荣



  
姚捷



刘荣

宗美琴（已离职）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年4月12日





## 发行人验资机构关于承担验资业务 签字注册会计师离职的声明

本所出具的下列验资报告，承担验资业务的签字注册会计师宗美琴已经从本所离职：

合肥晶合集成电路股份有限公司：容诚验字[2020]230Z0263号。

本声明仅供合肥晶合集成电路股份有限公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市使用，不适用于其他用途。


容诚会计师事务所（特殊普通合伙）




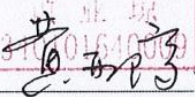
### 验资复核机构声明



本机构及签字注册会计师已阅读合肥晶合集成电路股份有限公司的招股意向书, 确认招股意向书与本机构出具的验资复核报告(容诚验字[2021]230Z0049号)无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对合肥晶合集成电路股份有限公司在招股意向书中引用的上述验资复核报告的内容无异议, 确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名:

  
  
肖厚发

签字注册会计师签名:

  
  
黄亚琼

  
  
鲍光荣

  
  
刘荣

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)




2023年4月12日

## 资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本机构出具的鹏信资评报字[2020]第 080 号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股意向书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办资产评估师：



丁建花



卞雪亮

资产评估机构负责人：



聂竹青

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司



2023 年 4 月 12 日

### 资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股意向书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办资产评估师：

方强                      陈大海                      龚世虎

资产评估机构负责人：



肖力

中水致远资产评估有限公司  
2023年4月12日



## 第十二节 附件

### 一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报表及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- (七) 与投资者保护相关的承诺；
- (八) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- (九) 内部控制鉴证报告；
- (十) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (十一) 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- (十二) 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- (十三) 募集资金具体运用情况；
- (十四) 子公司、参股公司简要情况；
- (十五) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间及地点

投资者可于本次发行承销期间除法定假日以外的工作日 9:00-11:30、13:30-16:30 至上海证券交易所网站查询，也可以至公司或保荐人（主承销商）的办公地点查阅。

### 三、查阅网址

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 附件一 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

### 一、投资者关系主要安排

#### （一）信息披露制度和流程

为了切实保护投资者的合法权益，根据适用的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，以保障公司与投资者之间的美好沟通，增加投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

#### （二）投资者沟通渠道的建立情况

为规范发行人投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据适用的法律、法规和规范性文件的规定，结合发行人实际情况，发行人于 2021 年 2 月 9 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过《投资者关系管理制度》，就投资者关系管理工作的原则和目的、投资者关系管理工作的对象、内容、职责及组织、投资者关系活动的方式以及相关机构和个人的管理等内容做出了明确规定。根据《投资者关系管理制度》，选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本，在确保股东利益的前提下，提高信息披露工作的效率和质量。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：1、公告（包括定期报告与临时公告）；2、股东大会；3、公司网站、信息披露指定媒体；4、一对一沟通；5、邮寄资料；6、电话咨询、电子邮箱、传真咨询；7、广告；8、路演；9、现场参观；10、分析师说明会；11、业绩说明会；12、其他方式。

#### （三）未来开展投资者关系管理的规划

根据《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理的基本原则为：除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；严格按照《科创板上市规则》

等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定向投资者披露公司信息，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系管理时，应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；平等对待和尊重所有投资者，避免进行选择性的信息披露，全面、及时、完整地做好信息披露工作；严禁信息误导和欺诈行为，如实向投资者报告公司的经营情况，充分保障投资者知情权及其合法权益；选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本，在确保股东利益的前提下，提高信息披露工作的效率和质量；公司相关人员不得擅自对外披露、透露或泄露非公开信息；公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。投资者关系管理工作的第一负责人为公司董事长，投资者关系管理工作主要由董事会秘书负责，公司设立投资者关系处理职能部门，协助董事会秘书处理投资者关系管理工作的日常事务。公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及下属公司应积极配合。在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司其他职能部门、公司下属控股子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书实施投资者关系管理工作。

## 二、公司本次发行后的股利分配政策和决策程序

2021年3月16日，发行人召开股东大会，审议通过了《关于〈合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划〉的议案》，对本次发行后的股利分配政策作出了相应规定，具体如下：

### （一）制定股东分红回报规划的主要考虑因素及原则

股东回报规划的制定应符合相关法律法规以及上市后适用的《公司章程（草案）》规定，重视对投资者合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，兼顾处理好公司短期利益和长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、公司的盈利情况和现金流量状况、自身经营模式、经营发展规划及企业所处的行业特点、发展阶段、资金需求情况、社会资



金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

## （二）股东回报规划的具体方案

### 1、利润分配的顺序

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润，可以按照股东持有的股份比例分配。

### 2、利润分配的形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、行政法规、部门规章、规范性文件允许的其他方式分配利润；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

### 3、现金分红的条件和比例

#### （1）现金分红的条件

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出指：公司未来 12 个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10% 且绝对金额超过 5,000 万元；或公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

## （2）现金分红的比例

在满足前述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的 10%。每年具体现金分红比例由公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，按现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%的要求执行。

## （三）股东回报规划的决策程序和监督机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案

的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

6、股东大会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

#### （四）利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （五）回报规划的制定周期和调整机制

1、公司根据《公司章程》确定的利润分配政策制定股东回报规划，并确保应每三年制订一次股东回报规划，就未来三年的分红政策进行规划。公司董事会在制定股东回报规划时，应通过多种方式充分听取和吸收股东（特别是中小股东）、独立董事及监事会的意见和建议。公司董事会制订的分红政策及三年股东回报规划报股东大会批准后实施；

2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策时，董事会应做专题论述，详细论述调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配方案政策变更事项时，应充分考虑中小股东的意见。

### 三、股东投票机制建立情况

#### （一）累积投票制选举董事的相关安排

根据《公司章程（草案）》，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程（草案）》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制度。前述累积投票制

是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会以累积投票方式选举董事、监事的，董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

## （二）中小投资者单独计票机制

公司已建立中小投资者单独计票机制。根据《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

## （三）网络投票相关安排

根据《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

## （四）征集投票权相关安排

根据《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》，董事会、独立董事、符合相关规定的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

## 附件二 与投资者保护相关的承诺

### 一、股份锁定的承诺

#### （一）实际控制人合肥市国资委的承诺

自晶合集成首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行上市”）之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不提议由晶合集成回购本单位在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

在晶合集成实现盈利前，自晶合集成股票上市之日起3个完整会计年度内，本单位不转让或者委托他人管理本单位在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不提议由晶合集成回购本单位在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份；自晶合集成股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，本单位每年转让在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份数不超过晶合集成股份总数的2%。

晶合集成股票上市且实现盈利后，本单位可以自晶合集成当年年度报告披露后次日与自晶合集成股票上市交易之日起36个月届满之日中较晚之日起转让本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本单位同意对本单位所持晶合集成股份的锁定期进行相应调整。

#### （二）控股股东合肥建投的承诺

自晶合集成首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行上市”）之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不提议由晶合集成回购本公司在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

在晶合集成实现盈利前，自晶合集成股票上市之日起3个完整会计年度内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不提议由晶合集成回购本公司在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份；自晶合集成股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，本公司每年转让在

本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份数不超过晶合集成股份总数的 2%。

晶合集成股票上市且实现盈利后，本公司可以自晶合集成当年年度报告披露后次日与自晶合集成股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起转让本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

若本公司所持晶合集成股票在前述锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（不包括本公司在晶合集成本次发行上市后从公开市场中新买入的 A 股股票）。在晶合集成上市后 6 个月内如晶合集成股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有晶合集成股票的上述锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指晶合集成本次发行上市的发行价格，如果晶合集成上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本公司同意对本公司所持晶合集成股份的锁定期进行相应调整。

### （三）控股股东合肥建投一致行动人合肥芯屏的承诺

自晶合集成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行上市”）之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不提议由晶合集成回购本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

在晶合集成实现盈利前，自晶合集成股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不提议由晶合集成回购本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份；自晶合集成股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，本企业每年转让在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份数不超过晶合集成股份总数的 2%。

晶合集成股票上市且实现盈利后，本企业可以自晶合集成当年年度报告披露后次日与自晶合集成股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

若本企业所持晶合集成股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将

不低于发行价（不包括本企业在晶合集成本次发行上市后从公开市场中新买入的 A 股股票）。在晶合集成上市后 6 个月内如晶合集成股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有晶合集成股票的上述锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指晶合集成本次发行上市的发行价格，如果晶合集成上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持晶合集成股份的锁定期进行相应调整。

#### **（四）持有发行人 5%以上股份的股东力晶科技的承诺**

自晶合集成本次发行上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不由晶合集成回购本公司在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

本公司将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本公司持有的晶合集成股份的转让、减持另有要求的，则本公司将按相关要求执行。若前述规定被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求执行。

如本公司违反上述承诺，本公司将承担由此而产生的法律责任。

#### **（五）美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成的承诺**

自本公司/本企业取得晶合集成股份之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不由晶合集成回购本公司在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

本公司将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所对本公司持有的晶合集成股份的转让、减持另有要求的，则本公司将按相关要求执行。若前述规定被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求执行。

如本公司违反上述承诺，本公司将承担由此而产生的法律责任。

#### **（六）员工持股平台合肥晶焮、合肥晶遂、合肥晶炯、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶愚、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶辽、合肥晶确、合肥晶铁、合肥晶妥、合肥晶雄的承诺**

自晶合集成本次发行上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不由晶合集成回购本公司/本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

本公司/本企业将确保，如本公司/本企业合伙人所持本公司/本企业相关权益拟转让退出的，按照本公司/本企业合伙协议以及晶合集成员工持股管理办法的约定处理。

本公司/本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本公司/本企业持有的晶合集成股份的转让、减持另有要求的，则本公司/本企业将按相关要求执行。若前述规定被修订、废止，本公司/本企业将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求执行。

如本公司/本企业违反上述承诺，本公司/本企业将承担由此而产生的法律责任。

#### **（七）董事、高级管理人员及核心技术人员承诺**

通过员工持股平台持有发行人股份的董事长蔡国智，高级管理人员李洳谕、周义亮、简瑞荣，董事兼高级管理人员朱才伟、朱晓娟承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本



人不转让或者委托他人管理本人首发前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

公司股票上市后且实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起转让本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本人所持首发前股份的锁定期届满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。

本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本人将同时遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关董事、监事、高级管理人员减持首发前股份的相关规定。

前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。本人根据持股平台就所持有的公司股份，按照晶合集成员工持股管理办法的规定处理。若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司董事、监事、高级管理人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。”

通过员工持股平台持有发行人股份的高级管理人员兼核心技术人员蔡辉嘉、邱显寰、詹奕鹏及李庆民承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

公司股票上市后且实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起转让本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本人所持首发前股份的锁定期届满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。

在不违反前述第二条承诺的前提下，自本人所持首发前股份的锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持首发前股份总数的

25%，减持比例可以累积使用。

本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本人将同时遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关董事、监事、高级管理人员减持首发前股份的相关规定。

前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。本人根据持股平台就所持有的公司股份，按照晶合集成员工持股管理办法的规定处理。若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司董事、监事、高级管理人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

通过员工持股平台持有发行人股份的核心技术人员张伟瑾承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

公司股票上市后且实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起转让本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

自本人所持首发前股份的锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。本人根据持股平台就所持有的公司股份，按照晶合集成员工持股管理办法的规定处理。若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司核心技术人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

## 二、持股意向和减持意向的承诺

### （一）实际控制人合肥市国资委的承诺

在锁定期届满后，若本单位拟减持直接或间接持有的公司股票，将按照相关法律、法规、规章及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，审慎制定股份减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反发行人首次公开发行时所作出的公开承诺。

减持价格不低于发行人本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。

减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采用集中竞价方式减持的，本单位保证在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划；采取其他方式减持的，本单位保证提前3个交易日通知公司予以公告。若届时相关减持规则相应调整的，本承诺内容相应调整。

### （二）控股股东合肥建投的承诺

本公司将严格依据相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求，就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项。

本公司所持晶合集成股份在锁定期满后，如果届时相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求对于本公司减持行为有任何规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求。

本公司持有的晶合集成股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（不包括本公司在晶合集成本次发行上市后从公开市场中新买入的 A 股股票）。上述发行价指晶合集成本次发行上市的发行价格，如果晶合集成上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本公司通过集中竞价交易方式减持晶合集成首次公开发行前股份的，将在首次卖出晶合集成股份的 15 个交易日前将减持计划向上海证券交易所备案并以书面方式通知晶合集成并由晶合集成予以公告，并按照相关法律法规及上海证券交易所的规定披露减持进展情况。本公司通过集中竞价交易以外的其他方式减持晶合集成首次公开发行前股份时，本公司将提前 3 个交易日以书面方式通知晶合集成并由晶合集成予以公告。

本公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。若前述规定被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。

本公司将严格遵守上述承诺，若本公司违反上述承诺进行减持，本公司则自愿将减持所得收益上缴至晶合集成并同意归晶合集成所有。

### （三）控股股东合肥建投一致行动人合肥芯屏的承诺

本企业将严格依据相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求，就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项。

本企业所持晶合集成股份在锁定期满后，如果届时相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求对于本企业减持行为有任何规定，则本企业承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求。

本企业持有的晶合集成股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（不包括本企业在晶合集成本次发行上市后从公开市场中新买入的 A 股股票）。上述

发行价指晶合集成本次发行上市的发行价格，如果晶合集成上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本企业通过集中竞价交易方式减持晶合集成首次公开发行前股份的，将在首次卖出晶合集成股份的 15 个交易日前将减持计划向上海证券交易所备案并以书面方式通知晶合集成并由晶合集成予以公告，并按照相关法律法规及上海证券交易所的规定披露减持进展情况。本企业通过集中竞价交易以外的其他方式减持晶合集成首次公开发行前股份时，本企业将提前 3 个交易日以书面方式通知晶合集成并由晶合集成予以公告。

本企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。若前述规定被修订、废止，本企业将依据不时修订的相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。

本企业将严格遵守上述承诺，若本企业违反上述承诺进行减持，本企业则自愿将减持所得收益上缴至晶合集成并同意归晶合集成所有。

#### **（四）持有发行人 5%以上股份的股东力晶科技的承诺**

在锁定期满后，如果届时相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求对于本公司减持行为有任何规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求。

本公司持有的晶合集成股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（不包括本公司在晶合集成本次发行上市后从公开市场中新买入的 A 股股票）。上述发行价指晶合集成本次发行上市的发行价格，如果晶合集成上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本公司减持晶合集成股份前，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本公司将在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；采取其他方式减持的应提前 3 个交易日以书面方式通知晶合集成并由晶合集成予以公告；但本公司持有晶合集成股份低于 5%以下时除外。

本公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。若前述规定被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。

本公司将严格遵守上述承诺，若本公司违反上述承诺进行减持，本公司则自愿将减持所得收益上缴至晶合集成并同意归晶合集成所有。

#### **（五）持有发行人 5%以上股份的股东美的创新的承诺**

如果在锁定期满后，本公司拟减持晶合集成股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合晶合集成稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持。

本公司减持晶合集成股份的方式应符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，具体包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

本公司减持晶合集成股份前，应提前 3 个交易日以书面方式通知晶合集成并由晶合集成予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务；但本公司持有晶合集成股份低于 5%以下时除外。

本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

### **三、股份回购和股份购回的措施和承诺**

#### **（一）实际控制人合肥市国资委的承诺**

如中国证券监督管理委员会认定晶合集成本次发行上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断晶合集成是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位承诺将确保晶合集成依法回购本次发行上市的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。

#### **（二）控股股东合肥建投的承诺**

如中国证券监督管理委员会认定晶合集成本次发行上市招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，对判断晶合集成是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司承诺将督促晶合集成依法回购本次发行上市的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

### （三）控股股东合肥建投一致行动人合肥芯屏的承诺

如中国证券监督管理委员会认定晶合集成本次发行上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断晶合集成是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业承诺将督促晶合集成依法回购本次发行上市的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。

## 四、稳定股价的措施和承诺

为在公司上市后保持公司股价稳定，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规要求制订了《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），相关主体出具了关于稳定股价措施事宜的承诺，具体情况如下：

### （一）启动股价稳定预案的具体条件

自公司本次 A 股股票发行上市之日起三年（36 个月）内，如非因不可抗力因素所致，在公司 A 股股票收盘价格出现连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发日”，每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，下同；最近一期审计基准日后，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同）的条件（以下简称“稳定股价条件”）满足时，将依据法律法规及公司章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，且在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施。

### （二）稳定股价的具体措施

（1）当上述稳定股价条件满足时，公司将及时采取以下任一措施稳定公司股价。



稳定股价的具体措施包括但不限于：①公司回购公司股票；②控股股东合肥建投及其一致行动人合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体增持公司股票；③除独立董事和不在公司领取薪酬的董事以外的董事（以下简称“相关董事”）、高级管理人员增持公司股票：

①在稳定股价条件满足后的 20 个交易日内，公司董事会将公告回购公司股票的预案。股份回购预案将包括但不限于拟回购股份的数量范围、价格区间、回购资金来源、完成时间等信息。公司三年内（36 个月）用以稳定股价的回购股份资金总额合计不高于公司本次首次公开发行募集资金总额的 25%，单次回购股份数量不超过公司股份总数的 1%，单一会计年度累计回购股份数量不超过公司股份总数的 2%。公司应依据股份回购预案所适用的法律法规及公司章程等规定，完成公司的内部审批程序，履行相关法律法规所规定的其他相关程序后，实施稳定股价方案。公司全体董事（独立董事除外）承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。公司控股股东合肥建投及其一致行动人合肥芯屏承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。

②如公司董事会未如期公告前述稳定股价方案，或因各种原因导致前述稳定股价方案未能通过股东大会的，则触发公司控股股东合肥建投及其一致行动人合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体增持公司股份的义务，合肥建投、合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体将依据法律法规及发行人章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，且在不影响发行人上市条件的前提下实施并依法履行所需的审批手续。在前述其增持公司股份触发条件满足之日（以较先发生的为准）起 10 个交易日内，合肥建投、合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告。合肥建投、合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红的 20%，由于出现稳定股价预案终止情形导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外。

③如合肥建投、合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体未如期公告股份增持计划或明确表示未有增持计划，则触发相关董事、高级管理人员增持公司股份的义务。在符合相关法律法规规定的前提下，相关董事、高级管理人员应在前述其增持公司股份触发条件满足之日（以较先发生的为准）起 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制相关董事、高级管理人员买卖股票，则相关董事、高级管理人员应在触发

增持公司股份义务后的 10+N 个交易日内), 制定增持公司股份计划并由公司公告。公司相关董事、高级管理人员各自累计增持金额不低于其上年度自公司领取的薪酬总额(税后)的 10%, 且不超过自公司领取的薪酬总额(税后)的 30%。

(2) 在履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的 120 个交易日内, 公司、合肥建投、合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体、相关董事及高级管理人员的稳定股价义务自动解除。从履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的第 121 个交易日开始, 如果公司 A 股股票收盘价格出现连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产, 则视为稳定股价条件再次满足, 应继续按照上述稳定股价预案执行。

(3) 公司、合肥建投、合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体、相关董事及高级管理人员在采取前述稳定股价措施时, 应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务, 并需符合所适用的法律法规及公司章程等相关规定。

### (三) 稳定股价预案的终止情形

公司在触发稳定股价条件后, 若出现以下任一情形, 已制定或公告的稳定股价方案终止执行, 已开始执行的方案视为实施完毕而无需继续执行:

(1) 公司 A 股股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于公司最近一期经审计的每股净资产;

(2) 继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的, 或者相关增持义务人增持公司股份将触发全面要约收购义务。

### (四) 相关约束措施

(1) 自触发日起, 公司未如期公告稳定股价方案的, 或公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价方案要求公司回购股份但未实际履行的, 公司将在股东大会及证券监管机构指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

合肥建投、合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体未能履行增持义务, 将在股东大会及证券监管机构指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并停止从公司获得现金分红(如有), 同时持有的公司股份将不得转让, 直至履行增持义务, 不可抗力因素除外。

公司相关董事及高级管理人员因主观原因未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并停止从公司领取现金分红（如有）及薪酬，同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至履行增持义务，不可抗力因素除外。

（2）如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、合肥建投、合肥芯屏或其指定的其他符合法律法规的主体、相关董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购股份义务的，相关责任主体可免于适用前述约束措施，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

## （五）关于稳定股价的承诺

### （1）发行人的承诺

在本公司股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本公司将严格遵守执行《稳定股价预案》以及本公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案，根据前述预案及具体实施方案采取包括但不限于回购本公司股份或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务。

### （2）实际控制人合肥市国资委的承诺

如根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》触发合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）及合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）增持晶合集成股份的义务，本单位将确保合肥建投及合肥芯屏根据其出具的《关于上市后三年内稳定股价措施的承诺函》履行稳定股价义务。

### （3）控股股东合肥建投的承诺

同意公司董事会、股东大会审议通过的《稳定股价预案》。

如根据《稳定股价预案》触发本公司增持晶合集成股份的义务，在符合相关法律法规规定的前提下，本公司应在履行完毕相关国有资产主管部门（如需）及本公司内部审议程序之日起 10 个工作日内就其是否有股份增持计划书面通知晶合集成并由晶合集成进行公告，如有具体股份增持计划，应披露拟增持股份的数量范围、价格区间、

完成时间等信息。

本公司将根据《稳定股价预案》的要求以及晶合集成上市后稳定股价的需要，积极履行稳定股价义务。

#### **(4) 控股股东合肥建投一致行动人合肥芯屏的承诺**

同意公司董事会、股东大会审议通过的《稳定股价预案》。

如根据《稳定股价预案》触发本公司增持晶合集成股份的义务，在符合相关法律法规规定的前提下，本公司应在履行完毕相关国有资产主管部门（如需）及本公司内部审议程序之日起 10 个交易日内就其是否有股份增持计划书面通知晶合集成并由晶合集成进行公告，如有具体股份增持计划，应披露拟增持股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息。

本公司将根据《稳定股价预案》的要求以及晶合集成上市后稳定股价的需要，积极履行稳定股价义务。

#### **(5) 公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员的承诺**

同意公司董事会、股东大会审议通过的《稳定股价预案》。

如根据《稳定股价预案》触发本人增持公司股份的义务，在符合相关法律法规规定的前提下，本人应在触发增持公司股份义务后的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制本人买卖股票，则本人应在触发增持公司股份义务后的 10+N 个交易日内），向公司书面提交增持公司股份计划并由公司公告。

本人累计增持金额不低于本人上年度自本公司领取的薪酬总额（税后）的 10%，且不超过自本公司领取的薪酬总额（税后）的 30%。

若公司 A 股股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于公司最近一期经审计的每股净资产或继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的，或者相关增持义务人增持公司股份将触发全面要约收购义务，本人可不再实施上述增持计划。

本人将根据《稳定股价预案》的要求以及晶合集成上市后稳定股价的需要，积极履行稳定股价义务。

本人在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。

本人因主观原因未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并停止从公司领取现金分红（如有）及薪酬，同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至履行增持义务，不可抗力因素除外。

## 五、对欺诈发行上市的股份购回承诺

### （一）发行人的承诺

如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次发行上市的股票，并承担与此相关的法律责任。

若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司将依法遵从该等规定。

### （二）实际控制人合肥市国资委的承诺

如晶合集成不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册的，本单位将在中国证券监督管理委员会等有权部门依法对上述事实作出认定后5个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次发行上市的股票。

若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本单位因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本单位将依法遵从该等规定。

### （三）控股股东合肥建投的承诺

本公司作为控股股东，如晶合集成不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且本公司负有责任的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门依法对上述事实作出认定后 5 个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次发行上市的股票，并承担与此相关的法律责任。

若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本公

司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司将依法遵从该等规定。

#### **（四）控股股东一致行动人合肥芯屏的承诺**

本企业作为控股股东的一致行动人，如晶合集成不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且本公司负有责任的，本企业将在中国证券监督管理委员会等有权部门依法对上述事实作出认定后 5 个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次发行上市的股票，并承担与此相关的法律责任。

若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业将依法遵从该等规定。

## **六、填补被摊薄即期回报的措施与承诺**

### **（一）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺**

本次发行上市后，公司将及时有效地将募集资金投入使用，从而实现合理的资本回报水平。但是由于募集资金运用产生的效益可能无法在短期内明显体现，在股本增加的情况下，公司基本每股收益和稀释每股收益等指标将可能面临下降的风险。

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，增强公司持续回报的能力，充分保护中小股东的利益，公司根据自身经营特点制定了相关措施，具体内容如下：

#### **（1）大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力**

公司将持续地改善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和管理流程，稳步提升公司的市场份额、品牌形象，同时进一步开拓国内外市场，努力实现销售规模的持续、快速增长。公司将依托管理层和研发团队丰富的行业经验，紧紧把握市场需求，不断提升核心竞争力和持续盈利能力，为股东创造更大的价值。

#### **（2）加快募投项目实施进度，加强募集资金管理**

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，以使募投项目早日实现预期收益。同时，公司将根据《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》《合肥晶合集

成电路股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。

### **(3) 不断完善公司治理，完善员工激励机制，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立非执行董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。此外，公司将加大人才引进力度，不断完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为公司持续发展提供保障。

### **(4) 完善利润分配政策，强化投资者回报**

为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过了公司上市后适用的《合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）》和《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。公司本次发行上市完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行上市对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因，向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

## **(二) 实际控制人合肥市国资委的承诺**

在作为晶合集成实际控制人期间，本单位承诺不越权干预晶合集成经营管理活动，不侵占晶合集成利益。

在本次发行上市完成前，如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的

其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本单位承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

### （三）控股股东合肥建投的承诺

在作为晶合集成控股股东期间，本公司承诺不越权干预晶合集成经营管理活动，不侵占晶合集成利益。

在本次发行上市完成前，如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

### （四）控股股东合肥建投一致行动人合肥芯屏的承诺

在作为晶合集成控股股东的一致行动人期间，本企业承诺不越权干预晶合集成经营管理活动，不侵占晶合集成利益。

在本次发行上市完成前，如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

### （五）公司董事及高级管理人员的承诺

本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，不会越权干预公司经营管理，也不会采用其他方式侵占或损害公司利益。

本人承诺将对本人的职务消费行为进行约束。

本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若公司后续推出股权激励政策，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

在本次发行上市完成前，如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。



若本人违反上述承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，依法承担对公司和股东的补偿责任，并无条件接受中国证监会或上海证券交易所等监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

## 七、利润分配政策的安排及承诺

### （一）利润分配的顺序

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润，可以按照股东持有的股份比例分配。

### （二）利润分配的形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、行政法规、部门规章、规范性文件允许的其他方式分配利润；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红；在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

### （三）现金分红的条件和比例

#### （1）现金分红的条件

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出指：公司未来 12 个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 5,000 万元；或公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

## （2）现金分红的比例

在满足前述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的 10%。每年具体现金分红比例由公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，按现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%的要求执行。

## （四）股东回报规划的决策程序和监督机制

（1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

(2) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(4) 在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

(6) 股东大会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

#### **(五) 利润分配方案的实施**

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### **(六) 利润分配政策的调整**

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策时，董事会应做专题论述，详细论述调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配方案政策变更事项时，应充分考虑中小股东的意见。

#### **(七) 其他事项**

公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

## （八）实际控制人合肥市国资委的承诺

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，本单位将确保相关方适时提出利润分配预案。在审议晶合集成利润分配预案的股东大会上，本单位将确保合肥市建设投资控股（集团）有限公司及合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票。本单位将确保晶合集成根据相关决议实施利润分配。

## 八、未能履行承诺的约束措施

### （一）发行人的承诺

如本公司在招股说明书中所披露的承诺（以下简称“本公司承诺”）未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

- （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- （2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；

（4）本公司将严格遵守就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项中的相关约束措施，如本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

### （二）控股股东合肥建投的承诺

如本公司在招股说明书中所披露的承诺（以下简称“本公司承诺”）未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

- （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- （2）向晶合集成及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（3）本公司违反本公司承诺所得收益将归属于晶合集成，因此给晶合集成或投资者造成损失的，将依法对晶合集成或投资者进行赔偿。

### （三）控股股东合肥建投一致行动人合肥芯屏的承诺

如本企业在招股说明书中所披露的承诺（以下简称“本企业承诺”）未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

- （1）及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- （2）向晶合集成及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- （3）本企业违反本企业承诺所得收益将归属于晶合集成，因此给晶合集成或投资者造成损失的，将依法对晶合集成或投资者进行赔偿。

### （四）持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新的承诺

如本公司在招股说明书中所披露的承诺（以下简称“本公司承诺”）未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

- （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- （2）向晶合集成投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

### （五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺

如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

- （1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- （2）如所违反承诺可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如所违反承诺确已无法履行的，本人将向晶合集成及其投资者提出补充承诺或替代承诺，并按法律、法规、届时有效的公司章程的规定履行相关审批程序，以尽可能保护投资者的权益；

（3）本人违反本人承诺所得收益将归属于晶合集成，因此给晶合集成或投资者造成损失的，本人将依法对晶合集成或投资者进行赔偿。

## 九、证券服务机构出具的承诺事项

中介机构关于申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：

### （一）保荐人（主承销商）

中金公司作为本次发行的保荐人及主承销商，特此作出承诺如下：

本公司承诺为发行人本次发行并上市所制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本公司为发行人本次发行并上市所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

### （二）发行人律师

金杜作为本次发行的发行人律师，特此作出承诺如下：

如因本所为合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

### （三）发行人会计师

容诚作为本次发行的审计机构、验资复核机构，特此作出承诺如下：

根据《证券法》等法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，按照中国注册会计师执业准则和中国注册会计师职业道德守则的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）为晶合集成申请首次公开发行股票并科创板上市依法出具相关文件，本所保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。

#### （四）发行人评估师

中水致远作为本次发行的评估机构，特此作出承诺如下：

中水致远资产评估有限公司在晶合集成首次公开发行 A 股股票并在科创板上市中被聘请为资产评估机构。

本公司及经办人员承诺：为晶合集成首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的资产评估报告之专业结论不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司制作、出具的资产评估报告之专业结论有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

### 十、其他承诺事项

#### （一）关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东合肥建投及其一致行动人合肥芯屏出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体请参见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“六、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺”。

#### （二）关于规范并减少关联交易的承诺

发行人控股股东合肥建投及其一致行动人合肥芯屏、力晶科技、美的创新以及发行人的全体董事、监事和高级管理人员均出具了《关于规范并减少关联交易的承诺函》，具体请参见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（五）规范和减少关联交易的措施”之“2、相关责任主体关于规范和减少关联交易承诺”。

#### （三）关于避免资金占用和违规担保的承诺

发行人控股股东合肥建投及其一致行动人合肥芯屏出具了《关于避免资金占用和违规担保的承诺函》，具体请参见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（五）规范和减少关联交易的措施”之“3、相关责任主体关于避免资金占用和违规担保的承诺”。

#### （四）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

##### （1）发行人的承诺

本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如中国证券监督管理委员会认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按如下方式依法回购本次发行上市的全部新股：

①若上述情形发生于本公司本次发行新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则本公司将把本次发行上市的募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。

②若上述情形发生于本公司本次发行新股已完成发行上市交易后，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内召开董事会，制订针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过上海证券交易所系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如本公司本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。

如中国证券监督管理委员会认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，能够证明本公司没有过错的除外。

##### （2）实际控制人合肥市国资委的承诺

招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本单位对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如中国证券监督管理委员会认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失，能够证明本单位没有过错的除外。



### **(3) 控股股东合肥建投的承诺**

招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如中国证券监督管理委员会认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，能够证明本公司没有过错的除外。

### **(4) 控股股东合肥建投一致行动人合肥芯屏的承诺**

招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如中国证券监督管理委员会认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失，能够证明本企业没有过错的除外。

### **(5) 发行人全体董事、监事和高级管理人员的承诺**

招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

## **(五) 关于申报材料真实、准确、完整的承诺**

### **(1) 发行人的承诺**

本公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市。本公司现就申报材料的真实性、准确性、完整性承诺如下：

在本次申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市期间，本公司已依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，本公司所披露信息及报送的申请文件是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。

### **(2) 发行人全体董事、监事和高级管理人员的承诺**

晶合集成拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市。本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申报材料进行了核查和审阅，确认上述申报材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## （六）股东信息披露的相关承诺

公司出具的关于股东信息披露的专项承诺如下：

（一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

（二）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；

（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

（四）除中金浦成投资有限公司为本次发行的中介机构中国国际金融股份有限公司的全资子公司以及本承诺函附件披露的情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他直接或间接持有发行人股份情形；

（五）发行人股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；

（六）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

承诺函附件内容如下：

根据国家企业信用信息公示系统公开信息显示，本次发行的保荐人中金公司通过其以自有或投资的已在基金业协会备案的相关金融产品等形式间接持有本公司股东集创北方、宁波华淳的股权/财产份额，该等投资行为并非中金公司主动针对本公司进行的投资。集创北方、宁波华淳与中金公司间接持有其股权/财产份额相关的前两层间接股东/合伙人的情况如下：

序号	发行人直接股东		第一层间接股东/合伙人		第二层间接股东/合伙人	
	名称	持有发行人股份的比例	名称	持有直接股东股权/财产份额的比例	名称	持有第一层间接股东股权/财产份额的比例
1	集创北方	0.58%	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	3.03%	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	17.94%
			北京芯动能投资基金（有限合伙）	0.71%	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	37.35%
			宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	2.97%	宁波金蛟朗秋投资合伙企业（有限合伙）	1.00%
			深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙）	0.32%	中金启融（厦门）股权投资基	16.84%

序号	发行人直接股东		第一层间接股东/合伙人		第二层间接股东/合伙人	
	名称	持有发行人股份的比例	名称	持有直接股东股权/财产份额的比例	名称	持有第一层间接股东股权/财产份额的比例
					金合伙企业（有限合伙）	
			中青芯鑫鼎橡（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	0.32%	芯鑫融资租赁（北京）有限责任公司	54.45%
			苏州芯动能显示科技创业投资合伙企业（有限合伙）	0.80%	苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）	15.30%
			湖南湘江祥鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	0.51%	厦门创鼎达兴投资合伙企业（有限合伙）	4.94%
			平潭宝盛股权投资合伙企业（有限合伙）	0.16%	宁波华淳	98.08%
			苏州元禾厚望睿芯创业投资合伙企业（有限合伙）	0.63%	苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）	14.66%
			珠海金镒铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.10%	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9.8%
2	宁波华淳	0.88%	华泰保险集团股份有限公司	5.65%	北京伟思腾科技发展有限公司	0.05%

根据国家企业信用信息公示系统公开信息显示，中金公司系集创北方、宁波华淳第四层以上的间接股东，中金公司通过集创北方、宁波华淳间接持有本公司的股份合计低于0.01%，间接持股比例极低。

#### （七）力晶科技出具的其他承诺

截至本承诺函出具之日，本公司及本公司下属企业在资产、业务、人员、机构、财务等方面均与晶合集成相互独立，不存在与晶合集成共用资产或资产混同、相互参与业务开拓、人员在晶合集成兼职或领薪、与晶合集成机构混同等影响晶合集成独立性的情形。除本公司向晶合集成提名并获晶合集成聘任的董事在晶合集成董事会层面参与公司重大事项的决策外，本公司及本公司下属企业不存在干预晶合集成采购、生产、销售、研发、财务、人事等日常经营决策的情形。

2018年1月至今，本公司及本公司下属企业与晶合集成存在部分客户、供应商重叠，该等重叠的客户、供应商均系双方独立开发、谈判、维护，不存在非公平竞争、通过重叠客户或供应商进行利益输送、相互或单方让渡商业机会等情形。

截至本承诺函出具之日，晶合集成的董事会中，存在 2 名非独立董事及 1 名独立董事系本公司提名，该等董事均未在力积电任职（包括但不限于担任力积电董事、高级管理人员等职务，下同），未来本公司亦不会向晶合集成提名在力积电任职的人员为董事。本公司承诺不会通过提名的董事作出不利于晶合集成而有利于本公司及本公司下属企业的行为。

除力积电外，本公司及本公司下属企业目前不存在在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与晶合集成及其控股子公司所从事的主营业务相同或相似业务的情形。

本公司目前及将来不会利用股东地位谋求不正当利益或作出不利于晶合集成而有利于本公司下属企业的任何决定，不会损害晶合集成及其他股东的合法权益。若因违反本承诺函的任何条款而导致晶合集成遭受损失的，本公司将依法赔偿，最终赔偿方案由双方协商确定或由有管辖权的法院作出的生效判决确定。

本公司保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保晶合集成按照上市公司的规范独立自主经营，保证晶合集成的资产、业务、财务、人员、机构独立。

## 附件三 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

发行人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《科创板上市规则》等适用法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定和要求设立了股东大会、董事会（下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会）、监事会、独立董事、董事会秘书制度，形成了规范的公司治理结构。同时，发行人制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关治理制度。

### 一、股东大会、董事会、监事会的实际运行情况

#### （一）股东大会运行情况

公司股东大会严格遵循《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，保障各股东利益。自股份公司设立以来，公司股东大会运行情况良好，股东大会的会议通知、召开方式、提案审议、表决均符合相关规定，对会议表决事项均做出了有效决议。

截至本招股意向书签署之日，公司自整体变更为股份有限公司后，共召开过 7 次股东大会，具体情况如下：

序号	届次	日期	出席情况
1	创立大会	2020年11月20日	全体股东
2	2020年年度股东大会	2021年3月16日	全体股东
3	2021年第一次临时股东大会	2021年8月27日	全体股东
4	2021年第二次临时股东大会	2021年12月20日	全体股东
5	2022年第一次临时股东大会	2022年3月16日	全体股东
6	2021年年度股东大会	2022年6月30日	全体股东
7	2023年临时股东大会	2023年3月16日	全体股东

## （二）董事会运行情况

公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使职权。自股份公司设立以来，公司董事会运行情况良好，董事会的会议通知、召开方式、提案审议、表决均符合相关规定，对会议表决事项均做出了有效决议。

截至本招股意向书签署之日，公司自整体变更为股份有限公司后，共召开过 16 次董事会会议，具体情况如下：

序号	届次	日期	出席情况
1	第一届董事会第一次会议	2020年11月20日	全体董事
2	第一届董事会第二次会议	2020年12月25日	全体董事
3	第一届董事会第三次会议	2021年2月9日	全体董事
4	第一届董事会第四次会议	2021年3月5日	全体董事
5	第一届董事会第五次会议	2021年5月26日	全体董事
6	第一届董事会第六次会议	2021年8月12日	全体董事
7	第一届董事会第七次会议	2021年10月11日	全体董事
8	第一届董事会第八次会议	2021年11月30日	全体董事
9	第一届董事会第九次会议	2021年12月28日	全体董事
10	第一届董事会第十次会议	2022年3月15日	全体董事
11	第一届董事会第十一次会议	2022年3月23日	全体董事
12	第一届董事会第十二次会议	2022年6月10日	全体董事
13	第一届董事会第十三次会议	2022年10月19日	全体董事
14	第一届董事会第十四次会议	2022年11月25日	全体董事
15	第一届董事会第十五次会议	2023年3月1日	全体董事
16	第一届董事会第十六次会议	2023年4月7日	全体董事

## （三）监事会运行情况

公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定行使职权。自股份公司设立以来，公司监事会运行情况良好，监事会的会议通知、召开方式、提案审议、表决均符合相关规定，对会议表决事项均做出了有效决议。

截至本招股意向书签署之日，公司自整体变更为股份有限公司后，共召开过 3 次监事会会议，具体情况如下：

序号	届次	日期	出席情况
1	第一届监事会第一次会议	2020年11月20日	全体监事
2	第一届监事会第二次会议	2021年2月9日	全体监事
3	第一届监事会第三次会议	2022年3月23日	全体监事

## 二、独立董事制度运行情况

为完善公司董事会结构，保护中小股东利益，加强董事会的决策功能，公司董事会设有3名独立董事，并制定有《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、职权、工作条件等作出明确规定。公司独立董事自聘任以来，按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责。各位独立董事亦根据自身的专长，分别担任董事会下设各专门委员会委员，参与董事会下属专门委员会的工作。公司独立董事在规范公司运作、维护公司权益、完善内部控制制度、提高董事会决策水平等方面起到了积极作用，公司法人治理结构得到进一步完善。

截至本招股意向书签署之日，独立董事未对发行人有关事项提出异议。

## 三、董事会秘书制度运行情况

公司董事会秘书自聘任以来，按照《公司章程》《董事会秘书工作制度》的规定，负责组织筹备董事会会议和股东大会会议、投资者关系管理、协调公司信息披露事务等各项工作，勤勉尽职地履行了职责。

## 附件四 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的主要职责、组成情况及运行情况如下：

### 一、董事会战略委员会

战略委员会主要负责审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，评估公司各类业务的总体发展状况，审议公司的经营计划、投资和融资方案，审议年度财务预算、决算方案，评估公司的治理状况并向董事会提出建议，监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况。战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

截至本招股意向书签署之日，第一届董事会战略委员会由公司董事蔡国智、郑素芬、朱才伟三人组成，战略委员会召集人由公司董事长蔡国智担任。

2021年1月26日，公司召开第一届董事会第一次战略委员会会议。

2021年8月9日，公司召开第一届董事会第二次战略委员会会议。

2021年12月23日，公司召开第一届董事会第三次战略委员会会议。

2022年3月15日，公司召开第一届董事会第四次战略委员会会议。

2022年3月17日，公司召开第一届董事会第五次战略委员会会议。

2023年2月28日，公司召开第一届董事会第六次战略委员会会议。

2023年4月3日，公司召开第一届董事会第七次战略委员会会议。

### 二、董事会审计委员会

审计委员会主要负责监督及评估外部审计机构工作、内部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，且至少包括一名会计专业人士担任的独立董事。审计委员会设召集人一名，由



公司独立董事担任（为专业会计人士）。

截至本招股意向书签署之日，第一届董事会审计委员会由公司董事安广实、陈绍亨、陈小蓓组成，审计委员会召集人由公司独立董事安广实担任。

2020年12月23日，公司召开第一届董事会第一次审计委员会会议。

2021年1月26日，公司召开第一届董事会第二次审计委员会会议。

2021年8月9日，公司召开第一届董事会第三次审计委员会会议。

2021年12月23日，公司召开第一届董事会第四次审计委员会会议。

2022年3月15日，公司召开第一届董事会第五次审计委员会会议。

2022年3月17日，公司召开第一届董事会第六次审计委员会会议。

2022年6月2日，公司召开第一届董事会第七次审计委员会会议。

2022年10月9日，公司召开第一届董事会第八次审计委员会会议。

2022年11月25日，公司召开第一届董事会第九次审计委员会会议。

2023年2月28日，公司召开第一届董事会第十次审计委员会会议。

2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十一次审计委员会会议。

### 三、董事会提名委员会

提名委员会主要负责研究董事、总经理的选择标准和程序并向董事会提出建议，审核董事、总经理和董事会秘书候选人，就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核，提名董事会下设各专门委员会召集人和委员人选，拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委员会设召集人一名，由公司独立董事担任。

截至本招股意向书签署之日，第一届董事会提名委员会由公司董事 BEICHAO ZHANG（张北超）、朱晓娟、安广实三人组成，提名委员会召集人由公司独立董事 BEICHAO ZHANG（张北超）担任。

2020年12月23日，公司召开第一届董事会第一次提名委员会会议。

2021年11月25日，公司召开第一届董事会第二次提名委员会会议。

#### 四、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责拟订董事的履职评价办法，董事、监事的薪酬方案，组织董事的履职评价，提出对董事薪酬分配的建议，根据监事会对监事的履职评价，提出对监事薪酬分配的建议，就前述事项报经董事会同意后提交股东大会决定，拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准，涉及股东大会职权的应报股东大会批准。薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任。

截至本招股意向书签署之日，第一届董事会薪酬与考核委员会由公司董事陈绍亨、陆勤航、BEICHAO ZHANG（张北超）三人组成，薪酬与考核委员会召集人由公司独立董事陈绍亨担任。

2020年12月23日，公司召开第一届董事会第一次薪酬与考核委员会会议。

2021年5月20日，公司召开第一届董事会第二次薪酬与考核委员会会议。

2021年8月9日，公司召开第一届董事会第三次薪酬与考核委员会会议。

2021年12月23日，公司召开第一届董事会第四次薪酬与考核委员会会议。

## 附件五 募集资金具体运用情况

### 一、合肥晶合集成电路先进工艺研发项目

#### (一) 后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目

##### (1) 项目基本情况

本项目将基于晶合集成已量产的90nm前照式（FSI）CMOS图像传感器工艺平台，开发90nm及55nm后照式（BSI）CMOS图像传感器工艺平台，重点开发方向包括器件、工艺、性能等方面，具体情况如下：

序号	开发方向	开发内容
1	器件	开发高性能的低压元件（1.2V）、后照式感光元件以及像素 IP
2	工艺	持续进行制程优化、工艺流程改进，精简光罩层数
3	性能	改进像素损伤，降低了金属离子污染，使关键特性像素白点和噪声问题降至最低水平

和国内主流的8英寸集成电路110nm前照式图像传感技术相比，公司该项目将要开发的90nm及55nm后照式（BSI）CMOS图像传感器工艺平台可获得更高的感亮度和量子效率、更宽广感光角度、更低像素串扰、更高成像品质等优势，可生产超高画素及质量要求之终端产品上，广泛用于高端安防监控系统、智能车载环视及后视摄像头及高端智能手机等终端设备。

上述研发项目完成后，公司将具备生产后照式CMOS图像传感器芯片的技术能力，终端应用包括手机、无人机、单眼相机、中画幅相机、安防监控等。

##### (2) 项目投资概算

本项目将组建约50人的研发团队，总投资为6.0亿元，主要包括主机台设备投资、测试软硬件费用和人力费用。项目具体投资概算情况如下：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	投资金额	占比
1	研发设备购置费	4.7	78.3%
	其中：主机台	4.2	70.0%

序号	项目名称	投资金额	占比
	附属设备及建置费用	0.5	8.3%
2	测试软硬件费用	0.8	13.3%
	其中：研发测试设备及软件	0.3	5.0%
	第三方 IP 授权费用	-	-
	研发光罩及晶圆耗材	0.5	8.3%
3	人力费用	0.5	8.3%
合计		6.0	100.0%

### (3) 项目周期和时间进度

本项目于2021年第四季度开始实施，具体时间节点如下：

时间	项目进度安排
2021年第四季度	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台项目启动
2022年第二季度	完成 90 纳米后照式 CMOS 图像传感器芯工艺平台开发
2023年第四季度	完成 55 纳米后照式 CMOS 图像传感器芯工艺平台开发

## (二) 微控制器芯片工艺平台研发项目

### (1) 项目基本情况

本项目以晶合集成已拥有的110nm制程节点领域的微控制器技术和研发经验为基础，进一步开发55纳米及40纳米微控制器技术，开发元件包含：可供微控制器使用的低功耗核心低压元件（1.1V），以及核心组件硅智材-多次性可编程（MTP）及嵌入式非挥发性记忆体（eFlash）等，并在平台上导入多种嵌入式非挥发性记忆体IP，包含多次性可编程技术，嵌入式电可擦除只读存储器技术和嵌入式闪存技术。平台开发完成后，预计项目完成后，公司将可以提供性能、功耗、耐久性、资料保存性能等指标良好的中高端微控制器芯片。

上述研发项目完成后，公司将具备生产微控制器芯片的技术能力，终端应用包括车用电子、智能家居等。

### (2) 项目投资概算

本项目将组建约100人的研发团队，总投资为3.53亿元，主要包括主机台设备投

资、测试软硬件费用和人力费用。项目具体投资概算情况如下：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	投资金额	占比
1	研发设备购置费	0.23	6.5%
	其中：主机台	0.2	5.7%
	附属设备及建置费用	0.03	0.8%
2	测试软硬件费用	2.8	79.3%
	其中：研发测试设备及软件	0.7	19.8%
	第三方 IP 授权费用	1.3	36.8%
	研发光罩及晶圆耗材	0.8	22.7%
3	人力费用	0.5	14.2%
合计		3.53	100.0%

### （3）项目周期和时间进度

本项目预计于2023年第三季度开始实施，具体时间节点如下：

时间	项目进度安排
2023年第三季度	微控制器芯片工艺平台项目启动
2026年第二季度	完成40纳米微控制器工艺平台开发

## （三）40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目

### （1）项目基本情况

目前晶合集成正进行55nm技术平台开发。未来，公司将以此技术为基础，进行40纳米逻辑芯片工艺平台开发，重点开发方向为40nm标准逻辑制程的低漏电（LL）器件平台，其核心组件电压为1.1V，涵盖三种不同阈值电压，以及2.5V的输入/输出组件电压（超载3.3V，低载1.8V），并导入生产效率更高的多晶硅栅氮氧化硅绝缘层栅极（Poly/SiON）工艺技术，开发超浅结退火以及应力技术，大幅度降低晶格缺陷，提高生产良率以及运作效率，以满足不同客户的设计要求。

上述研发项目完成后，公司将具备生产40纳米逻辑芯片的技术能力，终端应用包括物联网、无线逻辑传输等。

## （2）项目投资概算

本项目将组建约150人的研发团队，总投资为15.0亿元，主要包括主机台设备投资、测试软硬件费用和人力费用。项目具体投资概算情况如下：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	投资金额	占比
1	研发设备购置费	10.4	69.3%
	其中：主机台	9.2	61.3%
	附属设备及建置费用	1.2	8.0%
2	测试软硬件费用	3.1	20.7%
	其中：研发测试设备及软件	1.5	10.0%
	第三方 IP 授权费用	0.8	5.3%
	研发光罩及晶圆耗材	0.8	5.3%
3	人力费用	1.5	10.0%
合计		15.0	100.0%

## （3）项目周期和时间进度

本项目预计于2022年第一季度开始实施，具体时间节点如下：

时间	项目进度安排
2022年第一季度	40 纳米逻辑芯片工艺平台项目启动
2024 年中	完成 40 纳米逻辑芯片工艺平台开发

## （四）28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目

### （1）项目基本情况

晶合集成持续深耕先进工艺，在未来40nm等技术开发完成的基础上，公司将进一步开发28nm逻辑平台和28nmOLED显示驱动工艺平台：在制程方面，28纳米将开发后闸极的高介电常数金属闸极（HKMG）制程提供更快速、更低功耗的元件性能，同时采用Low-K超低介电质材料以降低后段金属导线的漏电；在元件方面，提供多种不同阈值的组件（0.9V/1.8V/2.5V等）供客户设计使用。同时，该项目将导入业界最先进的金属闸极工艺（HKMG），不仅能够大幅减小漏电，还能有效降低栅极电容，提升晶体管驱动能力。

上述研发项目完成后，公司将具备生产28纳米逻辑芯片、无线逻辑芯片和OLED面板驱动芯片的技术能力，终端应用包括物联网、无线逻辑传输、高端手机屏幕等。

## （2）项目投资概算

本项目将组建约200人的研发团队，总投资为24.5亿元，主要包括主机台设备投资、测试软硬件费用和人力费用。项目具体投资概算情况如下：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	投资金额	占比
1	研发设备购置费	15.0	61.2%
	其中：主机台	13.4	54.7%
	附属设备及建置费用	1.6	6.5%
2	测试软硬件费用	7.0	28.6%
	其中：研发测试设备及软件	2.0	8.2%
	第三方 IP 授权费用	3.0	12.2%
	研发光罩及晶圆耗材	2.0	8.2%
3	人力费用	2.5	10.2%
合计		24.5	100.0%

## （3）项目周期和时间进度

本项目预计于2022年第三季度开始实施，具体时间节点如下：

时间	项目进度安排
2022年第三季度	28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台项目启动
2025年底	完成28纳米OLED/逻辑芯片工艺平台开发

## （五）募投项目备案程序的履行情况

合肥晶合集成电路先进工艺研发项目已由合肥新站高新技术产业开发区经贸局于2021年8月20日完成项目备案（项目代码：2108-340163-04-05-220549）。

## （六）项目实施地点与环境保护事项

本项目实施地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号，位于发行人现有厂区范围，不涉及新取得土地或房产的情况。

合肥晶合集成电路先进工艺研发项目已于2021年9月15日取得合肥市生态环境局出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司合肥晶合集成电路先进工艺研发项目环境影响报告表的批复》（环建审【2021】12048号）。

## 二、收购制造基地厂房及厂务设施

### （一）项目基本情况

2017年6月，公司与合肥蓝科签署《电子器件厂房设施租赁合同》，合肥蓝科按照要求将电子器件厂房基础设施建设完毕后，将电子器件厂房设施及土地租赁给公司，租赁期间自2017年6月28日起至2037年6月27日。

上述合肥蓝科建造并向公司出租的厂房包括公司生产经营所使用的主体厂房，以及仓库、废水处理站、综合动力站、大宗气体站等配套房屋。其中，主体厂房面积为173,982.92平方米，约一半面积已建设洁净室等配套厂务设施，用于公司目前已投产的“12英寸晶圆制造基地项目”（以下简称“晶合一厂”或“N1厂”）；另一半主体厂房建成后将用于“合肥新晶集成电路有限公司12吋晶圆制造项目”（即原“12英寸晶圆制造二厂项目”，以下简称“晶合二厂”或“二期厂”）。

为增强公司资产方面的独立性、完整性，公司拟向合肥蓝科收购制造基地厂房及厂务设施，收购完成后，公司将拥有主要生产经营厂房、现有土建建成部分对应的土地及配套厂务设施的完整所有权。拟收购资产合计资产评估值约为32.2亿元，拟使用募集资金规模约31亿元，上述资产评估报告已于2021年8月26日完成相关备案程序。

### （二）募投项目备案程序的履行情况

根据《企业投资项目核准和备案管理条例》《企业投资项目核准和备案管理办法》等相关法律法规，本项目无需履行募集资金投资项目备案程序。

### （三）项目实施地点与环境保护事项

本项目实施地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号，位于发行人现有厂区范围，不涉及新取得土地或房产的情况。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》《建设项目环境影响登记表备案管理办法》，本项目无需取得环境保护监管部门



的审批或备案手续。

#### （四）募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产

发行人募集资金拟向合肥蓝科收购制造基地厂房及厂务设施。合肥蓝科系发行人控股股东合肥建投的全资子公司，属于募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情形。本次被收购资产不存在效益承诺和对应的补偿责任。

### 三、补充流动资金及偿还贷款

公司本次公开发行拟使用募集资金15.0亿元用于补充流动资金及偿还贷款。结合公司所处行业的经营特点和财务状况，补充流动资金及偿还贷款能够有效提升公司资金使用效率，有利于增强公司市场竞争力。

公司业务的稳定增长需要流动资金的支持。受益于国内集成电路行业近年来的迅猛发展，报告期内公司业务持续稳定增长。报告期各期，公司营业收入分别为151,237.05万元、542,900.93万、1,005,094.86万元。2020年末开始，下游智能手机、平板电脑、台式/笔记本电脑、汽车等终端设备对显示器的需求呈现增长趋势，带动了面板显示驱动芯片市场规模的快速提升，全球芯片行业供应趋紧，芯片处于紧缺状态，全球半导体晶圆代工产能供不应求，随着公司经营规模的进一步扩张，公司营运资金需求将相应增加。补充流动资金及偿还贷款项目能够有效提升公司资金使用效率，提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，并对公司研发投入和人才队伍建设给予有力的支持，有利于增强公司市场竞争力。

## 附件六 发行人主要无形资产

## 一、境内专利情况

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
1	晶合集成	发明专利	光学光刻方法	ZL03155531.4	2003/08/28	继受取得
2	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	ZL200510065580.3	2005/04/18	继受取得
3	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	ZL200510065608.3	2005/04/18	继受取得
4	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	ZL200610005891.5	2006/01/19	继受取得
5	晶合集成	发明专利	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	ZL200510129767.5	2005/12/05	继受取得
6	晶合集成	发明专利	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	ZL200710161775.7	2007/09/26	继受取得
7	晶合集成	发明专利	监控光刻工艺的方法与监控标记	ZL200810093317.9	2008/04/18	继受取得
8	晶合集成	发明专利	分栅式非易失性存储器及其制备方法	ZL201810796277.8	2018/07/19	原始取得
9	晶合集成	发明专利	一种晶元破片分析装置及其晶元破片分析方法	ZL201810897300.2	2018/08/08	原始取得
10	晶合集成	发明专利	一种裂片装置及方法	ZL201810920343.8	2018/08/14	原始取得
11	晶合集成	发明专利	一种半导体结构制造方法	ZL201810980356.4	2018/08/27	原始取得
12	晶合集成	发明专利	MOS 场效应晶体管及其制造方法	ZL201811237197.5	2018/10/23	原始取得
13	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811345719.3	2018/11/13	原始取得
14	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811354139.0	2018/11/14	原始取得
15	晶合集成	发明专利	沟槽隔离结构的形成方法	ZL201910048694.9	2019/01/18	原始取得
16	晶合集成	发明专利	一种存储器及其制造方法	ZL201910104747.4	2019/02/01	原始取得
17	晶合集成	发明专利	高耐压半导体元件及其制造方法	ZL201910299871.0	2019/04/15	原始取得
18	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	ZL201910611966.1	2019/07/08	原始取得
19	晶合集成	发明专利	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	ZL201911268173.0	2019/12/11	原始取得
20	晶合集成	发明专利	半导体集成器件的阱制备方法和阱注入光罩组	ZL201911303991.X	2019/12/17	原始取得
21	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制造方法及其形成的半导体器件	ZL201911326563.9	2019/12/20	原始取得
22	晶合集成	发明专利	扩散型场效应晶体管的形成方法	ZL202010043997.4	2020/01/15	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
23	晶合集成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202010099798.5	2020/02/18	原始取得
24	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	ZL201910103609.4	2019/02/01	原始取得
25	晶合集成	发明专利	一种建立光学数据校正模型的方法	ZL202010219356.X	2020/03/25	原始取得
26	晶合集成	发明专利	一种晶圆的退火方法	ZL202010372489.0	2020/05/06	原始取得
27	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202010454977.6	2020/05/26	原始取得
28	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202010358483.8	2020/04/29	原始取得
29	晶合集成	发明专利	电容性半导体元件	ZL201910340165.6	2019/04/25	原始取得
30	晶合集成	发明专利	电容性半导体元件	ZL202010324914.9	2020/04/23	原始取得
31	晶合集成	发明专利	一种监测系统及监测方法	ZL201811145985.1	2018/09/29	原始取得
32	晶合集成	发明专利	一种静态随机存取存储器	ZL201910530203.4	2019/06/19	原始取得
33	晶合集成	发明专利	一种化学机械平坦化设备及其应用	ZL202011607411.9	2020/12/30	原始取得
34	晶合集成	发明专利	一种降低 CMOS 图像传感器暗电流的方法	ZL202210229027.2	2022/03/10	原始取得
35	晶合集成	发明专利	一种 GOI 测试电路结构	ZL202210228948.7	2022/03/10	原始取得
36	晶合集成	发明专利	一种光阻层移除方法及半导体器件的制作方法	ZL202210336244.1	2022/04/01	原始取得
37	晶合集成	发明专利	洁净室的空气净化装置及洁净室离子控制系统	ZL202010317150.0	2020/04/21	原始取得
38	晶合集成	发明专利	互连结构及其制备方法	ZL202210229023.4	2022/03/10	原始取得
39	晶合集成	实用新型	一种液位测量仪	ZL201820995525.7	2018/06/25	原始取得
40	晶合集成	实用新型	双灯丝离子源装置	ZL201821163226.3	2018/07/23	原始取得
41	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的安装位检测装置	ZL201821130870.0	2018/07/17	原始取得
42	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的定位装置	ZL201821147988.4	2018/07/19	原始取得
43	晶合集成	实用新型	一种气体供应装置	ZL201821192419.1	2018/07/24	原始取得
44	晶合集成	实用新型	一种载台及载具	ZL201821719617.9	2018/10/22	原始取得
45	晶合集成	实用新型	一种气体除尘装置及具有该气体除尘装置的气体处理装置	ZL201821753440.4	2018/10/26	原始取得
46	晶合集成	实用新型	掩膜板	ZL201821957502.3	2018/11/23	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
47	晶合集成	实用新型	可感测基片破损的片盒	ZL201822002991.3	2018/11/30	原始取得
48	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的不间断储水装置及半导体设备	ZL201920706945.3	2019/05/17	原始取得
49	晶合集成	实用新型	一种防干扰装置及半导体制程机台	ZL201921016248.1	2019/07/02	原始取得
50	晶合集成	实用新型	流速调节装置	ZL201921235650.9	2019/08/01	原始取得
51	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的组件调整装置	ZL201921439572.4	2019/09/02	原始取得
52	晶合集成	实用新型	一种半导体设备夹持装置	ZL201921604162.0	2019/09/25	原始取得
53	晶合集成	实用新型	半导体检测机台	ZL201921654723.8	2019/09/30	原始取得
54	晶合集成	实用新型	一种光罩	ZL202020368355.7	2020/03/23	原始取得
55	晶合集成	实用新型	一种晶体管结构	ZL202020257664.7	2020/03/04	原始取得
56	晶合集成	实用新型	封装芯片的移除装置	ZL201922312082.4	2019/12/20	原始取得
57	晶合集成	实用新型	多次可编程存储器的单元结构	ZL202020331150.1	2020/03/16	原始取得
58	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL202020519501.1	2020/04/10	原始取得
59	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL202020519503.0	2020/04/10	原始取得
60	晶合集成	实用新型	一种半导体器件	ZL202020333222.6	2020/03/17	原始取得
61	晶合集成	实用新型	半导体器件	ZL202020247738.9	2020/03/02	原始取得
62	晶合集成	实用新型	封装结构	ZL202020404622.1	2020/03/24	原始取得
63	晶合集成	实用新型	一种半导体结构及其应用的半导体器件	ZL202020778398.2	2020/05/12	原始取得
64	晶合集成	实用新型	嵌入式焊盘结构	ZL202020252537.8	2020/03/04	原始取得
65	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的腔室及半导体设备	ZL202020604243.7	2020/04/21	原始取得
66	晶合集成	实用新型	量测机台	ZL202020832666.4	2020/05/15	原始取得
67	晶合集成	实用新型	一种转接装置	ZL202021137450.2	2020/06/18	原始取得
68	晶合集成	实用新型	一种半导体的测试装置	ZL202021166959.X	2020/06/22	原始取得
69	晶合集成	实用新型	一种基板表面污染物取样装置	ZL202021248626.1	2020/06/30	原始取得
70	晶合集成	实用新型	封装芯片的开封装置	ZL202021282186.1	2020/07/02	原始取得
71	晶合集成	实用新型	一种晶圆侦测设备	ZL202021283661.7	2020/07/03	原始取得
72	晶合集成	实用新型	研磨垫中心校准治具	ZL202021581370.6	2020/08/03	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
73	晶合集成	实用新型	流体测量治具	ZL202021618739.6	2020/08/06	原始取得
74	晶合集成	实用新型	研磨后清洗装置和化学机械研磨设备	ZL202021645116.8	2020/08/10	原始取得
75	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL202021645079.0	2020/08/10	原始取得
76	晶合集成	实用新型	一种用于化学机械研磨的清洗装置	ZL202021794843.0	2020/08/25	原始取得
77	晶合集成	实用新型	一种半导体设备	ZL202021873549.9	2020/09/01	原始取得
78	晶合集成	实用新型	进样装置	ZL202021935217.9	2020/09/03	原始取得
79	晶合集成	实用新型	晶圆表面金属离子收集装置	ZL202022409723.0	2020/10/23	原始取得
80	晶合集成	实用新型	吹气管、吹气式液位计和硅片清洗装置	ZL202022619232.9	2020/11/12	原始取得
81	晶合集成	实用新型	高度测量装置	ZL202022982757.9	2020/12/07	原始取得
82	晶合集成	实用新型	一种循环水控温装置	ZL202120383318.8	2021/02/20	原始取得
83	晶合集成	实用新型	晶圆定位标示工具	ZL202120350044.2	2021/02/08	原始取得
84	晶合集成	实用新型	电容测试结构	ZL202023278550.X	2020/12/29	原始取得
85	晶合集成	实用新型	一种用于微光显微镜的测试夹具	ZL202022727035.9	2020/11/23	原始取得
86	晶合集成	实用新型	一种更换制程材料的防呆装置及防呆系统	ZL202120139540.3	2021/01/19	原始取得
87	晶合集成	实用新型	一种探针弯折装置	ZL202023000991.3	2020/12/11	原始取得
88	晶合集成	实用新型	一种二次离子质谱的样品装载盒	ZL202120419724.5	2021/02/25	原始取得
89	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的张力自动调控装置	ZL202120256206.6	2021/01/29	原始取得
90	晶合集成	实用新型	变容二极管	ZL202022952129.6	2020/12/08	原始取得
91	晶合集成	实用新型	超纯水取样器	ZL202120367091.8	2021/02/09	原始取得
92	晶合集成	实用新型	缺陷检测装置	ZL202121665116.9	2021/07/21	原始取得
93	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL202121554906.X	2021/07/08	原始取得
94	晶合集成	实用新型	涂胶机喷头位置测量装置及涂胶机	ZL202121665098.4	2021/07/21	原始取得
95	晶合集成	实用新型	套刻对准标记及掩模板组件	ZL202120925351.9	2021/04/29	原始取得
96	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的压力测量装置	ZL202121520685.4	2021/07/05	原始取得
97	晶合集成	实用新型	一种监测系统及检测机台	ZL202120368720.9	2021/02/08	原始取得
98	晶合集成	实用新型	晶圆装卸系统	ZL202121786395.4	2021/07/30	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
99	晶合集成	实用新型	支撑装置及反应腔	ZL202121691255.9	2021/07/21	原始取得
100	晶合集成	实用新型	一种过滤装置及光阻液涂布机	ZL202121894979.3	2021/08/13	原始取得
101	晶合集成	实用新型	防污染检测系统	ZL202121778033.0	2021/07/30	原始取得
102	晶合集成	实用新型	一种芯片失效分析用测试装置	ZL202122336617.9	2021/09/26	原始取得
103	晶合集成	实用新型	一种晶圆曝光后的烘烤设备	ZL202122173046.1	2021/09/09	原始取得
104	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的废气排放管道连接件及装置	ZL202122527065.X	2021/10/20	原始取得
105	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的排气阀及排气装置	ZL202122611732.2	2021/10/28	原始取得
106	晶合集成	实用新型	一种晶圆研磨装置	ZL202122934294.3	2021/11/26	原始取得
107	晶合集成	实用新型	晶圆清洗装置	ZL202123008798.9	2021/11/30	原始取得
108	晶合集成	实用新型	晶圆运载装置	ZL202122904647.5	2021/11/19	原始取得
109	晶合集成	实用新型	一种半导体机台液体自动补充装置及半导体机台	ZL202122704920.X	2021/11/03	原始取得
110	晶合集成	实用新型	晶圆清洗装置	ZL202220179328.4	2022/01/21	原始取得
111	晶合集成	实用新型	一种晶圆清洗设备	ZL202220255812.0	2022/02/08	原始取得
112	晶合集成	实用新型	一种光刻对准标记图形结构及半导体晶片	ZL202220533150.9	2022/03/11	原始取得
113	晶合集成	实用新型	半导体加热、显影装置	ZL202220527027.6	2022/03/11	原始取得
114	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的清洁装置	ZL202022972896.3	2020/12/11	原始取得
115	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202010983155.7	2020/09/18	原始取得
116	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011001446.8	2020/09/22	原始取得
117	北京晶芯成	发明专利	SRAM 器件及其形成方法	ZL202010998495.7	2020/09/22	原始取得
118	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202011012426.0	2020/09/24	原始取得
119	北京晶芯成	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL202011021046.3	2020/09/25	原始取得
120	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011019411.7	2020/09/25	原始取得
121	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011039422.1	2020/09/28	原始取得
122	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其形成方法	ZL202011059138.0	2020/09/30	原始取得
123	北京晶芯成	发明专利	一种金属互连结构的形成方法	ZL202011054620.5	2020/09/30	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
124	北京晶芯成	发明专利	LDMOS 晶体管及其制造方法	ZL202011054657.8	2020/09/30	原始取得
125	北京晶芯成	发明专利	浅沟槽隔离结构的制造方法及其形成的浅沟槽隔离结构	ZL202011069600.5	2020/10/09	原始取得
126	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆表面处理方法和表面处理装置	ZL202011069584.X	2020/10/09	原始取得
127	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011069193.8	2020/10/09	原始取得
128	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011073751.8	2020/10/10	原始取得
129	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆背封结构及其制造方法	ZL202011084965.5	2020/10/12	原始取得
130	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法与制造系统	ZL202011081316.X	2020/10/12	原始取得
131	北京晶芯成	发明专利	测试结构及其测试方法	ZL202011106814.5	2020/10/16	原始取得
132	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106813.0	2020/10/16	原始取得
133	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011106699.1	2020/10/16	原始取得
134	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106690.0	2020/10/16	原始取得
135	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106407.4	2020/10/16	原始取得
136	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106406.X	2020/10/16	原始取得
137	北京晶芯成	发明专利	一种介质层缺陷检测的测试结构	ZL202011114851.0	2020/10/19	原始取得
138	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试结构	ZL202011114835.1	2020/10/19	原始取得
139	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆中心的校正方法及系统	ZL202011114387.5	2020/10/19	原始取得
140	北京晶芯成	发明专利	Nor 闪存结构及其制作方法	ZL202011122506.1	2020/10/20	原始取得
141	北京晶芯成	发明专利	半导体器件	ZL202011122488.7	2020/10/20	原始取得
142	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆电性测试方法及测试设备	ZL202011121614.7	2020/10/20	原始取得
143	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136464.7	2020/10/22	原始取得
144	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136463.2	2020/10/22	原始取得
145	北京晶芯成	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL202011136147.5	2020/10/22	原始取得
146	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法及点胶装置	ZL202011135589.8	2020/10/22	原始取得
147	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011135359.1	2020/10/22	原始取得
148	北京晶芯成	发明专利	半导体数据分析方法、系	ZL202011160	2020/10/27	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			统及计算机可读存储介质	229.3		
149	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构	ZL202011159 567.5	2020/10/27	原始取得
150	北京晶芯成	发明专利	SONOS 存储器及其制造方法	ZL202011159 566.0	2020/10/27	原始取得
151	北京晶芯成	发明专利	隔离结构的制作方法、DAC 器件及其制作方法	ZL202011159 556.7	2020/10/27	原始取得
152	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制备方法	ZL202011159 377.3	2020/10/27	原始取得
153	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL202011176 040.3	2020/10/29	原始取得
154	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL202011184 712.5	2020/10/30	原始取得
155	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的结构及其制备方法	ZL202011207 288.1	2020/11/03	原始取得
156	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011207 284.3	2020/11/03	原始取得
157	北京晶芯成	发明专利	LDMOS 晶体管及其制造方法	ZL202011206 497.4	2020/11/03	原始取得
158	北京晶芯成	发明专利	MIM 电容器的制作方法	ZL202011206 496.X	2020/11/03	原始取得
159	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213 725.0	2020/11/04	原始取得
160	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213 310.3	2020/11/04	原始取得
161	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213 304.8	2020/11/04	原始取得
162	北京晶芯成	发明专利	一种静态随机存取存储器及其制造方法	ZL202011235 571.5	2020/11/09	原始取得
163	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆清洗位置的监测装置及监测方法	ZL202011235 545.2	2020/11/09	原始取得
164	北京晶芯成	发明专利	气体置换装置及光阻烘烤设备	ZL202011243 682.0	2020/11/10	原始取得
165	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及其形成方法、半导体器件的测试方法	ZL202011243 675.0	2020/11/10	原始取得
166	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及半导体钝化层的质量测试方法	ZL202011242 883.9	2020/11/10	原始取得
167	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL202011251 097.5	2020/11/11	原始取得
168	北京晶芯成	发明专利	一种洁净室过滤装置	ZL202011249 788.1	2020/11/11	原始取得
169	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL202011275 119.1	2020/11/16	原始取得
170	北京晶芯成	发明专利	一种自动调整半导体设备平衡性的装置及方法	ZL202011283 036.7	2020/11/17	原始取得
171	北京晶芯成	发明专利	一种半导体设备的报警方法	ZL202011283 029.7	2020/11/17	原始取得



序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
172	北京晶芯成	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL202011333530.X	2020/11/25	原始取得
173	北京晶芯成	发明专利	一种光学邻近校正模型的建模方法及建模系统	ZL202011359576.9	2020/11/27	原始取得
174	北京晶芯成	发明专利	半导体生产过程中的参数监控方法、系统及计算机可读存储介质	ZL202011367625.3	2020/11/30	原始取得
175	北京晶芯成	发明专利	半导体产品的良率分析及良率分析系统	ZL202011384551.4	2020/12/02	原始取得
176	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆失效的分析方法及系统	ZL202011419830.X	2020/12/08	原始取得
177	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011424911.9	2020/12/09	原始取得
178	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011565146.2	2020/12/25	原始取得
179	北京晶芯成	发明专利	一种曝光位置的确定方法及系统	ZL202011579234.8	2020/12/28	原始取得
180	北京晶芯成	发明专利	半导体存储器件	ZL202011572842.6	2020/12/28	原始取得
181	北京晶芯成	发明专利	ESD 保护电路、ESD 保护结构及其制造方法	ZL202110010268.3	2021/01/06	原始取得
182	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的形成方法	ZL202110010266.4	2021/01/06	原始取得
183	北京晶芯成	发明专利	化学机械研磨方法	ZL202110051576.0	2021/01/15	原始取得
184	北京晶芯成	发明专利	一种集成半导体器件	ZL202110248935.1	2021/03/08	原始取得
185	北京晶芯成	发明专利	静态随机存储器的制备方法	ZL202110252700.X	2021/03/09	原始取得
186	北京晶芯成	发明专利	一种化学机械研磨方法及其分析系统	ZL202110281539.9	2021/03/16	原始取得
187	北京晶芯成	发明专利	一种半导体元件的制造方法	ZL202110306176.X	2021/03/23	原始取得
188	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202110397617.1	2021/04/14	原始取得
189	北京晶芯成	发明专利	3D 半导体器件及其形成方法	ZL202110574826.9	2021/05/26	原始取得
190	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202110816834.X	2021/07/20	原始取得
191	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202110575021.6	2021/05/26	原始取得
192	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试电路及其测试方法	ZL202110421520.X	2021/04/20	原始取得
193	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011106408.9	2020/10/16	原始取得
194	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构的制备方法	ZL202110252703.3	2021/03/09	原始取得
195	北京晶芯成	发明专利	一种 LDMOS 晶体管及其形成方法	ZL202110921916.0	2021/08/12	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
196	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构及其制备方法	ZL202110921908.6	2021/08/12	原始取得
197	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111036002.2	2021/09/06	原始取得
198	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111103889.2	2021/09/22	原始取得
199	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及制造方法	ZL202111083665X	2021/09/16	原始取得
200	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111125376.1	2021/09/26	原始取得
201	北京晶芯成	发明专利	图像传感器及其制备方法	ZL202111417363.1	2021/11/26	原始取得
202	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202111436365.5	2022/02/11	原始取得
203	北京晶芯成	发明专利	MOM 电容器及集成电路装置	ZL202111118330.7	2022/02/11	原始取得
204	北京晶芯成	发明专利	一种用于气体分流模组的拆除治具及方法	ZL202111417349.1	2021/11/26	原始取得
205	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202111513751.X	2022/03/22	原始取得
206	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111514590.6	2021/12/13	原始取得
207	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆检测方法及检测装置	ZL202111616331.4	2021/12/28	原始取得
208	北京晶芯成	发明专利	自动化质量管控系统、方法及计算机可读存储介质	ZL202111514086.6	2021/12/13	原始取得
209	北京晶芯成	发明专利	一种阶梯沟槽横向绝缘栅双极型晶体管结构及制造方法	ZL202111513776.X	2021/12/13	原始取得
210	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体版图的监控方法及系统	ZL202210076385.4	2022/01/24	原始取得
211	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体隔离结构的制造方法	ZL202210089156.6	2022/01/26	原始取得
212	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体结构的制作方法	ZL202210076893.2	2022/01/24	原始取得
213	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种通信发射装置、系统、制造方法及电子设备	ZL202210148441.0	2022/02/18	原始取得
214	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体器件结构	ZL202210126953.7	2022/02/11	原始取得
215	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种失效芯片的剥层方法	ZL202210274980.9	2022/03/21	原始取得
216	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体装置及其制造方法	ZL202210123457.6	2022/02/10	原始取得
217	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体器件及其制作方法	ZL202210292285.5	2022/03/24	原始取得
218	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	集成器件及其制作方法	ZL202210279740.8	2022/03/22	原始取得
219	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体器件的制造方法	ZL202210292178.2	2022/03/24	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
220	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	多次可编程存储器及其制备方法	ZL202210376476.X	2022/04/12	原始取得
221	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体结构及其形成方法	ZL202210376486.3	2022/04/12	原始取得
222	南京晶驱	发明专利	晶圆裂片方法及其应用	ZL202010931740.2	2020/09/08	原始取得
223	南京晶驱	发明专利	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	ZL202010938526.X	2020/09/09	原始取得
224	南京晶驱	发明专利	一种光阻层阻挡能力的检测方法及其检测系统	ZL202010937768.7	2020/09/09	原始取得
225	南京晶驱	发明专利	一种半导体器件制造方法	ZL202010938519.X	2020/09/09	原始取得
226	南京晶驱	发明专利	刻蚀方法	ZL202010998512.7	2020/09/22	原始取得
227	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011005773.0	2020/09/23	原始取得
228	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽结构制备方法	ZL202011012959.9	2020/09/24	原始取得
229	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制作方法	ZL202011013439.X	2020/09/24	原始取得
230	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202010937769.1	2020/09/09	原始取得
231	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011021798.X	2020/09/25	原始取得
232	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL202011019947.9	2020/09/25	原始取得
233	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制造方法	ZL202011019302.5	2020/09/25	原始取得
234	南京晶驱	发明专利	电容器及其制备方法	ZL202011037143.1	2020/09/28	原始取得
235	南京晶驱	发明专利	一种静电放电防护线路	ZL202011099926.2	2020/10/15	原始取得
236	南京晶驱	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011093528.X	2020/10/14	原始取得
237	南京晶驱	发明专利	一种版图边界图案的修正方法与修正系统	ZL202011095237.4	2020/10/14	原始取得
238	南京晶驱	发明专利	MOS 晶体管及其制造方法	ZL202011093599.X	2020/10/14	原始取得
239	南京晶驱	发明专利	电容的测量结构及测量方法	ZL202011093598.5	2020/10/14	原始取得
240	南京晶驱	发明专利	一种光刻图形的仿真方法及仿真系统	ZL202011135351.5	2020/10/22	原始取得
241	南京晶驱	发明专利	图形显影情况的检测方法	ZL202011189007.4	2020/10/30	原始取得
242	南京晶驱	发明专利	光强阈值的获取方法以及辅助图形显影情况的检测方法	ZL202011185018.5	2020/10/30	原始取得
243	南京晶驱	发明专利	辅助图形的添加方法、装置及测试版图	ZL202110492632.4	2021/05/07	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
244	南京晶驱	发明专利	光学临近修正方法、装置及电子设备	ZL202110754593.0	2021/07/05	原始取得
245	南京晶驱	发明专利	光学邻近修正模型的建模方法	ZL202110951888.7	2021/08/19	原始取得
246	南京晶驱	发明专利	预测图形桥联的方法、装置及电子设备	ZL202110951881.5	2021/08/19	原始取得
247	南京晶驱	发明专利	一种光学临近效应的修正方法及系统	ZL202110816830.1	2021/07/20	原始取得
248	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器单元、阵列及制备方法	ZL201810796535.2	2018/07/19	原始取得
249	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体结构及其制备方法	ZL202210336009.4	2022/04/01	原始取得
250	晶合集成	发明专利	半导体器件的形成方法	ZL202210335631.3	2022/04/01	原始取得
251	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	晶圆对准装置及方法、晶圆测试方法	ZL202210321449.2	2022/03/30	原始取得
252	晶合集成	实用新型	一种光刻对准标记图形结构及半导体晶片	ZL202220532836.6	2022/03/11	原始取得
253	晶合集成	发明专利	一种光学临近效应修正模型的获取方法及系统	ZL202210315048.6	2022/03/29	原始取得
254	晶合集成	发明专利	一种版图图形的修正方法及系统	ZL202210315047.1	2022/03/29	原始取得
255	晶合集成	实用新型	一种光刻对准标记图形结构及半导体晶片	ZL202220533149.6	2022/03/11	原始取得
256	晶合集成	发明专利	半导体结构及其制作方法	ZL202210321479.3	2022/03/30	原始取得
257	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种 MOS 晶体管的形成方法	ZL202210335956.1	2022/04/01	原始取得
258	晶合集成	实用新型	一种光刻对准标记图形结构及半导体晶片	ZL202220559379.X	2022/03/11	原始取得
259	晶合集成	发明专利	光学临近修正方法及装置	ZL202210335630.9	2022/04/01	原始取得
260	晶合集成	发明专利	3D 半导体器件及其形成方法	ZL202210336445.1	2022/04/01	原始取得
261	晶合集成	实用新型	一种用于吹净晶圆的吹净装置及其半导体设备腔室	ZL202220616340.7	2022/03/21	原始取得
262	晶合集成	实用新型	一种晶圆吸附设备	ZL202220747737.X	2022/04/01	原始取得
263	晶合集成	发明专利	一种金属互连结构及其制作方法	ZL202210500317.6	2022/05/10	原始取得
264	晶合集成	实用新型	加热装置及半导体设备	ZL202220771678.X	2022/03/29	原始取得
265	晶合集成	发明专利	一种集成电路结构及其形成方法	ZL202210566009.3	2022/05/24	原始取得
266	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种 MIM 电容及其形成方法	ZL202210089607.6	2022/01/26	原始取得
267	晶合集成	发明专利	光学临近修正方法、装置及电子设备	ZL202210506434.3	2022/05/11	原始取得
268	新晶集成	发明专利	生产力分析方法及生产力	ZL202210659	2022/06/13	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			分析系统	761.2		
269	晶合集成	实用新型	一种晶圆处理装置	ZL202221183 626.7	2022/05/17	原始取得
270	晶合集成	发明专利	一种图像传感器及其制作方法	ZL202210571 703.4	2022/05/25	原始取得
271	晶合集成	发明专利	SRAM 及其制作方法	ZL202210603 301.8	2022/05/31	原始取得
272	北京晶芯成、 晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202210603 268.9	2022/05/31	原始取得
273	晶合集成	发明专利	一种对准误差的量测方法及系统	ZL202210565 869.5	2022/05/24	原始取得
274	北京晶芯成、 晶合集成	发明专利	一种图像传感器及其制造方法	ZL202210525 533.6	2022/05/16	原始取得
275	新品集成	发明专利	光罩及半导体结构	ZL202210560 079.8	2022/05/23	原始取得
276	新品集成	发明专利	半导体器件结构及其制备方法	ZL202210536 819.4	2022/05/18	原始取得
277	晶合集成	发明专利	测试结构	ZL202210581 453.2	2022/05/26	原始取得
278	晶合集成	发明专利	集成电路及其形成方法	ZL202210677 361.4	2022/06/16	原始取得
279	晶合集成	发明专利	一种半导体集成器件的制作方法	ZL202210663 773.2	2022/06/14	原始取得
280	北京晶芯成、 晶合集成	发明专利	高压晶体管仿真模型及建模方法	ZL202210229 031.9	2022/03/10	原始取得
281	晶合集成	发明专利	金属硅化物层的形成方法、半导体器件及其形成方法	ZL201810717 248.8	2018/07/03	原始取得
282	晶合集成	发明专利	金属刻蚀方法	ZL202210659 482.6	2022/06/13	原始取得
283	晶合集成	实用新型	一种晶圆转移设备	ZL202221383 880.1	2022/06/02	原始取得
284	北京晶芯成、 晶合集成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202210664 390.7	2022/06/14	原始取得
285	新品集成	发明专利	优化图像传感器死线的方法及图像传感器	ZL202210722 474.1	2022/06/24	原始取得
286	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制作方法	ZL202210701 233.9	2022/06/21	原始取得
287	北京晶芯成、 晶合集成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202210785 556.0	2022/07/06	原始取得
288	晶合集成	实用新型	一种关键尺寸测试条结构	ZL202221464 366.0	2022/06/10	原始取得
289	晶合集成	实用新型	一种测试电路结构	ZL202221281 593.X	2022/05/25	原始取得
290	晶合集成	发明专利	一种半导体器件及其制作方法	ZL202210701 263.X	2022/06/21	原始取得
291	晶合集成	发明专利	一种介质层可靠性测试结构及测试方法	ZL202210817 928.3	2022/07/13	原始取得
292	晶合集成	发明专利	一种半导体集成器件及其制作方法	ZL202210571 693.4	2022/05/25	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
293	晶合集成	实用新型	晶圆支撑装置	ZL202221086125.7	2022/04/29	原始取得
294	新品集成	发明专利	目标图像的更新方法及系统、晶圆检测方法和计算机设备	ZL202210733693.X	2022/06/27	原始取得
295	新品集成	发明专利	晶圆清洗系统及方法	ZL202210738612.5	2022/06/28	原始取得
296	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202010506035.8	2020/06/05	原始取得
297	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202210754353.5	2022/06/30	原始取得
298	晶合集成	实用新型	晶圆背面自清洁装置及光刻机	ZL202220462327.0	2022/03/04	原始取得
299	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体器件及其制备方法	ZL202210694366.8	2022/06/20	原始取得
300	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制造方法及半导体结构	ZL202210418608.0	2022/04/21	原始取得
301	晶合集成	发明专利	半导体器件版图结构及其形成方法	ZL202210844793.X	2022/07/19	原始取得
302	晶合集成	发明专利	半导体结构及其制作方法	ZL202210433073.4	2022/04/24	原始取得
303	晶合集成	实用新型	一种晶圆装载装置及其校准装置	ZL202221941646.6	2022/07/26	原始取得
304	晶合集成	发明专利	闪存器件、存储单元及其制造方法	ZL202210850397.8	2022/07/20	原始取得
305	晶合集成	发明专利	半导体器件及其制作方法	ZL202210844726.8	2022/07/19	原始取得
306	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	3D CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL202210852983.6	2022/07/20	原始取得
307	晶合集成	发明专利	3D CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL202210850365.8	2022/07/20	原始取得
308	晶合集成	发明专利	一种逻辑芯片漏电失效分析方法	ZL202210966115.0	2022/08/12	原始取得
309	晶合集成	发明专利	晶体管及其制造方法	ZL202210844962.X	2022/07/19	原始取得
310	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202211015524.9	2022/08/24	原始取得
311	晶合集成	实用新型	一种真空调压装置及曝光机	ZL202221678854.1	2022/07/01	原始取得
312	晶合集成	实用新型	一种晶圆的快速热处理装置	ZL202222020880.1	2022/08/02	原始取得
313	晶合集成	实用新型	一种化学机械研磨装置	ZL202222021080.1	2022/08/02	原始取得
314	晶合集成	发明专利	对准标记的制作方法及其晶圆键合方法	ZL202210677258.X	2022/06/16	原始取得
315	晶合集成	发明专利	一种半导体器件及其制作方法	ZL202210941301.9	2022/08/08	原始取得
316	晶合集成	发明专利	一种半导体结构的制造方法及半导体结构	ZL202210844521.X	2022/07/19	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
317	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制作方法	ZL202210941307.6	2022/08/08	原始取得
318	晶合集成	发明专利	一种 efuse 单元结构以及存储器	ZL202210964664.4	2022/08/12	原始取得
319	晶合集成	实用新型	一种晶圆盒检测系统	ZL202221304446.X	2022/05/27	原始取得
320	晶合集成	发明专利	存储器及其形成方法	ZL202210965859.0	2022/08/12	原始取得
321	晶合集成	发明专利	晶圆键合方法以及背照式图像传感器的形成方法	ZL202210850359.2	2022/07/20	原始取得
322	新品集成	发明专利	晶圆结构及芯片良率检测方法	ZL202211025890.2	2022/08/25	原始取得
323	晶合集成	发明专利	一种晶圆的刻蚀方法及系统	ZL202210983922.3	2022/08/17	原始取得
324	南京晶驱、晶合集成	发明专利	一种测试结构及测试方法	ZL202210850740.9	2022/07/20	原始取得
325	新品集成	发明专利	对准标记图形的识别方法及装置、计算机设备和存储介质	ZL202211003240.8	2022/08/22	原始取得
326	晶合集成	发明专利	一种高压器件的形成方法及高压器件	ZL202210845012.9	2022/07/19	原始取得
327	晶合集成	发明专利	一种测试结构	ZL202211081388.3	2022/09/06	原始取得
328	晶合集成	发明专利	半导体器件及其制备方法	ZL202210844775.1	2022/07/19	原始取得
329	晶合集成	发明专利	一种版图图形的修正方法及系统	ZL202211002917.6	2022/08/22	原始取得
330	晶合集成	实用新型	一种晶圆的分析设备	ZL202222043244.0	2022/08/04	原始取得
331	晶合集成	发明专利	3D CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL202210850363.9	2022/07/20	原始取得
332	晶合集成	发明专利	金属线的去层方法以及器件缺陷检测方法	ZL201910568844.9	2019/06/27	原始取得
333	新品集成	发明专利	目标结构晶圆获取方法、装置、设备及存储介质	ZL202210991828.2	2022/08/18	原始取得
334	晶合集成	实用新型	一种外加式流量测量装置、混合设备及清洗机	ZL202222389232.3	2022/09/08	原始取得
335	晶合集成	实用新型	一种漏液侦测设备	ZL202222394526.5	2022/09/07	原始取得
336	晶合集成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202211067774.7	2022/09/02	原始取得
337	晶合集成	实用新型	一种漏液侦测设备	ZL202222376099.8	2022/09/07	原始取得
338	晶合集成	发明专利	一种掩模板及形成方法	ZL202211036759.6	2022/08/29	原始取得
339	晶合集成	发明专利	一种电容器及其制备方法	ZL202211059956.X	2022/09/01	原始取得
340	晶合集成	发明专利	图像传感器及其制作方法	ZL202211059920.1	2022/09/01	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
341	晶合集成	发明专利	一种芯片的失效分析方法及系统	ZL202211194766.9	2022/09/29	原始取得
342	晶合集成	实用新型	一种湿法刻蚀机	ZL202222291466.4	2022/08/30	原始取得
343	晶合集成	实用新型	一种电子激发组件、电离装置及离子植入机	ZL202222375679.5	2022/09/07	原始取得
344	晶合集成	发明专利	栅极结构的制作方法	ZL202211250270.9	2022/10/13	原始取得
345	晶合集成	发明专利	栅极结构的制作方法	ZL202211250269.6	2022/10/13	原始取得
346	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制作方法	ZL202211133736.7	2022/09/19	原始取得
347	晶合集成	实用新型	一种半导体设备功率匹配器的连接装置	ZL202222199750.9	2022/08/18	原始取得
348	晶合集成	发明专利	CMOS 图像传感器的制作方法	ZL202211170495.3	2022/09/26	原始取得
349	晶合集成	发明专利	一种半导体结构的制作方法	ZL202211219589.5	2022/10/08	原始取得

## 二、境外专利情况

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	发明专利	Method for automatically controlling defect - specification in a semiconductor manufacturing process	US 6,807,454 B2	2003/03/17	继受取得	美国
2	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	US 6,670,254 B1	2002/10/01	继受取得	美国
3	晶合有限	发明专利	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	US 6,828,633 B2	2003/02/26	继受取得	美国
4	晶合有限	发明专利	Silicon-on-insulator device structure	US 7,019,582 B2	2004/09/29	继受取得	美国
5	晶合有限	发明专利	Method for producing a gate	US 6,699,755 B1	2003/03/24	继受取得	美国
6	晶合有限	发明专利	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	US 7,461,472 B2	2003/06/16	继受取得	美国
7	晶合有限	发明专利	Method of improving a resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle	US 7,008,733 B2	2003/09/25	继受取得	美国
8	晶合有限	发明专利	Re-performable spin-on process	US 6,881,590 B2	2003/08/25	继受取得	美国



序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
9	晶合有限	发明专利	Method for fabricating a through hole on a semiconductor substrate	US 6,995,086 B2	2004/06/28	继受取得	美国
10	晶合有限	发明专利	Method for forming a titanium nitride layer	US 7,030,015 B2	2004/09/16	继受取得	美国
11	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device	US 7,056,787 B2	2005/01/12	继受取得	美国
12	晶合有限	发明专利	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	US 7,098,124 B2	2005/05/31	继受取得	美国
13	晶合有限	发明专利	Semiconductor device having self-aligned contact	US 7,612,433 B2	2005/09/21	继受取得	美国
14	晶合有限	发明专利	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	US 7,803,692 B2	2009/09/18	继受取得	美国
15	晶合有限	发明专利	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	US 7,550,372 B2	2005/08/29	继受取得	美国
16	晶合有限	发明专利	Method for forming buried doped region	US 7,465,632 B2	2005/10/28	继受取得	美国
17	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing self-aligned contact openings	US 7,429,527 B2	2007/09/11	继受取得	美国
18	晶合有限	发明专利	Method of fabricating semiconductor device	US 7,268,055 B2	2005/11/07	继受取得	美国
19	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing gate dielectric layer	US 7,273,787 B2	2005/11/18	继受取得	美国
20	晶合有限	发明专利	Method for forming contact window	US 8,722,538 B2	2012/09/12	继受取得	美国
21	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing semiconductor device	US 8,822,303 B2	2012/09/15	继受取得	美国
22	晶合有限	发明专利	SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATION METHOD THEREOF	US10,636,801 B2	2018/11/25	原始取得	美国
23	晶合有限	发明专利	METHOD OF FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,490,647 B1	2018/08/31	原始取得	美国
24	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION METHOD	US10,726,894 B2	2018/11/25	原始取得	美国
25	晶合有限	发明专利	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US 10,490,441 B1	2018/10/18	原始取得	美国
26	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND	US 10,854,758 B2	2019/02/18	原始取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME				
27	晶合集成	发明专利	Pre-processing method, method for forming metal silicide and semiconductor processing apparatus	US10,916,417B2	2020/06/16	原始取得	美国
28	晶合集成	发明专利	METHOD OF FABRICATING MOSFET	US10,957,776B2	2020/05/21	原始取得	美国
29	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	US10,930,545B2	2019/06/27	原始取得	美国
30	晶合集成	发明专利	CURRENT SOURCE USING EMITTER REGION AS BASE REGION ISOLATION STRUCTURE	US10,950,601B2	2019/04/15	原始取得	美国
31	晶合集成	发明专利	MOSFET AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,971,595B2	2018/12/17	原始取得	美国
32	晶合集成	发明专利	DIFFUSED FIELD-EFFECT TRANSISTOR AND METHOD OF FABRICATING SAME	US11,024,722B1	2020/03/25	原始取得	美国
33	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US10,916,664B2	2020/09/19	原始取得	美国
34	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND METHOD OF FORMING SAME	US11,069,559B1	2020/06/22	原始取得	美国
35	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FABRICATING SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY	US11,088,155 B2	2020/03/18	原始取得	美国
36	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US11,049,947B2	2019/11/07	原始取得	美国
37	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	US11,257,668B2	2020/07/01	原始取得	美国
38	晶合集成	发明专利	Method for manufacturing Semiconductor Element	US11,398,411B2	2020/06/19	原始取得	美国
39	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	US11,404,328B2	2020/07/23	原始取得	美国
40	晶合集成	发明专利	METHOD FOR MANUFACTURING	US11,437,281 B2	2020/04/16	原始	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			SEMICONDUCTOR DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE THEREBY FORMED			取得	
41	晶合集成	发明专利	WAFER ANNEALING METHOD	US11,348,781B2	2020/07/10	原始取得	美国
42	晶合集成	发明专利	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	I313889	2003/07/21	继受取得	中国台湾
43	晶合集成	发明专利	制作通孔的方法	I240988	2004/01/07	继受取得	中国台湾
44	晶合集成	发明专利	浅沟渠隔离结构的制造方法	I234228	2004/05/12	继受取得	中国台湾
45	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	I254409	2005/02/16	继受取得	中国台湾
46	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	I254365	2005/01/27	继受取得	中国台湾
47	晶合集成	发明专利	自行对准接触窗开口的制作方法	I301997	2005/06/17	继受取得	中国台湾
48	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	I267190	2005/08/29	继受取得	中国台湾
49	晶合集成	发明专利	隔离结构的制造方法	I300968	2006/06/28	继受取得	中国台湾
50	晶合集成	发明专利	光罩复验方法与系统	I305004	2006/07/17	继受取得	中国台湾
51	晶合集成	发明专利	管制规格界限之制定方法	I305838	2006/09/29	继受取得	中国台湾
52	晶合集成	发明专利	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	I301982	2006/09/28	继受取得	中国台湾
53	晶合集成	发明专利	接触窗的形成方法	I473206	2012/07/03	继受取得	中国台湾
54	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	I464831	2012/06/27	继受取得	中国台湾
55	晶合集成	发明专利	分栅式非挥发性记忆体及其制备方法	I720350	2018/10/09	原始取得	中国台湾
56	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	I739473	2020/06/11	原始取得	中国台湾
57	晶合集成	发明专利	晶圓的退火方法	I755775	2020/06/24	原始取得	中国台湾
58	晶合集成	发明专利	一种套刻标记、套刻标记方法及套刻测量方法	I775382	2021/04/09	原始取得	中国台湾
59	晶合集成	发明专利	半導體結構及其製造方法	I777422	2020/07/24	原始取得	中国台湾
60	晶合集成	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	原始取得	日本
61	晶合集成	发明专利	SRAM、半導體集積回路及び LCD ドライバ	特许第 6801053 号	2019/06/19	原始取得	日本

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
62	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6831067 号	2019/04/25	原始取得	日本
63	晶合集成	发明专利	半導体素子の製造方法	特许第 6826795 号	2019/01/09	原始取得	日本
64	晶合集成	发明专利	高耐庄半導体素子及びその製造方法	特许第 6892889 号	2019/04/15	原始取得	日本
65	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6918173 号	2020/04/23	原始取得	日本
66	晶合集成	发明专利	半導体テスト構造	特许第 7094344 号	2020/10/27	原始取得	日本
67	晶合集成	发明专利	半導体装置、及びその製造方法	特许第 7171650 号	2020/05/27	原始取得	日本

### 三、境内商标情况

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
1	晶合集成	<b>Nexchip</b>	26258933	25	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
2	晶合集成	<b>Nexchip</b>	26283789	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
3	晶合集成	<b>Nexchip</b>	26255490	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
4	晶合集成	<b>晶合</b>	26295138A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
5	晶合集成	<b>晶合</b>	26261189	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
6	晶合集成	<b>晶合</b>	26283543	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
7	晶合集成	<b>晶合</b>	26258453	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
8	晶合集成	<b>晶合集成</b>	26296982A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
9	晶合集成	晶合集成	26257005	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
10	晶合集成	晶合集成	26279879	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
11	晶合集成	晶合集成	26258966	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
12	晶合集成		26279826	9	2018/12/07-2028/12/06	原始取得
13	晶合集成		43218141	25	2020/10/14-2030/10/13	原始取得
14	晶合集成		26279830	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
15	晶合集成		26273278	40	2019/12/14-2029/12/13	原始取得
16	晶合集成	 Nexchip	36794768	25	2020/08/21-2030/08/20	原始取得
17	晶合集成	晶芯成	54924121	9	2021/11/07-2031/11/6	原始取得
18	晶合集成	晶芯成	53267990	25	2021/09/07-2031/09/06	原始取得
19	晶合集成	晶芯成	54895828	35	2021/11/07-2031/11/06	原始取得
20	晶合集成	晶芯成	53268332	40	2021/09/07-2031/09/06	原始取得
21	晶合集成	晶驱	53274613	25	2021/08/28-2031/08/27	原始取得
22	晶合集成	晶驱	53264804	40	2021/08/28-2031/08/27	原始取得
23	晶合集成	新品	59163417	9	2022/06/14-2032/06/13	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
24	晶合集成	<b>新晶</b>	59154730	25	2022/03/14-2032/03/13	原始取得
25	晶合集成	<b>新晶</b>	59142175	35	2022/05/21-2032/05/20	原始取得
26	晶合集成	<b>新晶</b>	59148502	40	2022/05/21-2032/05/20	原始取得
27	晶合集成	<b>Nexchip</b>	61874559	35	2022/06/21-2032/06/20	原始取得
28	晶合集成	 <b>Nexchip</b>	61859353	16	2022/07/07-2032/07/06	原始取得
29	晶合集成	 <b>Nexchip</b>	61857484	24	2022/07/07-2032/07/06	原始取得
30	晶合集成	 <b>Nexchip</b>	61854331	35	2022/07/07-2032/07/06	原始取得
31	晶合集成	<b>Nexchip</b>	61890806	16	2022/07/07-2032/07/06	原始取得
32	晶合集成	<b>Nexchip</b>	61877615	24	2022/07/07-2032/07/06	原始取得
33	晶合集成	<b>Nexchip</b>	62617086	16	2022/08/14-2032/08/13	原始取得
34	晶合集成	<b>Nexchip</b>	62615949	24	2022/08/14-2032/08/13	原始取得
35	晶合集成	<b>Nexchip</b>	62618866	35	2022/08/14-2032/08/13	原始取得

## 四、境外商标情况

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	Nexchip	6098177	9	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
2	晶合有限	Nexchip	6071853	25	2018/08/17- 2028/08/16	原始取得	日本
3	晶合有限	Nexchip	6098177	35	2018/11/16- 2028/11/15	原始取得	日本
4	晶合有限	Nexchip	6071853	40	2018/08/17- 2028/08/16	原始取得	日本
5	晶合有限	晶合	6050343	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
6	晶合有限	晶合	6070505	25	2018/08/10- 2028/08/09	原始取得	日本
7	晶合有限	晶合	6050343	35	2018/06/08- 2028/06/07	原始取得	日本
8	晶合有限	晶合	6070505	40	2018/08/10- 2028/08/09	原始取得	日本
9	晶合有限	晶合集成	6050344	9	2018/06/08- 2028/06/07	原始取得	日本
10	晶合有限	晶合集成	6071852	25	2018/08/17- 2028/08/16	原始取得	日本
11	晶合有限	晶合集成	6050344	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
12	晶合有限	晶合集成	6071852	40	2018/08/17- 2028/08/16	原始取得	日本
13	晶合有限		6050345	9	2018/06/08- 2028/06/07	原始取得	日本
14	晶合有限		6070504	25	2018/08/10- 2028/08/09	原始取得	日本
15	晶合有限		6050345	35	2018/06/08- 2028/06/07	原始取得	日本
16	晶合有限		6070504	40	2018/08/10- 2028/08/09	原始取得	日本
17	晶合有限	Nexchip	01919639	9	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
18	晶合集成	Nexchip	01923633	25	2018/07/01- 2028/06/30	原始取得	中国台湾
19	晶合有限	Nexchip	01920983	35	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
20	晶合集成	Nexchip	01912745	40	2018/05/01- 2028/04/30	原始取得	中国台湾
21	晶合有限	晶合	01919637	9	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
22	晶合集成	晶合	01909401	25	2018/04/16- 2028/04/15	原始取得	中国台湾
23	晶合有限	晶合	01920981	35	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
24	晶合集成	晶合	01912743	40	2018/05/01- 2028/04/30	原始取得	中国台湾
25	晶合有限	晶合集成	01919636	9	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾



序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
26	晶合集成	晶合集成	01909400	25	2018/04/16- 2028/04/15	原始取得	中国台湾
27	晶合有限	晶合集成	01920980	35	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
28	晶合集成	晶合集成	01918174	40	2018/06/01- 2028/05/31	原始取得	中国台湾
29	晶合有限		01919638	9	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
30	晶合集成		01909402	25	2018/04/16- 2028/04/15	原始取得	中国台湾
31	晶合有限		01920982	35	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
32	晶合集成		01912744	40	2018/05/01- 2028/04/30	原始取得	中国台湾
33	晶合有限	Nexchip	5513533	9	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国
34	晶合有限	Nexchip	5513299	25	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国
35	晶合有限	Nexchip	5559722	35	2018/09/11- 2028/09/10	原始取得	美国
36	晶合有限	Nexchip	5513440	40	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国
37	晶合有限	晶合	5523772	9	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
38	晶合有限	晶合	5518583	25	2018/07/17- 2028/07/16	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
39	晶合有限	晶合	5513532	35	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国
40	晶合有限	晶合	5518584	40	2018/07/17- 2028/07/16	原始取得	美国
41	晶合有限	晶合集成	5518591	25	2018/07/17- 2028/07/16	原始取得	美国
42	晶合有限	晶合集成	5523770	9	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
43	晶合有限	晶合集成	5523769	35	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
44	晶合有限	晶合集成	5513586	40	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国
45	晶合有限		5523767	9	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
46	晶合有限		5523806	25	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
47	晶合有限		5523768	35	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
48	晶合有限		5523807	40	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
49	晶合有限	Nexchip	018074417	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
50	晶合有限	Nexchip	018074417	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
51	晶合有限	Nexchip	018074417	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
52	晶合有限	 Nexchip	018073971	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
53	晶合有限	 Nexchip	018073971	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
54	晶合有限	 Nexchip	018073971	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
55	晶合有限		018073976	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
56	晶合有限		018073976	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
57	晶合有限		018073976	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
58	晶合有限	Nexchip	4196328	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
59	晶合有限	Nexchip	4196329	40	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
60	晶合有限	 Nexchip	4216333	35	2019/06/25-2029/06/24	原始取得	印度
61	晶合有限	 Nexchip	4216334	40	2019/06/25- 2029/06/24	原始取得	印度
62	晶合有限		4196323	9	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
63	晶合有限		4196324	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
64	晶合有限		4196325	40	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
65	晶合有限	Nexchip	401603379	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
66	晶合有限	Nexchip	401603380	40	2020/05/07- 2030/05/06	原始取得	韩国
67	晶合集成	Nexchip	401684625	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
68	晶合有限	 Nexchip	401605036	35	2020/05/12- 2030/05/11	原始取得	韩国
69	晶合有限	 Nexchip	401605037	40	2020/05/12- 2030/05/11	原始取得	韩国
70	晶合集成	 Nexchip	401684665	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
71	晶合有限		401603377	9	2020/05/07- 2030/05/06	原始取得	韩国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
72	晶合有限		401603378	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
73	晶合有限		401599318	40	2020/04/23- 2030/04/22	原始取得	韩国
74	晶合有限	<b>Nexchip</b>	4020192683 2S	35	2019/12/12- 2029/12/11	原始取得	新加坡
75	晶合有限	<b>Nexchip</b>	4020192683 1T	40	2019/12/12- 2029/12/11	原始取得	新加坡
76	晶合集成	<b>Nexchip</b>	4020192680 6V	9	2019/12/11-2029/12/10	原始取得	新加坡
77	晶合有限	 Nexchip	4020192581 4T	35	2019/11/28- 2029/11/27	原始取得	新加坡
78	晶合集成	 Nexchip	4020192581 5S	40	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
79	晶合集成	 Nexchip	4020192686 9W	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
80	晶合有限		4020192684 2V	9	2019/12/12- 2029/12/11	原始取得	新加坡
81	晶合有限		4020192683 8P	35	2019/12/12- 2029/12/11	原始取得	新加坡
82	晶合集成		4020192684 7Q	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
83	晶合集成	 Nexchip	TM2019044 357	9	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
84	晶合集成	 Nexchip	TM2019044 362	35	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
85	晶合集成	 Nexchip	TM2019044 364	40	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
86	晶合集成	<b>Nexchip</b>	TM2019045 346	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
87	晶合集成	<b>Nexchip</b>	TM2019045 348	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
88	晶合集成	<b>Nexchip</b>	TM2019045 350	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
89	晶合集成		TM2019045 352	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
90	晶合集成		TM2019045 355	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
91	晶合集成		TM2019045 357	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚

## 五、域名

序号	注册所有人	ICP备案号	域名	有效期限
1	晶合集成	皖ICP备17001750号-1	www.nexchip.com.cn	2015/09/16-2023/09/16